

In Bewegung ▶▶



Never stop thinking.

Infineon-Kennzahlen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre¹

	2002		2003		2003:2002 Veränderung in %	2003 ² Mio. Dollar
	Mio. Euro	in % vom Umsatz	Mio. Euro	in % vom Umsatz		
Umsatzerlöse	4.890		6.152		26 %	7.167
nach Regionen						
Deutschland	1.266	26 %	1.535	25 %	21 %	1.788
Übriges Europa	943	19 %	1.112	18 %	18 %	1.295
Nordamerika	1.158	24 %	1.393	23 %	20 %	1.623
Asien-Pazifik	1.446	29 %	2.077	34 %	44 %	2.420
Andere	77	2 %	35	1 %	-55 %	41
nach Geschäftsbereichen						
Drahtgebundene Kommunikation	386	8 %	459	7 %	19 %	535
Sichere Mobile Lösungen ³	1.278	26 %	1.645	27 %	29 %	1.916
Automobil- und Industrieelektronik	1.201	25 %	1.392	23 %	16 %	1.622
Speicherprodukte	1.861	38 %	2.485	40 %	34 %	2.895
Sonstige Geschäftsbereiche	117	2 %	139	2 %	19 %	162
Konzernfunktionen	47	1 %	32	1 %	-32 %	37
Bruttoergebnis vom Umsatz	601	12 %	1.538	25 %	156 %	1.792
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.060		1.089		3 %	1.269
Betriebsergebnis	-1.072		-344		68 %	-401
Konzernjahresfehlbetrag	-1.021		-435		57 %	-507
EBIT/EBIT-Marge	-1.135	-23 %	-299	-5 %	74 %	-348
Konzernjahresfehlbetrag pro Aktie – unverwässert und verwässert	€ -1,47		€ -0,60		59 %	\$ -0,70
Dividende pro Aktie in Euro	-		-		-	-
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	226		731		223 %	852
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.244		-1.522		22 %	-1.773
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.448		566		-61 %	659
Free Cash Flow ⁴	-360		-53		85 %	-62
Planmäßige Abschreibungen	1.370		1.437		5 %	1.674
Außerplanmäßige Abschreibungen	51		98		92 %	114
Auszahlung für Sachanlagen	643		872		36 %	1.016
Brutto-Cash-Position ⁵	2.007		2.820		41 %	3.285
Netto-Cash-Position (zum 30. September) ⁶	177		328		85 %	382
Sachanlagen	4.491		3.817		-15 %	4.447
Bilanzsumme	10.918		10.805		-1 %	12.588
Summe Eigenkapital	6.158		5.666		-8 %	6.601
Eigenkapitalquote	56 %		52 %		-7 %	52 %
Eigenkapitalrendite ⁷	-16 %		-7 %		53 %	-7 %
Gesamtkapitalrendite ⁷	-9 %		-4 %		57 %	-4 %
Anlagendeckung ⁸	137 %		148 %		8 %	148 %
Verschuldungsgrad ⁹	30 %		44 %		48 %	44 %
Gesamtverschuldungsgrad	17 %		23 %		38 %	23 %
Mitarbeiter zum 30. September	30.423		32.308		6 %	32.308

1 Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

2 Zum 1. November 2002 entschied Infineon, die Geschäftsbereiche Mobile Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs in einem neuen Geschäftsfeld Sichere Mobile Lösungen zusammenzuliegen.

3 Free Cash Flow = Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit minus Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.

4 Brutto-Cash-Position = Zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens und als Sicherheitsleistung hinterlegte Zahlungsmittel.

5 Netto-Cash-Position = Brutto-Cash-Position verringert um kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

6 Eigenkapitalrendite = Jahresfehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital.

7 Gesamtkapitalrendite = Jahresfehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.

8 Anlagendeckung = Eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.

9 Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

10 Die Umrechnung von US-Dollar in Euro erfolgte mit dem Wechselskurs € 1 = \$ 1,165, dem Mittagkurs vom 30. September 2003.

Anwendungen	Charakter des Geschäfts	Marktposition
Infineon-Konzern Infineon Technologies ist der ausgegliederte Halbleiterbereich der Muttergesellschaft Siemens und wurde im April Symbol „IFX“ notiert. Infineon entwickelt, fertigt und vermarktet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- Das Produktportfolio umfasst Digital-, Mixed-Signal- und Analog-ICs, diskrete Halbleiterprodukte sowie Systemlo Tokio. Mit weltweit rund 32.300 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2003 einen Umsatz von 6,15 Milliar		
Drahtgebundene Kommunikation (Wireline Communications, COM)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Traditionelle Sprachkommunikation ■ Breitband-Datenkommunikation ■ Lokale Rechner- und Speichernetzwerke ■ Glasfaserbasierte Metro- und Weitverkehrsnetze 	<p>Als Zulieferer der Telekommunikationsindustrie hängen die Infineon-Umsätze in erster Linie von den Investitionen der Telefongesellschaften in deren Infrastruktur ab. Hohe Ausgaben in glasfaserbasierte Weitverkehrsnetze wie noch vor einigen Jahren sind momentan nicht zu erkennen. Investitionen werden nun vor allem in kupferbasierte Breitbandanschlüsse in Vermittlungsstellen und bei Endkunden getätigt. Neben den Telefongesellschaften tragen Firmen mit ihren Investitionen in private Vermittlungsstellen, LANs, Speichernetzwerke sowie die Automobilindustrie mit der Einführung der glasfaserbasierten Breitbandleitungen zunehmend zum Umsatz bei.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. 1 in ISDN ■ Nr. 2 in traditio Telekommunikation (SLICs, CODECs, ■ Nr. 1 bei VDSL- ■ Nr. 3 bei optic
Sichere Mobile Lösungen (Secure Mobile Solutions, SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Funktechnologie über kurze, mittlere und große Entfernungen ■ Schnurlose Telefone ■ Infrastruktur für Mobilfunk ■ Vielfältige Anwendungen für chipbasierte Karten in den Bereichen Kommunikation (SIM-Karten, Telefonkarten), Zahlungsverkehr (Kredit- und Debitkarten), Identifikation (Ausweise, Versicherungskarten), Unterhaltung (Pay-TV) und Plattform-sicherheit (Rechner, Netzwerke) 	<p>Markenhersteller von Mobiltelefonen verlagern zunehmend die Produktion wie auch die Entwicklung neuer Modelle nach Asien. Diesem Trend folgend bietet Infineon nicht mehr nur einzelne Komponenten seinen etablierten Kunden an, sondern unterstützt immer mehr Auftragsfertiger und asiatische Markenhersteller mit kompletten Plattformen und Systemdesigns von Mobilfunkgeräten. Im Bereich Security ist die SIM-Karte das umsatzstärkste Segment. Chipbasierte Kreditkarten, chipbasierte Identifikationskarten und kontaktlose Anwendungen gewinnen an Bedeutung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. 1 im Markt ■ Führender Anbieter Hochfrequenz- ■ Führender Anbieter Chips und -Lösungen
Automobil- und Industrieelektronik (Automotive & Industrial, AI)	<p>Automobilelektronik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Antriebsstrang, Motorsteuerung ■ Komfort und Sicherheit ■ Navigation und Unterhaltung <p>Industrie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Antriebssteuerung ■ Automatisierungssysteme ■ Energieversorgung, Energiewandlung ■ Netzteile, Stromversorgung 	<p>Im Gegensatz zu den anderen drei Geschäftsbereichen zeichnet sich der Automobilbereich durch lange Produktlebenszyklen und höchste Qualitätsanforderungen aus. Charakteristisch sind ferner die langfristigen Kundenbeziehungen und die hohe Planungssicherheit. Das Umsatzwachstum wird weniger aus dem Pkw-Wachstum als viel mehr aus der zunehmenden Elektronikausstattung des Autos erzielt. Im Industriebereich treiben die Bemühungen nach geringerer Verlustleistung und höherer Schaltgeschwindigkeit den Halbleiteranteil in Spannungsversorgungen sowie Beleuchtungs- und Motorsteuerung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Marktführer in Automobilbereich ■ Nr. 2 bei industri Traktion ■ Führend bei Str ■ Positionierung Wachstumsmär überwachungs Infotainment
Speicherprodukte (Memory Products, MP)	<ul style="list-style-type: none"> ■ PCs und Notebooks ■ Speichermodule für PC-Aufrüstung ■ Workstations ■ Infrastruktur (Server und Netzwerke) ■ PDAs und Smartphones ■ Peripheriegeräte ■ Multimedia-Speicherkarten 	<p>Der größte Teil des Infineon-Umsatzes wird mit Standardspeichern (DRAMs) erzielt. Diese Speicher sind industrieweit genormt und unterliegen damit einem harten Wettbewerb. Der PC-Markt absorbiert mit 60 bis 70 Prozent den größten Anteil der weltweiten DRAM-Produktion. Den Rest teilen sich die weniger preissensitiven Märkte der Workstations, Server und Großrechner sowie Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und PC-Peripherie. Die enorm steigende Nachfrage nach Speicherbausteinen erklärt sich zum einen aus dem Wachstum des PC-Marktes und zum anderen aus der zunehmenden Speicherausstattung pro Rechner.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nr. 3 im Markt ■ Schnellstwach Hersteller ■ Technologiefüh meter-Produkt ■ Spitzenstellung DRAM-Produkt fähigkeit wie DDR400 ■ Bevorzugter PC-Hersteller

einen Blick

1999 mit Hauptsitz in München als Aktiengesellschaft gegründet. Infineon ist seit dem 13. März 2000 an den Börsen von Frankfurt und New York (NYSE) unter dem und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen und drahtlosen Kommunikation, für Chipkarten sowie für Speicherbauelemente. sungen. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus den Euro im Vergleich zu 4,89 Milliarden Euro in 2002.

	Produkte	Schlüsselkunden (alphabetisch)	Wettbewerber (alphabetisch)
nellen tionsanwendungen T/E) Breitbandanschlüssen hen Modulen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnittstellenbausteine für Sprach- und Datenkommunikation in Vermittlungsstellen und Endgeräten ■ Systemlösungen für drahtgebundene Breitbandtechnologie (ADSL, VDSL, SHDSL, 10BaseS) ■ Transceiver-Module gängiger Glasfaserstandards (Fibre Channel, SONET/SDH, Gigabit-Ethernet) ■ Kanten- und oberflächenemittierende Laserdioden (FB, DFB, VCSEL) ■ ICs für optische Netzwerke 	<ul style="list-style-type: none"> ■ AFC ■ Alcatel ■ Cisco ■ Ericsson ■ Fujitsu ■ Huawei ■ Lucent ■ Marconi ■ NEC ■ Nokia ■ Nortel ■ Samsung ■ Siemens ■ Tyco 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agere ■ Agilent ■ Broadcom ■ Conexant ■ Finisar ■ GlobespanVirata ■ JDS Uniphase ■ PMC Sierra ■ STMicroelectronics ■ Texas Instruments
für Chipkarten-ICs ter von Transceivern ter von Bluetooth- ungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Basisband- und Hochfrequenz-Technologie der gängigen drahtlosen Kommunikationsstandards (GSM, GPRS, E-GPRS, W-CDMA, DECT, WDC, Bluetooth) ■ Plattformdesign, Module, Software-Unterstützung und Systemlösungen für diverse Mobilfunkstandards und Bluetooth ■ Leistungshalbleiter für Hochfrequenzanwendungen ■ Diskrete Bauelemente (Dioden, Transistoren, BAW-Filter, MMIC, LNA) ■ Sicherheitskontrollier (8-bit, 16-bit, 32-bit) ■ Sicherheitsspeicher ■ Kontaktlose Chipkartenanwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DBTEL ■ Ericsson ■ Gemplus ■ Giesecke & Devrient ■ Nokia ■ Panasonic ■ Schlumberger ■ Siemens ■ Sony 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hitachi ■ Motorola ■ Philips ■ Skyworks ■ STMicroelectronics ■ Texas Instruments
Europa im ch (Nr. 2 weltweit) riellen Antrieben und omversorgung im PC in den neuen kten Reifendruck- systeme, x-by-wire und	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mikrokontrollier (8-bit, 16-bit, 32-bit) ■ Digitale Signalprozessoren ■ Sensoren (Druck, Temperatur, Magnetfeld, Beschleunigung) ■ Diskrete Leistungshalbleiter (Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, bipolare Transistoren, Power MOSFETs, IGBTs) ■ Integrierte Leistungshalbleiter ■ Hochspannungs- und Starkstrommodule 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Autooliv ■ Awmet ■ Bosch ■ Continental ■ Delphi ■ Delta ■ Denso ■ Hella ■ Johnson Controls ■ Lear ■ SAC ■ Siemens ■ TRW ■ Visteon 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fairchild ■ International Rectifier ■ Motorola ■ National Semiconductor ■ ON Semiconductor ■ Renesas ■ STMicroelectronics
für Standard-DRAMs ender Top-10-DRAM- rer in der 300-Milli- on bei hochkomplexen en höchster Leistungs- 512 Mbit, 1 Gbit, Partner führender	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardspeicher von 64 Mbit bis 1 Gbit ■ Unterstützung sämtlicher gängiger Standards: SDRAM, DDR, DDR II ■ Spezialspeicher für 3D-Grafikkarten (SGRAM) ■ Spezialspeicher für batteriebetriebene Geräte (Mobile-RAM, CellularRAM) ■ Spezialspeicher für Netzwerkinfrastruktur (RLDRAM) ■ Nichtflüchtiger Speicher (NAND-Flash) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acer ■ Cisco ■ Dell ■ HP/Compaq ■ IBM ■ Kingston ■ Legend ■ Sony ■ Sun Microsystems 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hynix ■ Micron ■ Samsung

Im Rahmen der Agenda **5-to-1** ist für Infineon der Fokus in den **5** Jahren von 2002 bis 2007,

zu den Top **4** Halbleiterherstellern weltweit zu gehören,

in jedem Segment mindestens eine Top **3** Position zu erreichen,

uns im Vergleich zum Wettbewerb finanziell in allen Geschäftsbereichen unter den Top **2** zu positionieren

und das Nummer **1** Halbleiterunternehmen im Lösungsgeschäft zu werden.

Inhaltsverzeichnis

INFORMATIONEN FÜR AKTIONÄRE

- 4 Brief an die Aktionäre
- 8 Vorstand, Vision und Mission
- 10 Unternehmensstrategie
- 14 Die Infineon-Aktie
- 18 Das Geschäftsjahr 2003 im Überblick

UNSER GESCHÄFTSKONZEPT

- 24 Kunde im Fokus
- 26 Globale Präsenz
- 29 Innovationen
- 34 Fertigung und Logistik

UNSER GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

- 38 Personelles Engagement
- 41 Ökologisches Engagement

FINANZBERICHT

- 46 Inhaltsverzeichnis
- 48 Bericht des Aufsichtsrats
- 51 Corporate Governance
- 55 Konzernlagebericht
- 88 Konzernabschluss
- 94 Anhang zum Konzernabschluss

WEITERE INFORMATIONEN

- 144 Mehrjahresübersicht 1999–2003
- 146 Finanz- und Technologieglossar
- 150 Stichwortverzeichnis
- 152 Finanzkalender

Zukunftsorientierte Aussagen

Der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte Aussagen. Diese sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der Infineon Technologies AG. Diese beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

In Bewegung ▶▶

Für Infineon war die Halbleiterkrise kein Stillstand. Wir haben unser Unternehmen verändert und bewegen uns stetig nach vorn.

Mit klaren Zielen. Und ersten Erfolgen.



Informationen flexibler austauschen

Basisband-ICs und RF-Transceiver schaffen die Basis für die heute selbstverständliche Kommunikation über Mobil- und Schnurlos-Telefone.

Bluetooth-basierte Module verbinden jedes Handy kabellos mit dem Kommunikationssystem im Auto (→ Bluetooth Communication Gateway).

Innovative Glasfaser-Technologien ermöglichen Multimedia-Anwendungen in Kraftfahrzeugen (→ Plastic Optical Fiber).

Dr. Thuyen Le, bei Infineon als Konzeptingenieur maßgeblich beteiligt an der Entwicklung von Basisband-ICs für UMTS – dem Mobilfunkstandard der 3. Generation. Nur ein Beispiel dafür, wie Infineon am flexibleren Austausch von Informationen arbeitet.

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren,



Dr. Ulrich Schumacher, CEO und
Vorsitzender des Vorstands

zwei Jahre lang waren die guten Nachrichten aus der Halbleiterindustrie so selten, wie Sie und wir uns das von den schlechten Nachrichten gewünscht hätten. Im Geschäftsjahr 2003 überwiegen erstmals wieder die guten Nachrichten: Nach zwei mageren Jahren ist die Nachfrage gestiegen und die Chippreise haben sich leicht erholt. Der Umsatz der Halbleiterindustrie soll sich im Kalenderjahr 2003 weltweit um rund 14 Prozent auf 161 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Im Infineon-Abschluss, den wir Ihnen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren, überwiegen ebenfalls die guten Nachrichten. Unser Umsatz ist mit 6,15 Milliarden Euro um 26 Prozent höher als im Vorjahr. Ich halte dies für bemerkenswert, weil Infineon im ersten Kalenderhalbjahr 2003 mit knapp 30 Prozent das stärkste Umsatzwachstum unter den zehn größten Halbleiterunternehmen der Welt zu verzeichnen hatte. Unsere Wettbewerber haben natürlich auch zugelegt, aber eben nicht so stark wie wir. Auf dem Weg, unser Ergebnis zu verbessern, sind wir ein großes Stück vorangekommen.

Leider haben wir es nicht geschafft, alle Verluste zu beseitigen. Der EBIT-Verlust beträgt 299 Millionen Euro und ist damit um 836 Millionen geringer als im Vorjahr. Der Konzernfehlbetrag hat sich mit 435 Millionen Euro mehr als halbiert. Damit hat sich der Verlust je Aktie von 1,47 Euro auf 0,60 Euro verringert.

Trotz dieses abermaligen Jahresverlusts gibt es gute Nachrichten. Nach neun Verlustquartalen in Folge haben wir im vierten Quartal des letzten Geschäftsjahrs die Verlustzone verlassen und wieder schwarze Zahlen geschrieben. Meine Kollegen und ich sind zuversichtlich, dass wir im neuen Geschäftsjahr 2004 in der Gewinnzone bleiben und wieder Geld verdienen werden.

Außerdem hat sich die Finanzsituation von Infineon weiter verbessert. Der freie Cash Flow ist seit dem Juni-Quartal wieder positiv, und die Brutto-Cash-Position konnte von zwei Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden Euro erhöht werden. Diesen liquiden Finanzmitteln stehen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro gegenüber. Infineon verfügt damit über ausreichend Spielraum, um das innere und äußere Wachstum zu finanzieren.

Und noch etwas hat sich positiv entwickelt. Der Aktienkurs von Infineon ist im Geschäftsjahr 2003 um 100 Prozent gestiegen. Damit hat sich die Börsenkaptalisierung binnen Jahresfrist wieder verdoppelt und lag am 30. September 2003 bei 8,1 Milliarden Euro. Ich weiß,

dass Sie, unsere Anteilseigner, in den ersten drei Jahren nach dem Börsengang in Bezug auf unseren Aktienkurs einige Enttäuschungen verkraften und viel Geduld aufbringen mussten. Für das Vertrauen, das Sie meinen Kollegen und mir in dieser Zeit entgegengebracht haben, möchten wir uns bedanken.

Abgesehen von diesen Zahlen, haben wir im vergangenen Jahr einige Dinge angepackt, die für die Gegenwart und Zukunft unseres Unternehmens wichtig sind. An erster Stelle steht dabei, dass wir in die wichtigsten Wachstumsmärkte der Halbleiterindustrie investieren und unsere Position dort verstärken. Der eine oder andere von Ihnen hat bestimmt im September in der Presse gelesen, dass wir in Shanghai unser chinesisches Hauptquartier eröffnet haben. Dies war ein wichtiger Meilenstein unserer Asien-Strategie. China ist der am schnellsten wachsende Markt für Chips weltweit. Marktanalysten erwarten, dass sich die Nachfrage nach Halbleitern dort innerhalb der nächsten vier Jahre auf 80 Milliarden US-Dollar verdreifachen wird.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Marktanteil in China in den nächsten fünf Jahren von heute fünf auf dann zehn Prozent auszubauen und damit zu verdoppeln. Sie werden fragen, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Der wichtigste Schritt auf dem Weg dorthin ist sicherlich, dass wir für viele Produkte die gesamte Wertschöpfungskette in China anbieten können. Vom Design über die Entwicklung, Produktion und Montage bis hin zur Software-Entwicklung. In den nächsten fünf Jahren werden wir rund 1,2 Milliarden Euro in China investieren. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich von heute 800 auf 3.000 erhöhen.

In den vergangenen Monaten sind wir außerdem eine Reihe von Partnerschaften und Fertigungskooperationen nicht nur im Speicherchip-Bereich eingegangen, die uns neues Geschäft bringen. So haben wir, um Ihnen nur ein konkretes Beispiel zu nennen, mit unserem chinesischen Partner Huawei eine Kooperation geschlossen, um gemeinsam für die dritte Mobilfunkgeneration Geräteplattformen zu entwickeln. Ich bin aber noch aus einem anderen Grund von unserem Erfolg auf dem chinesischen Markt überzeugt. Von Anfang an, und das ist immerhin acht Jahre her, arbeiten wir mit unseren chinesischen Geschäftspartnern und Kunden vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.

Auf dem zweiten wichtigen Wachstumsmarkt, in den USA, konnten wir unsere Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent steigern. Um künftig noch näher bei unseren Kunden

zu sein, haben wir unsere Vertriebsorganisation ausgebaut. Neben unserer Nordamerika-Zentrale im kalifornischen Silicon Valley sind wir jetzt auch an der Ostküste vertreten, im sogenannten Research Triangle Center um Cary/North Carolina. Unsere Vertriebsmitarbeiter betreuen von dort aus alle unsere Kunden an der Ostküste Amerikas. Darüber hinaus haben wir in New York ein Büro eröffnet, um am wichtigsten Kapitalmarkt der Welt besser vertreten zu sein. Zusätzlich haben wir die Partnerschaft mit IBM verstärkt, um gemeinsam Logik-Technologien der Zukunft zu entwickeln.

Beim Erwerb von Unternehmen haben wir uns danach umgesehen, was unsere eigenen Geschäftsbereiche und Produkte ergänzt oder erweitert und wo wir Wachstumschancen auf dem Markt sehen. Die Übernahme des norwegischen Unternehmens SensoNor, des führenden Anbieters von Reifendruck- und Beschleunigungssensoren, erfüllt genau diesen Anspruch. Der Markt für Halbleitersensoren in der Automobilindustrie wächst jährlich um bis zu 20 Prozent. Wegen der Gesetzgebung in den USA zu Reifendrucksensoren erwarten Marktforscher eine sehr schnelle Verbreitung dieser Sicherheitstechnik bei den derzeit jährlich zirka 17 Millionen Neufahrzeugen. Die Übernahme des Marktführers für Reifendrucksensoren bringt Infineon in eine Spitzenposition, um diesen schnell wachsenden Markt zu bedienen.

Meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr habe ich Sie an dieser Stelle darüber informiert, dass wir mit unserem Kostensenkungsprogramm Impact über 2,8 Milliarden Euro eingespart haben. Wir haben in diesem Jahr alle Geschäftsprozesse erneut auf den Prüfstand gestellt, um weitere Kosten zu sparen. Dadurch wollen wir im nächsten Jahr unsere Kosten nochmals um über 500 Millionen Euro verringern.

Nicht aus den Augen verloren haben wir unsere führende Position bei der Fertigung von Speicherchips mit der 300-Millimeter-Technologie, die wir weiter ausbauen. Mittlerweile fertigen wir etwa 35 Prozent unserer Speicherchips auf Siliziumscheiben mit 300-Millimeter-Durchmesser im Vergleich zu nur etwa zwölf Prozent im Durchschnitt der DRAM-Industrie. Dieser Vorsprung verringert unsere Kosten, da die Fertigung auf 300-Millimeter-Scheiben mittlerweile einen Produktivitätsvorteil von mehr als 30 Prozent gegenüber der Fertigung mit der 200-Millimeter-Technologie erreicht hat. Damit haben wir uns für die nächsten zwei bis drei Jahre einen Kosten- und Technologievorsprung gegenüber den meisten Wettbewerbern gesichert.

Sie sehen, dass wir die Dinge, die wir 2001 kraftvoll und manchmal schmerzhaft begonnen haben, im vergangenen Jahr fortgeführt haben und 2004 weiter fortführen werden. Die Richtschnur für unser Handeln bleibt dabei die von uns so bezeichnete Agenda 5-to-1, die ich Ihnen vor einem Jahr in Grundzügen erläutert habe. An deren Ende steht: Infineon soll im Jahr 2007 unter die Top 4 der weltweit größten Halbleiterunternehmen vorrücken und den Marktanteil von drei Prozent in 2002 auf dann sechs Prozent verdoppeln. Diese Ziele sind ehrgeizig, aber wir meinen, realistisch. Bitte schenken Sie uns auf diesem Weg weiter Ihr Vertrauen.

Wir sind überzeugt, dass wir diesen Zielen im nächsten Jahr ein Stück näher kommen. Aus unserer Sicht wird die Halbleiterindustrie auch 2004 wachsen. Wir rechnen damit, dass das Marktvolumen weltweit um etwa 18 Prozent zunehmen wird. Die stärksten Wachstumsimpulse erwarten wir dabei aus der Telekommunikationsindustrie. Geografisch betrachtet erwarten wir, dass der Umsatzanteil der Region Asien-Pazifik weiter zulegt und etwa 40 Prozent erreichen wird. Was allerdings bleibt, ist der harte Preiskampf.

Angesichts dieser alles in allem guten Nachrichten verfallen wir keineswegs in Euphorie. Die hinter uns liegende Krise hat gezeigt, dass nichts dauerhafter ist als der Wandel. An der Fähigkeit, diesen Wandel mitzugestalten, werden wir in Zukunft gemessen.

Ihr



Dr. Ulrich Schumacher
CEO und Vorsitzender des Vorstands

Unsere Vision

Wir schaffen Halbleiterlösungen, die den Technology Lifestyle des Menschen im 21. Jahrhundert ermöglichen.

Die Vision und Mission von Infineon Technologies zeigen unseren Mitarbeitern, Kunden und nicht zuletzt den Investoren, was unser Unternehmen von anderen unterscheidet. Sie wurden im Sommer 2002 formuliert und bestimmen seither unser Denken und Handeln.

Profitable elektronische Systemlösungen für den Technology Lifestyle

Infineon Technologies bietet einen maßgeschneiderten Mix von Produkten und Dienstleistungen, basierend auf den Wünschen unserer Kunden und Verbraucher. Dafür verknüpfen wir unsere Kernkompetenzen weltweit mit dem Know-how von Partnerfirmen. Mit der optimalen Kombination der notwendigen Ressourcen bauen wir unser Lösungsgeschäft profitabel aus, stärken nachhaltig die Performance unserer Kunden und damit auch den Shareholder Value von Infineon.

Unsere Mission

Wir generieren und optimieren Mehrwert für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter.

■ Wir entwerfen, produzieren und verkaufen die modernsten Halbleiterlösungen und -dienstleistungen, indem wir die Branchenführerschaft bei Innovation und Kundenorientierung erreichen.

■ Wir bauen auf unsere Kernkompetenzen und Innovationskraft. Wir wollen unseren Kunden branchenweit das umfassendste Portfolio an Kommunikationsprodukten und Automobillösungen anbieten, einschließlich Breitband- und Zugangstechnologie, sicherer Lösungen für Mobilfunk und Speicherprodukte.

■ Wir schaffen zukünftigen Mehrwert, indem wir die traditionellen Grenzen der Industrie überwinden. Wir bieten Integrationsmöglichkeiten für Halbleiter, Biowissenschaften, Dienstleistungen und Miniaturisierung.

■ Weltweit gewinnen wir die größten Talente und binden diese an uns, indem wir ihnen ein spannendes und kreatives Arbeitsumfeld, eine einmalige Unternehmenskultur und Honorierung der weltweiten Spitzenklasse bieten.

Die Mitglieder des Vorstands der Infineon Technologies AG



Peter J. Fischl
Jahrgang 1946
Chief Financial Officer (CFO)
und Arbeitsdirektor

Dr.-Ing. Andreas von Zitzewitz
Jahrgang 1960
Chief Operating Officer (COO)

Dr.-Ing. Ulrich Schumacher
Jahrgang 1958
Chief Executive Officer (CEO)
und Vorsitzender des Vorstands

Peter Bauer
Jahrgang 1960
Chief Sales & Marketing
Officer (CMO)

Unternehmensstrategie

**In Bewegung:
Wer im Halbleitermarkt
erfolgreich sein will, muss
schnell auf den ständigen
Wandel reagieren können.**

Es gibt kaum einen Markt, der so schnell gewachsen und so faszinierend ist wie der Halbleitermarkt. Es gibt aber auch kaum einen Markt, der sich so schnell verändert und so großen Schwankungen unterliegt. Dies haben wir in den vergangenen zwei Jahren schmerzlich erleben müssen. Wer auf diesem Markt erfolgreich sein will, muss beweglich und schnell auf diesen Wandel reagieren können. Infineon ist ein entwicklungsstarkes und innovatives Unternehmen. Innovation heißt für uns: Wir sind immer auf der Suche nach dem besseren Produkt, der besseren Lösung und dem besseren System. Innovation heißt für Infineon aber auch: den praktischen Nutzen für den Kunden zu erhöhen und gleichzeitig Kosten und Zeit zu sparen.

Halbleitermarkt: Innovation und Wachstum sind die Basis für eine erfolgreiche Zukunft

Der Einsatz von Mikrochips wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Das ist auf der einen Seite positiv, weil der Markt für Halbleiter kontinuierlich wächst. Auf der anderen Seite erhöht dies jedoch auch das Innovationstempo sowie die Forschungs- und Entwicklungskosten. Darüber hinaus sind wir ständig auf der Suche nach besseren und kostengünstigeren Produktionsverfahren. Diese Rahmenbedingungen aus Innovation, steigender Produktivität, Kosten- und Preisdruck haben die erfolgreiche Entwicklung des Halbleitermarkts in den vergangenen 40 Jahren stark geprägt.

Jahrzehntelang haben die Halbleiterunternehmen immer leistungsfähigere Chips auf den Markt gebracht, die neue Anwendungen wie DVD oder intelligente Handys überhaupt erst möglich gemacht haben. Es galt: „Technology sells“. Heute entscheiden nicht

mehr allein Innovationen und technische Parameter über die Akzeptanz und den wirtschaftlichen Erfolg eines neuen Produkts. Unternehmen wie Infineon müssen sich Gedanken darüber machen, welche Bedeutung die Kunden dem Produkt beimessen, welche Moden und Trends kommen und wieder gehen, mit welchen kulturellen Werten und Botschaften die Produkte versehen werden.

Für das Innovationsmanagement von Infineon ergeben sich daraus wesentliche Veränderungen: Wir müssen nicht nur den technischen Fortschritt wie etwa das Vordringen der Chipstrukturen in den Nanometerbereich meistern, sondern auch gleichzeitig neue Faktoren im Innovationsprozess berücksichtigen. Wir müssen unsere Kunden von Anfang an in die Produktplanungs- und Konzeptionsphase einbeziehen und uns von einem Komponenten- oder Bauelementelieferanten zu einem Lösungsanbieter entwickeln, der von der Planung über die Bauteile und die Software bis zum Service alles aus einer Hand anbietet.

Dieser radikale Wandel wird nicht ohne Folgen für die Halbleiterunternehmen bleiben. Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl der Halbleiterunternehmen verkleinern wird und sich am Ende nur die Unternehmen am Markt halten können, die über die notwendige Finanz- und Innovationskraft verfügen. Damit Infineon aus diesem schmerzhaften Konsolidierungsprozess als Sieger hervorgeht, haben wir im vergangenen Jahr nach intensiver Analyse des Halbleitermarkts und der Kundenbedürfnisse die Agenda 5-to-1 formuliert und sie zur Richtschnur unseres Handelns gemacht. Unsere Arbeit konzentriert sich auf fünf Schwerpunkte:

- Wir bauen das Lösungsgeschäft aus.
- Wir verbessern unsere Effizienz und Kostenstruktur.
- Wir erhöhen die Flexibilität durch unser Partnerschaftsnetzwerk.
- Wir dezentralisieren und konzentrieren uns auf Wachstumsregionen.
- Wir stärken unsere Innovationskraft.

Mit diesen fünf Maßnahmen wollen wir die in der Agenda 5-to-1 formulierten Ziele erreichen. An erster Stelle steht dabei, dass wir bis 2007 zu den vier größten Halbleiterunternehmen der Welt gehören. Laut dem Marktforschungsinstitut iSuppli waren wir im ersten Kalenderhalbjahr 2003 auf Rang sechs. Im selben Zeitraum 2003 hat unser Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 30 Prozent zugelegt, laut iSuppli so stark wie bei keinem anderen der weltweit zehn größten Halbleiterunternehmen. Zusätzlich wollen wir unseren weltweiten Umsatzanteil von drei Prozent in 2002 auf sechs Prozent verdoppeln. Diesem Ziel ist Infineon im abgelaufenen Geschäftsjahr schon ein Stück näher gekommen. Bezogen auf unsere Geschäftssegmente wollen wir bis 2007 mindestens eine Top-3-Position im Markt erreichen und in allen Geschäftsbereichen bei der Ertragskraft unter den zwei führenden Unternehmen sein. Im Lösungsgeschäft wollen wir weltweit die Nummer eins werden.

Ausbau des Lösungsgeschäfts

Einen wesentlichen Teil unserer Unternehmensstrategie bildet der Ausbau des Lösungsgeschäfts. Wir erzielen damit zu-

sätzlichen Umsatz, sind weniger abhängig vom Preisdruck traditioneller Standardhalbleiterprodukte und etablieren langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden. Durch ein um Software und Services erweitertes Angebot unterliegen wir nicht mehr so stark den Schwankungen des Halbleitermarkts.

Was aber heißt genau Lösungsgeschäft und wo liegt der Unterschied zu Produkten und Systemen? Schon heute integrieren wir unsere Chips zu kompletten Subsystemen oder Modulen, die zum Beispiel aus verschiedenen Infineon-Chips, passender Software und zum Teil aus Komponenten von Drittunternehmen bestehen. Eine erfolgreiche Systemlösung ist unsere Mobiltelefonplattform, die den gesamten elektronischen Kern eines Handys umfasst – wie Speicher- und Logikchips sowie die dazu passende Software. Für unsere Kunden entstehen dadurch drei wesentliche Vorteile. Durch die verkürzte Systementwicklungszeit bringen die Kunden ihre Produkte schneller auf den Markt. Darüber hinaus fallen für die Kunden auf Grund des Skalenfaktors geringere Kosten an, da wir unsere Lösungen in höheren Stückzahlen vermarkten können. Zuletzt sind die Kunden in der Lage, ihre eigenen Entwickler in der Wertschöpfungskette noch näher am Endkunden einzusetzen (vgl. S. 24 „Kunde im Fokus“).

Mit dem Lösungsansatz gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Wir wollen unseren Kunden zusätzlich Dienstleistungen anbieten, die ihre Geschäftsprozesse messbar verbessern. Dazu gehören unter anderem Beratung, Design- und Diagnoseleistungen, Logistik und auch das Management ausgewählter Projekte. Der Ausbau des Lösungsgeschäfts

Produkt – System – Lösung:
Dieses Gesamtkonzept garantiert dem Kunden weit reichende Vorteile.

bedeutet deshalb nicht, dass wir uns nun weniger auf Produkte, deren Höherintegration oder unser Applikationswissen konzentrieren. Im Gegenteil: Exzellente Produkte und gutes System-Know-how bilden die Grundlage für attraktive Kundenlösungen und werden auch weiterhin über den Erfolg von Infineon mitentscheiden.

Effizienzsteigerung durch Impact²

Flexibilität und Effizienz sind entscheidende Voraussetzungen, um im harten Wettbewerb und bei den sich schnell wandelnden Kundenbedürfnissen bestehen zu können. Deshalb müssen Wandel und Verbesserung ein kontinuierlicher Prozess sein. Mit dem Programm Impact² haben wir unseren Anstrengungen, das Unternehmen schneller und effizienter zu machen, eine feste Form gegeben. So identifizieren wir im gesamten Unternehmen Arbeitsleistungen, die externe Dienstleister kostengünstiger erbringen können. Durch die Ausgliederung unserer SAP-Betreuung an Accenture rechnen wir mit einer Kostenersparnis in Höhe von 43 Millionen Euro in den kommenden sieben Jahren. Wenn wir Aufgaben in der gleichen Qualität, aber zu geringeren Kosten erledigen können, ist auch der Weg ins Ausland kein Tabu. Wesentliche Buchhaltungsaktivitäten der großen europäischen Gesellschaften werden inzwischen deutlich kostengünstiger zentral in Portugal erledigt. Zusätzlich versuchen wir, unsere Synergien besser auszunutzen. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenlegung unserer Frontend-Werke in München, Regensburg und Villach zu einem Fertigungsverbund. Durch diese Maßnahmen haben wir unsere Prozesse und Strukturen bei gleichzeitiger Kosteneinsparung flexibler und marktgerechter gestaltet.

Ausbau des Partnerschaftsnetzwerks

Partnerschaften spielen eine zentrale Rolle in unserer Geschäftsstrategie. Mit Hilfe von Kooperationen können wir unsere Entwicklungskosten und Investitionsrisiken teilen sowie die Produktion schneller den Nachfrageschwankungen anpassen. Dies ist die beste Antwort auf das ständige Auf und Ab unseres Marktes und den steigenden Investitionsbedarf. Neben unseren Kooperationen im Bereich Forschung & Entwicklung (vgl. S. 29 „Innovationen“) haben wir auch in der Fertigung ein weit reichendes Netzwerk aufgebaut.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir strategisch wichtige Kooperationen schließen, unter anderem mit IBM, China-Singapore Suzhou Industrial Park Venture Co., Nanya und SMIC. Unsere eigenen Produktionskapazitäten bauen wir nicht mehr so stark aus wie bisher und konzentrieren unsere Investitionen mehr auf die Entwicklung unserer Technologie, um weiterhin Standards in der Branche zu setzen. Schon heute lizenzieren wir unsere Produktionstechnologie an Partner, wie zum Beispiel die chinesische SMIC, und sichern uns im Gegenzug Abnahmerechte für deren Produktionskapazitäten (vgl. S. 34 „Fertigung und Logistik“).

Ausrichtung auf Wachstumsmärkte

Damit Infineon langfristig zur Spitze der Halbleiterindustrie gehört, muss die Marktposition vor allem in den Ländern ausgebaut werden, die nachweislich ein hohes Wachstumspotenzial bieten. Dazu gehören China, Nordamerika und auch Japan. In allen drei Regionen haben wir unsere Präsenz im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich verstärkt. Unter anderem hat Infineon eine neue

China-Zentrale in Shanghai eröffnet. Um am bedeutendsten Finanzplatz der Welt vertreten zu sein, haben wir zusätzlich ein neues Büro in New York eröffnet. Unser Vorrücken von Platz sieben auf Platz fünf der größten Halbleiterhersteller auf dem amerikanischen Markt im abgelaufenen Geschäftsjahr bestärkt uns in unserem Vorhaben, auf den wichtigsten Wachstumsmärkten angemessen positioniert zu sein (vgl. S. 26 „Globale Präsenz“).

Die Nähe zu unseren Kunden ist dabei der Schlüssel für zukünftige Geschäfte. Ohne die genaue Kenntnis der Bedürfnisse und Wünsche der Endverbraucher können wir keine erfolgreichen Produkte entwickeln. Da diese Bedürfnisse und Wünsche in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sein können, ist die Präsenz auf den jeweiligen Märkten so wichtig. In den nächsten Jahren werden wir deshalb die Verantwortung für die Geschäfte stärker in die Regionen verlagern und damit das Unternehmen Infineon dezentralisieren. So erweitern wir zum Beispiel unsere Produktions- und Forschungskapazitäten in China, um durch lokale Präsenz unsere Absatzchancen zu verbessern. Unser Ziel ist es, die Vorteile eines jeden Landes und die Begabungen all unserer Mitarbeiter optimal zu nutzen: die Stärken deutscher Ingenieurkunst in der Chiparchitektur, die Software-Expertise indischer Fachkräfte oder den Vorsprung der US-Amerikaner in der Dienstleistungskultur. Am Ende dieses Prozesses wird Infineon kein rein deutsches Unternehmen mehr sein, sondern ein in allen Teilen der Welt agierender Konzern, der Entscheidungen dort trifft, wo seine Kunden zu Hause sind.

Stärkung der Innovationskraft

Innovationen bei Produkten und Fertigungstechnologien werden auch in Zukunft über den Erfolg von Infineon entscheiden. Unsere in der Branche anerkannte Position als Kosten- und Technologieführer haben wir maßgeblich den exzellenten Leistungen unserer Forscher und Ingenieure zu verdanken. Selbst in der letzten Krise der Halbleiterindustrie haben wir an unseren hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung festgehalten.

Um die steigenden Anforderungen an Forschung und Entwicklung erfüllen zu können, werden wir in Zukunft unsere Ressourcen noch gezielter einsetzen. Dabei werden wir nur die Projekte weiterverfolgen, die ein hohes Marktpotenzial erkennen lassen. So stehen wir beispielsweise bei der Weiterentwicklung unserer Biochips in engem Kontakt zu möglichen Kunden im Gesundheitssektor, um von vornherein zielgerichtete Anwendungen ins Auge fassen zu können.

Erste Erfolge zu verzeichnen

Wir haben im gesamten Unternehmen Maßnahmen ergriffen, die die beschriebenen Ansätze widerspiegeln. Bei einigen Vorhaben, die wir in Angriff genommen haben, wie etwa dem Aufbau des Lösungsgeschäfts, brauchen wir Geduld, bis wir die Früchte ernten können.

Andere Programme wie Impact² unterstützen die von uns eingeschlagene Strategie und erzielen bereits heute sichtbare Erfolge. Alle strategischen Maßnahmen zusammen werden die Position von Infineon im Vergleich zum Wettbewerb deutlich stärken.

Unsere Technologieführerschaft haben wir maßgeblich den exzellenten Leistungen unserer Forscher und Ingenieure zu verdanken.

Global denken, lokal handeln: Wir verwirklichen die Nähe zum Kunden.

Die Infineon-Aktie

Infineon-Aktie profitiert überdurchschnittlich von der Erholung auf dem Halbleitermarkt

- Infineon-Aktie legt im Berichtsjahr um 100 Prozent zu – DJ STOXX-Halbleiterindex um 54 Prozent
- Marktkapitalisierung von Infineon steigt auf über acht Milliarden Euro
- Handelsvolumen erneut deutlich erhöht

Die Infineon-Aktie verbuchte im Geschäftsjahr 2003 ein Kursplus von 100 Prozent.

Halbleiteraktien zählten im abgelaufenen Geschäftsjahr zu den großen Gewinnern an den Börsen. Der Grund dafür liegt in der deutlichen Erholung des Halbleitermarkts. So prognostiziert das Marktforschungsunternehmen World Semiconductor Trade Statistics für das Jahr 2003 ein Marktwachstum von 14 Prozent, für 2004 sogar ein Wachstum von 19 Prozent (Stand: November 2003).

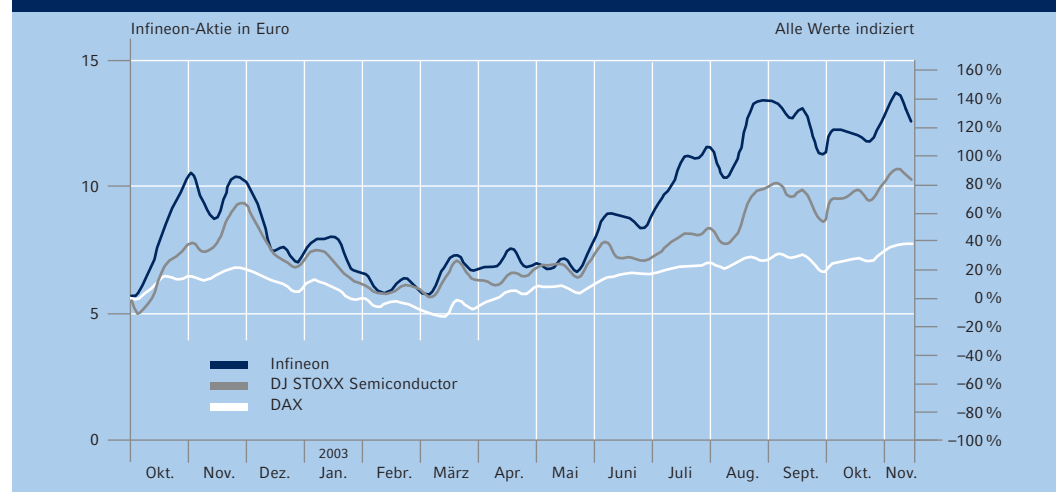
Entsprechend dieser Entwicklung hat der Halbleiter-Aktienindex DJ STOXX Semiconductor im Jahresverlauf um 54 Prozent zugelegt, während die Indizes DJ STOXX 50

und DAX um drei beziehungsweise 18 Prozent dazugewonnen haben.

Infineon-Aktie entwickelt sich besser als der Markt

Die Infineon-Aktie konnte von diesem Trend überdurchschnittlich profitieren und hat sich vom 1. Oktober 2002 bis zum 30. September 2003 mit einem Kursplus von 100 Prozent verdoppelt. Doch zu Beginn des Berichtsjahrs hatte der Kurs am 9. Oktober zunächst ein Jahrestief von 5,34 Euro erreicht. Anschließend erholte sich der Kurs wieder mit einem starken Anstieg und einer besseren Entwicklung als vergleichbare Indizes. Dies war vor allem auf eine positive Geschäftsentwicklung insbesondere im Bereich Speicherprodukte zurückzuführen. Ab Ende November 2002 bis Anfang März 2003 kam es auf Grund von Befürchtungen hinsichtlich einer weiteren Abkühlung der US-Konjunktur und der Angst vor den Folgen eines langwierigen Kriegs im Irak zu Kursrückgängen an den Aktienmärkten.

Relative Entwicklung von Infineon Technologies, DAX und DJ STOXX Semiconductor Index seit Beginn des Geschäftsjahrs 2003 (Wochen-Schlusskurse)



Hinzu kam ein signifikanter Rückgang der Preise für DRAM-Chips, sodass die Infineon-Aktie wieder überdurchschnittlich an Wert verlor und einen Großteil des Kurswachstums vom Beginn des Geschäftsjahrs wieder einbüßte. Als sich die Angst vor einer länger anhaltenden großen Krise im Nahen Osten legte, erholte sich die Infineon-Aktie bis Mitte Mai mit dem Markt, wurde jedoch wie andere Technologiewerte noch durch die SARS-Krise gebremst. Als diese Krise vorüber war, verzeichnete die Infineon-Aktie im weiteren Verlauf deutliche Kurszuwächse und konnte gegenüber anderen Halbleiteraktien überdurchschnittlich an Wert gewinnen, was im Wesentlichen an einem starken Anstieg der Preise für Speicherchips lag. Im Zuge dieser Entwicklung wurde am 9. September der Jahreshöchstkurs von 13,79 Euro erreicht. Zum Ende des Geschäftsjahrs fiel die Aktie mit dem Markt auf einen Kurs von 11,22 Euro.

Das Handelsvolumen und damit das Interesse an der Infineon-Aktie hat im Geschäftsjahr 2003 weiter stark zugenommen. So hat sich der Durchschnitt der täglich in Deutschland gehandelten Infineon-Aktien auf Xetra, auf dem Frankfurter Parkett und den Regionalbörsen gegenüber dem Vorjahr um zirka 53 Prozent erhöht. Besonders erfreulich ist auch das größere Interesse der Investoren in Nordamerika. So wurden an der New Yorker Börse NYSE im Tagesdurchschnitt 766.588 ADS-Anteile gehandelt, was einem Anstieg von 102 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Basisinformationen zur Aktie

Art der Aktien	Namensaktien (Stammaktien) in Form von Aktien oder American Depositary Shares (ADS) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 2,00 Euro (Verhältnis ADS : Aktien = 1 : 1)
Grundkapital	1.442 Mio. Euro (am 30.9.2003)
Ausstehende Aktien	721 Mio. (am 30.9.2003)
Börsennotierungen	Aktien: Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ADS: New York Stock Exchange (NYSE)
Optionshandel	Optionen auf die Aktien: EUREX Optionen auf die ADS: CBOE
Börsengang	13. März 2000 an der FWB und NYSE
Emissionspreis	35,00 Euro pro Aktie 33,92 US-Dollar pro ADS
Börsenkürzel	IFX
ISIN-Code	DE0006231004
CUSIP	45662N103
Bloomberg	IFX.GY (Xetra-Handelssystem) IFX.US
Reuters	IFXGn.DE
Index-Mitglied (Auswahl)	DAX-30 Dow Jones German Titans 30 Dow Jones STOXX Semiconductor Index FTSE Euro 100 MSCI Germany S&P Europe 350

Kursdaten der Infineon-Aktie

Geschäftsjahr (zum 30.9.)	2002	2003
Europa (Xetra-Schlusskurse in Euro)		
Höchstkurs	29,11	13,79
Tiefstkurs	5,61	5,34
Jahresendkurs (Ende September)	5,61	11,22
Durchschnittlich gehandelte Aktien (pro Tag) (davon auf Xetra)	6.562.893 (95 %)	10.041.871 (94 %)
USA (NYSE-Schlusskurse in US-Dollar)		
Höchstkurs	25,57	15,35
Tiefstkurs	5,70	5,25
Jahresendkurs (Ende September)	5,70	12,89
Durchschnittlich gehandelte Aktien (pro Tag)	378.856	766.588

Langfristige Entwicklung Infineon-Aktie und Indizes

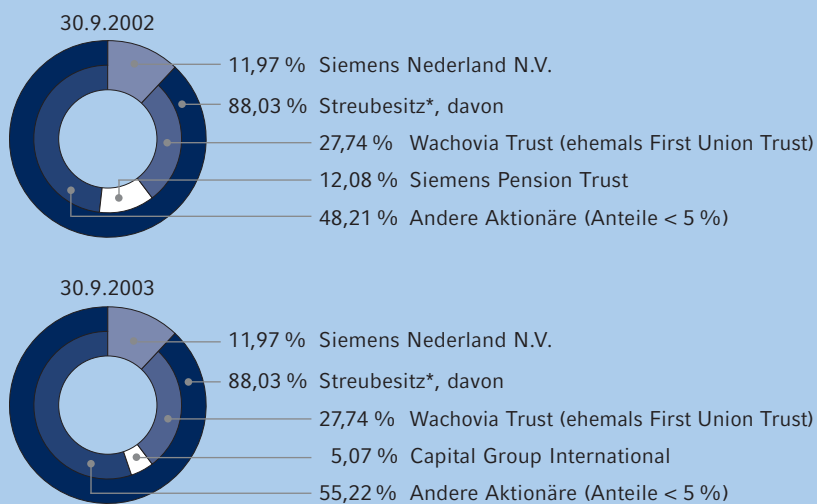
Zeitraum (zum 30.9.2003)	Seit Oktober 2002	Seit IPO am 13.3.2000
Europa		
Infineon (Xetra)	+100 %	-68 %*
DJ STOXX Semiconductor	+54 %	-81 %
DJ STOXX Technology	+45 %	-81 %
DJ STOXX 50	+3 %	-52 %
DAX	+18 %	-58 %
USA		
Infineon (NYSE)	+126 %	-62 %*
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	+76 %	-68 %

*Basiert auf dem Ausgabepreis von 35 Euro bzw. 33,92 US-Dollar.

Grundkapital, Anzahl Aktien und Marktkapitalisierung Infineon Technologies AG

Stichtag	30.9.2002	30.9.2003	Entwicklung
Grundkapital	€ 1.442 Mio.	€ 1.442 Mio.	+/-0 %
Ausstehende Aktien (im Jahresdurchschnitt)	721 Mio. (695 Mio.)	721 Mio. (721 Mio.)	+/-0 % (+4 %)
Marktkapitalisierung (Zeitwert in US-Dollar)	€ 4.045 Mio. (\$ 4.110 Mio.)	€ 8.090 Mio. (\$ 9.294 Mio.)	+100 % (+126 %)

Aktionärsstruktur Infineon Technologies AG



* Streubesitz gemäß Definition von FTSE; z. B. die Deutsche Börse und STOXX berechnen den Infineon-Streubesitz ohne die Anteile des Wachovia Trust (ehemals First Union Trust).

Die langfristige Kursentwicklung der Infineon-Aktie ist trotz des deutlichen Kursplus von 100 Prozent im letzten Geschäftsjahr enttäuschend. Seit dem Börsengang am 13. März 2000 verlor die Aktie auf Basis des Ausgabepreises 68 Prozent an Wert. Dennoch ist das Ergebnis besser als bei vergleichbaren Technologieindizes, die im selben Zeitraum noch stärkere Einbußen zu verzeichnen hatten.

Deutlicher Anstieg der Börsenkapitalisierung

Die Börsenkapitalisierung lag zum Ende des Geschäftsjahrs bei 8,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 100 Prozent gegenüber dem Stichtag im Vorjahr. Dieser Anstieg ist ausschließlich auf das Kursplus der Aktie zurückzuführen. Die Anzahl der ausstehenden Aktien blieb unverändert.

Infineon zahlt keine Dividende

Da wir im Geschäftsjahr 2003 ein negatives Ergebnis von 0,60 Euro je Aktie (Vorjahr: -1,47 Euro) und somit keinen Gewinn erwirtschaftet haben, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung keine Dividendenzahlung vorschlagen. Zukünftige Erträge planen wir für die Entwicklung und Expansion des Unternehmens zu verwenden, um so zur nachhaltigen Wertsteigerung des Unternehmens beizutragen.

700-Millionen-Euro-Wandelanleihe verbessert Cash-Position weiter

Am 5. Juni 2003 begab Infineon eine nachrangige Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2010. Der Bruttoemissionserlös belief sich auf 700 Millionen Euro. Die Anleihestücke können in bis zu 68,4 Millionen Stammaktien der Infineon Technologies AG

gewandelt werden. Infineon begab die Wandelanleihe vor dem Hintergrund günstiger Finanzierungsbedingungen im Markt für Wandelanleihen wie niedrige Zinssätze am europäischen Anleihemarkt und hohe Volatilität des Aktienkurses. Der Emissionserlös wird zur weiteren Stärkung der finanziellen Position und zur Umsetzung der langfristigen Konzernstrategie verwendet.

Streubesitz unverändert

Der Anteil der im Streubesitz befindlichen Infineon-Aktien hat sich im Berichtsjahr nicht verändert. Er blieb nach der Definition des britischen Index-Anbieters FTSE bei 88,03 Prozent.

Innerhalb des Streubesitzes gab es folgende mitteilungspflichtige Veränderungen, die dem Unternehmen bekannt sind:

- Der Siemens Pension Trust hat seine restlichen Anteile komplett verkauft.
- Die Fonds der Fidelity Management & Research Company haben am 30. April 2003 insgesamt die Schwelle von fünf Prozent (mit 5,08 Prozent) überschritten und diese am 5. August 2003 wieder unterschritten (mit 4,98 Prozent).
- Die Fonds der Capital Group International haben am 25. September 2003 insgesamt die Schwelle von 5 Prozent (mit 5,07 Prozent) überschritten.

Dialog mit Investoren und Analysten kontinuierlich ausgeweitet

Ein intensiver Dialog mit privaten und institutionellen Investoren sowie mit Finanzanalysten ist für uns insbesondere in der anhal-

tenden Konsolidierungsphase der Halbleiterindustrie und der volatilen Börsen wichtig. Die weiter intensivierte Investor-Relations-(IR)-Arbeit von Infineon konzentriert sich in dieser Phase darauf, für alle unsere Aktionäre relevante Informationen bezüglich der Geschäftsentwicklung, Technologieposition und Bilanzstruktur zeitnah zur Verfügung zu stellen. Neben den täglichen Gesprächen der IR-Manager mit Fondsmanagern, Analysten und Privatanlegern trifft sich der Vorstand regelmäßig mit vielen Investoren in Europa, den USA und Asien. Weiterhin präsentiert das Infineon-Management den Konzern auf zahlreichen Technologiekonferenzen.

Ferner wurde im Berichtsjahr der komplette Internet-Auftritt von Infineon überarbeitet. Aktuelle Nachrichten, Finanzberichte sowie ausführliche Informationen über den Konzern, unsere Corporate Governance (vgl. S. 51 „Corporate Governance“), die Infineon-Aktie und der IR-Kalender finden sich nun im neuen Layout unter www.infineon.de oder www.infineon.com.

Unser Investor-Relations-Team informiert Fondsmanager, Analysten und Privatanleger umfassend.

Kontakte

Das IR-Team von Infineon ist für Fragen der Anleger und Analysten per E-Mail an investor.relations@infineon.com erreichbar sowie in München unter **Telefon +49 (0)89 234-26655 bzw. Fax +49 (0)89 234-26155** und im Nordamerika-Büro in San Jose/Kalifornien unter **Telefon +1 408 501 6800 bzw. Fax +1 408 392 8023**.

Das Geschäftsjahr 2003 im Überblick

Oktober 2002

■ Infineon bereichert seine Mobilfunksystemlösung um neue Anwendungen: Mit der Instant-Communications-Plattform des Partners Sonim können Nutzer von Handys zunächst feststellen, ob der gewünschte Gesprächsteilnehmer verfügbar ist, und anschließend das Gespräch einfach per Knopfdruck beginnen.

■ Zur Senkung der Kosten für Schaltnetzwerke um bis zu 50 Prozent entwickelt Infineon einen hochintegrierten Leistungsschalter, der gleichzeitig den Platzbedarf für die Stromversorgung in Personal Computern, Notebooks und anderen elektronischen Geräten deutlich verringert.

November 2002

■ Infineon bündelt zum 1. November die Bereiche Mobile Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs im neuen Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen. Diese Kombination trägt dem wachsenden Bedarf nach Sicherheit von Daten und der damit verbundenen Privatsphäre in der Kommunikation Rechnung. So werden neue Anwendungen bei drahtloser Kommunikation und persönlicher Mobilität in Verbindung mit höchster Hard- und Softwaresicherheit möglich.

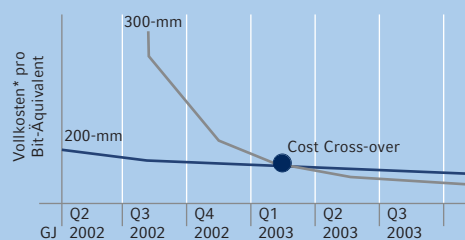
■ Neuer Geschwindigkeitsrekord I: Infineon erreicht mit einem experimentellen Halbleiter-Schaltkreis eine Datenübertragung von 40 Milliarden Bit pro Sekunde in CMOS-Technik.

■ Auf der Chipkarten-Messe „Cartes 2002“ in Paris erhält Infineon zum zweiten Mal in Folge den Sesames Award für die „Beste technologische Innovation“. Preisgekrönt werden ein Infineon-Sicherheitskontroller und ein gemeinsam mit Sony entwickelter Mikrokontroller für kontaktlose Chipkarten-Anwendungen.

■ Infineon kooperiert mit dem taiwanischen Speicherchip-Hersteller Nanya. Beide Partner forschen gemeinsam daran, die Strukturen bei Speicherchips von 130 auf 90 und 70 Nanometer zu reduzieren. Die Unternehmen gründen ferner ein 50:50-Joint-Venture für eine neue 300-Millimeter-Fabrik in Taiwan, in der ab Ende 2003 die neue Fertigungstechnik eingesetzt werden soll.

Dezember 2002

Führend in Speichertechnologie und Produktivität



Mehr als 30 % Produktivitätsvorteil gegenüber 200-mm.

* Beinhaltet Herstellungskosten zuzüglich Kosten für Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Verwaltung.

■ Nur ein Jahr nach dem Start der Volumenproduktion von Speicherchips auf 300-Millimeter-Wafern hat das 300-Millimeter-Werk in Dresden das Cost Cross-over erreicht. Die Kosten per Bit sind seitdem geringer als bei 200-Millimeter-Wafern.

■ Infineon und die US-amerikanische 3Com schließen ein Abkommen über Ethernet-over-DSL: Infineon erwirbt damit wichtige Patentrechte und stärkt seine führende Position im DSL-Markt.

■ Quantensprung für Neurowissenschaften: Mit einem neu entwickelten Bio-Neurochip von Infineon ist es gelungen, die elektrischen Signale von lebenden Nervenzellen aufzunehmen. Der Chip verspricht neue Erkenntnisse in der Hirnforschung und für die zellgestützte Medikamentenentwicklung. Dabei arbeitet Infineon mit dem Max-Planck-Institut für Biochemie in München zusammen.

■ Infineon und Ferrari vereinbaren eine weit reichende technische Kooperation. Als offizieller Lieferant von Ferraris Formel-1-Team unterstützt Infineon Ferrari mit seinen Spitzentechnologien für die Automobilelektronik und durch die Expertise einer Gruppe von erfahrenen Renningenieuren.

■ Infineon und die Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Shanghai, erweitern ihre Kooperation bei der DRAM-Fertigung. Nach dem 140-Nanometer-Fertigungsprozess lizenziert Infineon auch seine 110-Nanometer-Trench-Technologie sowie das 300-Millimeter-Fertigungs-Know-how an das chinesische Unternehmen und erhält für die damit hergestellten Speicherchips das exklusive Abnahmerecht.

■ Meilenstein für Fertigung künftiger Chipgenerationen: Infineon hat einen Prototyp des ersten kommerziell verfügbaren Laborbelichtungssystems für die Extrem-Ultraviolett(EUV)-Lithographie installiert.

■ Infineon und das israelische Unternehmen Saifun Semiconductors gründen das Joint Venture Infineon Flash, das aus dem bestehenden Gemeinschaftsunternehmen Ingentix hervorgeht und mit dem die Aktivitäten bei Flash-Speichern deutlich ausgebaut werden sollen. Am Hauptsitz Dresden sollen sowohl Daten- als auch Programm-Flash-Speicher gefertigt werden.

■ Infineon stellt eine Biochip-Systemlösung vor, mit der die Entwicklung von Medikamenten erheblich beschleunigt wird. Der Flow-Thru-Chip kann auf nur einem Quadratzentimeter zeitgleich die Reaktion von bis zu 400 bekannten Genen auf einen bestimmten Wirkstoff analysieren.

Januar 2003

Februar 2003

März 2003



Infineon-Flow-Thru-Chip: Labor im Miniaturformat.

April 2003

■ Infineon startet die Serienproduktion von 256-Megabit-DRAMs mit der 110-Nanometer-Technologie. Im Vergleich zur 140-Nanometer-Prozesstechnik können Chips mit noch kleineren Strukturen gefertigt werden. Auf einen Wafer passen bis zu 50 Prozent mehr Chips, die Stückkosten sinken um 30 Prozent.

■ Infineon hat für die Nutzer der neuen multimedialen Hauptbücherei in Wien ein anwenderfreundliches Selbstbedienungssystem entwickelt. Funkchips, mit denen 300.000 Bücher und andere Medien ausgestattet wurden, machen eine selbstständige und Zeit sparende Ausleihe möglich.

Mai 2003

■ Die neuen Hall-Sensoren sind genauer und widerstandsfähiger gegenüber elektrischen Störungen und mechanischem Stress und ermöglichen vielfältige Komfort-Anwendungen im Auto, beispielsweise als Positionsbzw. Näherungsschalter in der Sitzeinstellung, im Gurtschloss, Fensterheber oder Schiebedach.

■ Mit der freundlichen Übernahme der norwegischen SensoNor ASA, des führenden Anbieters von Reifendruck- und Beschleunigungssensoren, baut Infineon seine Position bei automobilen Halbleitersensoren deutlich aus. Damit wird das Unternehmen auf dem Gebiet der Reifendrucksensoren zum Marktführer.

Juni 2003

■ Neue Maßstäbe bei der Chipintegration: Der Modem-on-Chip VDSL5100i von Infineon kommt gegenüber herkömmlichen VDSL-Modem-Lösungen mit 75 Prozent weniger Board-Fläche aus und bringt digitale Informationen über gewöhnliche Kupferleitungen mit 100 Megabit pro Sekunde zum Kunden.

■ In einem Memorandum of Understanding verständigen sich Infineon und das Bundesinnenministerium auf eine weit reichende Sicherheitskooperation. Ziel ist es, Konzepte und verbesserte Sicherheitsstandards für IT-Systeme von öffentlicher Verwaltung, Unternehmen und Privathaushalten zu entwickeln.

■ Zur weiteren Stärkung seiner Finanzkraft und zur Unterstützung der langfristigen Unternehmensstrategie emittiert Infineon eine nachrangige Wandelanleihe in Höhe von 700 Millionen Euro. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA.



Bundesinnenminister Otto Schily (r.) und CEO Dr. Ulrich Schumacher bei der Vertragsunterzeichnung.

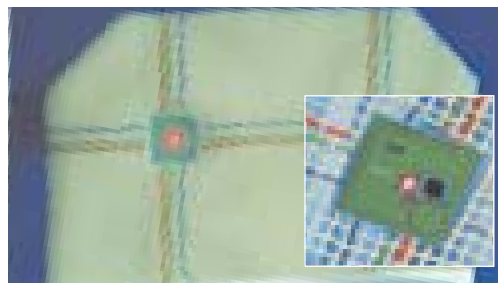
■ Infineon-Forscher haben ein sich selbst organisierendes Chipnetzwerk für intelligente Industrietextilien entwickelt, das mit wasser- und hitzebeständigen Chips über Temperatur, Druck oder Vibrationen wacht und so als Bewegungs- oder Feuermelder dient. In einer Kooperation mit dem Teppichproduzenten Vorwerk sollen schnellstmöglich marktfähige Lösungen entstehen.

■ Neuer Geschwindigkeitsrekord II: Elektronikbausteine in der hauseigenen Silizium-Germanium-Bipolar-Technologie erlangen die bislang unerreichte Betriebsfrequenz von mehr als 110 GigaHertz. Sie kommen vor allem da zum Einsatz, wo höchste Übertragungsfrequenzen benötigt werden, um in kürzerer Zeit große Datenmengen übermitteln zu können.

■ Infineon, IBM und Chartered Semiconductor Manufacturing starten gemeinsam die Entwicklung von Fertigungstechnologien für Chipstrukturen von 65 Nanometern.

■ Infineon eröffnet in Shanghai seine neue China-Zentrale, die besondere Bedeutung für die Software-Entwicklung haben wird, und erweitert damit sein Netzwerk zu Kunden, Verbänden, Politik und Universitäten.

■ Der neue 512-Megabit-Speicherchip der zweiten Double-Data-Rate-Generation, der in der 110-Nanometer-CMOS-Technologie hergestellt wird, hat branchenweit den geringsten Leistungsverbrauch und die kleinste Chipfläche.



Infineon und Vorwerk weben gemeinsam an der Zukunft.

■ Expansion in China: Infineon und die China-Singapore Suzhou Industrial Park Venture Co. (CSVC), Ltd. gründen ein Joint Venture für die Montage und den Test von Speicherchips. In Suzhou nahe Shanghai ist der Bau eines gemeinsamen Werks geplant, in dem Anfang 2005 die Volumenproduktion starten soll.

■ Infineon und die United Epitaxy Company (UEC) aus Taiwan gründen ein Joint Venture für die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Glasfaser-Komponenten.

■ Verstärkte Präsenz in den USA: Infineon eröffnet seine New Yorker Niederlassung mit dem vorrangigen Ziel, die Beziehungen zum Finanz-, Politik- und Wirtschaftssektor auszubauen.

■ Vorreiterrolle bei „grünen“ Produkten: Infineon bietet blei- und halogenfreie DRAM-Komponenten an und stellt die Fertigung von Speichermodulen schrittweise auf diese umweltfreundlichen Technologien um.

Juli 2003

August 2003

September 2003

Leben sicherer machen

Reifendrucksensoren überwachen ständig den Luftdruck in Autoreifen und leiten die Daten an den Fahrer weiter (→ Tire Pressure Monitoring System).

Smartcards im Scheckkartenformat sorgen für Verschlüsselung und sicheren Austausch persönlicher Daten.

Großflächige Textilien wie beispielsweise Teppiche mit integrierten Bewegungs- und Feuermeldern sichern Menschen und Gebäude.

Dr. Christian Burrer verantwortet bei Infineon das Produktmarketing für Reifendrucksensoren. Nur ein Beispiel dafür, wie Infineon für mehr Sicherheit im Leben sorgt.



Kunde im Fokus

Ausbau des Lösungsgeschäfts

- **Kundenbedürfnisse ändern sich – mit ihnen unser Angebot**
- **Vom klassischen Produktgeschäft zum Lösungsanbieter**
- **Neue Kompetenzen erwerben und Vorteile ausbauen**

Die Ansprüche der Endkunden an elektronische Produkte steigen: Technische Spielereien oder eine schnelle Datenverarbeitung allein reichen heute nicht mehr aus, um den Verbraucher des 21. Jahrhunderts von einer bestimmten Ware zu überzeugen. Stattdessen fordern unsere Endkunden praktische und einfach zu bedienende Produkte zur Verbesserung ihrer Lebensqualität. Der Druck auf Elektronikhersteller, innovativ, kundenorientiert und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten, nimmt daher weiter zu. Sie können nicht mehr auf ihr ursprüngliches Fachgebiet beschränkt bleiben. Da ihre Produkte durch die Integration neuer Technologien und Funktionen immer komplexer werden, müssen sie darüber hinaus ihr Know-how erweitern. Gleichzeitig stehen sie unter einem extremen Wettbewerbsdruck. Besonders bei Konsumgütern werden die Innovationszyklen kürzer, Produkte gleichen sich zunehmend an und der Preisdruck wächst.

Ausbau des kundenorientierten System- und Lösungsgeschäfts

Wir haben diese Veränderungen frühzeitig erkannt und reagieren darauf mit dem Ausbau unseres Applikationswissens und unseren Systemlösungen (vgl. S. 10 „Unternehmensstrategie“). Bei unserem Denken und Handeln orientieren wir uns vornehmlich an den konkreten Geschäftsproblemen jedes einzelnen Kunden.

Diese Handlungsweise führt zu einer stabilen Kunden-Lieferanten-Beziehung und Vorteilen auf beiden Seiten. Infineon hebt sich so von seinen Wettbewerbern ab, etabliert eine langfristige Partnerschaft mit dem Kunden und verstetigt so die Einkünfte. Die Informationen und Erkenntnisse, die wir aus dem direkten und guten Kontakt mit unseren Kunden gewinnen, fließen wieder in unsere Produkt- und Softwarebereiche zurück und verbessern damit auch unser klassisches Geschäft, wovon erneut unsere Kunden profitieren.

Erste Erfolge im Lösungsgeschäft

Infineon steht bei der Entwicklung zum Lösungsanbieter zwar noch am Anfang. Doch haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits erste Lösungen erfolgreich am Markt platzieren können.

Für die Entwicklung von Mobiltelefonen beispielsweise bieten wir unseren Kunden neben den relevanten Chipsets zusätzliche Unterstützung bei Boarddesign und Software-Entwicklung an. Diese Zusatzleistung wird zurzeit vor allem für die Entwicklung von GSM-Telefonen von so genannten Original Design Manufacturers (ODMs) in Asien in Anspruch genommen. ODMs entwickeln und fertigen komplette Systeme für so genannte Original Equipment Manufacturers (OEMs), die diese Systeme spezifizieren und dem Endverbraucher dann unter ihrem eigenen Markennamen anbieten. Typischerweise haben ODMs vor allem Erfahrung in der Fertigung von Elektronikgeräten in großen Stückzahlen und zu optimierten Kosten.

Die notwendigen Vorarbeiten, wie die Integration der Hardwarekomponenten und die

Unser Denken und Handeln orientieren wir an den konkreten Geschäftsproblemen unserer Kunden.

Entwicklung von Software, wurden bisher von OEMs selbst geleistet und sind für ODMs eher Neuland. Hier leisten wir gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen Hilfeleistung oder übernehmen ganze Aufgabenpakete für ODMs.

Herausforderungen im Lösungsgeschäft

Applikationsspezifische Lösungen zu entwickeln setzt voraus, dass alle Mitarbeiter die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen. Ein Problem beim Kunden oder eine neue Tendenz am Markt sollten sofort den Denkprozess in Gang setzen: „Wie kann ich dabei unseren Kunden unterstützen?“ Wichtig ist also auch das Wissen darüber, welche Anforderungen der Markt an unsere Kunden selbst stellt. Deshalb haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls unsere Aktivitäten auf dem Gebiet von Marktbeobachtung sowie Markt- und Trendforschung deutlich verstärkt. Dieses Wissen nutzen wir, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und unseren Kunden proaktiv Lösungen anzubieten.

Viele Erkenntnisse und Anregungen verdanken wir auch den zahlreichen Kooperationen mit unseren Kunden. So haben wir im letzten Geschäftsjahr beispielsweise unsere Zusammenarbeit mit Siemens und Ericsson auf dem Gebiet der Mobilfunkinfrastruktur und bei Mobilfunkgeräten ausgebaut. Auf diesem Weg findet ein reger Erfahrungsaustausch statt, der es uns erleichtert, die Vorstellungen unserer Kunden in konkrete Produkte, Systeme und Lösungen umzusetzen. Aus diesem Grund werden wir in den nächsten Jahren die Zusammenarbeit mit unseren Schlüsselkunden in allen Geschäftsbereichen (vgl. Umschlag „Infineon auf einen Blick“) weiterhin intensivieren und unser

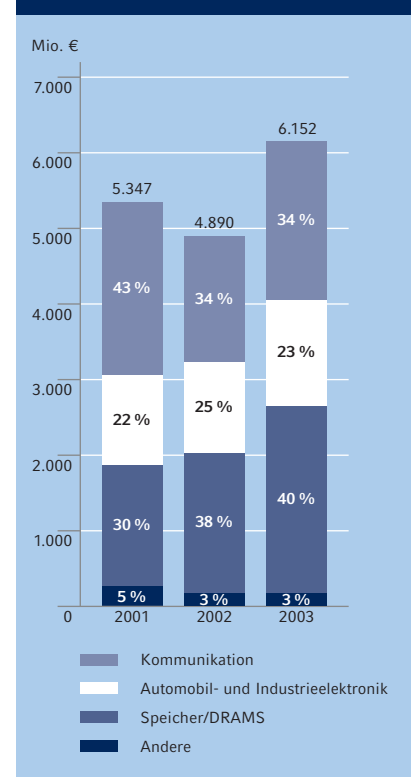
Wissen bei Logikchips für drahtgebundene, mobile und sichere Kommunikation, Halbleitern für die Automobil- und Industrieelektronik sowie Speicherchips weiter ausbauen.

Infineons großer Vorteil bei der Vernetzung verschiedener Technologien ist das im Vergleich zum Wettbewerb breite Produktportfolio. Unser produkt- und branchenübergreifendes Know-how nutzen wir, um Systeme herzustellen, die verschiedene Funktionen integrieren, so zum Beispiel Sicherheitsanwendungen in Computern oder drahtlose Kommunikation im Auto. In geschäftsbereichsübergreifenden Projektgruppen treiben wir diesen Austausch weiter voran. In Randgebieten unseres Geschäfts stützen wir uns auf das Spezialwissen anderer Unternehmen und knüpfen Partnernetzwerke. Zusätzlich zu unserer Halbleiterkompetenz bauen wir beispielsweise unsere Softwarekompetenz weiter aus und bieten unseren Kunden in Zukunft ergänzende Services an. So haben wir geprüft, welche bestehenden Services ausgebaut, neu strukturiert oder welche völlig neu entwickelt werden müssen, und können so unsere Lösungen noch abrunden.

Auf dem Weg zur Nummer eins unter den Lösungsanbietern

Auf diesem Feld gibt es für uns weiterhin viel zu tun. Doch wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Vorgehen die richtige Antwort auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden sowie die der Endverbraucher gefunden haben. Im laufenden Geschäftsjahr werden wir an den oben beschriebenen Herausforderungen mit aller Kraft arbeiten. Nur so können wir unser Ziel erreichen, bis zum Jahr 2007 im Lösungsgeschäft die Nummer eins aller Halbleiterunternehmen zu sein.

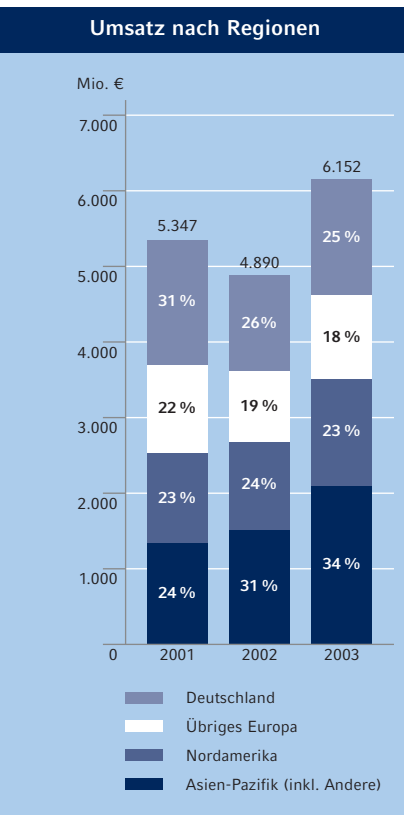
Umsatz nach Märkten



Den Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden werden wir in allen Geschäftsbereichen weiter intensivieren.

Globale Präsenz

Wachstum in allen Regionen



■ Starke Marktstellung in Europa und Asien

■ Verbesserte Servicestruktur in Nordamerika

■ Hohes Wachstumstempo in China

Die internationale Präsenz kontinuierlich ausbauen und dadurch schneller wachsen als der Gesamtmarkt: Mit der Umsetzung der Agenda 5-to-1 (vgl. S. 10 „Unternehmensstrategie“) sind wir im Geschäftsjahr 2003 weltweit auf dem richtigen Kurs und konnten unseren Umsatz in jeder einzelnen Region steigern. Dies gilt sowohl für die großen Absatzmärkte Europa und Asien als auch für die Wachstumsmärkte Nordamerika, China und Japan.

Wir haben wichtige Etappenziele erreicht: In China – dem Land mit dem weltweit größten Wachstumspotenzial – kommt die Umsetzung des regionalen Konzepts vor allem über Kooperationen mit lokalen Partnern zügig voran. Parallel dazu konnten wir in Europa und Asien die Kundenbeziehungen ausbauen und uns in Nordamerika im Segment Automobilelektronik optimal positionieren.

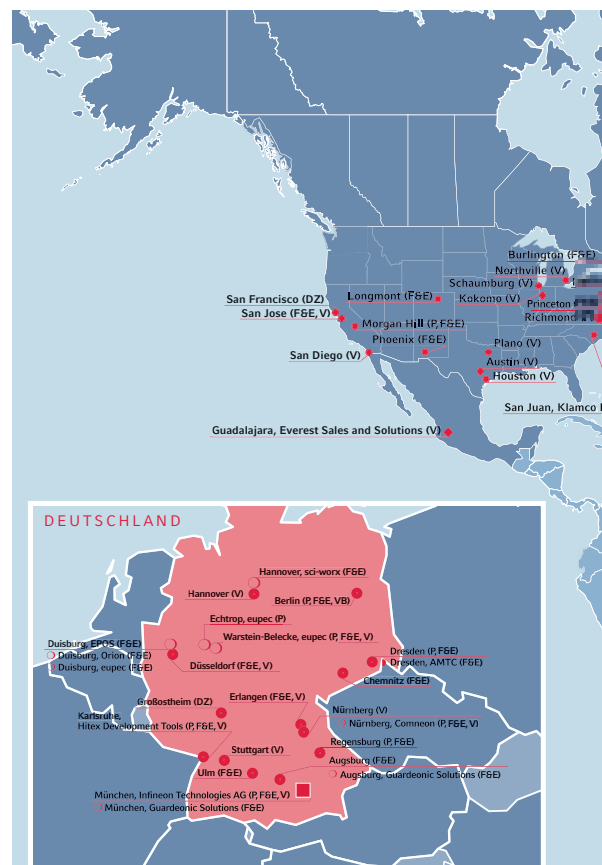
Gewachsene Kundenbeziehungen in Europa und Asien

Europa und Asien sind weiterhin unsere wichtigsten Absatzmärkte. Im vergangenen Geschäftsjahr bauten wir die Marktpräsenz in beiden Regionen weiter aus. Wir haben uns mit einem Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro als die Nummer zwei im europäischen Halbleitermarkt etabliert. Bereits ein Drittel aller Umsätze, nämlich 2,1 Milli-

arden Euro, realisieren wir im asiatischen Raum – Tendenz steigend. In beiden großen Märkten intensivierten wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden – speziell in den Geschäftsbereichen Sichere Mobile Lösungen sowie Drahtgebundene Kommunikation. Diese bilden die Basis, die entscheidend dabei hilft, unsere Präsenz weiter zu erhöhen.

Des Weiteren haben wir einen signifikanten Umsatzzuwachs in Asien durch so genannte ODMs (vgl. S. 24 „Kunde im Fokus“), die mit neuen Geschäftsmodellen vor allem Mobiltelefone für namhafte Hersteller entwickeln und fertigen.

Ein Drittel unserer Umsätze im Geschäftsjahr 2003 realisierten wir im asiatischen Raum, Tendenz steigend.



Insbesondere in Europa haben wir zudem unsere Position im Chipkartengeschäft weiter gestärkt. Darüber hinaus gilt unser besonderes Augenmerk dem Bereich Automobil- und Industrieelektronik, in dem wir europaweit als führendes Halbleiterunternehmen im Automobilbereich agieren. Aus dieser Position heraus gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden Trends und stärken unsere Marktstellung über Europa hinaus.

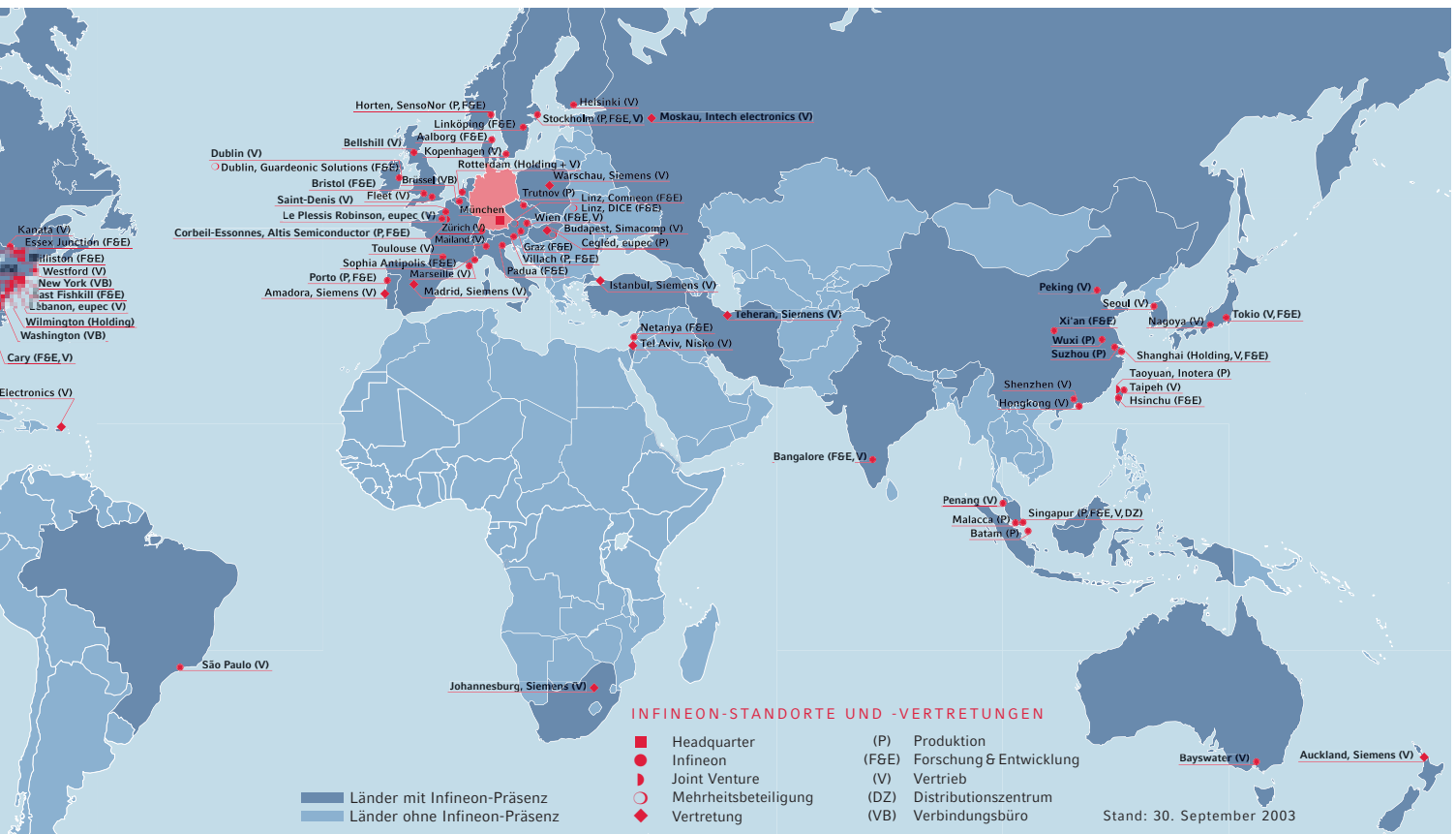
Nordamerika: Stärkung unserer Vertriebs- und Servicestruktur

Der nordamerikanische Markt birgt für alle Geschäftsbereiche Potenzial: Mit einem Marktanteil von über vier Prozent nehmen wir seit dem ersten Kalenderhalbjahr 2003

die Top-5-Position der Halbleiterunternehmen in Nordamerika ein. Hier haben wir 2003 zum Beispiel unsere Vertriebsstruktur gestärkt sowie unsere Serviceorganisation ausgebaut. Über diese bieten wir unseren Kunden die Entwicklungskompetenz aller Geschäftsbereiche aus einer Hand an. Ergänzend dazu entstanden Customer Training Center in San Jose, Richmond und Cary. Hier stellt Infineon einzelnen Kundengruppen jeweils maßgeschneiderte Trainingsprogramme zur Verfügung.

Zwei Standorte haben wir im Geschäftsjahr 2003 komplett neu aufgebaut: Cary und New York. Während sich in Cary unter anderem die Bereiche Vertrieb, Marketing und

Unsere führende Position als Halbleiterunternehmen im europäischen Automobilmarkt haben wir 2003 weiter ausgebaut.



Infineon-Standorte weltweit.

Entwicklung befinden, fungiert das New Yorker Büro als zentrale Anlaufstelle für Analysten und Investoren. Von hier aus werden wir die Investor Relations für den nordamerikanischen Markt weiter intensivieren und unsere Kontakte zu den Vertretern der Finanzwelt stärken.

Um unser Netzwerk an Distributoren zu erweitern, haben wir in Nordamerika einen weiteren spezialisierten Distributor aufgenommen. Infineon hat das Geschäftsjahr 2003 auch dazu genutzt, das Forschungsnetzwerk in Nordamerika auszubauen und den Kontakt zu führenden Universitäten zu suchen. Begleitet werden alle Aktivitäten von einer Marketing- und Kommunikations-offensive, mit der wir in erster Linie Industriekunden ansprechen, aber auch bei Endverbrauchern präserter werden wollen.

Wachstumsmarkt Nummer eins: China

Der konsequente Ausbau der lokalen Präsenz charakterisiert unser Wachstumskonzept in China. Langfristig wollen wir uns mit über zehn Prozent Marktanteil unter den vier größten Anbietern etablieren und in China über 3.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Die gesteigerte Präsenz auf den globalen Märkten ist ganz im Sinne der von uns eingeschlagenen Wachstumsstrategie.

Auf dem Weg dorthin haben wir das Wachstumstempo noch weiter erhöht: Nach 21 Prozent im Vorjahr konnten wir den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 30 Prozent steigern. Besonders wichtig war und ist die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, wie zum Beispiel neue Fertigungskooperationen im Bereich Speicherchips (vgl. S. 34 „Fertigung und Logistik“). Parallel dazu haben wir die Fertigung in Wuxi ausgebaut und die lokalen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vorangetrieben,

unter anderem im Design Center in Xi'an, über die Kooperation mit Huawei (Mobile Kommunikation) und in einem neuen Kompetenzzentrum für das System- und Lösungsgeschäft.

Koordiniert werden all diese Aktivitäten von unserer China-Zentrale in Shanghai. Hier schlägt das Herz unseres Engagements in China, hier laufen die Fäden des lokalen Netzwerks mit Kunden, Verbänden, Politik und Universitäten zusammen.

Neue Kooperationen in Japan

Japan bleibt ein wichtiger Zukunftsmarkt mit großem Absatzpotenzial. Im Vergleich zu China ist das Wachstum zwar geringer, dafür sehen wir aber gute Chancen, künftig unseren Marktanteil weiter zu erhöhen. Entsprechend haben wir unsere Präsenz dort weiter ausgebaut. Im Mittelpunkt standen dabei Kooperationen mit Großkunden in den Bereichen mobile und drahtgebundene Kommunikation, Automobilelektronik und Chipkarten. Zudem erwarten wir, in den kommenden Jahren von der zunehmenden Öffnung des japanischen Marktes für internationale Unternehmen zu profitieren.

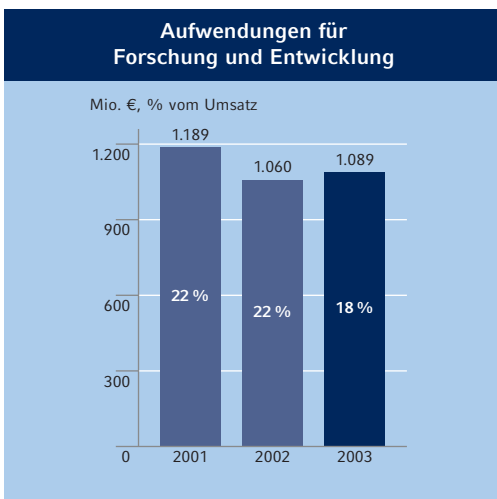
Die regionalen Aktivitäten sind wichtige Bausteine für den Ausbau des System- und Lösungsgeschäfts und unsere Entwicklung zum weltweiten Halbleiterunternehmen Nummer eins im Lösungsgeschäft. Wir werden uns in jeder Region konsequent an den Kundenanforderungen vor Ort orientieren und auf Kooperationen mit lokalen Partnern setzen – ganz im Sinne der von uns eingeschlagenen Wachstumsstrategie.

Innovationen

Aus dem Forschungslabor in den Alltag

- **Innovation als Grundlage anwenderfreundlicher Produkte**
- **Nutzen für den Endkunden im Mittelpunkt von Forschung und Entwicklung**
- **Auszeichnungen für Chipkarten-ICs, Biochips und Halbleiter in Textilien als Beleg für Infineons Erfolg**

Infineon macht aus technischem Fortschritt Produkte und Anwendungen für jedermann möglich – und ermöglicht so den Technology Lifestyle des 21. Jahrhunderts. Forschung und Entwicklung sind für uns als Technologieunternehmen die Keimzelle des Erfolgs. Im Geschäftsjahr 2003 haben wir deshalb 1,09 Milliarden Euro und damit 18 Prozent unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert.



Rund 5.900 Ingenieure und Wissenschaftler auf der ganzen Welt verwandeln Hochtechnologie in Produkte, Systeme und Produktionsmethoden. Rund 1.600 neue Erfindungen meldet Infineon jährlich zum Patent an; in Deutschland liegen wir damit nach Siemens und Bosch auf dem dritten Rang.

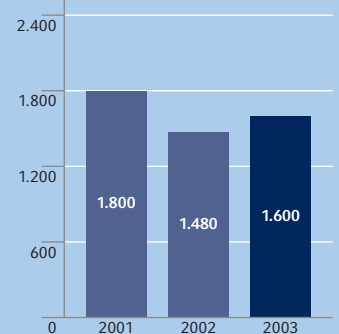
Dabei ist nicht etwa das technisch Machbare unser Maßstab. Vielmehr orientieren sich unsere Produkte an den individuellen Bedürfnissen der Menschen, um ihren Alltag zu erleichtern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Innovationen von Infineon

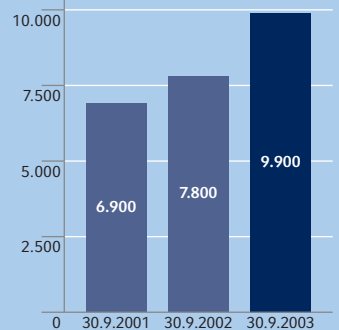
Unsere Sicherheitschips lassen sich vielseitig einsetzen, etwa in Bankkarten, elektronischen Tickets, Firmen- oder Behördenausweisen. Sie ermöglichen höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit und kommunizieren – wo es dem Bedürfnis des Endkunden entgegenkommt – quasi im Vorbeigehen drahtlos per Funk mit dem Terminal. Unsere Chipkartentechnologie steht auf dem Siegereppchen der technologischen Neuerungen. Zum zweiten Mal in Folge ist Infineon mit der höchsten Auszeichnung der Chipkartenbranche, dem Sesames Award, geehrt worden. Ausgezeichnet als „Beste technologische Innovation“ wurden ein Sicherheitskontroller und ein gemeinsam mit Sony entwickelter Mikrokontroller für kontaktlose Chipkartenanwendungen.

Infineon-Chips werden uns bald auch zu Füßen liegen. Unsere Forscher haben einen Weg gefunden, großflächige Textilien wie Teppichböden mit „Intelligenz“ auszustatten. In die Textilstruktur eingewebt, kontrolliert ein sich selbst organisierendes Netzwerk aus wasser- und hitzebeständigen Chips bei Bedarf Temperatur, Druck oder Vibrationen. Ein mit dieser Elektronik ausgestatteter Teppichboden könnte etwa als Bewegungs- oder Feuermelder fungieren beziehungsweise Alarm- und Klimaanlage steuern. Werden zudem Leuchtdioden integriert, kann der intelligente Teppich auch

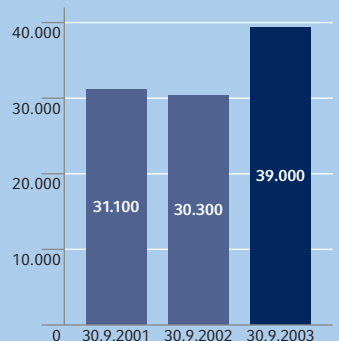
Erstanmeldungen Patente*



Lebende Patentfamilien**



Lebende Patente und Patentanmeldungen*** weltweit kumuliert



* Erfindungen werden zunächst bei einem Patentamt in einem Land angemeldet.
 ** Patente haben eine maximale Lebensdauer von 20 Jahren und zählen kumuliert. Alle Patente und Patentanmeldungen, die eine Erfindung betreffen, bilden zusammen „Patentfamilien“.
 *** Infineon meldet wichtige Erfindungen innerhalb eines Jahres auch im Ausland an. Bei Infineon entstehen daher im Durchschnitt aus einer Erfindung 4 Patentanmeldungen.

Einzigartige Innovationen entwickeln wir weiter zu marktfähigen Lösungen.

Besucherströme lenken, Fluchtwege kennzeichnen oder als Werbeträger dienen. Einen ersten Kooperationsvertrag haben wir mit dem Teppichproduzenten Vorwerk abgeschlossen. Beide Firmen wollen bis Ende 2004 eine marktfähige Lösung präsentieren. Unsere Technologie hat überzeugt: Die Infineon-Forscher haben für ihr Projekt vom Organisationskomitee der TechTextil-Messe 2003 den TechTextil-Innovationspreis in der Kategorie „Integration neuer Technologien“ erhalten.

Unsere Biochiptechnologie unterstützt die schnellere Entwicklung neuer Medikamente.

Eine Bibliothek mit Selbstbedienung – auch das machen Infineon-Chips möglich. Herzstück der Komplettlösung sind 300.000 Funkchips. Mit diesen so genannten my-d-RFID-Chips (Radio Frequency Identification) wurden bereits 240.000 Bücher und 60.000 CDs und DVDs in der Hauptbücherei Wien ausgestattet. Der Kunde legt die ausgewählten Medien an den dazugehörigen Selbstverbuchungsterminals ab und steckt seinen Bibliotheksausweis in ein Lesegerät. Ein Funksystem, das in den Tisch integriert ist, liest die Inhalte der RFID-Chips ein und verbucht die Ausleihe. So werden Wartezeiten vermieden, weil bei jedem Leihvorgang mehrere Medien gleichzeitig erfasst werden. Die Chips mit einer Speicherkapazität von bis zu zehn Kilobit können weit mehr Informationen aufnehmen als herkömmliche Barcodes. Wir haben das Projekt gemeinsam mit dem Bibliotheksausstatter ekz aus Reutlingen und dem Schweizer Partner Bibliotheca Library Systems AG entwickelt und weitere Büchereien in Österreich, der Schweiz, in Belgien und Deutschland ausgestattet.

Auch unsere Biochiptechnologie wurde im vergangenen Jahr prämiert. Das „Wall

Street Journal Europe“ nominierte sie als „Best Technological Innovation 2002“ und zeichnete sie mit dem zweiten Preis aus. Dazu gehört der so genannte Flow-Thru-Chip, der bereits auf dem Markt ist und zur schnelleren Entwicklung neuer Medikamente eingesetzt wird. Er unterstützt die Suche nach Wirkstoffen gegen Entzündungen, Brust- und Lungenkrebs sowie nach Mitteln gegen Degenerationserscheinungen des Nervensystems wie Alzheimer, Parkinson oder Multiple Sklerose. Der Chip, den Infineon gemeinsam mit der amerikanischen Biotech-Firma MetriGenix entwickelt hat, kann auf einem Quadratcentimeter Grundfläche innerhalb von zwei Stunden bis zu 400 unterschiedliche Genproben zugleich testen – das ist sechs Mal schneller als bisherige Lösungen auf dem Markt.

Noch in Entwicklung befindet sich derzeit ein vollelektronischer Biochip, der ohne optische Auswertungsapparatur funktioniert. Dabei setzen wir als weltweit erstes Halbleiterunternehmen Standard-Chiptechnik ein: Modifizierte CMOS-Halbleiterchips werden durch prozesstechnische Erweiterungen zu Biochips. Der vollelektronische Biochip spürt einzelne Genabschnitte auf. So können Krankheiten identifiziert und diejenigen Medikamente ausfindig gemacht werden, die der Patient am besten verträgt. Auch die Krebsfrüherkennung wird unser Chip vorantreiben. Insbesondere dürften jedoch medizinische Einrichtungen von ihm profitieren: Die Laborarbeit erledigt der Biochip deutlich günstiger, besser und schneller.

Außerdem arbeiten wir intensiv an einem Neurochip, einem weiteren Biochip, der erstmals die Kommunikation zwischen

lebenden Nervenzellen und einem Halbleitersensor ermöglicht. Er lässt auf neue Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns hoffen. Einzelne Nervenzellen werden isoliert und auf einem Chip angebracht, wo zum ersten Mal der Informationsaustausch zwischen den Neuronen untersucht werden kann. Dieses Experiment gelang unseren Forschern gemeinsam mit Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München. Mögliche Anwendungen versprechen sich die Experten im Bereich der zellgestützten Medikamentenentwicklung.

Auch für das häusliche Infotainment bietet Infineon Revolutionäres: Fernsehen, Telefonie und Hochgeschwindigkeits-Internet können in Zukunft über ein und dieselbe Leitung zum Endkunden übertragen werden. In der Regel sind heute noch mindestens zwei getrennte Netze dafür notwendig. Das optische Triplexer-Modul Triport-BIDI von Infineon macht es möglich, die Signale für diese drei unterschiedlichen Anwendungen in beide Richtungen über eine einzige Glasfaserleitung zu übertragen. Diese so genannten Single-Fiber-Systeme haben eine Reichweite von bis zu 20 Kilometern.

Eine andere Neuentwicklung gibt der Internet-Telefonie einen qualitativen Schub: Unsere innovativen INCA-IP-Chips optimieren Voice-over-Internet-Protocol(VoIP)-Telefone mit integrierter Konferenzschaltung, Freisprechfunktionalität und Audioleistung auf höchstem Niveau. So bietet der Chip vollständige Ethernet/Fast-Ethernet-Fähigkeiten für den direkten Anschluss an eine Netzwerkverbindung und unterstützt neue drahtlose Telefon-Headsets sowie Funktionen wie die

Identifizierung des Anrufers und Spracherkennung. Zudem macht der INCA-IP das Telefonieren per Internet sicherer: Er ist der erste Chip seiner Art, der Hardware-Beschleuniger für Verschlüsselung anbietet, um IP-Telefonie effektiv vor Hacker-Angriffen zu schützen. Siemens ICN wird unseren Chip beispielsweise für seine zukünftige Produktlinie von Internet-Telefonen verwenden.

Miniaturisierung: Infineon weiterhin Technologieführer

Bereits im vergangenen Geschäftsjahr gelang es uns, die Strukturbreite von Speicherchips von 140 auf 110 Nanometer zu reduzieren. Die Produktionskosten pro Chip sinken damit gegenüber der bisherigen Prozesstechnik um weitere 30 Prozent (vgl. S. 34 „Fertigung und Logistik“).

Da sich die Chipstrukturen im nächsten Jahrzehnt immer mehr der Größe einzelner Atome annähern werden, stellen sich uns ganz neue Herausforderungen: Beispielsweise müssen die Lithographiewerkzeuge verfeinert und die Leitungen in den Chips immer dünner werden. Die Lithographie dient dazu, die Chipstrukturen auf dem Silizium abzubilden. In diesem Verfahren, das der Fotografie ähnelt, werden lichtempfindliche Schichten auf dem Siliziumwafer mit den Chipstrukturen belichtet. Für immer kleinere Strukturen müssen immer kürzere Wellenlängen verwendet werden, was nur durch eine Anpassung der Werkzeuge erfolgen kann. Heute arbeiten wir in der Chip-Massenfertigung mit Wellenlängen von 193 Nanometern; die nächste optische Wellenlänge für die Chipproduktion wird bei 157 Nanometern liegen. Bei diesen Wellenlängen sind völlig neue Materialien notwendig.

Über Glasfaser können Fernsehen, Telefonie und Internet in Zukunft über eine einzige Leitung übertragen werden.

Infineon hat erstmals Chips mit einer Betriebsfrequenz von mehr als 110 GigaHertz entwickelt.

Deshalb kooperiert Infineon mit dem Chemieunternehmen Clariant, um den Fotolack der nächsten Generation zu entwickeln. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, als eines der ersten Halbleiterunternehmen mit der 157-Nanometer-Pilotfertigung zu beginnen, um Strukturen von nur noch 55 Nanometern zu produzieren.

Immer kürzere Wellenlängen erfordern immer feinere Lithographiewerkzeuge. So forschen wir bereits aktiv an der so genannten Extrem-Ultravioletten(EUV)-Strahlung, die nahe dem Röntgenspektrum liegt und keine optischen Linsen mehr passieren kann.

Forschung für die besten Chips

Unseren Forschern ist es zum wiederholten Male gelungen, Geschwindigkeitsrekorde mit Bauteilen auf Siliziumbasis aufzustellen.

Bis vor zwei Jahren war man der Meinung, die hohen Frequenzen, die vor allem für Mobiltelefone nötig sind, seien einzig mit den Materialien Galliumarsenid (GaAs) oder Indiumphosphid (InP) zu erreichen. Deren Elektronenmobilität ist sehr viel höher als die von Silizium. Bei GaAs und InP handelt es sich allerdings um problematische Werkstoffe: Sie sind teuer, potenziell umweltgefährdend und schwer zu entsorgen. Silizium hingegen ist deutlich preisgünstiger und lässt sich in erprobten Prozessen verarbeiten. Entwickler von Infineon haben nun bei minimaler Stromaufnahme für ihre Siliziumbauteile die bislang unerreichte Betriebsfrequenz von mehr als 110 GigaHertz umsetzen können. Dagegen arbeiten heutige Prozessoren für PCs, die auf Silizium-CMOS-Technologie basieren, mit Spitzenwerten von weniger als vier GigaHertz. Auf der Grundlage von Sili-

zium, das mit Germanium-Atomen dotiert wurde, entstehen so Chips, die bis zu 30 Prozent schneller sind als die Schaltkreise aus nicht dotiertem Silizium. Sie kommen vor allem da zum Einsatz, wo höchste Übertragungsfrequenzen benötigt werden, um in kürzerer Zeit große Datenmengen übermitteln zu können. Das gilt zum Beispiel für die Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation.

Infineons Chips könnten auch Autos sicherer machen, etwa durch Abstandswarnung und Kollisionsvermeidung mittels Radar. Es wäre sogar möglich, die Signale mit einer individuellen Kennung unempfindlich gegen Störsignale von anderen Autos zu machen. Auch Stop-and-go-Automaten, die dem Autofahrer das ständige Nachrücken im Stau erleichtern, sind mit den schnellen Chips denkbar. Erste Anwendungen sind schon in drei Jahren zu erwarten.

Einen weiteren Geschwindigkeitsrekord haben unsere Forscher mit einem experimentellen Halbleiterschaltkreis für CMOS-Bauteile aufgestellt. Mit dem Chip, der Daten mit 40 Milliarden Bit pro Sekunde überträgt, werden sich schon in Kürze kostengünstiger noch leistungsfähigere Chips für Kommunikationsnetzwerke herstellen lassen.

In der Kooperation erfolgreich

Neben diesen spektakulären eigenen Entwicklungen kooperiert Infineon zunehmend mit anderen Unternehmen und Institutionen. Dadurch profitieren wir nicht nur von der Kompetenz des jeweiligen Partners, sondern senken gleichzeitig die Entwicklungskosten und verteilen die hohen Investitionen und Risiken der Halbleiterbranche auf mehrere Schultern.

Jüngstes Produkt einer solchen Partnerschaft ist die weltweit kleinste MRAM-Speicherzelle von nur 1,4 Quadratmikrometern, die wir gemeinsam mit IBM entwickelt und im Juni dieses Jahres in einem 128-Kilobit-MRAM-Speicherchip demonstriert haben. Die Informationen werden bei diesen Chips nicht mit elektrischen, sondern magnetischen Ladungselementen gespeichert. MRAMs vereinen die Vorteile etablierter Halbleiter-Speichertypen, unter anderem die hohe Geschwindigkeit von SRAMs und die Nichtflüchtigkeit von Flash-Speichern. Da MRAMs die Daten auch noch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung speichern, lassen sich damit in ferner Zukunft auch Computer realisieren, die ähnlich wie Fernseher oder Radio sofort nach dem Einschalten betriebsbereit sind. In Anwendungen wie Handys oder PDAs können diese Chips schon früher eingesetzt werden als ursprünglich erwartet: IBM und Infineon wollen bereits 2004 ein MRAM-Musterprodukt vorstellen. Erste Kundenmuster sind für 2005 geplant.

Speziell für die Entwicklung von Flash-Speichern hat Infineon mit dem israelischen Unternehmen Saifun Semiconductors das Joint Venture Infineon Technologies Flash

GmbH & Co. KG gegründet. Das Unternehmen geht aus dem bereits seit 2001 bestehenden Joint Venture Ingentix hervor und hat seinen Hauptsitz in Dresden. Die Produktion der ersten Flash-Speicher soll Ende 2003 beginnen. Die Chips speichern ihren Inhalt ebenfalls ohne Betriebsspannung und werden vornehmlich in mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, tragbaren Computern und Digitalkameras eingesetzt. Marktforschungsunternehmen rechnen in diesem Markt bis 2006 weltweit mit einem jährlichen Wachstum von zehn Prozent.

Vorsprung bei Innovationen für erfolgreiche Lösungen nutzen

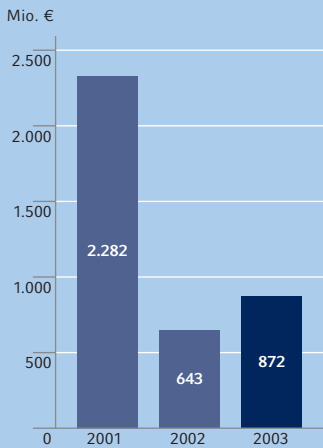
Infineon wurde für wegweisende Entwicklungen mehrfach ausgezeichnet und ist ein gefragter Kooperationspartner. Das zeigt, dass wir nach wie vor Taktgeber in der Halbleiterbranche sind, wenn es um zukunftsfähige Technologien und Produkte geht. Auch in den kommenden Jahren werden wir uns auf die Entwicklung erfolgreicher Lösungen konzentrieren. Dabei haben wir bereits auf der Ebene von Forschung und Entwicklung die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden vor Augen – mit dem Ziel, den Technology Lifestyle des 21. Jahrhunderts zu ermöglichen.

Unsere Leistungen in Forschung und Entwicklung wurden mehrfach ausgezeichnet.

Fertigung und Logistik

Im Wettlauf um Kosten- und Technologieführerschaft

Investitionen in Sachanlagen



Den Schwankungen des Halbleitergeschäfts begegnen wir mit flexiblen Fertigungsprozessen und Partnerschaften.

■ Kostenführer auf Grund überlegener Technologie

■ Von 140 zu 90 Nanometern: Chipstrukturen werden immer kleiner

■ Kooperationen und vielseitige Fertigungsanlagen bieten Synergien und Flexibilität

Die äußerst dynamische Halbleiterindustrie verlangt nach immer weiteren Technologiesprüngen, die zu immer höher integrierten Chips auf immer kleinerer Fläche führen. Auf der anderen Seite werden die Siliziumwafer immer größer. Als Kosten- und Technologieführer gehört Infineon auf beiden Gebieten zu den Vorreitern.

Die fortschreitende Miniaturisierung der Chips erhöht zur selben Zeit jedoch auch die notwendigen Investitionen. Wurde etwa 1995 noch rund eine Milliarde US-Dollar für ein neues Halbleiterwerk veranschlagt, so müssen die Hersteller heute bereits mit mehr als zwei Milliarden US-Dollar rechnen.

Zusätzlich unterliegt das Halbleitergeschäft starken Schwankungen. Um dennoch wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir die Kosten stetig reduzieren, Fertigungsprozesse flexibel gestalten und verfügbare Ressourcen zielgerichtet einsetzen. Mit dem Ziel, die Kosten zu senken und die Risiken auf mehrere Schultern zu verteilen, setzen wir sowohl in der Entwicklung als auch in der Fertigung zunehmend darauf, mit Partnern zu kooperieren. Zudem bauen wir unseren Vorsprung in den Kerntechnologien weiter aus und flexibilisieren kontinuierlich unsere Entwicklungs- und Fertigungsprozesse.

Kostenführer auf Grund überlegener Technologie

Im Wettlauf um die günstigsten Produktionsmethoden haben wir schon heute die Nase vorn – zum Beispiel als Vorreiter bei der 300-Millimeter-Technologie im Dresdner Werk, dem weltweit ersten mit 300-Millimeter-Volumenproduktion. Im Vergleich zu den bisher üblichen 200-Millimeter-Wafern bietet ein 300-Millimeter-Wafer eine knapp zweieinhalb Mal so große Grundfläche. Und das lohnt sich: Bereits ein Jahr nach Fertigungsstart wurde im Dezember vergangenen Jahres das so genannte Cost Cross-over erreicht, ab dem die Produktion günstiger als auf den bisher üblichen 200-Millimeter-Wafern ist. Durch die erfolgreiche Einführung dieser 300-Millimeter-Technologie in Dresden und die kontinuierliche Umstellung unserer weltweiten Fertigungslinien auf Strukturbreiten von 140 Nanometern haben wir die Produktionskosten pro DRAM um etwa 60 Prozent reduziert.

Und auch wenn es um die kleinsten Chipstrukturen geht, gibt Infineon das Tempo vor: Derzeit bemustern wir den weltweit kleinsten 1-Gigabit-Speicherchip; die Serienfertigung läuft bald an. Die wesentliche Grundlage dafür ist die neue Prozesstechnik, die Strukturbreiten von nur noch 110 Nanometern ermöglicht – eine Technologie, die schrittweise an allen Fertigungsstätten eingeführt wird und weitere Kosteneinsparungen mit sich bringt.

Parallel dazu forschen wir bereits an noch kleineren Strukturen: Gemeinsam mit unserem Partner Nanya arbeiten wir an 300-Millimeter-Fertigungstechnologien für Speicherchipstrukturen von 90 und 70 Nanometern.

Das gemeinsame Werk Inotera in Taiwan wird Ende 2003 mit Fertigungsequipment ausgestattet, der Produktionsanlauf ist für 2004 geplant. Darüber hinaus kooperieren wir mit IBM und Chartered Semiconductor Manufacturing, um Fertigungsprozesse zu entwickeln, mit denen Logikbauteile in 65- und später auch in 45-Nanometer-Strukturen hergestellt werden können. Dazu haben rund 200 Ingenieure der drei Partnerfirmen in einem Entwicklungslabor von IBM bereits die Arbeit aufgenommen. In Dresden haben wir mit AMD und DuPont Photomasks das gemeinsame Maskenzentrum Advanced Mask Technology Center (AMTC) errichtet, um die lithographischen Masken der nächsten Generationen zu entwickeln und zu produzieren.

Sinkende Kosten durch ein flexibles Partnerschaftsnetzwerk

Auch in der Fertigung setzt Infineon zunehmend auf Kooperationen. Indem wir unsere innovativen Technologien an Partner lizenzieren und uns gleichzeitig Abnahmerechte sichern, senken wir zum einen unsere Investitionskosten und können zum anderen besser auf wechselnde Marktbedingungen reagieren. So kann Infineon beispielsweise mit seinem Partner Winbond zusätzliche Kapazitäten schnell und flexibel anbieten.

Außerdem haben wir unsere Zusammenarbeit mit dem chinesischen Auftragshersteller Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) intensiviert.

Infineon verfügt hier über das exklusive Fertigungs- und Abnahmerecht an DRAMs aus der 200- und 300-Millimeter-Fertigung. In Suzhou entsteht zudem ein neues Werk für die Endfertigung von Speicherchips, das Infineon mit China-Singapore Suzhou Indus-

trial Park Venture (CSVC) errichtet. Dieses Joint Venture stärkt entscheidend unsere Position im Zukunftsmarkt China (vgl. S. 26 „Globale Präsenz“).

Um darüber hinaus die Investitionen in unsere eigene Fertigung bestmöglich zu nutzen, greifen wir auf Synergien zurück, die sich zwischen der Speicher- und der Logikproduktion ergeben. Als einer von wenigen Halbleiterherstellern vereinen wir die Produktion von Speicher- und Logikchips unter einem Dach; ein Großteil der Fertigungsanlagen ist für beide Arten von Bauelementen einsetzbar. Damit können wir bei Bedarf zwischen Logik- und DRAM-Fertigung wechseln, Schwankungen der Marktsegmente ausgleichen und die Auslastung in unseren Fertigungsstätten weiter erhöhen.

Schlanke Fertigungslogistik senkt Kosten und verkürzt die Lieferzeiten zum Kunden

Wir betrachten es als unsere fortlaufende Aufgabe, Fertigung und Logistik weiter zu optimieren. Beispielsweise haben wir unsere Fertigungslogistik konsequent verbessert, sodass die Durchlaufzeiten vom Auftragseingang bis zur Warenauslieferung im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als 25 Prozent verringert wurden. Dadurch werden Kundenaufträge deutlich schneller und flexibler als in der Vergangenheit ausgeführt. Gleichzeitig konnten wir Liefertreue und -fähigkeit signifikant steigern.

Mit all diesen Maßnahmen haben wir uns im Bereich Fertigung und Logistik weltweit erneut eine Spitzenstellung gesichert und unsere Technologieführerschaft bestätigt. Diese werden wir auch im Geschäftsjahr 2004 kontinuierlich ausbauen und optimieren.

Im AMTC, dem neuen Maskenzentrum in Dresden, entwickeln und produzieren wir modernste lithographische Masken.

Ressourcen effizienter nutzen

Flow-Thru-Chips beschleunigen die Entwicklung neuer Medikamente und optimieren Therapiemöglichkeiten.

OptiMOS, CoolMOS und LightMOS sorgen als Spezialtransistoren bei Elektrogeräten für deutlich geringeren Energieverbrauch.

IGBTs optimieren die Steuerung von Elektromotoren und erhöhen deren Wirkungsgrad in Maschinen und Zügen erheblich (→ Insulated Gate Bipolar Transistor).

Dr. Michaela Fritz, bei Infineon als Produktmanagerin maßgeblich beteiligt an der Vermarktung des Flow-Thru-Chips für schnelle Genanalysen in der pharmazeutischen und klinischen Forschung. Nur ein Beispiel dafür, wie Infineon Ressourcen besser nutzbar macht.



Personelles Engagement

Unternehmenswandel mit den Mitarbeitern gestalten

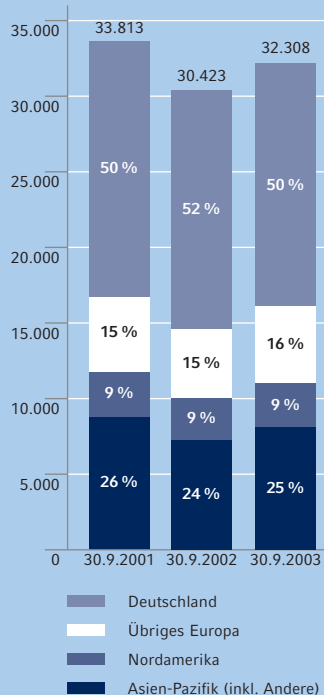
- **Unternehmerisches Denken fördern – neue Programme stärken die Eigenverantwortung und Identifikation mit Infineon**
- **Anreize schaffen – Qualifikationsmaßnahmen und flexible Vergütung motivieren die Mitarbeiter**
- **Vielfalt nutzen – internationale Expertenteams und Netzwerke unterstützen das globale Denken**

fördern wir die Eigeninitiative und Selbstverantwortung unserer Mitarbeiter und stärken ihre Identifikation mit Infineon.

■ Wir fordern und fördern jeden einzelnen unserer über 32.000 Mitarbeiter entsprechend seinen individuellen Leistungen und Potenzialen. Wir schaffen für jeden Mitarbeiter die Voraussetzungen, optimale Leistungen zu erbringen.

■ Um als global agierendes Unternehmen marktgerecht zu arbeiten, richten wir die Personalpolitik flexibel und international aus.

Mitarbeiter in den Regionen



Zum 30. September 2003 waren weltweit 32.308 Mitarbeiter für Infineon tätig, 1.885 mehr als im Vorjahr. Über 1.000 Mitarbeiter haben wir allein in Asien gewonnen, wo inzwischen 8.234 Menschen für Infineon arbeiten. Zuwächse verzeichneten wir zudem v. a. in Deutschland (450 neue Mitarbeiter) und den anderen europäischen Ländern (444 neue Mitarbeiter).

Eine Unternehmensstrategie kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Mitarbeiter, die sie umsetzen, optimale Rahmenbedingungen vorfinden. Interessante Herausforderungen, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und eine entsprechende Anerkennung für die geleistete Arbeit motivieren Mitarbeiter, sich zu engagieren und den Wandel des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Die Voraussetzungen hierfür zu schaffen und so unsere Unternehmensziele zu unterstützen liegt in der Verantwortung des Personalmanagements.

Zentrale Aufgaben für die Personalpolitik

Kundenorientierung, Internationalität und Flexibilität stehen nicht nur für die Unternehmensausrichtung Infineons, sondern charakterisieren gleichzeitig auch unsere Art zu arbeiten. Daraus ergeben sich mehrere zentrale Aufgaben, die die Personalpolitik bei Infineon bestimmen:

- Wir unterstützen den entscheidenden Unternehmenswandel bei Infineon: die Weiterentwicklung von einem technologiegetriebenen zu einem gleichzeitig auch kundenorientierten Unternehmen. Dafür

Personalmanagement neu aufgestellt

Damit wir diesen Aufgaben gerecht werden können, haben wir das Personalmanagement im vergangenen Geschäftsjahr neu aufgestellt. Die Kernaspekte unserer Personalpolitik – Kundenorientierung, Operational Excellence und strategische Services – prägen unsere Personalarbeit dabei weiterhin. Neben Human Resources ist der Bereich People & Organization entstanden, in dem wir künftig strategische Aktivitäten bündeln. Von diesem Bereich aus steuern wir unter anderem die Personalstrategie und alle Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung sowie Personalsysteme und -prozesse, gestalten das Recruiting und organisieren die Betreuung unserer Führungskräfte.

In enger Abstimmung werden beide Bereiche, Human Resources sowie People & Organization, das weltweite Personalmanagement noch besser auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens ausrichten und einen perfekten Service für alle Mitarbeiter von Infineon bieten.

Den Unternehmenswandel unterstützen

Ganz gleich, in welcher Region und in welchem Geschäftsbereich unsere Mitarbeiter tätig sind: Um schneller als der Markt und besser als die Konkurrenz zu sein, unterstützen wir sie dabei, als Unternehmer im Unternehmen zu denken und zu handeln. Kundenausrichtung, globale Identität sowie Leistungsorientierung zeichnen Infineon aus.

Dies fördern wir mithilfe des Infineon Institute, das aus der Infineon University entstanden ist und die Aktivitäten der unternehmensweiten Personal- und Organisationsentwicklung sowie des Wissensmanagements bündelt. Unter anderem erarbeiten wir im Infineon Institute innovative Konzepte zu den Themenbereichen Führung und Veränderung und bauen darüber hinaus eine unternehmensweite Infrastruktur als Basis für globales und effizientes Lernen auf.

Zentrale Programme 2003

Mit der Top-Management-Konferenz haben wir eine Dialogplattform etabliert, in deren Rahmen der Vorstand und das Top-Management jährlich zusammentreffen, um den Status quo und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens zu diskutieren.

Zielgerichteter Wissenstransfer und Dialog kennzeichnen auch die Projektmanager-Foren am Infineon Institute. Das im Jahr 2003 initiierte Programm bietet Projektleitern die Möglichkeit, gezielt verschiedene Trainingsprogramme in Anspruch zu nehmen sowie Know-how und Erfahrungen mit Kollegen aus allen Bereichen und Regionen des Konzerns auszutauschen.

Über das neu ins Leben gerufene Global-Lead-Programm verankern wir konzernweit zentrale Ansätze, wie Unternehmertum und Führung. So genannte „Change Agents“ aus dem Top-Management garantieren, dass sukzessive alle Mitarbeiter in diesen Prozess eingebunden werden.

Darüber hinaus haben wir im Juli 2003 ein Programm zum weltweiten Ideenmanagement gestartet: Bei YIP („Your Idea Pays“) steht die Förderung der Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter im Vordergrund – bei gleichzeitiger Nutzung von Kosteneinsparpotenzial.

Auf allen Ebenen gezielt weiterqualifizieren

Wir arbeiten gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Ebenen und alle Bereiche des Unternehmens aus. Speziell den Auf- und Ausbau neuer Standorte, wie etwa in den vergangenen Jahren in Dresden oder Porto, begleiten wir von Anfang an mit zahlreichen berufsbegleitenden Kursen und Trainings. In Dresden, wo Infineon in einem der weltweit modernsten Werke Speicherchips produziert, bündeln wir dieses Angebot beispielsweise in der „dresden chip academy“: Im vergangenen Geschäftsjahr nahmen dort insgesamt 2.500 Produktionsmitarbeiter Fortbildungsmaßnahmen wahr.

Mentorenprogramm

2003 haben wir damit begonnen, ein Mentorenprogramm auf Managementebene zu etablieren. Erfahrene Top-Manager agieren als „Mentoren“ und geben Wissen und Erfahrung aus ihrer täglichen Arbeit weiter. Auf diese Weise bauen wir ein Netzwerk auf, von dem insbesondere unsere Nachwuchskräfte profitieren.

Das Infineon Institute bündelt unsere Aktivitäten der Personal- und Organisationsentwicklung sowie des Wissensmanagements.

**Engagement wird belohnt.
Wir fördern unsere Nach-
wuchskräfte.**

Juniorenkreise

Juniorenkreise sind ein weiteres Beispiel dafür, wie sich speziell junge Mitarbeiter bei Infineon über ihren eigentlichen Arbeitsbereich hinaus engagieren. Nachwuchskräfte werden mit den globalen Entwicklungen in ihrem Geschäftsbereich und im gesamten Konzern vertraut gemacht. Sie tauschen sich regelmäßig mit dem Management aus, realisieren standortübergreifende Projekte und bringen neue Ideen in das Unternehmen ein.

Markt-, erfolgs- und leistungsorientierte Vergütung

Wir bauen die Vergütung bei Infineon zu einem international einsetzbaren strategischen Führungs- und Steuerungsinstrument aus und honorieren auf diesem Weg das unternehmerische Handeln unserer Mitarbeiter.

Infineon arbeitet mit einem weltweit einheitlichen Ansatz und kombiniert fixe und variable Einkommensbestandteile. Der variable Anteil orientiert sich an Unternehmens- und individuellen Zielen für jeden einzelnen Mitarbeiter. Die Basis der Zielstruktur und Einkommensbandbreiten bilden Global Grades und lokale Marktdaten.

Darüber hinaus setzt Infineon weiterhin bewusst auf Aktienoptionen als Instrument der Mitarbeitermotivation und -bindung und beteiligt seine Mitarbeiter damit direkt am Unternehmenserfolg.

Internationalisierung und Flexibilität

Bereits heute prägen Menschen aus 82 Nationen die Unternehmenskultur Infineons und bringen unterschiedlichste Kenntnisse und Fähigkeiten in den Konzern ein. Um von dieser Vielfalt im gesamten Unterneh-

men zu profitieren, setzen wir das Konzept der Managing Diversity seit langem erfolgreich in die Praxis um. In international besetzten Expertenteams und über globale Netzwerke führen wir die Kompetenzen unserer Mitarbeiter zusammen und bauen Geschäftsbeziehungen in verschiedenen Kulturkreisen erfolgreich aus.

Auslandseinsätze

Wie intensiv das Know-how unserer Mitarbeiter auch im Geschäftsjahr 2003 weltweit zum Einsatz kam, zeigt sich insbesondere an den zahlreichen Auslandseinsätzen. Komplette Expertenteams wechseln für einen bestimmten Zeitraum den Arbeitsplatz, um am Aufbau von Joint Ventures oder neuen Standorten mitzuarbeiten. Im vergangenen Geschäftsjahr unterstützten zum Beispiel 50 Experten in Hsinchu, Taiwan, die Entwicklung von Prozesstechnologien für Logik-ICs.

Internationale Nachwuchsprogramme

Wir pflegen unsere Kontakte zu Universitäten und Schulen über Gastprofessuren, Stiftungslehrstühle und Forschungskooperationen. Darüber hinaus holen wir junge Talente direkt ins Unternehmen: zum Beispiel über das College Program, in dessen Rahmen wir Studenten anspruchsvolle Praktika anbieten, über das Student MemberChip Program, das sich an international orientierte Studenten wendet, oder das International Graduate Program. Dieses führt Trainees im In- und Ausland durch verschiedene Stationen bei Infineon. Der Erfolg dieser Maßnahmen gibt uns Recht: Infineon hat unter Akademikern seinen Platz als beliebter Arbeitgeber gefestigt. Dieses Image wollen wir weiter ausbauen – besonders auf internationaler Ebene.

**82 Nationen arbeiten
bei Infineon weltweit
unter einem Dach.**

Ökologisches Engagement

Umweltschutz – mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis

- **Ressourcen sparen durch neue Technologien**
- **Umweltbericht mit Umwelterklärungen vorgelegt**
- **Interner Environment, Safety and Health (ESH) Award zum zweiten Mal vergeben**

Zu unseren unternehmerischen Pflichten zählt auch der verantwortungsbewusste Umgang mit Mensch und Natur. Wir sind überzeugt, dass die Natur in erster Linie durch kontinuierliche Maßnahmen wirksam geschützt werden kann. Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz sind deshalb bereits seit vielen Jahren integraler Bestandteil unserer Geschäftsprozesse.

Verantwortungsvoller Einsatz von Ressourcen

Halbleiter können nicht ohne den Einsatz von Chemikalien gefertigt werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit diesen Stoffen sparsam und gezielt umgehen. Fast alle Produktionsprozesse, bei denen Gefahrstoffe eingesetzt werden, finden in geschlossenen Systemen statt. Besonders strenge Regeln gelten dort, wo Menschen mit gefährlichen Chemikalien in Berührung kommen könnten: Diese Mitarbeiter werden regelmäßig arbeitsmedizinisch betreut und im Rahmen eines Biomonitorings untersucht.

Dass Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze sein müssen, zeigt die Umstellung auf die 110-Nanometer-Technologie an unserem Dresdner Standort. Mit ihr ist es möglich, 50 Prozent mehr 256-Megabit-DRAMs auf einem Wafer zu produzieren. Das senkt die

Kosten um 30 Prozent im Vergleich zur Vorgängertechnologie und verbraucht gleichzeitig deutlich weniger Ressourcen. Aber auch bei der Optimierung unserer Infrastrukturanlagen spielen Umweltaspekte eine wichtige Rolle. Beispielhaft ist hierfür das Energienutzungskonzept an unserem Standort Regensburg. In der Vergangenheit wurde das Prozesswasser über das Heizsystem erwärmt, jetzt nutzen wir die Abwärme der Kältemaschinen. Im Ergebnis ließen sich hier im abgelaufenen Geschäftsjahr 307.000 Kilowattstunden Energie einsparen. Trotz unserer Leistungen, Ressourcen sparsam zu nutzen, war im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Anstieg des Verbrauchs von Wasser sowie von Primär- und Sekundärenergie von jeweils zirka 13 Prozent zu verzeichnen, normiert auf Umsatzkosten. Dies lässt sich durch die erhebliche Ausweitung der Volumenproduktion in unserem Unternehmen erklären.

Umweltschutz mit Konzept: Zertifizierung und Dokumentation

An fast allen unserer Produktionsstätten (vgl. S. 26 „Globale Präsenz“) haben wir mittlerweile unser Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm EN/ISO 14001 zertifiziert. In Richmond/Virginia und dem ungarischen Cegléd finden die Audits zur Aufnahme in das Matrixzertifikat im Geschäftsjahr 2004 statt. Auch an neuen Standorten, wie beispielsweise bei SensoNor, dem erst kürzlich übernommenen Sensorenhersteller in Norwegen, haben wir bereits mit der Planung der Arbeiten für die Zertifizierung begonnen.

Die Dokumentation umweltrelevanter Daten konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr

In allen Bereichen gehen wir verantwortungsbewusst mit Mensch und Natur um.

Ökologie und Ökonomie sind bei uns keine Gegensätze.

Unsere Produkte leisten einen positiven Beitrag zum Umweltschutz und helfen etwa beim Sparen von Strom und Kraftstoff.

mithilfe eines weltweiten intranetgestützten Systems erheblich verbessern. Ein gutes Stück vorangekommen sind wir beim Aufbau unserer SAP-Chemikaliendatenbank, die das Wissen um die eingesetzten Chemikalien systematisiert und die Gefahreneigenschaften dieser Stoffe beschreibt. Inzwischen ist die Datenbank an den beiden Münchner Standorten, in Regensburg, Dresden und Villach verfügbar.

Erstmals Umweltbericht veröffentlicht

Drei Jahre nach unserem Börsengang haben wir erstmals einen ausführlichen Umweltbericht veröffentlicht. Dieser enthält Wissenswertes über all unsere Aktivitäten und Leistungen im Umweltschutz und gibt Auskunft über die umweltrelevanten Daten unserer Produktionsstandorte. Für die Dresdner Unternehmen bereitet der Umweltbericht 2002 einen völlig neuen Weg: Er stellt für Dresden zugleich die Umwelterklärungen nach der europäischen Verordnung „... über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS)“ dar.

Der Umweltbericht beschreibt zum Beispiel ausführlich unser Engagement bei der Emissionsreduzierung perfluorierter Verbindungen (PFC), bestimmter Treibhausgase. Infineon gehört hier zu den Vorreitern in der Branche, da wir uns maßgeblich für die freiwillige Verpflichtung der europäischen Halbleiterindustrie einsetzen: Bis 2010 werden wir im Vergleich zum Jahr 1995 die PFC-Emissionen um zehn Prozent senken (gerechnet in Kohlenstoffdioxid-Äquivalenten). Unterstellt man ein Volumenwachstum der Halbleiterindustrie von jährlich rund

15 Prozent, entspricht dies einer Senkung um 90 Prozent.

Mit Infineon-Produkten die Umwelt schützen

Nicht nur bei der Herstellung unserer Halbleiterbauelemente achten wir auf den Umweltschutz: Unsere Produkte selbst leisten einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt. Der Endverbraucher fordert heutzutage elektronische Geräte, die komfortabel sind und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen (vgl. S. 24 „Kunde im Fokus“). Diese Forderung erfüllen wir: So benötigen Computer mit unseren innovativen Speicherchips weniger Strom. Bei Autos helfen Infineon-Bauelemente für die elektronische Motorsteuerung, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Denselben Effekt erreichen Reifendrucksensoren von SensoNor.

Engagement im Umweltschutz lohnt sich

Zahlreiche Auszeichnungen für unsere Leistungen auf diesem Gebiet, wie beispielsweise der Industrial Water Quality Award 2003 für unseren Standort Richmond, zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und auch unsere Mitarbeiter werden für ihre Ideen und ihr Engagement belohnt: 2003 haben wir zum zweiten Mal den Environment, Safety and Health (ESH) Award vergeben. Mit diesem Preis werden die besonderen Leistungen unserer Mitarbeiter bei der Verbesserung unseres betrieblichen Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes gewürdigt. Aus zahlreichen eingereichten Projekten wurden folgende drei ausgewählt:

■ In einem weltweiten Projekt ist es abteilungsübergreifend gelungen, blei- und halogenfreie Produkte zu entwickeln. Da-

Unsere Mitarbeiter werden für Engagement im Umweltschutz belohnt.

durch können bei mindestens gleich bleibender Qualität schadstofffreie und noch umweltfreundlichere Produkte angeboten werden. In 2004 wird die Mehrzahl unserer Produkte umgestellt sein.

■ Unsere Mitarbeiter in Porto, Portugal, haben durch Energieeinsparungen einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Sie haben ihr Ziel, den spezifischen Energieverbrauch (gemessen in Kilowattstunden pro Gigabit) am Standort in den letzten drei Geschäftsjahren jeweils um 20 Prozent zu reduzieren, sogar noch übertroffen.

■ In einem Projekt am Fertigungsstandort Malacca, Malaysia, konnten im Geschäftsjahr 2002 durch erhebliche Energieeinsparungen die Kohlenstoffdioxid-Emissionen um knapp 7.500 Tonnen reduziert werden.

Gleichzeitig sind damit erhebliche Kosteneinsparungen in den nächsten Jahren verbunden.

Mit High Tech die Umwelt schützen

Als High-Tech-Unternehmen sehen wir uns in der besonderen Verantwortung, unser Know-how zum Wohl der Umwelt und zum Schutz der Mitarbeiter einzusetzen. Unsere Projekte und Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten erneut zeigen, dass technologischer Fortschritt und Ökologie keine Gegensätze sein müssen, sondern dass High Tech einen großen Beitrag zur Schonung der Umwelt leisten kann. Weitere Initiativen und Ergebnisse unseres ökologischen Engagements finden sich im Umweltbericht 2002. Der Umweltbericht 2003 wird Anfang 2004 erscheinen und ist auf Anfrage erhältlich.

Die Initiativen und Ergebnisse unseres ökologischen Engagements fassen wir im Umweltbericht zusammen.



Alltag komfortabler gestalten

RFID-Chips als kontaktlose Systeme machen elektronische Fahrscheine für öffentliche Verkehrsmittel möglich (→ Radio Frequency Identification).

Mobile-RAMs speichern Daten mobiler Endgeräte wie PDAs und Smartphones stromsparender und ermöglichen so eine wesentlich längere batteriebetriebene Nutzung.

Telematik führt mittels Navigation und Informationsabruf im Fahrzeug bequem ans Ziel (→ Telematics Communication Gateway).

Dorothee Göbel treibt bei Infineon im Business Development die Entwicklung von RFIDs voran. Nur ein Beispiel dafür, wie Infineon für mehr Komfort im Alltag sorgt.

Inhaltsverzeichnis

48 BERICHT DES AUFSICHTSRATS AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG

51 CORPORATE GOVERNANCE

55 KONZERNLAGEBERICHT

57 Überblick

63 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

73 Darstellung der Finanzlage

79 Mitarbeiter und Campeon

80 Risiken und Chancen

84 Infineon Technologies AG

85 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

86 Ausblick

87 BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER

88 KONZERNABSCHLUSS

88 Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen

89 Konzern-Bilanzen

90 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen

92 Konzern-Kapitalflussrechnungen

94 ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS

94 Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung

94 Bilanzierung und Bewertung

98 Akquisitionen

100 Aufgegebene Geschäfte und Geschäftsanteilsveräußerungen

102 Lizenzen und Know-how-Überlassungsverträge

102 Zuwendungen der öffentlichen Hand

102	Zusätzliche Angaben zu betrieblichen Aufwendungen
103	Umstrukturierungsmaßnahmen
103	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
106	Ergebnis je Aktie
107	Wertpapiere
108	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
108	Vorräte
108	Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände
109	Sachanlagen
109	Finanzanlagen
111	Sonstige Vermögensgegenstände
112	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
113	Rückstellungen
113	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
113	Finanzverbindlichkeiten
115	Sonstige Verbindlichkeiten
115	Grundkapital
116	Aktienoptionspläne
119	Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren
119	Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung
119	Verbundene Unternehmen
121	Pensionsverpflichtungen
124	Derivative Finanzinstrumente
125	Risiken
125	Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten
130	Segmentberichterstattung
133	Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
133	Ergänzende Erläuterungen
137	Vorstand und Aufsichtsrat
143	Wesentliche Beteiligungen

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Mit großer Begeisterung!



Max Dietrich Kley,
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen der jeweiligen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus legte er uns ausführliche Quartalsberichte vor und berichtete zusätzlich schriftlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen unterrichten lassen.

Auch in diesem Geschäftsjahr nahm die anhaltend schwierige Situation des Halbleitermarkts, insbesondere der andauernde starke Preisdruck sowie der ungünstige Wechselkurs von Euro und Dollar, einen großen Teil der Arbeit des Aufsichtsrats in Anspruch. Vor allem die erste Hälfte des Geschäftsjahrs war von Preiseinbrüchen bei den Speicherprodukten von bis zu 50 Prozent gekennzeichnet. Außerdem kam es zu einem weiteren Rückgang bei Infrastrukturinvestitionen von Telekommunikationsunternehmen. Der Aufsichtsrat hat in seinen Beratungen die Entwicklung des Halbleitermarkts und die Situation von Infineon in diesem Markt sehr aufmerksam verfolgt. Im Zusammenhang damit hat sich der Aufsichtsrat ausführlich über die Lage der Geschäftsbereiche Speicherprodukte und Drahtgebundene Kommunikation berichten lassen und mit dem Vorstand die weitere Ausrichtung dieser beiden Geschäftsbereiche erörtert. Erfreulicherweise ist der Geschäftsbereich Speicherprodukte im zweiten Halbjahr in die Gewinnzone gekommen und hat diese ausgebaut, um letztlich sogar für das gesamte Geschäftsjahr ein positives Ergebnis zu erzielen. Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation hat sich im letzten Quartal deutlich verbessert und ist in die Nähe des Break-Even gekommen.

Wir sind optimistisch, dass sich die Nachfragesituation sowohl in den Logik-Segmenten als auch bei den Speicherprodukten weiter verbessern wird. Gleichwohl stimmen Aufsichtsrat und Vorstand darin überein, dass auch weiterhin konsequent Produktivitäts- und Kosteneinsparmaßnahmen umgesetzt werden müssen, um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.

Der Aufsichtsrat hat sich in einer Sitzung ausführlich über die Entwicklung der bisher getätigten Unternehmensakquisitionen informiert; ein Schwerpunkt bildete dabei die Akquisition der Ericsson Microelectronics AB, Stockholm, Schweden.

Weiterhin hat sich der Aufsichtsrat mit der Ende des Geschäftsjahrs 2002 verabschiedeten Agenda 5-to-1 beschäftigt, insbesondere sich über die Programme zur Umsetzung der in der Agenda definierten strategischen Ziele informiert.

Schließlich bildete das Thema Corporate Governance einen weiteren Schwerpunkt der Aufsichtsratsarbeit in diesem Geschäftsjahr. In seiner Sitzung im November 2002 beschloss der Aufsichtsrat die Einrichtung eines Prüfungsausschusses (Audit Committee) durch

Erweiterung der Aufgaben des bereits bestehenden Investitions- und Finanzausschusses um die Aufgaben und Befugnisse eines Prüfungsausschusses und der entsprechenden Umbenennung in „Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss“. In der November-Sitzung wurde auch der Infineon Corporate Governance Kodex durch den Aufsichtsrat verabschiedet und damit ein wichtiger Eckpfeiler des Infineon Corporate Governance Systems implementiert. Die Änderungen am Deutschen Corporate Governance Kodex vom Mai 2003 hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Juli 2003 ausführlich diskutiert und darüber beschlossen. Die Entsprechenserklärung 2003 gemäß § 161 Aktiengesetz hat der Aufsichtsrat im November 2003 beschlossen. Auf Seite 51 dieses Geschäftsberichts ist das Infineon Corporate Governance System detailliert beschrieben.

In seiner Sitzung im November 2002 entschied der Aufsichtsrat, die Mandate der Vorstandsmitglieder Dr. Schumacher, Bauer, Fischl und Dr. v. Zitzewitz um fünf Jahre zu verlängern. Wegen der Verkleinerung des Vorstands auf vier Mitglieder schied Herr Dr. Sönke Mehrgardt mit Auslaufen seines Vertrages zum 30. September 2003 aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Mehrgardt seinen Dank für die geleistete Arbeit ausgesprochen.

Der Präsidialausschuss hat im November 2003 beschlossen, im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2004 die Vergütungsregelungen für den Vorstand unter Hinzuziehung eines externen Beraters und unter Berücksichtigung des erreichten Stands des Deutschen Corporate Governance Kodex sowie der Wettbewerbssituation in der internationalen Halbleiterindustrie hinsichtlich der fixen und der variablen Vergütungen sowie der Aktienoptionspläne zu überprüfen und entsprechend anzupassen.

Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse

Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden im Berichtsjahr ausschließlich in den Sitzungen gefasst. Der Präsidialausschuss trat im Berichtsjahr viermal zusammen, insbesondere befasste er sich mit der Verlängerung der Vorstandsverträge.

Der Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr fünfmal getagt. Schwerpunkte der Sitzungen des Ausschusses waren die Prüfung der Zwischenabschlüsse, Vorprüfung des Jahresabschlusses, die Erörterung des Prüfungsberichts mit dem Wirtschaftsprüfer, die Prüfung der Investitionsplanung, die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte sowie die Prüfung zustimmungspflichtiger Geschäfte, insbesondere die Errichtung des Gemeinschaftsunternehmens mit der Firma Nanya in Taiwan, der Verkauf der Aktien an der Gesellschaft ProMOS Technologies Inc. und die Platzierung einer Wandelanleihe.

Der gemäß § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss musste nicht einberufen werden.

Jahres- und Konzernabschluss

Den Jahresabschluss der Infineon Technologies AG zum 30. September 2003, den nach den Vorschriften der US-GAAP unter Anwendung der Befreiungsvorschrift des § 292 a HGB aufgestellten Konzernabschluss zum 30. September 2003 sowie den zusammengefassten Lagebericht der Infineon Technologies AG und des Konzerns hat die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir haben diese Unterlagen auch selbst geprüft.

Die Berichte der KPMG über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden zunächst in der Sitzung des Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschusses am 6. November 2003 und dann in unserer Bilanzsitzung am 19. November 2003 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung berichtet. Wir hatten keine Einwendungen und stimmen dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Infineon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Leistung im Geschäftsjahr 2003. Darüber hinaus dankt der Aufsichtsrat den Betriebsräten für ihre konstruktive Mitwirkung.

München, im November 2003

Für den Aufsichtsrat



Max Dietrich Kley
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Corporate Governance

Unser ganzheitliches Konzept

- **Corporate Governance – unser ganzheitliches Konzept**
- **Infineon-Kodex auf unser besonderes Geschäftsumfeld zugeschnitten**
- **Ganzheitliches Konzept zur Umsetzung der unternehmerischen Ziele und Erfassung aller unternehmerischen Prozesse**
- **Corporate Governance-Beauftragter berichtet direkt an Vorstand und Aufsichtsrat**

Corporate Governance – das sind Standards guter und verantwortlicher Unternehmensführung. Unser Corporate Governance-System umfasst das gesamte Unternehmen und orientiert sich an unserer Firmenstrategie: Infineon entwirft, produziert und verkauft die modernsten Halbleiterlösungen, bietet effektive Halbleiterdienstleistungen und ist Branchenführer bei Innovation und Kundenorientierung. Unser oberstes Gebot ist die Kundenorientierung, um Mehrwert zu produzieren, von dem neben unseren Kunden auch unsere Aktionäre und Mitarbeiter profitieren sollen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Infineon verstehen unter Corporate Governance ein ganzheitliches Konzept, das alle unternehmerischen Werte, Prozesse und Ziele einschließt, die unserem unternehmerischen Auftrag dienen. Es umfasst die Standards des internen Controllings, die „Business Conduct Guidelines“ (Leitlinien für das unternehmerische Verhalten im Wettbewerb) und auch die Regelungen, die die Organisations- und Aufsichtspflichten

des Unternehmens betreffen. Wir haben einen Corporate Governance-Beauftragten berufen, der direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Ein wesentliches Element des Konzepts ist der speziell für die Anforderungen unseres Geschäftsumfelds konzipierte Infineon-Corporate Governance-Kodex.

Auf dieser Grundlage wollen wir die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben – und zu den Unternehmen mit der besten Corporate Governance gehören.

Infineon hält hohe Standards ein

Infineon hat fast alle Regelungen übernommen, die die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ empfiehlt oder anregt, außerdem entsprechen wir den Vorgaben des US-amerikanischen Kapitalmarktrechts. So haben wir z. B. in der Directors- & Officers-Versicherung einen Selbstbehalt der Mitglieder des Vorstands von 25% und des Aufsichtsrats von 100% des jeweiligen Jahresfixums vereinbart.

Infineon hat sich über die Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex hinaus zusätzliche Ziele hinsichtlich guter Unternehmensleitung und -überwachung gesteckt:

- Wir werden unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit weiterhin umfassend und offen über das Unternehmen informieren.
- Wir wollen die Aktionäre bei der Ausübung ihrer Rechte so weit wie möglich unterstützen. Die Aktionäre können sich zum Beispiel online zur Hauptversammlung anmelden, über das Internet an Abstimmungen teilnehmen oder die Generaldebatte im Internet verfolgen.

■ Wir werden die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat noch weiter stärken. Wir sind davon überzeugt, dass das deutsche System der Trennung von Unternehmensleitung und -kontrolle die beste Voraussetzung für gute Corporate Governance ist. Jedoch erreichen wir unsere Ziele nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat. Deshalb wollen wir das positive Klima offener und respektvoller Gespräche weiter fördern.

■ Die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden ist nur mit fähigen und engagierten Mitarbeitern möglich. Vorstand und Aufsichtsrat sehen es als gemeinsame Aufgabe an, die größten Talente für das Unternehmen zu gewinnen und zu halten.

Ständige Überprüfung des Regelwerks

Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräfte sorgen dafür, dass unser Corporate Governance-Regelwerk aktiv im Unternehmen gelebt wird. Darüber hinaus wird es in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt. So haben wir im Juli 2003 die Änderungen der Regierungskommission am Kodex abermals überprüft. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, nicht alle Änderungen für Infineon zu übernehmen, weil einige dem Unternehmen nicht gerecht werden. Wir werden zum Beispiel auf die individualisierte Angabe der Vergütungen von Vorstand und Aufsichtsrat verzichten. Nach zwingendem deutschem Aktienrecht ist der Vorstand insgesamt für die wertschaffende Führung des Unternehmens verantwortlich. Auch nach der Geschäftsordnung des Infineon-Vorstands leiten alle Mitglieder das Unternehmen gemeinsam. Alle wesentlichen Entschei-

dungen müssen im Gesamtvorstand getroffen werden und bedürfen der Einstimmigkeit. Deshalb geben wir bei Infineon die Gesamtvergütung des Vorstands, getrennt nach Fixum, erfolgsabhängigen Komponenten und Aktienoptionen an, sodass jeder Aktionär erkennen kann, wie sich die Leistung des Vorstands auf sein Gehalt auswirkt. In einer individualisierten Angabe der Vergütung können wir keinen so großen Informationsgewinn erkennen, dass die Verletzung der Privatsphäre der Mitglieder des Vorstands gerechtfertigt wäre. Auch die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats geben wir nicht individualisiert an. Hier gilt dasselbe wie für den Vorstand. Im Übrigen bestimmen kraft Gesetzes die Aktionäre die Vergütung des Aufsichtsrats; sie haben die Vergütungsregelung in § 11 unserer Satzung in der Hauptversammlung beschlossen. Unsere Satzung finden Sie im Internet unter www.infineon.com und hier unter „Company Information“.

Selbstverständlich informieren wir unsere Aktionäre über die Struktur der Vorstandsvergütung. Das Gesamteinkommen der Vorstandsmitglieder setzt sich zusammen aus dem Jahres-Zieleinkommen (Barvergütung), aus Aktienoptionen und aus einkommenswirksamen Nebenleistungen.

Das Jahres-Zieleinkommen besteht

■ zu 40% aus einem festen Jahresgrundgehalt, das – nach Abzug der gesetzlichen Abgaben – monatlich anteilig ausgezahlt wird, und

■ zu 60% aus dem Jahresbonus als variable erfolgsabhängige Komponente. Im Geschäftsjahr 2003 war der Jahresbonus an

den Erreichungsgrad des Geschäftswertbeitrags (den wir als Geschäftsergebnis nach Steuern abzüglich Kapitalkosten definieren) gekoppelt und in der möglichen Zielerreichungsspanne begrenzt. Der Jahresbonus wird nach Geschäftsjahresende ausgezahlt.

Als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter erhalten die Vorstandsmitglieder Optionen auf Aktien der Infineon Technologies AG aus dem Aktienoptionsplan 2001.

Hinzu kommen Nebenleistungen, z. B. für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung.

Die Vergütungsstruktur für den Vorstand wird nach unserer Geschäftsordnung auch in Zukunft im Präsidialausschuss des Aufsichtsrats beraten und beschlossen, da dieser Ausschuss sich detailliert mit der Leistung der Vorstandsmitglieder befasst und diese bewertet. Das Aufsichtsratsplenum war nach intensiver Diskussion der Ansicht, dass diese Zuweisung weiter sachgerecht ist. Eine Komponente der Vergütung unserer Führungskräfte ist unser Aktienoptionsplan 2001, den Sie im Volltext ebenfalls im Internet unter www.infineon.com einsehen können und dessen Grundzüge wir dort erläutern. Dieser erlaubt die Ausgabe von Optionen an Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen. Wir brauchen dieses Instrument, um auch in Zukunft Talente für uns gewinnen und halten zu können. Sie sind eine Garantie für unseren Erfolg in einem wettbewerbsintensiven und technologiegetriebenen Umfeld. In der

Hauptversammlung 2001 haben unsere Aktionäre als Ausübungsbedingung und -preis eine Wertsteigerung des Aktienkurses von mindestens 5% während der Laufzeit der Optionen festgelegt. Da unsere Wettbewerber oft keine Erfolgshürde vorsehen oder sogar Optionen zu einem Kurs unter dem aktuellen Börsenkurs ihrer Aktien ausgeben, halten wir unseren Aktienoptionsplan im Vergleich dazu für anspruchsvoll, da er an für uns relevante Vergleichsparameter geknüpft ist.

Über das Corporate Governance-System von Infineon informieren wir Sie auf unseren Internet-Seiten www.infineon.com und auf der Hauptversammlung am 20. Januar 2004

Entsprechenserklärung 2003 gem. § 161 Aktiengesetz

„Die Infineon Technologies AG hat seit Abgabe der letzten Erklärung gem. § 161 Aktiengesetz allen Empfehlungen der Regierungskommission ‚Deutscher Corporate Governance Kodex‘ (Fassung 7. November 2002) entsprochen. Sie entspricht allen Empfehlungen der Regierungskommission ‚Deutscher Corporate Governance Kodex‘ (Fassung 21. Mai 2003) mit folgenden Ausnahmen:

- Wir verzichten auf die individualisierte Angabe der Vergütung des Vorstands (Ziffer 4.2.4).
- Auch die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats geben wir nicht individualisiert an (Ziffer 5.4.5).
- Die Struktur des Vergütungssystems des Vorstands (Ziffer 4.2.2) wird im Präsidialausschuss des Aufsichtsrats beraten und beschlossen.“

Weitere Informationen zur Corporate Governance in der Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse finden Sie im Geschäftsbericht im Bericht des Aufsichtsrats. Unser Risikomanagement stellen wir unter „Risiken und Chancen“ vor. Eine detaillierte Erläuterung der Regeln unserer Konzernrechnungslegung finden Sie im Anhang zum Konzernabschluss (vgl. Seite 94 „Finanzbericht“).

Konzernlagebericht

WICHTIGER HINWEIS

Dieser zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht (Lagebericht) sollte im Kontext mit den geprüften Konzernfinanzdaten und den Konzernanhangsangaben, die an anderer Stelle stehen, gelesen werden.

Die geprüften Konzernabschlüsse basieren auf einer Reihe von Annahmen, die detaillierter in den Konzernanhangsangaben Nr. 1 (Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung) und Nr. 2 (Bilanzierung und Bewertung) dargestellt sind.

Da die Infineon Technologies AG („Infineon“ oder die „Gesellschaft“) Teil des konzernweiten Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Marketingnetzwerks ist, wird der Lagebericht der Infineon Technologies AG mit dem des Infineon-Konzerns zusammengefasst.

Die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, die entsprechenden Finanzinformationen der Segmente sowie die Veröffentlichungen der Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 wurden angepasst, um den unten erwähnten Änderungen Rechnung zu tragen. Dieses Vorgehen dient der Konsistenz unserer abgeänderten Berichts- und Präsentationsstruktur und erleichtert die Analyse gegenwärtiger und zukünftiger Finanzinformationen.

■ Mit Wirkung vom 1. Oktober 2002 haben wir die Aktivitäten unserer beiden Segmente Mobile Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs zusammengelegt. Daraus entstand das neue Segment Sichere Mobile Lösungen.

■ Gemäß der Vereinbarung zwischen uns und der OSRAM GmbH („OSRAM“) haben wir sämtliche Aktivitäten des opto-elektronischen Geschäftsbereichs mit Wirkung vom 31. März 2003 an OSRAM übertragen. Das Ergebnis aus der opto-elektronischen Geschäftstätigkeit wurde ursprünglich in den „Sonstigen Geschäftsbereichen“ ausgewiesen. Folglich wird nun das Ergebnis der opto-elektronischen Geschäftstätigkeit als „Ergebnis von aufgegebenen Geschäften“ in den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen ausgewiesen, wodurch sämtliche Umsatzerlöse sowie zugehörige Kosten und Steuern aus unserem Ergebnis der Geschäftstätigkeit herausgenommen werden und als separater Posten aufgeführt werden.

■ Wir definieren EBIT als Ergebnis von fortgeführten Geschäften vor Zinsen und Steuern. In vorangegangenen Berichtsjahren hatten wir die auf konzernfremde Gesellschafter entfallenden Ergebnisanteile vom EBIT ausgeschlossen. Wir haben in dem abgelaufenen Berichtsjahr unsere EBIT-Definition abgeändert, und alle EBIT-Zahlen wurden entsprechend angepasst. Das Infineon-Management nutzt unter anderem das EBIT als Kennzahl für Budget- und operative Zielvorgaben, um seine Geschäfte zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Infineon berichtet EBIT-Daten, um Investoren nützliche Informationen über den operativen Geschäftserfolg der Gesellschaft und im Speziellen über die einzelnen Segmente zur Verfügung zu stellen.

Dieser Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen; Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Planungen, Annahmen und Schätzungen

beruhen. Zukunftsaussagen sind immer nur für den Zeitpunkt gültig, an dem sie gemacht werden. Infineon übernimmt keine Verpflichtung, diese beim Auftreten neuer Informationen zu überarbeiten. Zukunftsaussagen unterliegen immer Risiken und Unsicherheiten. Wir möchten Sie diesbezüglich deutlich darauf hinweisen, dass eine Reihe von Faktoren die tatsächlichen Ergebnisse dahingehend beeinflussen können, dass diese von den prognostizierten wesentlich abweichen. Einige dieser Faktoren sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ und in weiteren Teilen dieses Berichts beschrieben.

Grafiken und Schaubilder, einschließlich der Kommentierung, dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil dieses Lageberichts.

Wir entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie in Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie in Chipkarten, eingesetzt. Unser Leistungsspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Lösungen für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Unsere Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika. Unser Geschäftsjahr endet zum 30. September.

Die Gesellschaft ist schwerpunktmäßig in vier Geschäftsbereichen tätig, welche eine

Vielzahl von Märkten der Halbleiterbranche beliefern:

■ Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Glasfaserbauteile für ein breites Spektrum von Breitband-Kommunikationsanwendungen und Anwendungen mit geringen Übertragungsraten in den Bereichen WAN (Wide Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) und Access (sowohl Breitband als auch traditionelle Zugänge) des drahtgebundenen Kommunikationsmarkts.

■ Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt ein breites Spektrum von Bauelementen für drahtlose Anwendungen, Sicherheitskontrollbauelemente, Speicherspeicherbauelemente und andere Halbleiterprodukte sowie komplette Systemlösungen für Sicherheits- und drahtlose Anwendungen.

■ Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systemlösungen zur Verwendung in der Automobilindustrie und für industrielle Anwendungen.

■ Der Geschäftsbereich Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiter-Speicherprodukte in verschiedenen Gehäusen und Konfigurationen bzw. Architekturen und mit verschiedenen Leistungsparametern für den Einsatz in Standard-, speziellen und eingebetteten Speicheranwendungen.

Überblick

BEGINNENDE ERHOLUNG DER WELTKONJUNKTUR

In der ersten Hälfte des Kalenderjahrs 2003 herrschten ungünstige Rahmenbedingungen am Halbleitermarkt, die im Zusammenhang mit einer schwachen Weltwirtschaft, der politischen Unsicherheit im Irak und der Sorge über die Ausbreitung der Viruskrankheit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) in Asien standen. In der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2003 zeigte die US-Wirtschaft erste Anzeichen eines neuen Wachstumszyklus. Auch die Wirtschaft in der asiatisch-pazifischen Region – insbesondere in China – hat nach einem bis dahin schwächeren Verlauf wieder deutlich zugelegt. In der japanischen Wirtschaft zeigten sich ebenfalls Anzeichen für ein Wirtschaftswachstum nach einer mittlerweile mehr als zehnjährigen Rezessionsphase. Wegen des starken Euro und einer schwachen inländischen Nachfrage sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa nach wie vor schwierig. Dennoch gab es auch hier in einigen europäischen Volkswirtschaften Signale einer wirtschaftlichen Erholung.

Im September 2003 erwartete der Internationale Währungsfonds (IWF) ein weltweites Wirtschaftswachstum von 2,3% für das Jahr 2003, nach 1,9% in 2002. Für 2004 erwartet der IWF ein Wachstum von 3,2%. Wir glauben, dass dieses Wachstum, falls es erreicht wird, sich positiv auf den Halbleitermarkt auswirken wird.

AUF DEM HALBLEITERMARKT MEHREN SICH DIE POSITIVEN ZEICHEN

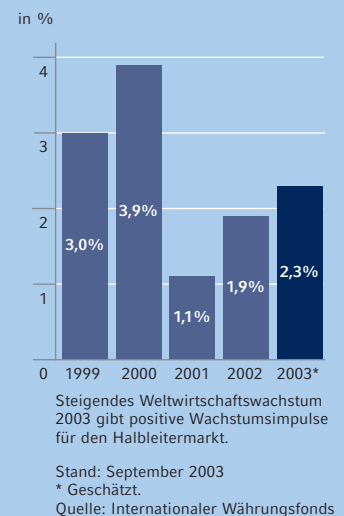
Nachdem der Halbleitermarkt 2002 entsprechend WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) ein nur moderates Wachs-

tum von 1,3% gezeigt hat, befindet er sich im Kalenderjahr 2003 in einer Übergangsphase hin zu einem deutlich höheren Wachstum im Jahr 2004. Für das gesamte Kalenderjahr 2003 sagt WSTS ein Wachstum von 14,2% (Stand: Oktober 2003) voraus. Die Analyse lässt darauf schließen, dass sowohl Nicht-Speicherprodukte (Logikchips, analoge, diskrete und optische Komponenten) als auch Speicherprodukte (DRAM, SRAM und nichtflüchtige Speicher wie z. B. Flash-Memories) zu dieser positiven Entwicklung beitragen werden. Der Bereich der Nicht-Speicherprodukte, der 80% des Gesamtmarkts ausmacht, soll gegenüber 2002 um 13,5% wachsen. Für den Bereich der Speicherprodukte wird im Vergleich zu 2002 sogar ein noch höheres Wachstum von 17,4% prognostiziert. Für das Kalenderjahr 2004 erwartet WSTS ein Wachstum von 19,4% für den weltweiten Halbleitermarkt.

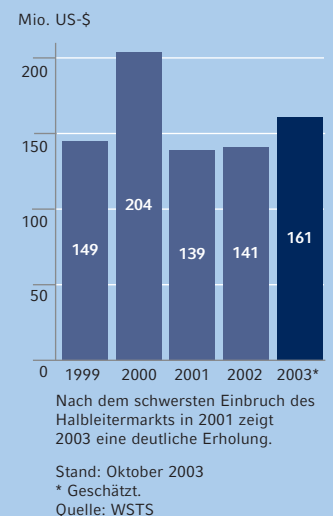
SIGNIFIKANTE ENTWICKLUNGEN WÄHREND DES GESCHÄFTSJAHR 2003

Gegenüber dem massiven Abschwung in den Jahren 2001 und 2002 verbesserte sich im Jahr 2003 unser Marktumfeld wieder. Die Branche ist jedoch nach wie vor geprägt von ungünstigen ökonomischen Rahmenbedingungen, einer schwachen, sich aber leicht verbessernden Nachfrage sowie geringen Investitionen für Technologie. Auf Grund einer gestiegenen Nachfrage und einer günstigeren Preisentwicklung insbesondere im Bereich Speicherprodukte sind wir im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nachstehend folgt ein kurzer Überblick über wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2003:

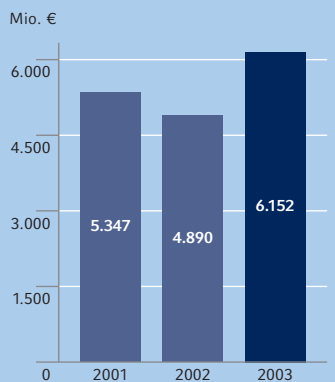
Weltwirtschaftswachstum



Entwicklung des Halbleitermarkts



Umsatzerlöse



Steigende Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2003 und Marktanteilsgewinne im 1. Kalenderhalbjahr 2003.

- Anstieg bei Umsatz und EBIT – im 4. Quartal Rückkehr in die Gewinnzone

- Marktposition ausgebaut

- Deutliche Verbesserung der Liquidität

- Anhaltende Verbesserungen durch unsere Impact- und ACT-Programme

- Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung – Engagement in strategischen Entwicklungspartnerschaften

- Erwerb von SensoNor verbessert Automobil- und Industrieelektronik-Produktportfolio

- Neue Allianzen unterstützen die Wachstumsstrategie

- Kontinuierliche Verbesserung der Fertigung

ANSTIEG BEI UMSATZ UND EBIT – IM 4. QUARTAL RÜCKKEHR IN DIE GEWINNZONE

Trotz der schwierigen Marktbedingungen in dem überwiegenden Teil des Geschäftsjahrs konnte der Konzernjahresfehlbetrag auf 435 Millionen Euro verringert werden. Gründe hierfür waren eine bessere Nachfrage und bessere Preise in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs, kombiniert mit einer verbesserten Produktionskostenstruktur, was zur Rückkehr in die Gewinnzone im 4. Quartal führte. Unsere wesentlichen Finanzdaten lauten wie folgt:

- Wir erzielten im Berichtsjahr 2003 Umsatzerlöse in Höhe von 6.152 Mio. Euro, was einem Anstieg um 26% entspricht (Vorjahr: 4.890 Mio. Euro).

- Unser Konzernjahresfehlbetrag reduzierte sich um 586 Mio. Euro auf 435 Mio. Euro (Vorjahr: 1.021 Mio. Euro).

- Wir reduzierten den Verlust je Aktie um 0,87 Euro auf 0,60 Euro gegenüber 1,47 Euro im Geschäftsjahr 2002.

- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich erheblich um 836 Mio. Euro auf minus 299 Mio. Euro (Vorjahr: minus 1.135 Mio. Euro).

- Der operative Cash Flow von fortgeführten Geschäften verbesserte sich um 505 Mio. Euro auf 731 Mio. Euro gegenüber 226 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002.

Die detaillierte Erläuterung unserer Finanzdaten erfolgt im Abschnitt „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“.

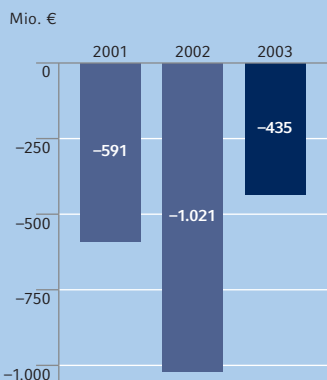
MARKTPosition AUSGEBAUT

Wir konnten auch im ersten Kalenderhalbjahr 2003 gemäß dem Marktforschungsinstitut iSuppli unseren Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr von 3,4% weiter auf 4% steigern. Laut dieser Studie von iSuppli haben wir bei DRAM-Produkten unseren Marktanteil von 13% im ersten Halbjahr 2002 auf 17% im ersten Halbjahr 2003 steigern können und festigten damit unsere Position auf Platz 3 unter den größten DRAM-Herstellern.

DEUTLICHE VERBESSERUNG DER LIQUIDITÄT

Im Geschäftsjahr 2003 konnten wir unsere Liquidität durch Finanzierungsmaßnahmen sowie durch einen deutlich verbesserten Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit wesentlich erhöhen. Als Folge eines verbes-

Konzernjahresfehlbetrag



Durch bessere Nachfrage und optimierte Kostenstruktur konnte ein deutlich verbessertes Ergebnis erwirtschaftet werden.

serten operativen Ergebnisses von fortgeführten Geschäften und intensiven Cash-Managements erhöhte sich der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr auf 731 Mio. Euro gegenüber 226 Mio. Euro im Vorjahr. Im Juni 2003 haben wir eine Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 686 Mio. Euro netto begeben. Den Erlös aus der Emission werden wir zur Finanzierung unserer langfristigen Geschäftsstrategie verwenden.

ANHALTENDE VERBESSERUNGEN DURCH UNSERE IMPACT- UND ACT-PROGRAMME

Das umfangreiche Impact-Kostenreduzierungsprogramm wurde als Reaktion auf den größten Markteinbruch in der Halbleiterindustrie im Juli 2001 gestartet. Durch verringerte Investitionsaufwendungen, die Rationalisierung der Einkaufsprozesse, Mitarbeiter- und Kostenreduzierungen haben wir liquiditäts- und ergebniswirksame Einsparungen erzielt. Das im Geschäftsjahr 2002 gestartete Prozessoptimierungsprogramm Impact² soll derzeitige Prozesse und Strukturen effizienter gestalten.

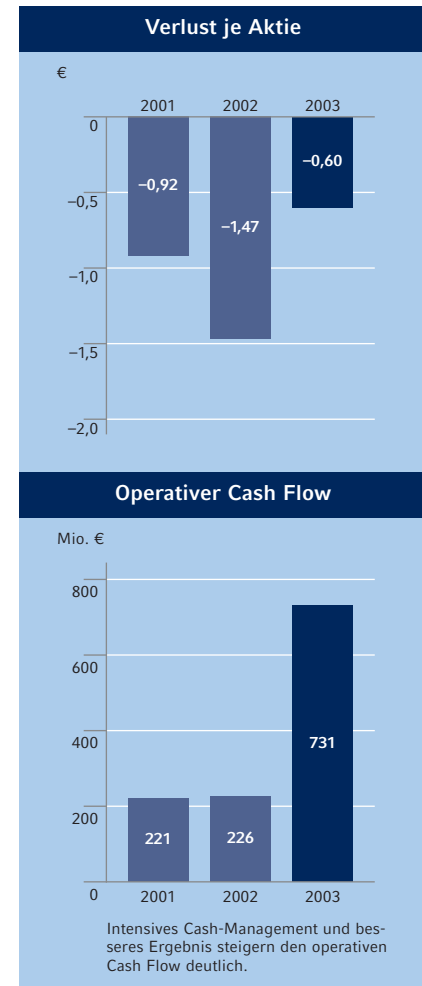
Wir setzen die Bemühungen fort, unsere Prozesse zu verbessern. Das Ganze wird begleitet von der Ausgliederung und Übertragung einzelner Betriebsfunktionen an interne und externe Stellen. Im abgelaufenen Berichtsjahr haben wir den größten Teil unserer europäischen Buchhaltungsprozesse an unseren Standort in Portugal verlegt. Zusätzlich haben wir unsere IT-Betreuung an einen externen Dienstleister ausgegliedert. Durch die Rationalisierung unserer Geschäftstätigkeit, die Verbesserung unserer Prozesse sowie die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen hoffen wir, uns

Vorteile zu verschaffen, die es uns ermöglichen, wesentlich schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Zusätzlich streben wir weiterführende Optimierungen durch die Dezentralisierung von Funktionen an. In diesem Zusammenhang haben wir begonnen, Funktionen unseres Geschäftsbereichs Automobil- und Industrieelektronik nach Villach, Österreich, zu verlegen, wo bereits andere Teile des Geschäfts abgewickelt werden. Zudem verstärken wir unsere regionale Präsenz in den USA und Asien. Wir beabsichtigen, unsere Leistungsfähigkeit zu steigern, indem wir die Nähe zu unseren Kunden suchen und unsere Entscheidungsfindung dezentralisieren.

KONTINUIERLICHE INVESTITIONEN IN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG – ENGAGEMENT IN STRATEGISCHEN ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFTEN

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E), einschließlich der Aufwendungen für erworbene, nicht abgeschlossene Forschung und Entwicklung in Höhe von 6 Mio. Euro (Vorjahr: 37 Mio. Euro), beliefen sich im Geschäftsjahr 2003 auf insgesamt 1.089 Mio. Euro (Vorjahr: 1.060 Mio. Euro). Als Teil unseres Impact-Programms richten sich unsere Bestrebungen hauptsächlich auf die Entwicklung neuer innovativer Produkte für unsere Kerngeschäftsbereiche. Größere Erfolge, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu verzeichnen waren, sind:

- Sicherheitschipkarten-Mikrokontroller-Familie mit fortschrittlicher Speicherarchitektur und innovativer „Flip Chip on Substrate“-Verpackungstechnik



- Nächste Generation von leistungsfähigen ADSL2+ und VDSL-Chips für Breitbandanwendungen

- Kundenspezifische Plattformlösungen für drahtlose Terminals, GSM/GPRS- und 3G-Standards sowie RF-Komponenten für drahtlose Infrastrukturen

- Intels Validierung von High-Speed-DDR-400-Speichermodulen mit 128 Megabit, 256 Megabit und 512 Megabit

- Der weltweit kleinste 1-Gbit-DDR-Chip auf 0,11-Mikrometer-Technologie ist bereits von Intel validiert

- Erste erfolgreiche Bemusterung von DDR-2 (512 Megabit) auf Intel-„Lindenhurst“-Plattform an Kunden und Pilotanwender

Wir werden weiterhin beträchtliche Investitionen in Produktionstechnologien zur Halbleiterfertigung sowie in Bibliotheken, Werkzeuge, Software und Methodiken, die wir für die Entwicklung von Spitzenprodukten benötigen, tätigen.

Die Mehrheit unserer rund 5.900 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung beschäftigt sich unmittelbar mit der Produktentwicklung in unseren vier Geschäftsbereichen. Daneben ist ein zentraler Entwicklungsbereich verantwortlich für die Entwicklung von Basistechnologien, die von allen anderen Geschäftsbereichen genutzt werden. Zusätzlich unterhalten wir eine hochqualifizierte Forschungsabteilung, die für Grundlagenforschung in Zukunftstechnologien verantwortlich ist.

Unsere Forschungsgruppe hat im Geschäftsjahr 2003 Auszeichnungen für die Entwicklung neuartiger Sensorchips auf Grundlage neuralen Gewebes, die Verknüpfung von elektronischen Geräten mit Kleidungsstücken und Textilien sowie die Entwicklung hoch verdichteter Datenspeicher und fortschrittlicher Architekturen für Multiband- und Multistandard-Mobiltelefone erhalten.

Unsere strategischen F&E-Partnerschaften mit anderen führenden Halbleiter- und Technologieunternehmen haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter intensiviert. Partnerschaften dienen dazu, uns Wettbewerbsvorteile durch effektivere Entwicklung neuer Technologien, schnellere Marktreife der Produkte sowie eine Teilung von Risiken und Kosten zu verschaffen. So haben wir beispielsweise begonnen, gemeinsam mit Nanya Technology Corporation („Nanya“) DRAM-Technologien der neuesten Generation zu entwickeln. Wir haben mit IBM und Chartered Semiconductor Manufacturing einen Entwicklungsvertrag unterzeichnet, um den Übergang auf die 65-Nanometer-Prozesstechnologie zu beschleunigen. Dieses mehrjährige Engagement verbindet in treffender Weise Infineons Wissen im Bereich Low Power Silicon mit IBMs führender Prozesstechnologie und Chartered's Fähigkeiten, eine gemeinsame Prozessplattform für Auftragsfertigung durch die nächsten Technologiegenerationen zu tragen.

ERWERB VON SENSONOR VERBESSERT AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK- GESCHÄFT-PRODUKTPORTFOLIO

Im Juni 2003 haben wir für insgesamt 34 Mio. Euro SensoNor AS („SensoNor“), mit Sitz in Horton, Norwegen, erworben.

Zusätzlich brachten wir im Zuge des Erwerbsvorgangs 13 Mio. Euro Eigenkapital ein. SensoNor war zuvor börsennotiert und entwickelt, produziert und vermarktet Reifendrucküberwachungssysteme und Sensoren für die Beschleunigungsmessung. Mit dem Zukauf möchten wir unsere Position auf dem Automobilmarkt im Bereich der Halbleitersensoren stärken.

NEUE ALLIANZEN UNTERSTÜTZEN DIE WACHSTUMSSTRATEGIE

- **CSVC** – Wir haben mit der China-Singapore Suzhou Industrial Park Venture Co. Ltd. („CSVC“), Suzhou, China, eine Firma gegründet, um eine Fertigungsstätte zur Montage und zum Test (Backend) für Speicherchips zu errichten. Der Standort ist im Industriepark von Suzhou, in der Nähe von Shanghai. Sie wird eine Kapazität von bis zu einer Milliarde Chips pro Jahr haben und, entsprechend den Trends sowie dem Wachstum des globalen Halbleitermarkts, in einzelnen Schritten fertig gestellt. Dabei werden wir über die nächsten fünf Jahre insgesamt 242 Mio. US-Dollar investieren. Alle weiteren im Hinblick auf diese Fertigungsstätte notwendigen Anlagenkäufe sollen ausschließlich über das Gemeinschaftsunternehmen fremd finanziert werden.
- **BMI** – Das Bundesministerium des Inneren („BMI“) und wir vereinbarten in einem Memorandum of Understanding eine weitreichende Sicherheitskooperation im Bereich der IT-Sicherheit. Ziel der Sicherheitskooperation zwischen dem BMI und uns ist es, die Grundlagen für sicherere IT-Systeme in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung, den Unternehmen sowie den Privathaushalten zu schaffen.
- **ProMOS** – Auf Grund anhaltender, schwerwiegender Vertragsbrüche seitens des Joint-Venture-Partners Mosel Vitelic haben wir uns aus dem ProMOS-Joint-Venture in Hsinchu, Taiwan, zurückgezogen. Zum 1. Januar 2003 haben wir den Kauf von ProMOS-Produkten eingestellt. Da der Ausfall durch andere existierende Kooperationen mit taiwanesischen Partnern, Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen kompensiert werden konnte, hatte der Rückzug keine Auswirkungen auf unsere führende Marktposition im DRAM-Geschäft.
- **SMIC** – Wir haben mit Semiconductor Manufacturing International Corporation („SMIC“), Shanghai, eine weitreichende Kooperation bei der Fertigung von Standardspeicherchips (DRAM) vereinbart. Wir werden unsere DRAM-Trench-Technologie sowie unser 300-Millimeter-Fertigungs-Know-how SMIC zur Verfügung stellen und erhalten im Gegenzug das exklusive Abnahmerecht für Speicherchips, die mit dieser Technologie hergestellt werden. Durch die Kooperation wollen wir unsere gesamte Fertigungskapazität deutlich steigern und Wachstum in unserem DRAM-Geschäft generieren. Ebenso stärken wir unsere regionale Präsenz, ohne in weitere Fertigungsstätten zu investieren.
- **UEC** – Mit United Epitaxy Company („UEC“) haben wir die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Entwicklung und Herstellung von Glasfaserkomponenten in Hsinchu, Taiwan, vereinbart. Wir werden 56 Prozent und UEC die restlichen 44 Prozent an dem Unternehmen halten. Die gesamten Investitionen, die von beiden Gesellschaften entsprechend ihren Anteilen

getragen werden, belaufen sich auf rund 12 Mio. Euro. Die Serienproduktion soll im vierten Quartal des Kalenderjahrs 2004 anlaufen.

■ **UMCi** – Wir haben unsere Beteiligung an UMCi Pte. Ltd. („UMCi“), Singapore, an United Microelectronics Corporation („UMC“), Taiwan, veräußert und dabei einen Vorsteuererlust von 9 Mio. Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 erzielt. Der Vorsteuererlust resultiert hauptsächlich aus der ungünstigen Wechselkursentwicklung zwischen US-Dollar und Euro, die nach unserer Investition in UMCi eintrat. Die bisherige Kooperation im Bereich der Fertigung wird wie geplant weitergeführt, und wir erhalten neben dem Zugang zu allen UMC-Produktionsanlagen in Taiwan auch mehr Flexibilität in der Fertigung und auch später Zugang zu den Produktionskapazitäten von UMCi.

■ **Winbond** – Wir haben unser Fertigungsnetzwerk konzept erweitert und mit Winbond Electronics Corp., („Winbond“) Taiwan, einen Technologielizenzvertrag und einen Vertrag über Auftragsfertigung geschlossen.

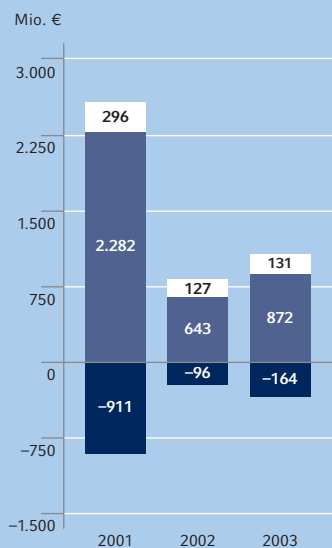
KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG DER FERTIGUNG

Zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2003 konnten wir erneut beweisen, wie erfolgreich unsere Maßnahmen in den Bereichen Kosten- und Kapazitätsvariabilität sind (flexible DRAM-Produktion gegenüber Logikchip-Produktion, flexible Belegschaft). Durch die Erholung des Marktes während des Kalenderjahrs 2003 war es uns möglich, die Auslastung in den meisten unserer Fertigungsstätten zu verbessern. Bei anhal-

tender Markterholung können wir weitere Kapazitäten für die Logikchip-Produktion umwidmen. Der Wechsel von DRAM- zu Logikchip-Produktion sowie die weitere Nutzung von Auftragsfertigern geben die Möglichkeiten hierfür.

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir zahlreiche Schlüsselprojekte im Bereich Fertigung umgesetzt, die uns auch zukünftig dabei helfen werden, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wir haben erfolgreich unsere Hochleistungs-Prozesstechnologie für die Produktion von Logikchip-Produkten auf der Basis von 0,13-Mikrometer-Strukturen eingeführt. Diese Technologie ermöglicht bis zu acht Metallebenen je Chip. Weiterhin befinden wir uns in der Einführungsphase des 90-Nanometer-Prozesses. Darüber hinaus haben wir bereits eine Technologie-Roadmap für die Einführung der nächsten Generationen bis hinunter zu 45 Nanometer verabschiedet. Unsere Prozesstechnologien haben einen modularen Aufbau zur Erfüllung verschiedenster Anwendungsanforderungen. Im Bereich der Speicher-Prozesstechnologien sind wir momentan dabei, die 0,11-Mikrometer-Prozesstechnologie für DRAM-Produkte einzuführen. Zusätzlich haben wir bereits zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahrs in unserer 300-Millimeter-Produktion das Kostenniveau unserer 200-Millimeter-Fertigungsstätten unterschritten.

Investitionen/Desinvestitionen*



■ Beteiligungen und immaterielle Vermögensgegenstände

■ Sachanlagen

■ Verkauf von Geschäftsaktivitäten**

Investitionen in Sachanlagen dienen der Fertigungsoptimierung und dem Ausbau des technologischen Vorsprungs bei der 300-Millimeter-Technologie.

* Ohne Wertpapiere.
** Inkl. Verkauf Opto-JV.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen und Regionen sowie das EBIT nach Geschäftsbereichen (Segmentdaten):

Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen

	Geschäftsjahr zum 30. September ¹					
	2001		2002		2003	
	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%
Drahtgebundene Kommunikation	766	14	386	8	459	7
Sichere Mobile Lösungen	1.522	29	1.278	26	1.645	27
Automobil- und Industrieelektronik	1.153	22	1.201	25	1.392	23
Speicherprodukte	1.614	30	1.861	38	2.485	40
Sonstige Geschäftsbereiche	236	4	117	2	139	2
Konzernfunktionen	56	1	47	1	32	1
Gesamt	5.347	100	4.890	100	6.152	100

Umsatzerlöse nach Regionen

	Geschäftsjahr zum 30. September ¹					
	2001		2002		2003	
	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%
Deutschland	1.636	31	1.266	26	1.535	25
Übriges Europa	1.172	22	943	19	1.112	18
Nordamerika	1.208	23	1.158	24	1.393	23
Asien-Pazifik	1.247	23	1.446	29	2.077	34
Andere	84	1	77	2	35	1
Gesamt	5.437	100	4.890	100	6.152	100

EBIT nach Geschäftsbereichen

	Geschäftsjahr zum 30. September ¹		
	2001	2002	2003
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Drahtgebundene Kommunikation	-93	-245	-188
Sichere Mobile Lösungen	-142	-116	-64
Automobil- und Industrieelektronik	143	111	186
Speicherprodukte	-938	-630	31
Sonstige Geschäftsbereiche	192	9	-49
Konzernfunktionen	-180	-264	-215
Gesamt	-1.018	-1.135	-299

Anmerkungen

¹ Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

Das EBIT wird wie folgt aus den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen hergeleitet:

EBIT			
Geschäftsjahr zum 30. September			
	2001	2002	2003
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Konzernfehlbetrag von fortgeführten Geschäften	-592	-1.017	-435
Addiert: Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-427	-143	84
Zinsergebnis	1	25	52
EBIT	-1.018	-1.135	-299

Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Ergebnispositionen der Geschäftstätigkeit im Verhältnis zum Umsatz:

Ergebnispositionen der Geschäftstätigkeit im Verhältnis zum Umsatz			
Geschäftsjahr zum 30. September¹			
	2001	2002	2003
	%	%	%
Umsatzerlöse	100,0	100,0	100,0
Umsatzkosten	-85,7	-87,7	-75,0
Bruttoergebnis vom Umsatz	14,3	12,3	25,0
Forschungs- und Entwicklungskosten	-22,2	-21,7	-17,7
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-14,6	-13,1	-11,0
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-2,2	-0,3	-0,5
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, Saldo	3,7	0,9	-1,4
Betriebsergebnis	-21,0	-21,9	-5,6
Zinsergebnis	0,0	-0,5	-0,8
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	0,4	-1,0	0,3
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	0,2	0,4	-0,0
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	1,2	-0,8	0,3
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	0,1	0,1	0,1
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19,1	-23,7	-5,7
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,0	2,9	-1,4
Konzernjahresfehlbetrag	-11,1	-20,9	-7,1

Anmerkungen

¹ Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

VERGLEICH DER GESCHÄFTSJAHRE 2003 UND 2002

Allgemeines

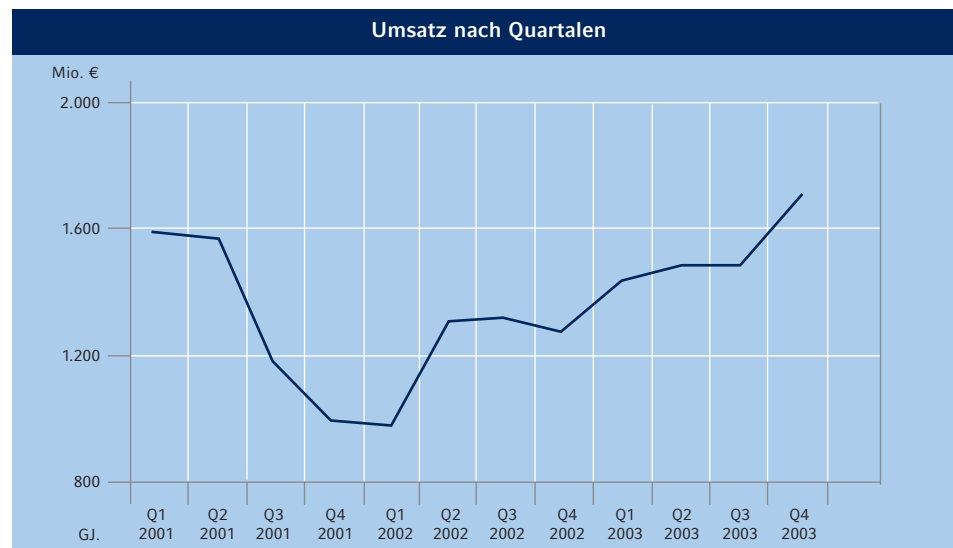
In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld konnten wir durch Absatzsteigerungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der asiatischen und pazifischen Region, durch eine verbesserte Preispolitik und höhere Nachfrage unsere Umsatzerlöse steigern. Dabei stieg besonders der Umsatz unserer Speicherprodukte. Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik konnte seine Leistungssteigerung der letzten Geschäftsjahre wiederholen.

Im Geschäftsjahr 2003 wurden diese Verbesserungen durch einen starken Euro gegenüber den Währungen in unseren wichtigsten Exportmärkten teilweise aufgehoben.

Unsere Ergebnisse haben sich durch eine deutliche Senkung der Herstellungskosten, insbesondere für Speicherbausteine entscheidend verbessert. Ursache hierfür waren eine höhere Produktivität, die Ergebnisse der 300-Millimeter-Volumenproduktion und der Wechsel zu Produkten mit höheren Gewinnmargen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2002 um 26% von 4.890 Mio. Euro auf 6.152 Mio. Euro. Die höheren Umsatzerlöse sind hauptsächlich auf eine verbesserte Nachfrage nach Speicherprodukten sowie Halbleitern für Mobiltelefone und die gute Entwicklung der Automobil- und Industrieelektronik zurückzuführen. Durch Akquisitionen wurde im Geschäfts-

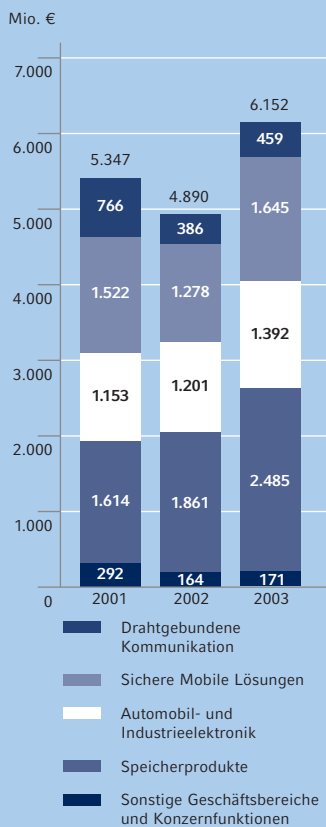


Die Umsatzerlöse konnten über das Geschäftsjahr 2003 deutlich gesteigert werden und erreichten im 4. Quartal den Spitzenwert.

jahr 2002 der Umsatz um 7 Mio. Euro und im Geschäftsjahr 2003 um 129 Mio. Euro gesteigert. Im Geschäftsjahr 2003 stellte der Bereich Speicherprodukte 40% unseres Gesamtumsatzes dar, gegenüber 38% im Vorjahr, und war weiterhin unser größtes Berichtssegment. Währungsschwankungen des Euro (hauptsächlich gegenüber dem US-Dollar) verringerten die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2003 um ungefähr 317 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (ermittelt auf Basis der durchschnittlichen Wechselkurse für das Geschäftsjahr 2002). Lizenzeinnahmen betrafen im Wesentlichen den Geschäftsbereich Speicherprodukte und wurden in Höhe von 183 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003 realisiert, im Vergleich zu 147 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002.

Nachfolgend wird der Vergleich der Umsatzerlöse der Geschäftsjahre 2002 und 2003 in den verschiedenen Geschäftsbereichen angestellt:

Umsatzerlöse nach Segmenten



Bessere Nachfrage nach Speicherchips und Bauelementen für Mobiltelefone steigern die Umsatzerlöse in 2003 beträchtlich.

■ **Drahtgebundene Kommunikation** – Die Umsatzerlöse im Bereich Drahtgebundene Kommunikation erhöhten sich um 19% von 386 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 auf 459 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003. Der Umsatzanstieg ist auf einen verbesserten Umsatz im Geschäft für Telekommunikationsanschlüsse zurückzuführen. Die wachsende Nachfrage, vor allem in den Entwicklungsländern, führte zu steigenden Umsätzen in unserem Geschäftsbereich. Der Anstieg konnte die rückläufigen Preise im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr mehr als kompensieren. Weiterhin geringe Investitionen bei Telekommunikationsinfrastruktur der weltweit operierenden Telefongesellschaften verhindern sowohl eine Erholung des Marktes für Glasfaserprodukte als auch für optische Netzwerkprodukte. Gleichwohl konnten wir im vierten Quartal eine gestiegene Nachfrage, vor allem für Glasfaserprodukte, verzeichnen.

■ **Sichere Mobile Lösungen** – Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen konnte seine Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 29% von 1.278 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 auf 1.645 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003 steigern. Die deutlich höheren Umsatzerlöse resultieren hauptsächlich aus einem gestiegenen Absatz für Basisband- und Hochfrequenz-Produkte und Produkte für Mobiltelefone. Wir verspürten anhaltenden Preisdruck bei Chipkarten-ICs und diskreten Bauteilen über das ganze Geschäftsjahr 2003 hinweg. Weiterhin profitierten die Umsatzerlöse von der Einbeziehung der Umsatzerlöse eines ganzen Jahres von Ericsson Microelectronics-Geschäfts („MIC“), das im September 2002 erworben wurde, und gestiegenen

Verkäufen von Sicherheitslösungen und Local-Area-Wireless-Anwendungen, hier insbesondere Bluetooth. Im vierten Quartal des Berichtsjahrs konnten die Umsatzerlöse von gesteigerter saisonaler Nachfrage profitieren, insbesondere Wide-Area-Wireless-Produkte.

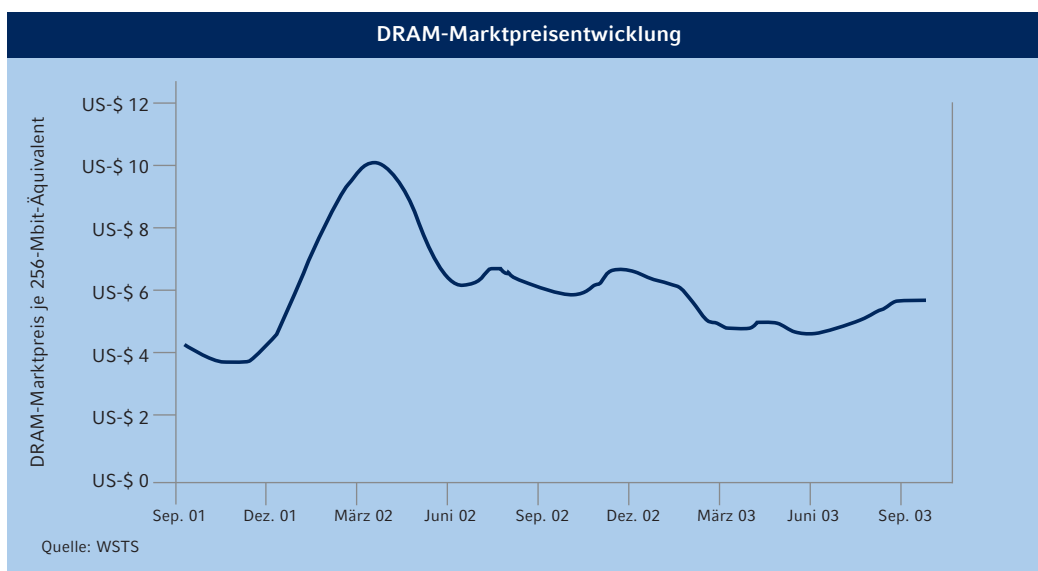
■ **Automobil- und Industrieelektronik** – Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik konnte seine Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 16% von 1.201 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 auf 1.392 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003 steigern. Die Umsatzsteigerung war überwiegend auf höheres Volumen in den Bereichen Automobilanwendungen, Energiemanagement und Energieversorgung zurückzuführen.

■ **Speicherprodukte** – Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Speicherprodukte stiegen um 34% von 1.861 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 auf 2.485 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003. Die Umsatzsteigerung resultiert hauptsächlich aus einem höheren Verkaufsvolumen und einem verbesserten Produkt-Mix, was auch den niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreis und den ungünstigen Wechselkurs zwischen Euro und Dollar im Vergleich zum vorhergehenden Jahr mehr als ausgleichen konnte. Der Umsatz wurde weiterhin von dem Produktionsbeginn der 300-Millimeter-Fertigung in Dresden und dem Zugang der kürzlich etablierten Kapazitätskooperation mit Winbond begünstigt. So konnte der Umsatzrückgang der von ProMOS gekauften Produkte kompensiert werden.

Das Absatzvolumen in Megabit erhöhte sich im Laufe des Geschäftsjahrs 2003 erheblich,

da die Nachfrage nach Personalcomputern und Datenspeichern anstieg. Die Erhöhung der 256-Megabit-DDR-DRAM-Serienpro-

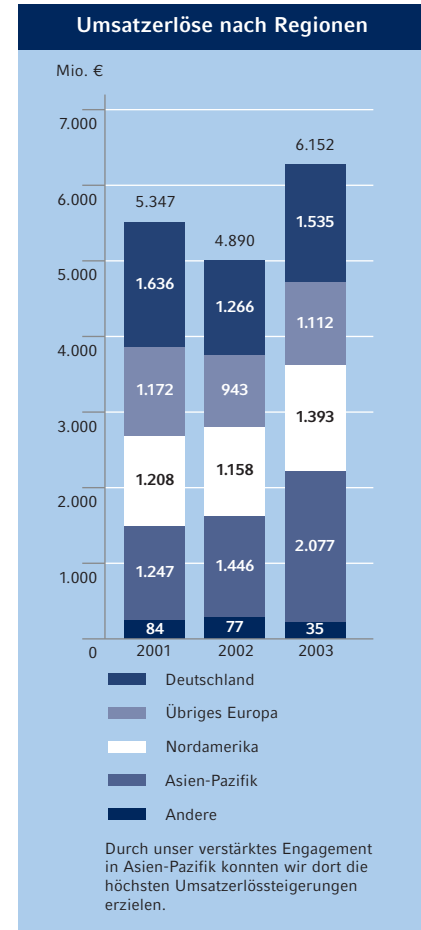
duktion und der Start der 512-Megabit-Serienproduktion trugen ebenfalls zum Anstieg des Absatzvolumens bei.



Die Preise für Speicherchips fielen zunächst im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2003, erholten sich aber im vierten Quartal wieder. Die Preisunterschiede zwischen 128-Megabit- und 256-Megabit-DRAM sowie zwischen Termin- und Spotmärkten schwankten im Jahresverlauf, während sich die Preise von SDRAM- und DDR-DRAM-Chips im Jahresverlauf annäherten, weil viele DRAM-Hersteller ihre DDR-DRAM-Produktion erhöhten. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Produkt-Mix zu optimieren, um diese Preisdifferenzen auszunutzen. Des Weiteren versuchen wir, uns verstärkt auf High-End-Produkte zu fokussieren und unser Produktportfolio zu diversifizieren. Hauptsächlich auf Grund höherer abgesetzter Stückzahlen (gemessen in Bit) reduzierte sich der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megabit (ohne Währungseffekte) im Geschäftsjahr 2003 um rund 12%.

■ Sonstige Geschäftsbereiche – Die Umsatzerlöse der sonstigen Geschäftsbereiche stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19% von 117 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 auf 139 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf die Umsatzerlöse unseres kürzlich errichteten Geschäftsfelds ASIC & Design Solutions (ADS) zurückzuführen.

Umsatzerlöse nach Regionen und Kunden
Bei einer Umsatzaufgliederung nach Regionen verzeichnet Europa mit 43% den größten Anteil im Geschäftsjahr 2003 im Vergleich zu 45% im Geschäftsjahr 2002. 57% des Gesamtumsatzes wurden außerhalb Europas erwirtschaftet (Vorjahr: 55%). Dies ist im Wesentlichen durch höhere Umsätze im asiatischen und pazifischen Raum begründet.



Nur auf einen Kunden, den Siemens-Konzern, entfielen in den Geschäftsjahren 2002 und 2003 mehr als 10% der Umsatzerlöse der Gesellschaft. Der Umsatz mit Siemens beinhaltet sowohl Direktverkäufe an den Siemens-Konzern in Höhe von 12% bzw. 13% für die Geschäftsjahre 2002 und 2003 als auch Verkäufe an die Siemens-Vertriebsorganisation zum Weiterverkauf an Drittkunden in Höhe von 2% bzw. 1% in den beiden Jahren. Die Umsätze an den Siemens-Konzern werden hauptsächlich mit Nicht-Speicherprodukten getätigt.

Umsatzkosten – Bruttomarge

Die Umsatzkosten stiegen im Geschäftsjahr 2003 um 8% auf 4.614 Mio. Euro (Vorjahr: 4.289 Mio. Euro).

Die Umsatzkosten im Verhältnis zum Umsatz verringerten sich auf 75% im Vergleich zu 88% im Geschäftsjahr 2002. Diese Verbesserung gründet sich auf eine Vielzahl von Faktoren: eine verbesserte Integration und niedrigere Leerkosten in den meisten Geschäftsbereichen, eine beträchtliche Verbesserung der Kostenstruktur im Segment Speicherprodukte und ein verbessertes Preisumfeld im Vergleich zum Geschäftsjahr 2002. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 konnten Preisverbesserungen verzeichnet werden, die aber im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs auf Grund des Preisdrucks, vor allem bei Speicherprodukten, wieder kompensiert wurden. Die Bruttoergebnisspannen verbesserten sich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2003 in allen Geschäftsbereichen. Der starke Preisdruck beeinflusste die Margen negativ während eines Großteils des Geschäftsjahrs. Erst im vierten Quartal

verbesserten sich die Margen auf Grund der besseren Marktbedingungen für Halbleiterprodukte, besonders für Speicherprodukte.

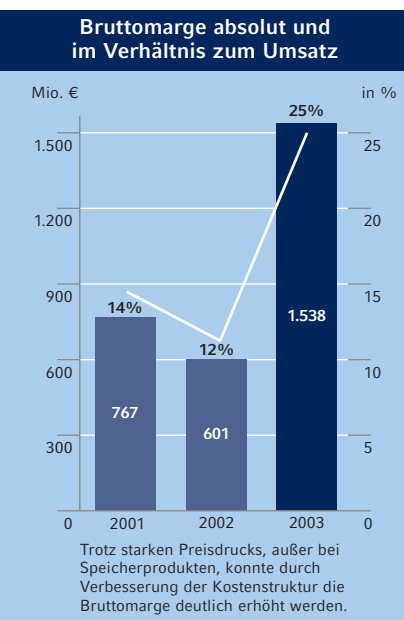
Die Bruttomarge unserer Geschäftsbereiche hat sich folgendermaßen entwickelt:

■ **Drahtgebundene Kommunikation** – Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2002 konnte die Bruttomarge auf Grund des erhöhten Absatzes für Access-Produkte mit höheren Margen und durch eine bessere Marge bei Glasfaserprodukten gesteigert werden. Höhere Produktivität und reduzierte Leerkosten trugen auch zu dieser Verbesserung im Geschäftsjahr 2003 bei.

■ **Sichere Mobile Lösungen** – Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2002 verbesserte sich die Bruttomarge hauptsächlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2003 auf Grund einer gestiegenen Nachfrage nach drahtlosen Produkten. Eine Anpassung des Produkt-Mix hin zu Produkten mit höheren Gewinnspannen und die Reduzierung der Leerkosten konnten den anhaltenden Preisdruck mehr als kompensieren.

■ **Automobil- und Industrieelektronik** – Die Bruttomarge verbesserte sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2002 auf Grund der höheren Produktivität und Kosteneinsparungen wegen der fortgeführten Umstellung von 5-Zoll- auf 6-Zoll- und 8-Zoll-Fertigung. Höhere Verkaufsmengen und eine bessere Kapazitätsauslastung der Fertigungsanlagen trugen zu einer verbesserten Effizienz und höheren Gewinnmargen bei.

■ **Speicherprodukte** – Die Gewinnspannen im Geschäftsjahr 2003 verbesserten sich



auf Grund einer wesentlich höheren Produktivität, geringerer Herstellungskosten in der 300-Millimeter-Produktion und der Einführung von Produkten mit höheren Bruttospannen, welche den negativen Effekt der niedrigeren Verkaufspreise im Vergleich zum Vorjahr mehr als kompensierten.

Infineon weist die Kosten für die Materialbezüge von unseren Gemeinschaftsunternehmen und anderen verbundenen und assoziierten Unternehmen wie ALTIS und bis zum 1. Januar 2003 auch ProMOS unter den Umsatzkosten aus. Diese Bezüge von diesen Fertigungen und von assoziierten und verbundenen Unternehmen beliefen sich im Berichtsjahr 2003 auf 470 Mio. Euro (gegenüber 686 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002).

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

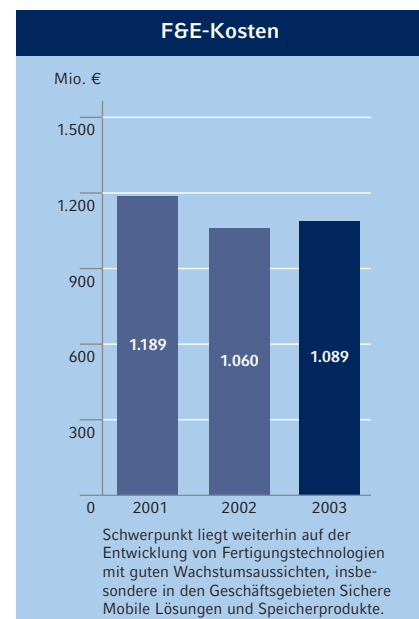
Im Berichtsjahr stiegen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung um 3% auf 1.089 Mio. Euro (Vorjahr: 1.060 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung umfassen vor allem Personalkosten, Lizenzgebühren, Laboreinrichtungen und Software. Weitere Aufwendungen fielen durch Vereinbarungen mit unseren Partnern Nanya und UMC über die Entwicklungen von gemeinsamen Technologien an. Die Aufwendungen für erworbene, nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte unserer diesjährigen Akquisitionen betragen 6 Mio. Euro (Vorjahr: 37 Mio. Euro). Die von der öffentlichen Hand erhaltenen Fördergelder für Forschungs- und Entwicklungsprojekte beliefen sich im Geschäftsjahr 2003 auf 59 Mio. Euro (Vorjahr:

59 Mio. Euro). Der Schwerpunkt unserer Investitionen liegt weiterhin auf der Entwicklung von Fertigungstechnologien mit guten Wachstumsaussichten, insbesondere in den Geschäftsbereichen Sichere Mobile Lösungen und Speicherprodukte. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen sanken die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung von 22% im Geschäftsjahr 2002 auf 18% im Berichtsjahr.

■ Drahtgebundene Kommunikation – Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung verringerten sich absolut als auch in Relation zu den Umsatzerlösen auf Grund niedrigerer Abschreibungen, im Wesentlichen aus dem Kauf von Catamaran, und geringerer Aufwendungen im Rahmen unseres Kostensenkungsprogramms Impact für Forschung und Entwicklung im Geschäftsfeld Access.

■ Sichere Mobile Lösungen – Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen für das Geschäftsjahr 2003 in absoluten Zahlen auf Grund der ganzjährigen Einbeziehung des erworbenen MIC-Geschäfts und der erhöhten Anstrengungen bei Software- und Lösungs-Aktivitäten. Dagegen wirken im letzten Jahr die außerordentlichen Aufwendungen für erworbene, nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte in Höhe von 37 Mio. Euro. Wir konzentrierten uns auf die Entwicklung von Software und Systemlösungen. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gingen in Relation zum Umsatz im Geschäftsjahr zurück.

■ Automobil- und Industrieelektronik – Die Kosten für Forschung und Entwicklung stie-



gen in absoluten Zahlen und im Verhältnis zum Umsatz auf Grund von höheren Forschungs- und Entwicklungskosten im Sensorenbereich und bei Automobilanwendungen, aber auch durch nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Verbindung mit der Akquisition von SensoNor in Höhe von 4 Mio. Euro.

■ Speicherprodukte – Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gingen sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zu den Umsatzerlösen zurück. Dies zeigt die Vorteile der partnerschaftlichen Entwicklung von DRAM-Technologien der nächsten Generation mit Nanya. Diese Vorteile wurden teilweise durch die gestiegenen Entwicklungskosten bei Standard-DRAM-Produkten und Flash-Technologien kompensiert.

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten

Diese Aufwendungen umfassen neben den Vertriebskosten auch die allgemeinen Verwaltungskosten und enthalten in beiden Jahren Gemein-, Personal-, Beratungs- und sonstige Verwaltungskosten. Die Vertriebskosten und die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen im Berichtsjahr um 6% auf 679 Mio. Euro (Vorjahr: 643 Mio. Euro). Der relative Anteil dieser Kosten an den Umsatzerlösen sank von 13% im Geschäftsjahr 2002 auf 11% im Berichtsjahr auf Grund der höheren Umsatzerlöse.

Die Vertriebskosten erhöhten sich im Berichtsjahr um 5% auf 358 Mio. Euro (Vorjahr: 341 Mio. Euro); relativ zum Umsatz betrachtet, entspricht dies einer Verringerung auf 6% (Vorjahr: 7%). Auf Grund des Erwerbs

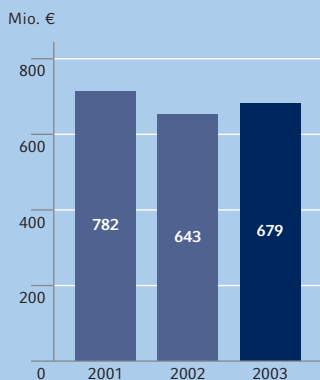
des MIC-Geschäfts im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen und eines höheren Umsatzvolumens für Speicherprodukte erhöhten sich die Vertriebskosten. Diese konnten aber teilweise durch Kostensenkungsprogramme in den Bereichen Drahtgebundene Kommunikation und Sichere Mobile Lösungen wieder kompensiert werden.

Die allgemeinen Verwaltungskosten erhöhten sich um 6% auf 321 Mio. Euro oder 5% vom Umsatz im Berichtsjahr gegenüber 302 Mio. Euro und 6% vom Umsatz im Vorjahr. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere IT-Ausgaben, Kosten externer Dienstleister und Ausgaben in Verbindung mit der Erweiterung unserer Präsenz in den USA und Asien zurückzuführen, welcher aber teilweise durch das Kostensenkungsprogramm Impact kompensiert werden konnte. Die ganzjährige Konsolidierung des Geschäfts von Ericsson Microelectronics erhöhte die allgemeinen Verwaltungskosten im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die allgemeinen Verwaltungskosten in den Geschäftsbereichen Speicherprodukte, Automobil- und Industrieelektronik und Sichere Mobile Lösungen in Folge der Erweiterung der Geschäftsaktivitäten. Ursache für die niedrigeren allgemeinen Verwaltungskosten im Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation waren insbesondere der reduzierte Personalbestand als auch andere Kosteneinsparungsaktivitäten.

Restrukturierung

Im Geschäftsjahr 2003 führten wir unsere Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen weiter. In Verbindung mit diesen Bemühungen fielen 29 Mio. Euro

Vertriebs- und Allgemeine Verwaltungskosten



Die Aufwendungen für die Geschäftsausweitung konnten von Einsparungen im Rahmen unserer Impact-Programme teilweise kompensiert werden.

Restrukturierungskosten an, hauptsächlich auf Grund von Abfindungszahlungen. Im Geschäftsjahr 2002 fielen Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 16 Mio. Euro für nicht kündbare Verpflichtungen an.

Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen, Saldo

Im Geschäftsjahr 2003 betrug der Saldo der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (netto) 85 Mio. Euro. Er resultiert im Wesentlichen aus der Wertberichtigung des Geschäfts- und Firmenwerts in Höhe von 68 Mio. Euro aus der Akquisition von Catamaran Communications und einer Rückstellung in Höhe von 28 Mio. Euro im Zusammenhang mit einer Untersuchung des US-Bundesjustizministeriums wegen möglicher Verletzung von Kartellgesetzen in der DRAM-Industrie und verbundener Zivilklagen. Im Geschäftsjahr 2002 belief sich der Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge auf 46 Mio. Euro und enthielt überwiegend die Vorsteuergewinne aus dem Verkauf des restlichen Infrarotkomponenten-Geschäfts in Höhe von 39 Mio. Euro und des Gallium-Arsenid-Geschäfts in Höhe von 2 Mio. Euro.

Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Das anteilige Ergebnis von assoziierten Unternehmen wird überwiegend im Geschäftsbereich Speicherprodukte ausgewiesen. Der anteilige Gewinn beträgt im Berichtsjahr 18 Mio. Euro gegenüber einem Verlust von 47 Mio. Euro im Vorjahr. Ursache für den Anstieg ist die gute Geschäftsentwicklung unseres Gemeinschaftsunternehmens ProMOS im Geschäftsjahr 2003 vor unserem Ausstieg während des Berichtsjahrs 2003.

Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo

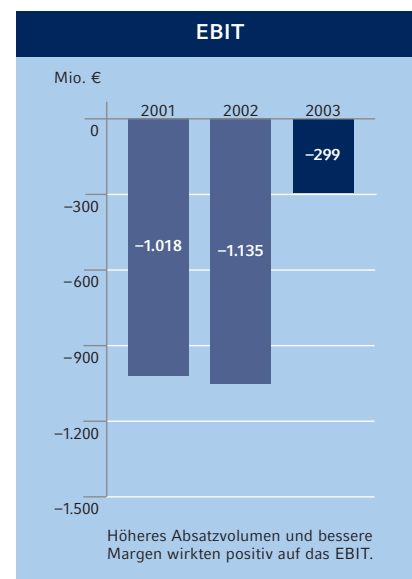
Die sonstigen Erträge, netto betragen im Geschäftsjahr 2003 21 Mio. Euro. Sie beinhalten einen Ertrag in Höhe von 60 Mio. Euro aus dem Verkauf der ProMOS-Anteile, der teilweise durch Wertberichtigungen auf verschiedene Finanzanlagen in Höhe von 34 Mio. Euro und dem Verlust aus dem Verkauf der UMCi-Anteile in Höhe 9 Mio. Euro ausgeglichen wurde. Im Geschäftsjahr 2002 betragen die sonstigen Aufwendungen netto 41 Mio. Euro bedingt durch Wertberichtigungen auf verschiedene Finanzanlagen.

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Als Resultat der unten aufgeführten Effekte entstand im Berichtsjahr 2003 ein EBIT-Verlust in Höhe von 299 Mio. Euro (Vorjahr: EBIT-Verlust 1.135 Mio. Euro).

■ **Drahtgebundene Kommunikation –** Die Verbesserung des EBIT in Höhe von 57 Mio. Euro wurde hauptsächlich durch ein größeres Geschäftsvolumen, einen optimierten Produkt-Mix, höhere Gewinnmargen bei Glasfaserprodukten und Kosteneinsparungen mittels Restrukturierung und anderer Kostenreduzierungsanstrengungen erzielt. Das EBIT des Geschäftsjahrs 2003 enthält eine Wertberichtigung in Höhe von 68 Mio. Euro aus der Akquisition von Catamaran Communications.

■ **Sichere Mobile Lösungen –** Der EBIT-Verlust verringerte sich um 52 Mio. Euro auf Grund von gestiegenen Absatzmengen, höherer Margen und auf Grund von Kostenreduzierungen, wodurch die Auswirkung der ganzjährigen Konsolidierung des MIC-Geschäfts mehr als ausgeglichen werden konnte.



■ **Automobil- und Industrieelektronik** – Die Verbesserung des EBIT in Höhe von 75 Mio. Euro resultierte hauptsächlich aus einem höheren Verkaufsvolumen und einer verbesserten Effizienz der Produktion.

■ **Speicherprodukte** – Die höheren Verkaufszahlen, ansteigende Produktivität, deutlich verbesserte Herstellungskosten und ein besserer Produkt-Mix waren Ursache für eine deutliche Verbesserung des EBIT in Höhe von 661 Mio. Euro und die Rückkehr zur Profitabilität.

■ **Sonstige Geschäftsbereiche** – Das EBIT verringerte sich von einem Gewinn in Höhe von 9 Mio. Euro zu einem Verlust von 49 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003. Ursache hierfür war der Gewinn aus dem Verkauf unserer Infrarot-Geschäftsaktivitäten in Höhe von 39 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002. Zusätzlich trugen Ausgaben zum Aufbau unseres Geschäftsfelds ASIC & Design Solutions (ADS) zum EBIT-Verlust im Geschäftsjahr 2003 bei.

■ **Konzernfunktionen** – Der EBIT-Verlust verringerte sich um 49 Mio. Euro, bedingt durch geringere Leerkosten auf Grund verbesserter Auslastung. Dies wurde teilweise durch höhere Aufwendungen für Umstrukturierungen und andere nicht zuordenbare Kosten kompensiert.

Zinsergebnis

Der Nettozinsaufwand stieg im Berichtsjahr auf 52 Mio. Euro (Vorjahr: 25 Mio. Euro). Dies beinhaltet Zinsen auf unsere im Februar 2002 ausgegebene Wandelanleihe und auch die Zinsen für die im Juni 2003 ausgegebene Wandelanleihe. Diese Zinsaufwendungen

wurden teilweise durch weitere Zinseinnahmen aus unseren angelegten Zahlungsmitteln und Wertpapieren kompensiert.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für das Berichtsjahr weisen wir Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 84 Mio. Euro gegenüber einem Ertrag von 143 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 aus. Dies entspricht einer negativen Steuerquote von 25%, im Vergleich zu einer positiven Steuerquote von 12% im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2002 wiesen wir eine Erhöhung der Wertberichtigung in Höhe von 271 Mio. Euro aus, welche den auszuweisenden Steuerertrag begrenzte. Infolge kumulativer Verluste in den letzten 3 Jahren bis zum 30. September 2002 in bestimmten Steuergebieten erhöhten wir die Wertberichtigung. Wir haben für das Geschäftsjahr 2003 in den besagten Steuergebieten wiederholt keine Steuererträge ausgewiesen. Die Wertberichtigung wurde im Geschäftsjahr 2003 um 182 Mio. Euro erhöht. In Steuergebieten mit positiven Ergebnissen zeigten wir Steueraufwendungen. Wir bewerten unsere latenten Steuern regelmäßig. Unsere Fähigkeiten zur Realisierung von Steuererträgen aus latenten Steuern hängen von der Möglichkeit ab, in der Zukunft steuerliche Einkünfte zu erzielen und steuerliche Verlustvorträge und Steuervergünstigungen vor Eintritt der Verjährung zu nutzen. Wir erwarten so lange keine Erträge für Steuern vom Einkommen und Ertrag in den besagten Steuergebieten auszuweisen, wie in diesen Steuergebieten über den Zeitraum der letzten 3 Jahre ein kumulativer Verlust besteht.

Darstellung der Finanzlage

CASH FLOW

Der Cash Flow zeigt Herkunft und Verwendung der Geldströme in den Berichtsperioden. Ihm kommt damit eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft zu.

Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit und die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit sind jeweils zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Mittel-

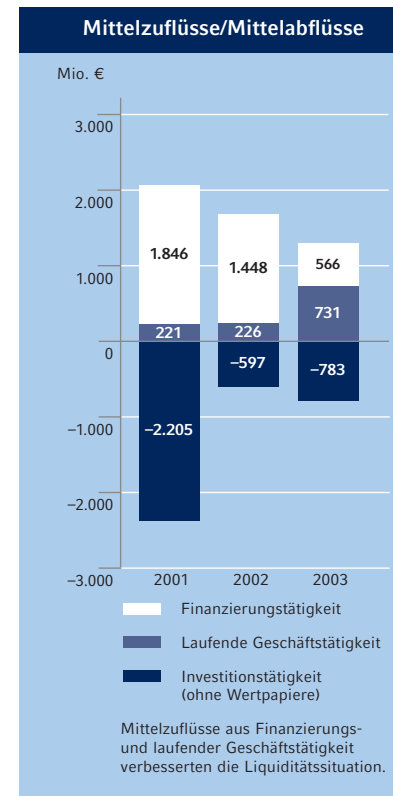
zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit ausgehend vom Konzernjahresergebnis indirekt abgeleitet. Die im Rahmen der indirekten Ermittlung berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäft sind um Effekte aus Währungsschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen bereinigt. Sie können deshalb nicht mit den entsprechenden Veränderungen der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Cash Flow			
	Geschäftsjahr zum 30. September		
	2001	2002	2003
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von fortgeführten Geschäften	221	226	731
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.813	-1.244	-1.522
Mittelzufluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	1.846	1.448	566
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von aufgegebenen Geschäften	-10	11	-1
Zahlungsmittel zum Periodenende	757	1.199	969

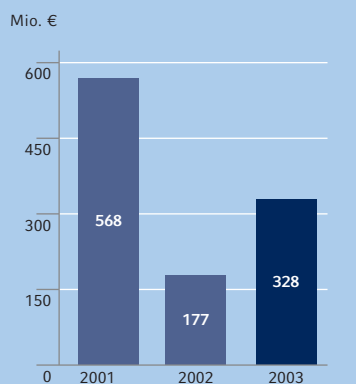
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 731 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003 ergibt sich im Wesentlichen aus dem Konzernfehlbetrag in Höhe von 435 Mio. Euro, gegenläufigen Abschreibungen in Höhe von 1.437 Mio. Euro und einem Anstieg des Netto-Umlaufvermögens in Höhe von 222 Mio. Euro. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich erheblich gegenüber dem Geschäftsjahr 2002, im Wesentlichen durch einen um 586 Mio. Euro deutlich geringeren Jahresfehlbetrag.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.522 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003 resultiert überwiegend aus dem Nettoerwerb von Wertpapieren des

Umlaufvermögens in Höhe von 739 Mio. Euro und Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 872 Mio. Euro. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2002, im Wesentlichen bedingt durch um 229 Mio. Euro höhere Investitionen in Sachanlagen.

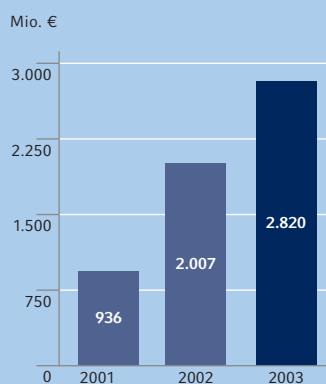


Netto-Cash-Position



Durch striktes Cash-Management konnte die positive Netto-Cash-Position ausgebaut werden.

Brutto-Cash-Position



Durch striktes Cash-Management und Begebung der Wandelanleihe Ausbau der soliden Brutto-Cash-Position.

Im Geschäftsjahr 2003 betrug der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 566 Mio. Euro (Vorjahr: 1.448 Mio. Euro) und enthält die Zuflüsse aus der im Juni 2003 begebenen Wandelanleihe in Höhe von 686 Mio. Euro netto. Im Geschäftsjahr 2002 beinhaltete der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 981 Mio. Euro netto, die durch die Begebung der Wandelanleihe im Februar 2002 erlöst wurden. Des Weiteren enthielt der Mittelzufluss ein 450-Mio.-Euro-Darlehen zur Finanzierung der 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Dresden.

Wir definieren den Free Cash Flow als Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit,

bereinigt um den Kauf und Verkauf von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren. Da wir einen Großteil unserer liquiden Mittel in Form von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren halten und in einer kapitalintensiven Industrie tätig sind, berichten wir den Free Cash Flow, um Investoren eine Kennzahl zur Verfügung zu stellen, die die Veränderung der Liquidität unter Berücksichtigung von Investitionen zeigt. Es bedeutet nicht, dass der restliche verfügbare Cash Flow für sonstige Ausgaben verwendet werden kann, da Schuldendienstverpflichtungen oder andere feste Ausgaben noch nicht abgezogen sind. Der Free Cash Flow wird wie folgt aus der Kapitalflussrechnung hergeleitet:

Free Cash Flow

	Geschäftsjahr zum 30. September		
	2001	2002	2003
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aller Geschäfte	211	237	730
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.813	-1.244	-1.522
Kauf von Wertpapieren, Saldo	-392	647	739
Free Cash Flow	-1.994	-360	-53

Netto-Zahlungsmittelbestand

	Zum 30. September 2003						
	Gesamt	Zahlung fällig in					
		weniger als 1 Jahr	1-2 Jahren	2-3 Jahren	3-4 Jahren	4-5 Jahren	5 Jahren und länger
Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Zahlungsmittel	969	969	–	–	–	–	–
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.784	1.784	–	–	–	–	–
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel	67	–	67	–	–	–	–
Brutto-Zahlungsmittelbestand	2.820	2.753	67	–	–	–	–
Abzüglich:							
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2.335	–	527	48	1.007	3	750
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	8	–	3	1	1	1	2
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	149	149	–	–	–	–	–
Gesamte Finanzverbindlichkeiten	2.492	149	530	49	1.008	4	752
Netto-Zahlungsmittelbestand	328	2.604	–463	–49	–1.008	–4	–752

Unsere Brutto-Cash-Position – definiert als Zahlungsmittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens und als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel – erhöhte sich zum 30. September 2003 auf 2.820 Mio. Euro (Vorjahr: 2.007 Mio. Euro), überwiegend durch die Begebung unserer Wandelanleihe und verbesserter operativer Cash Flow.

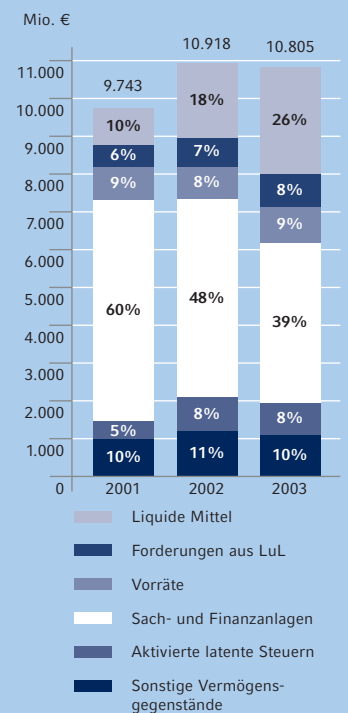
Die Netto-Cash-Position – der Saldo aus Finanzforderungen (Zahlungsmittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens und als Sicherheiten hinterlegte Zahlungsmittel) und Finanzverbindlichkeiten (kurz- und langfristige) – erhöhte sich um 151 Mio. Euro auf 328 Mio. Euro zum 30. September 2003 (Vorjahr: 177 Mio. Euro).

DARSTELLUNG DER VERMÖGENSLAGE

Das bilanzierte Gesamtvermögen von Infineon verringerte sich zum 30. September 2003 um 1% auf 10.805 Mio. Euro

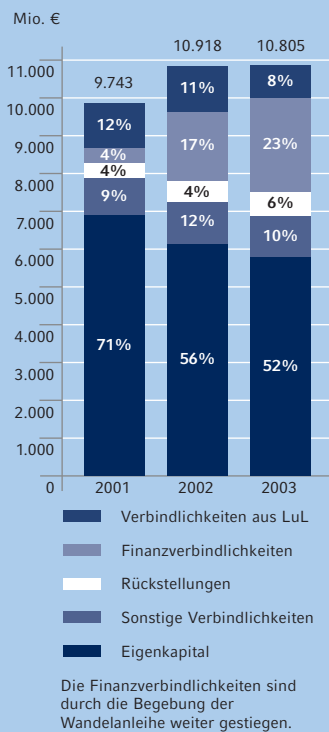
(Vorjahr: 10.918 Mio. Euro). Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 27% auf 5.306 Mio. Euro (Vorjahr: 4.191 Mio. Euro). Dies beruht im Wesentlichen auf dem Anstieg der Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens auf 2.753 Mio. Euro (Vorjahr: 1.937 Mio. Euro) auf Grund der Begebung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von 700 Mio. Euro und verbesserter operativer Cash Flow. Das Anlagevermögen ging um 18% auf 5.499 Mio. Euro (Vorjahr: 6.727 Mio. Euro) zurück. Dies resultiert aus dem Rückgang bei Sachanlagen, da die Abschreibungen die Neuinvestitionen im Geschäftsjahr 2003 überstiegen. Im Geschäftsjahr 2003 reduzierten wir unsere Finanzanlagen durch den Verkauf der Beteiligungen an ProMOS und UMCi. Sonstige Vermögensgegenstände verringerten sich durch die Wertberichtigung auf den Geschäfts- und Firmenwert unserer Beteiligung an Catamaran Communications.

Bilanzstruktur Aktiva



Rückgang bei Sachanlagen, da die planmäßigen Abschreibungen die Neuinvestitionen deutlich übertrafen. Die liquiden Mittel steigen auf Grund der Begebung der Wandelanleihe.

Bilanzstruktur Passiva



Die gesamten Verbindlichkeiten stiegen um 8% auf 5.139 Mio. Euro (Vorjahr: 4.760 Mio. Euro). Es erhöhten sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten um 633 Mio. Euro auf 2.343 Mio. Euro, im Wesentlichen durch die Begebung unserer Wandelanleihe im Juni 2003. Dagegen wirkte die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 320 Mio. Euro auf 877 Mio. Euro, überwiegend durch den Wegfall der Bezüge von unseren ehemaligen Joint-Venture-Gesellschaften ProMOS und OSRAM Opto.

Das Eigenkapital des Konzerns reduzierte sich im Geschäftsjahr um 8% auf 5.666 Mio. Euro (Vorjahr: 6.158 Mio. Euro). Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 435 Mio. Euro und den höheren negativen Währungseffekten. Die Eigenkapitalquote zum 30. September 2003 beträgt 52% (Vorjahr: 56%).

KAPITALBEDARF

Zum 30. September 2003 weisen wir Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 149 Mio. Euro aus, die innerhalb eines Jahres fällig werden. Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, diese Finanzverbindlichkeiten aus vorhandenen Zahlungsmitteln, Mittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit und Anleihen sowie durch die Prolongation der Finanzverbindlichkeiten im üblichen Geschäftsgang zurückzahlen zu können.

Am 5. Juni hat die Infineon Technologies Holding B.V., Niederlande, eine 2010 fällige nachrangige Wandelanleihe begeben und 686 Mio. Euro netto erlöst. Die Anleihe wird von der Infineon Technologies AG garantiert. Dabei haben wir das niedrige Zinsniveau auf dem europäischen Anleihemarkt genutzt, um unsere Cash-Position zu verbessern. Die Anleihe kann in bis zu 68,4 Millionen Aktien unserer Gesellschaft gewandelt werden.

Vertragliche Verpflichtungen und Eventualverpflichtungen^{1, 2, 3}

	Zum 30. September 2003						
	Gesamt	Zahlung fällig in					
		weniger als 1 Jahr	1–2 Jahren	2–3 Jahren	3–4 Jahren	4–5 Jahren	5 Jahren und länger
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Vertragliche Verpflichtungen:							
Zahlungen aus Leasingverträgen	391	82	76	68	46	44	75
Unbedingte Abnahmeverpflichtungen	1.062	420	206	121	68	55	192
Andere langfristige Verpflichtungen	636	334	227	75	–	–	–
Summe vertraglicher Verpflichtungen	2.089	836	509	264	114	99	267
Eventualverpflichtungen:							
Garantien ⁴	380	24	–	–	283	14	59
Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand ⁵	357	21	–	35	16	240	45
Summe Eventualverpflichtungen	737	45	–	35	299	254	104

Die oben stehende Tabelle sollte im Zusammenhang mit Anhang Nr. 31 zu unserem Konzernabschluss des Geschäftsjahrs 2003 gelesen werden.

Anmerkungen

- Die Umrechnung von US-Dollar in Euro erfolgt mit dem Wechselkurs €1 = \$ 1,165, dem Mittagskurs vom 30. September 2003.
- Oben stehende Tabelle enthält gewisse Rückzahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen. Die wahrscheinliche Fälligkeit wurde von der Gesellschaft abgeschätzt. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.
- Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2003 nicht quantifizierbar sind. Die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betragen 486 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2003.
- Garantien für Konzerngesellschaften in Höhe von 2.333 Mio. Euro sind darin nicht enthalten, da sie auf Grund der Konsolidierung in den Verbindlichkeiten der Konzernfinanzdaten enthalten sind.
- Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in Zusammenhang mit der Errichtung und Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten stehen und nicht anderweitig garantiert sind und müssen gegebenenfalls zurückerstattet werden, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden.

Wir haben verschiedene, voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart. Diese

Kreditlinien haben eine Höhe von 1.832 Mio. Euro, von denen 1.015 Mio. Euro zum 30. September 2003 verfügbar waren. Die Kreditlinien bestehen aus den folgenden vier Gruppen:

Kreditlinien

Laufzeit	Zusage durch Finanzinstitut	Zweck/beabsichtigter Einsatz	Zum 30. September 2003		
			Gesamthöhe	In Anspruch genommen	Verfügbar
			Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
kurzfristig	festе Zusage	Betriebskapital, Garantien, Cash Management	612	63	549
kurzfristig	keine feste Zusage	Betriebskapital	91	–	91
langfristig	festе Zusage	Betriebskapital	378	3	375
langfristig ¹	festе Zusage	Projektfinanzierung	751	751	–
Gesamt			1.832	817	1.015

Anmerkung

- Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Zum 30. September 2003 halten wir die geforderten Bilanzrelationen in Bezug auf die entsprechenden Kreditlinien ein. Wir haben eine im September 2005 fällige revolvingende Mehrwährungskreditlinie in Höhe von 375 Mio. Euro. Die Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinssätze. Zum 30. September 2003 wurde

diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen. Wir hatten zum 30. September 2002 einen weiteren kurzfristigen Teil zur revolvingenden Mehrwährungskreditlinie in Höhe von 375 Mio. Euro verfügbar. Im September 2003 entschieden wir, diese Kreditlinie auf Grund der vorhandenen Barmittel nicht zu verlängern.

Investitionen in Sachanlagen			
	Geschäftsjahr zum 30. September		
	2001	2002	2003
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Speicherprodukte	1.363	464	576
Nicht-Speicherprodukte	919	179	296
Gesamt	2.282	643	872

Zur Verbesserung von Produktivität und Technologie beabsichtigen wir, im Geschäftsjahr 2004 zwischen 1,0 und 1,5 Mrd. Euro in Sachanlagen zu investieren. Auf Grund der Länge des Zeitraums zwischen der Bestellung und der Lieferung von Anlagen sind üblicherweise erhebliche Investitionsbeträge vorab festgelegt. Etwa 54% der erwarteten Investitionen sollen auf die Frontend- und die Backend-Fertigungsprozesse des Geschäftsbereichs Speicherprodukte entfallen. 46% der geplanten Investitionen werden für die Logik-Fertigungsstätten ausgegeben. Zudem wollen wir 200 bis 400 Mio. Euro Finanz- und Beteiligungsinvestitionen im Geschäftsjahr 2004 tätigen.

Nach unserer Planung soll die Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens und des übr-

gen Finanzmittelbedarfs aus Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme von Kreditlinien, Darlehen, Fördermitteln der öffentlichen Hand und, falls notwendig, durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente erfolgen. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch Fördermittel der öffentlichen Hand beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt werden. Wir können weiterhin nicht garantieren, dass wir in der Lage sein werden, die zusätzlich benötigten Finanzmittel für Forschung und Entwicklung, zur Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens oder für andere Investitionen überhaupt bzw. zu günstigen Konditionen beschaffen zu können.

Mitarbeiter und Campeon

MITARBEITER

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung unserer Belegschaft nach Regionen und Funktionen jeweils zum 30. September der genannten Geschäftsjahre sowie die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl nach Regionen. Die Reduzierung der

Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2002 spiegelt im Wesentlichen den Mitarbeiterabbau im Rahmen des Kostenreduzierungsprogramms Impact wider. Der Mitarbeiteraufbau im Geschäftsjahr 2003 war bedingt durch den Hochlauf unserer 300-Millimeter-Fertigung und die Akquisition von SensoNor.

Anzahl der Mitarbeiter

	Zum 30. September		
	2001	2002	2003
Funktionen:			
Produktion	23.416	20.822	22.405
Forschung und Entwicklung	5.510	5.374	5.935
Vertrieb und Marketing	2.259	2.010	2.048
Verwaltung	2.628	2.217	1.920
Gesamt	33.813	30.423	32.308
Regionen:			
Deutschland	16.814	15.716	16.166
Übriges Europa	5.007	4.590	5.034
Nordamerika	3.023	2.889	2.757
Asien-Pazifik	8.949	7.200	8.234
Übrige	20	28	117
Gesamt	33.813	30.423	32.308

Durchschnitt über das Geschäftsjahr

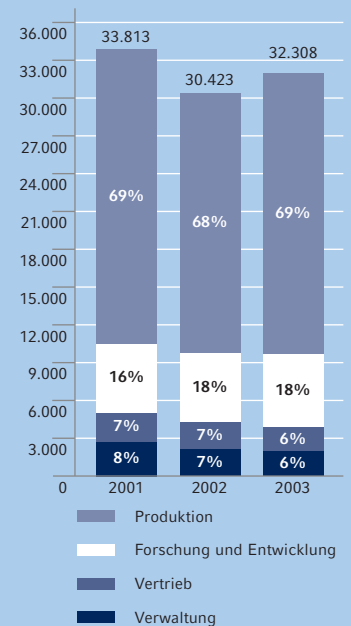
	2001	2002	2003
Regionen:			
Deutschland	16.279	15.773	16.043
Übriges Europa	4.921	4.376	4.753
Nordamerika	3.101	2.818	2.779
Asien-Pazifik	9.095	7.189	7.833
Übrige	7	24	115
Gesamt	33.403	30.180	31.523

CAMPEON

Wir beabsichtigen, einen langfristigen Leasingvertrag mit der MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG („MoTo“) abzuschließen. Wir werden einen von MoTo errichteten Bürokomplex im Südosten von München leasen. Dieser Bürokomplex soll als Firmenzentrale dienen und die momentan in Mün-

chen über mehrere Standorte verteilten Mitarbeiter in einer Arbeitsumgebung zusammenführen. MoTo ist für den Bau, der bis Mitte 2005 fertig gestellt sein soll, verantwortlich. Wir haben keine Finanzierungsverpflichtung für MoTo und keine Garantien im Zusammenhang mit der Errichtung übernommen.

Mitarbeiter in den Bereichen*



Auch nach erfolgreicher Umsetzung des Impact-Kostenreduzierungsprogramms weiterhin hoher Mitarbeitereinsatz in Forschung und Entwicklung.

* Rundungsdifferenzen sind möglich.

Risiken und Chancen

VORBEMERKUNG

Das Halbleitergeschäft ist gekennzeichnet durch eine hohe Zyklizität – d. h., dass sich Perioden starken Wachstums mit Perioden starker Marktschrumpfungen abwechseln. Marktschrumpfungen sind insbesondere gekennzeichnet durch Überkapazitäten, steigende Auftragsstornierungen sowie überdurchschnittlich sinkende Preise und rückläufige Umsatzerlöse. Ergänzt wird diese Risikolage durch den sehr hohen Investitionsbedarf zur Absicherung der Marktführerschaft sowie den außerordentlich schnellen technologischen Wandel. Diesen hohen Risiken stehen im Halbleitergeschäft allerdings auch außergewöhnliche Chancen gegenüber.

DAS RISIKOMANAGEMENTSYSTEM BEI INFINEON TECHNOLOGIES

Zur schnelleren Reaktion auf diese starken Marktschwankungen haben wir ein unternehmensweites Risiko- und Chancenmanagementsystem installiert, das uns in die Lage versetzt, die sich aus dem Markt heraus ergebenden Chancen und Risiken zu identifizieren bzw. zu antizipieren. Der alle Bereiche umfassende Ansatz und die zugehörige Berichterstattung als zentrales Element des Risiko- und Chancenmanagementsystems geben der Unternehmensleitung die Möglichkeit, schnell und effektiv zu handeln. In jedem Bereich des Unternehmens sind Risikobeauftragte und Risikoberichterstatter benannt, die für die Umsetzung des Reporting-Prozesses Verantwortung tragen. Der Reporting-Prozess sieht vor, dass Risiken und Chancen in Risiko- bzw. Chancenkategorien eingeteilt und zusammen mit einer Einschätzung des wahrscheinlichen Eintritts und ihrer Auswirkungen, gemessen in EBIT, berichtet werden.

Das Risiko- und Chancenmanagementsystem ist umfassend in unserem Intranet dokumentiert und damit für unsere Mitarbeiter weltweit zugänglich.

Das System basiert auf individuellen Beobachtungen, unterstützt durch entsprechende Managementprozesse, und ist in unsere Kernaktivitäten integriert. Es beginnt bei der Strategischen Planung und setzt sich über die Fertigung und den Vertrieb einschließlich des Forderungsmanagements fort. Als eine Erweiterung des Planungsprozesses in den Geschäftsbereichen, der Vertriebsorganisation, dem Fertigungs-Cluster und den Zentralbereichen dient das Risiko- und Chancenmanagementsystem zur Identifikation und Bewertung möglicher Abweichungen von erwarteten Entwicklungen. Neben der Identifikation und Bewertung von wesentlichen Entwicklungen, die unser Geschäft beeinflussen können, wird das System auch herangezogen, um Aktivitäten zu priorisieren und zu implementieren, um Chancen besser zu nutzen und Risiken zu reduzieren.

Die Geschäftseinheiten erstellen regelmäßig Risiken- und Chancenberichte, die den Kern des Risiko- und Chancenmanagementsystems darstellen. Die Berichte werden vom Vorstand und von den Geschäftsbereichsverantwortlichen bewertet und sind Teil des Berichtsprozesses. Im Zusammenhang mit Markt- und Wettbewerberanalysen sowie Benchmark-Untersuchungen werden diese Berichte vom Top-Management als Entscheidungsgrundlage herangezogen.

Neben diesem zentralen System gibt es weitere Frühwarnsysteme, die zur Beherrschung und Steuerung von Risiken und

Chancen beitragen. Hierzu gehört insbesondere der Einsatz der Balanced Scorecard als zentralem Teil des Infineon-Managementsystems. Ferner wird die Methodik der quantitativen Risikoanalyse im Rahmen von Investitions- bzw. Forschungs- und Entwicklungsprojekten eingesetzt, um größere Transparenz zu erzeugen und entsprechende Maßnahmen, die zum Erfolg der Projekte führen können, abzuleiten. Die systematische Weiterentwicklung bestehender und neuer Systeme mit Frühwarncharakter trägt maßgeblich zur weiteren Festigung und zum gezielten Ausbau unserer unternehmensweiten Risiko- und Chancenkultur bei.

Das Risikofrüherkennungssystem ist vom Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft worden.

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN

Durch Veränderungen in einigen geographischen Teilen der Welt, in denen wir aktiv sind, könnten Risiken entstehen.

Unsere weltweite Strategie sieht vor, dass wir aus den unterschiedlichsten Gründen Entwicklungs- und Fertigungsstandorte über den ganzen Globus verteilt unterhalten. Dies können Marktzugangs- oder auch Technologie- sowie Kostengründe sein. Über die Hälfte unserer Umsatzerlöse wird außerhalb Europas generiert. Mit den zu erwartenden hohen Wachstumsraten in asiatischen Ländern wird unsere Investitionstätigkeit in dieser Region eher zunehmen. Es können daher Risiken entstehen, die sich daraus ergeben, dass

- wirtschaftliche und geopolitische Krisen Auswirkungen auf regionale Märkte haben,

- länderspezifische Gesetze und Regelungen den Investitionsrahmen und die Möglichkeiten, freien Handel zu betreiben, beeinflussen und

- unterschiedliche Praktiken bei der Auslegung von steuerlichen, juristischen oder administrativen Regeln die Ausübung unternehmerischer Tätigkeiten eingrenzen.

Substanzuelle Veränderungen in dem jeweiligen Umfeld können negative Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Zum Beispiel hat die SARS-Epidemie 2003 zu einer vorübergehenden Nachfrageschwäche bei Mobiltelefonen im asiatischen Raum geführt. Dadurch verkauften unsere Kunden weniger Mobiltelefone, was wiederum negative Auswirkungen auf den Halbleitermarkt hatte. Es ist daher nicht auszuschließen, dass solche regionale Krisen auch in Zukunft negative Auswirkungen auf unsere Ertragsfähigkeit haben können. Die breite Diversifikation innerhalb unseres Produktportfolios und eine Streuung der Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten sind jedoch ein wirksames Mittel gegen die Auswirkungen solcher regionalen Krisen, weil die Abhängigkeiten generell geringer sind.

BRANCHEN- UND UNTERNEHMENS-SPEZIFISCHE RISIKEN

Für den Bereich Speicherprodukte besteht eine starke Abhängigkeit von der Entwicklung der Preise für DRAM-Speicher, die insgesamt auch weiterhin das bedeutendste Risiko für Infineon darstellt. Vor dem aktuellen Hintergrund und im Zusammenhang mit gezielten Maßnahmen hinsichtlich Risikominimierung durch z. B. noch stärkere Fokussierung auf ertragsreichere DRAM-

Produkte und Schlüsselkunden, verbunden mit einer gezielten Ausweitung des Produktportfolios, rechnen wir jedoch mit Chancen in annähernd gleicher Höhe.

Bei den Logikbereichen Drahtgebundene Kommunikation und Sichere Mobile Lösungen besteht trotz verhalten positiver Tendenzen das größte Risiko in einer weiterhin verzögerten bzw. nicht nachhaltigen Geschäftsbelegung mit entsprechend geringerem Absatz und anhaltend hohem Preisdruck.

Ein insgesamt für die Halbleitertechnologie wesentliches, geschäftstypisches Risiko ist der Hochlauf neuer Technologien mit dem Risiko von Verzögerungen bzw. deutlichen Ausbeuteschwankungen. Diesem Risiko versuchen wir mit verbessertem Projektmanagement und entsprechend engem Monitoring der betroffenen Geschäftsprozesse zu begegnen.

Gegen Produktrisiken haben wir ein Netz von Qualitätskontrollen eingerichtet, in das auch die wichtigsten Lieferanten einbezogen sind. Alle Standorte sind nach der Norm TS 16949:2000 zertifiziert.

Wir schützen uns mit Versicherungen bestmöglich gegen Auswirkungen von Haftungsrisiken oder Schadensfällen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Steuerliche, wettbewerbs-, patent- und börsenrechtliche Regelungen können ebenso Unternehmensrisiken beinhalten. Die Gesellschaft lässt sich deshalb umfassend von internen und externen Fachleuten beraten.

MARKTRISIKEN

Fremdwährungsmanagement

Die internationale Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit bringt eine Vielzahl von Zahlungsströmen in unterschiedlichen Währungen – vor allem in US-Dollar – mit sich. Da wir aus diesen Geschäften einem Währungsrisiko ausgesetzt sind, kommt der Absicherung des Währungsrisikos eine hohe Bedeutung zu.

Ein bedeutender Anteil unserer Umsatzerlöse, Fertigungs-, Vertriebs-, Verwaltungs- sowie Forschungs- und Entwicklungskosten entsteht originär nicht in Euro, sondern vorwiegend in US-Dollar. Wechselkursschwankungen gegenüber dem Euro können einen negativen Effekt auf Umsatzerlöse, Kosten und Ergebnis haben.

Unsere Geschäftspolitik zur Begrenzung von kurzfristigen Fremdwährungsrisiken ist es, mindestens 75% des erwarteten Netto- risikos über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten im Voraus, je nach Art des Grundgeschäfts für einen bedeutenden Anteil auch darüber hinaus, zu sichern. Ein Teil des Fremdwährungsrisikos bleibt auf Grund des Unterschieds zwischen tatsächlichen und erwarteten Beträgen bestehen. Wir berechnen dieses Nettorisiko auf Basis des Kapitalflusses unter Berücksichtigung von Bilanzpositionen, eingegangenen oder vergebenen Aufträgen und allen anderen geplanten Einnahmen und Ausgaben. Das verbleibende Risiko wird im Rahmen definierter Value-at-Risk-Parameter gesteuert.

Management des Zinsrisikos

Unsere Zinsrisikopositionen resultieren hauptsächlich aus Geldanlageinstrumenten,

Wertpapieremissionen und Kreditaufnahmen. In den Geschäftsjahren 2002 und 2003 haben wir jeweils eine Wandelschuldverschreibung begeben. Vor dem Hintergrund der hohen Geschäftszyklizität und der operativen Flexibilität halten wir einen vergleichsweise hohen Kassenbestand, den wir in Instrumente mit kurzer Zinsbindungsdauer anlegen. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos nutzen wir Zinsderivate, um die aktivische und passivische Zinsbindungsdauer einander anzunähern.

Materialpreisrisiken

Wir sind auf Grund unserer Abhängigkeit von verschiedenen Materialien Preisrisiken ausgesetzt. Wir versuchen, diese Risiken durch unsere Einkaufsstrategien und durch Einsatz geeigneter Instrumente zu minimieren. Wir setzen keine derivativen Finanzinstrumente zur Vermeidung von Restrisiken aus Preisschwankungen ein.

Finanzierungsrisiken

Alle Halbleiterunternehmen, die eigene Fertigungsstätten betreiben, müssen erhebliche Kapitalbeträge für den Bau, die Erweiterung, die Modernisierung und die Instandhaltung dieser Anlagen einsetzen. Darüber hinaus müssen erhebliche finanzielle Mittel für Forschung und Entwicklung aufgewendet werden. Der Finanzmittelbedarf soll aus Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme von Kreditlinien, Fördermitteln der öffentlichen Hand und – abhängig von Marktbedingungen – durch die Aufnahme von Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente erfolgen. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch

Fördermittel der öffentlichen Hand beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt werden. Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen von Forschung und Entwicklung und der Fertigung werden weiterhin aktiv genutzt, um den Finanzierungsbedarf zu reduzieren.

RECHTLICHES RISIKO

Wie bei vielen Unternehmen in der Halbleiterbranche wird auch Infineon gegenüber behauptet, das Unternehmen habe gewerbliche Schutzrechte verletzt, fehlerhafte Produkte geliefert oder die Umweltschutzaufgaben nicht eingehalten. Ungeachtet der Erfolgsaussichten derartiger Ansprüche, können dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Abwehr derartiger Ansprüche hohe Kosten entstehen. Infineon wehrt sich in solchen Angelegenheiten energisch mit Unterstützung interner und externer Experten.

GESAMTRISIKO

Trotz des anhaltend schwierigen Geschäftsumfelds haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt zu keinem Zeitpunkt bestandsgefährdende Risiken identifiziert. Für das laufende und folgende Geschäftsjahr schätzen wir insbesondere wegen der besseren Preisperspektiven für Speicherchips die Risiko-/Chancensituation im Vergleich zum Vorjahr insgesamt günstiger ein. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, sind nicht erkennbar.

Ergänzende Beschreibungen der Risiken können Sie aus dem anliegenden Anhang zum Konzernabschluss und den „Annual Report on Form 20-F“ entnehmen.

Infineon Technologies AG

Die Infineon Technologies AG ist die Führungsgesellschaft des Infineon-Konzerns und führt die entsprechenden Leitungs- und Zentralfunktionen aus. Die Infineon Technologies AG übernimmt wesentliche übergreifende Aufgaben, wie das konzernweite Finanz- und Rechnungswesen, das Personalwesen, strategische und produktionsorientierte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die weltweite Unternehmens- und Marketingkommunikation, und steuert die logistischen Prozesse im Konzern. Die Infineon Technologies AG verfügt über eigene Fertigungen in Berlin, München und Regensburg.

Die Infineon Technologies AG stellt ihren Jahresabschluss nach den Regeln des HGB auf. Der vollständige Abschluss wird separat veröffentlicht.

Die Umsatzerlöse der Infineon Technologies AG betragen im Berichtsjahr 8.122 Mio. Euro (Vorjahr: 6.765 Mio. Euro). Es wird ein Jahresfehlbetrag von 287 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahr: 617 Mio. Euro). Auf Grund der betriebsbedingten Abrechnungsstruktur im Infineon-Konzern mit der Infineon Technologies AG als Verrechnungsdrehscheibe für die Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften weist die Muttergesellschaft höhere Umsätze aus als der Konzern.

Die Vermögens- und Finanzlage der Infineon Technologies AG ist geprägt durch den Rückgang der Finanzanlagen, im Wesentlichen auf Grund der Veräußerungen der Beteiligungen an ProMOS und UMCi und eines Anstiegs bei Wertpapieren und flüssi-

gen Mitteln, dem ein korrespondierender Anstieg in den Verbindlichkeiten gegenübersteht. Das Eigenkapital ist, bedingt durch den Bilanzverlust, auf 6.774 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 7.061 Mio. Euro). Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 60% (Vorjahr: 64%).

DIVIDENDE

Da der Jahresabschluss der Infineon Technologies AG für 2001/2002 keinen Bilanzgewinn auswies, wurde für das Geschäftsjahr keine Dividende ausgeschüttet. Ebenso kann für das Geschäftsjahr 2002/2003 keine Dividende ausgeschüttet werden, da die Muttergesellschaft Infineon Technologies AG für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Bilanzverlust ausweist.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 8. Oktober 2003 haben wir die Vereinbarung über den Erwerb von Vermögensgegenständen und die Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten des Protocol-Software-Geschäfts von Siemens für 13 Mio. Euro und die Übernahme von rund 145 Software-Ingenieuren auf dem Gebiet der Mobilien Kommunikation bekannt gegeben. Des Weiteren haben wir einen Lizenz- und einen Entwicklungsleistungsvertrag mit Siemens geschlossen und unseren Produktliefervertrag mit Siemens geändert. Die endgültige Umsetzung dieser Transaktion hängt von einer Vielzahl von Bedingungen ab.

Im Zusammenhang mit unseren fortgeführten Restrukturierungen wurde am 16. Oktober 2003 mit Electronic Data Services (EDS) die Auslagerung von Teilen der weltweiten Personalbetreuung vereinbart. Der Umfang der Vereinbarung wird derzeit noch verhandelt und enthält den Übergang einiger Mitarbeiter zu EDS. Die Vereinbarung enthält bestimmte Kündigungsklauseln.

Ausblick

Im vierten Quartal unseres Geschäftsjahrs 2003 konnten wir eine merkliche Verbesserung im Halbleitermarkt feststellen. Wegen des anhaltenden Preisdrucks in allen unseren Segmenten und der charakteristischen Volatilität der Industrie können wir jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht daraus schließen, dass es sich bei dem gegenwärtigen Aufwärtstrend um einen nachhaltigen Aufschwung handelt. Führende Marktforschungsinstitute sagen ein Wachstum für den gesamten Halbleitermarkt von 19 bis 26 Prozent für das Kalenderjahr 2004 vorher.

Ausblick auf unsere Segmente für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2004:

■ Da sich der starke saisonale Effekt des vierten Quartals des Geschäftsjahrs 2003 nicht im gesamten ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 fortsetzen wird, erwarten wir im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs eine insgesamt niedrigere Nachfrage. Im Verlauf des Geschäftsjahrs 2004 erwarten wir für diesen Geschäftsbereich ein Wachstum entsprechend der Marktentwicklung.

■ Am Markt für Drahtgebundene Kommunikation erwarten wir weiterhin unsichere Marktbedingungen und einen anhaltenden starken Preisdruck, bedingt durch die Kombination aus dem starken Euro, verzögerten oder verhaltenen Investitionen in die Infrastruktur durch die globalen Netzwerkbetreiber und den Unsicherheiten bei der VDSL-Standardisierung. Für den Broadband-Access-Markt für ADSL erwarten wir jedoch ein festes Wachstum im Geschäftsjahr 2004.

■ Die weltweite Automobilproduktion soll im Jahr 2004 leicht wachsen, bei anhaltendem Preisdruck in der Automobilelektronik. Mit dem Übergang vom Einzelproduktgeschäft hin zu kompletten anwendungsspezifischen Chipsets erwarten wir für das Geschäftsjahr 2004 stabiles und über dem Markt liegendes Wachstum für Automobilhalbleiter. Für Leistungshalbleiter erwarten wir im Geschäftsjahr 2004 ein solides Wachstum.

■ Für Speicherprodukte sehen wir eine stabile Nachfrageentwicklung durch das Weihnachtsgeschäft und einen höheren Megabyte-Bedarf pro PC. Nach den Schätzungen führender Marktforschungsinstitute wird ein zehnpromotiges Wachstum für 2004 bei der PC-Nachfrage erwartet, basierend auf steigenden Ausgaben von Unternehmen, die ihre älteren Anlagen ersetzen. Das Wachstum auf der Angebotsseite wird wegen der niedrigen Investitionen der Industrie in den beiden letzten Jahren eher als begrenzt angesehen.

Wir versuchen, dem Preisdruck durch anhaltende Steigerung unserer Produktivität und Reduzierung unserer Produktionskosten mit unseren 300-Millimeter-Produktionsressourcen entgegenzuwirken. Wir glauben, dass unsere Technologie- und Produktionsallianzen uns die Möglichkeiten geben werden, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und weitere Marktanteile zu gewinnen. Unter stabilen Marktbedingungen erwarten wir die Einhaltung unserer Wachstumsstrategie und einen Gewinn im Geschäftsjahr 2004.

München, im November 2003
Der Vorstand

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer

An den Aufsichtsrat und die Aktionäre der Infineon Technologies AG

Wir haben die beigefügten Konzernbilanzen der Infineon Technologies AG, einschließlich ihrer Tochterunternehmen, zum 30. September 2002 und 2003, die Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, die Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen sowie die Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September 2001, 2002 und 2003 endenden Geschäftsjahre (Konzernrechnungslegung) geprüft. Die Konzernrechnungslegung liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über die Konzernrechnungslegung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der US-amerikanischen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Konzernrechnungslegung frei von wesentlichen Mängeln ist. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Wertansätze und Angaben in der Konzernrechnungslegung auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung des Vorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Konzernrechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung stellt die oben genannte Konzernrechnungslegung die Vermögens- und Finanzlage des Infineon-Konzerns zum 30. September 2002 und 2003 sowie die Ertragslage und die Zahlungsströme für die am 30. September 2001, 2002 und 2003 endenden Geschäftsjahre in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles) in allen wesentlichen Belangen angemessen dar.

München, den 7. November 2003

KPMG DEUTSCHE TREUHAND-GESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Berger
Wirtschaftsprüfer

Feege
Wirtschaftsprüfer

Konzernabschluss

Infineon Technologies AG

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre

	Anhang Nr.	2001	2002	2003
		Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Umsatzerlöse				
aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	5	4.352	4.035	5.153
aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen	27	995	855	999
Umsatzerlöse gesamt		5.347	4.890	6.152
Umsatzkosten	7	4.580	4.289	4.614
Bruttoergebnis vom Umsatz		767	601	1.538
Forschungs- und Entwicklungskosten		1.189	1.060	1.089
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten		782	643	679
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	8	117	16	29
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, Saldo		-200	-46	85
Betriebsergebnis		-1.121	-1.072	-344
Zinsergebnis		-1	-25	-52
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften		21	-47	18
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	16	11	18	-2
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo		65	-41	21
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile		6	7	8
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.019	-1.160	-351
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	9	427	143	-84
Konzernfehlbetrag von fortgeführten Geschäften		-592	-1.017	-435
Ergebnis von aufgegebenen Geschäften	4	1	-4	-
Konzernjahresfehlbetrag		-591	-1.021	-435
Konzernjahresfehlbetrag pro Aktie	10	Euro	Euro	Euro
von fortgeführten Geschäften – unverwässert und verwässert		-0,92	-1,46	-0,60
von aufgegebenen Geschäften – unverwässert und verwässert		-	-0,01	-
Konzernjahresfehlbetrag – unverwässert und verwässert		-0,92	-1,47	-0,60

Siehe auch die beigegefügtten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Infineon Technologies AG

Konzern-Bilanzen

Konzern-Bilanzen zum 30. September 2002 und 2003

	Anhang Nr.	2002 Mio. Euro	2003 Mio. Euro
AKTIVA			
Umlaufvermögen:			
Zahlungsmittel		1.199	969
Wertpapiere des Umlaufvermögens	11	738	1.784
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	758	876
Vorräte	13	891	959
Aktive kurzfristige latente Steuern	9	82	113
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	14	523	605
Summe Umlaufvermögen		4.191	5.306
Sachanlagen	15	4.491	3.817
Finanzanlagen	16	708	425
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel		70	67
Aktive latente Steuern	9	787	705
Sonstige Vermögensgegenstände	17	671	485
Summe Aktiva		10.918	10.805
PASSIVA			
Kurzfristige Verbindlichkeiten:			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	21	120	149
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	1.197	877
Rückstellungen	19	473	644
Passive kurzfristige latente Steuern	9	21	39
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	20	572	425
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		2.383	2.134
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, ohne kurzfristig fällige Bestandteile	21	1.710	2.343
Passive latente Steuern	9	58	32
Sonstige Verbindlichkeiten	22	609	630
Summe Verbindlichkeiten		4.760	5.139
Eigenkapital:			
Grundkapital	23	1.442	1.442
Zusätzlich eingezahltes Kapital (Kapitalrücklage)		5.569	5.573
Gewinnrücklagen		-826	-1.261
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	-27	-88
Summe Eigenkapital		6.158	5.666
Summe Passiva		10.918	10.805

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Infineon Technologies AG

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen für die

	Ausgegebene Stückaktien	Betrag
	Anzahl	Mio. Euro
Konzern-Bilanz zum 1. Oktober 2000	625.501.507	1.251
Konzernjahresfehlbetrag	–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren		
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:		
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung, saldiert mit Kosten der Kapitalerhöhung	60.000.000	120
Kauf von Ardent	706.714	1
Kauf von Catamaran	5.730.866	12
Einlage in ein assoziiertes Unternehmen	443.488	1
Von Gemeinschaftsunternehmen gehaltene, auf den Namen lautende Stückaktien	–	–
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	–	–
Auszahlung von Dividenden	–	–
Veräußerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen an eine Siemens-Gesellschaft	–	–
Einlagen der Siemens AG	–	–
Konzern-Bilanz zum 30. September 2001	692.382.575	1.385
Konzernjahresfehlbetrag	–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren		
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:		
Mitarbeiteraktien	355.460	1
Kauf von Catamaran	546.183	1
Kauf von MIC	27.500.000	55
Von Gemeinschaftsunternehmen gehaltene, auf den Namen lautende Stückaktien	–	–
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	–	–
Einlagen der Siemens AG	–	–
Konzern-Bilanz zum 30. September 2002	720.784.218	1.442
Konzernjahresfehlbetrag	–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren		
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:		
Kauf von Catamaran	96.386	–
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	–	–
Andere Einlagen	–	–
Konzern-Bilanz zum 30. September 2003	720.880.604	1.442

Siehe auch die beigegeführten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

am 30. September 2001, 2002 und 2003 endenden Geschäftsjahre

Zusätzlich eingezahltes Kapital/Kapitalrücklage	Verlustvortrag/Gewinnrücklagen	Kumulierte Fremdwährungs-Umrechnungsdifferenz	Zusätzliche Pensionsverbindlichkeiten	Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren	Gesamt
Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
3.251	1.192	106	–	6	5.806
–	–591	–	–	–	–591
–	–	–19	–12	–8	–39
					–630
1.355	–	–	–	–	1.475
38	–	–	–	–	39
240	–	–	–	–	252
20	–	–	–	–	21
–4	–	–	–	–	–4
–19	–	–	–	–	–19
–	–406	–	–	–	–406
392	–	–	–	–	392
–26	–	–	–	–	–26
5.247	195	87	–12	–2	6.900
–	–1.021	–	–	–	–1.021
–	–	–92	–8	–	–100
					–1.121
7	–	–	–	–	8
8	–	–	–	–	9
270	–	–	–	–	325
4	–	–	–	–	4
23	–	–	–	–	23
10	–	–	–	–	10
5.569	–826	–5	–20	–2	6.158
–	–435	–	–	–	–435
–	–	–76	2	13	–61
					–496
1	–	–	–	–	1
7	–	–	–	–	7
–4	–	–	–	–	–4
5.573	–1.261	–81	–18	11	5.666

Infineon Technologies AG

Konzern-Kapitalflussrechnungen

Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre

	2001	2002	2003
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Konzernfehlbetrag	-591	-1.021	-435
Abzüglich: Ergebnis von aufgegebenen Geschäften	1	-4	-
Konzernfehlbetrag von fortgeführten Geschäften	-592	-1.017	-435
Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresfehlbetrages von fortgeführten Geschäften auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Planmäßige Abschreibungen	1.121	1.370	1.437
Erworbene, nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	69	37	6
Auflösung der Abgrenzung von Personalaufwendungen	25	23	7
Wertberichtigungen auf Forderungen	19	-5	-16
Wertberichtigungen auf Vorräte	358	-	-
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1	1	-56
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten	-235	-39	10
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	-	2	3
Anteiliger Fehlbetrag/Überschuss von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	-21	47	-18
Aufwendungen/Erträge aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	-11	-18	2
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	-6	-7	-8
Außerplanmäßige Abschreibungen	51	51	98
Passive Rechnungsabgrenzung und andere nicht zahlungswirksame Vorgänge	-26	-87	-93
Latente Steuern	-493	-282	16
Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens:			
Zu-/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	681	-131	-227
Zu-/Abnahme von Vorräten	-394	-28	-112
Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-76	39	156
Ab-/Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49	40	-217
Ab-/Zunahme von Rückstellungen	-322	86	164
Ab-/Zunahme von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	36	-37	-17
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten	-11	181	31
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	221	226	731

Fortsetzung Konzern-Kapitalflussrechnungen

	2001	2002	2003
	Mio. Euro	Mio. Euro	Mio. Euro
Cash Flow aus Investitionstätigkeit:			
Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens	-82	-709	-2.752
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	474	62	2.013
Einzahlungen aus dem Abgang von Geschäftsaktivitäten	346	96	164
Einzahlungen aus Unternehmenszusammenschlüssen	-	50	3
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an assoziierten und verbundenen Unternehmen	-214	-88	-73
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-82	-39	-58
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.282	-643	-872
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	27	27	53
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.813	-1.244	-1.522
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit:			
Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten	-14	4	-36
Veränderung der Finanzforderungen und -verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen	70	-40	-76
Erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten	128	1.482	700
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-21	-21	-25
Veränderung der als Sicherheitsleistungen hinterlegten liquiden Mittel	45	15	3
Einzahlungen aus Ausgabe von Aktien an Minderheitsgesellschafter	20	-	-
Einzahlungen aus Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien	1.475	8	-
Auszahlungen von Dividenden	-406	-	-
Verkauf von Beteiligungen an einem Gemeinschaftsunternehmen an Siemens	564	-	-
Kapitaleinlagen	-15	-	-
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.846	1.448	566
Währungsumrechnungseffekte auf Zahlungsmittel	2	1	-4
Veränderung der Zahlungsmittel von fortgeführten Geschäften	256	431	-229
Veränderung der Zahlungsmittel von aufgegebenen Geschäften	-10	11	-1
Zahlungsmittel am Periodenanfang	511	757	1.199
Zahlungsmittel am Periodenende	757	1.199	969

Siehe auch die beigelegten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Anhang zum Konzernabschluss

1. BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, DER GRÜNDUNG UND DER GRUNDLAGEN DER DARSTELLUNG

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Infineon Technologies Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesellschaften („die Gesellschaft“) entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie in Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chipkarten, eingesetzt. Das Leistungsspektrum der Gesellschaft umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Lösungen für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden der Gesellschaft befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 30. September.

Gründung

Die Gesellschaft wurde als eigenständiges Rechtssubjekt mit Wirkung zum 1. April 1999 gegründet („Gründung“). Im Zuge der Gründung erfolgte die Übertragung des nahezu vollständigen mit dem Halbleitergeschäft verbundenen Vermögens der Siemens AG („Siemens“) mit allen Beteiligungen, Betrieben und Geschäftsaktivitäten. Der Börsengang der Gesellschaft erfolgte am 13. März 2000. Die Gesellschaft wird an der New York Stock Exchange gehandelt und ist eines der 30 DAX-Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Grundlagen der Darstellung

Der Konzernabschluss wurde nach den in den USA geltenden Grundsätzen der Rechnungslegung („US-GAAP“) erstellt. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufstellen. Nach § 292a HGB braucht ein Konzernabschluss nach deutschem Recht nicht aufgestellt werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen wie US-GAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt die Gesellschaft die Befreiungsmöglichkeit des § 292a HGB in Anspruch.

Alle in diesem Jahresabschluss gezeigten Beträge sind in Millionen Euro („€“), außer wenn anders angegeben.

Im Konzernabschluss und Konzernanhang des Vorjahrs wurden bestimmte Beträge umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Geschäftsjahr zu gewährleisten. Das Konzernergebnis wird von diesen Umgliederungen nicht beeinflusst.

2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

Konsolidierungsgrundsätze

Der vorliegende Konzernabschluss umfasst, jeweils auf konsolidierter Basis, die Gesellschaft und deren wesentliche Tochtergesellschaften. Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mit 20% oder mehr beteiligt ist, die jedoch nicht unter der einheitlichen Leitung der Gesellschaft stehen („Assoziierte Unternehmen“), werden prinzipiell unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert (siehe Anhang Nr. 16). Das anteilige Jahresergebnis von den nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften wird im Allgemeinen um drei Monate zeitversetzt erfasst. Sonstige Beteiligungen, an denen die Gesellschaft einen Eigentumsanteil von weniger als 20% hält, werden zu Anschaffungskosten aufgenommen. Die Auswirkungen aller wesentlichen Geschäftsvorfälle zwischen den konsolidierten Gesellschaften sind im Konzernabschluss eliminiert.

Der Infineon-Konzern besteht neben der Gesellschaft aus der folgenden Anzahl von Unternehmen:

	Konsolidierte Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gesamt
30. September 2002	44	11	55
Zugänge	8	3	11
Zusammenschlüsse	-1	-	-1
Abgänge	-	-2	-2
Übertragungen	1	-1	-
30. September 2003	52	11	63

Zusätzlich umfasst der Konzernabschluss 30 (2002: 32) Tochtergesellschaften und 8 (2002: 9) assoziierte Unternehmen, die nicht konsolidiert, sondern nach dem Anschaffungskostenprinzip bilanziert werden, da diese keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Finanzanlagen“. Die Auswirkung dieser Unternehmen auf die Konzernbilanzsumme, die Konzernumsätze und das Konzernergebnis war in den Betrachtungsperioden geringer als 1%.

Berichtswährung und Währungsumrechnung

Der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden ausländischer Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Euro ist, werden grundsätzlich unter Anwendung der Stichtagskursmethode

umgerechnet. Posten der Gewinn-und-Verlust-Rechnungen werden dagegen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs des Geschäftsjahrs umgerechnet. Unterschiede aus der Umrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden, die aus zu Vorjahren abweichenden Wechselkursen resultieren, werden innerhalb des Postens „Änderungen im

Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ (Other Comprehensive Income/Loss) separat im Eigenkapital ausgewiesen.

Nachfolgend sind die bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwendeten Wechselkurse für die wichtigsten Währungen aufgeführt:

	Wechselkurs zum 30. September		Jahresdurchschnittskurs	
	2002	2003	2002	2003
Währung:	Euro	Euro	Euro	Euro
US-Dollar	1 USD = 1,0208	0,8762	1,0910	0,9234
Japanische Yen	100 JPY = 0,8318	0,7852	0,8661	0,7760
Britisches Pfund	1 GBP = 1,5939	1,4428	1,6017	1,4797
Singapur-Dollar	1 SGD = 0,5722	0,5060	0,6029	0,5276

Zahlungsmittel

Bargeld sowie alle Finanzmittel mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis zu drei Monaten werden als liquide Mittel ausgewiesen.

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel beinhalten Geldanlagen, die im Rahmen der Finanzierung als Sicherheit hinterlegt sind.

Wertpapiere

Die Gesellschaft hält frei veräußerbare Wertpapiere („Available for Sale“-Papiere), die zu dem zuletzt gehandelten Marktpreis vor dem Bilanzstichtag bewertet sind. Kumulierte unrealisierte Gewinne und Verluste, nach Abzug von latenten Steuern, sind im Eigenkapital als „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste und voraussichtlich dauernde Wertminderungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens werden in der Position „Sonstige Erträge und Aufwendungen“ erfasst. Im Veräußerungsfall wird für die Ermittlung realisierter Gewinne oder Verluste vor Steuern von den individuellen Anschaffungskosten der Wertpapiere ausgegangen.

Vorräte

Die Vorräte werden entweder zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktpreis bewertet, wobei die Herstellungskosten vorwiegend zu Durchschnittswerten ermittelt werden. Die Herstellungskosten beinhalten die direkt zurechenbaren Material- und Lohnkosten sowie anteilige Gemeinkosten.

Sachanlagen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter

Abschreibungen bilanziert. Kosten für Ersatzteile, laufende Instandhaltung und Reparaturen werden bei Anfall aufwandswirksam erfasst. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder degressiven Methode ermittelt. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten Anzahlungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Grund und Boden, grundstücksgleiche Rechte sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht planmäßig abgeschrieben. Die Herstellungskosten bestimmter langlebiger Vermögensgegenstände enthalten aktivierte Finanzierungskosten, die über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände planmäßig abgeschrieben werden. Für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 wurden Zinsen in Höhe von €27, €0 und €0 aktiviert. Die den Abschreibungen zu Grunde gelegten Nutzungsdauern betragen bei:

	Jahre
Gebäuden	10–25
Technischen Anlagen und Maschinen	3–10
Sonstigen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1–10

Leasing

Die Gesellschaft ist Leasingnehmer von Sachanlagen. Alle Leasinggeschäfte, bei denen die Gesellschaft in der Position des Leasingnehmers als wirtschaftlicher Eigentümer zu sehen ist, werden gemäß dem vom Financial Accounting Standards Board („FASB“) veröffentlichten Statement of Financial Accounting Standards („SFAS“) Nr. 13, RECHNUNGSLEGUNG FÜR LEASING, als Finanzierungsleasing behandelt und bei der Gesellschaft als Sachanlagen bilanziert. Alle anderen Leasinggeschäfte werden als Operating Leases behandelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Gemäß SFAS Nr. 141, Geschäftszusammenschlüsse, wendet die Gesellschaft die Erwerbsmethode an. Die Erwerbsmethode fordert, dass bei einem Unternehmenserwerb neben dem Geschäfts- und Firmenwert (Goodwill) die immateriellen Vermögensgegenstände getrennt erfasst und ausgewiesen werden.

Seit dem 1. Oktober 2001 wendet die Gesellschaft SFAS Nr. 142, Geschäfts- und Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, an. Bei der Einführung des SFAS Nr. 142, SFAS Nr. 141 folgend, überprüfte die Gesellschaft ihre vorhandenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Firmenwerte, die bei früheren Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden, und gliederte Beträge von €1, die zuvor dem Mitarbeiterstamm zugerechnet wurden, um, damit den neuen Kriterien des SFAS Nr. 141 entsprochen wird. Bei Einführung des SFAS Nr. 142 überprüfte die Gesellschaft die Nutzungsdauern und Restwerte aller erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände neu, was zu keinen wesentlichen Änderungen der Abschreibungsdauern führte. Die Gesellschaft stellte keine immateriellen Vermögensgegenstände mit unbegrenzter Nutzungsdauer fest. Im Zusammenhang mit der Einführung von SFAS Nr. 142 und der Umstellungsbewertung der Geschäfts- und Firmenwerte gab es kein Anzeichen dafür, dass die Geschäfts- und Firmenwerte der Berichtseinheiten zum Zeitpunkt der Umstellung wertberichtigt werden müssen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen hauptsächlich aus erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen, wie z. B. Lizenzen und erworbenen Technologien, die zum Kaufpreis bilanziert wurden, sowie aus Geschäfts- und Firmenwerten, die im Zusammenhang mit Unternehmensakquisitionen als der Teil des Kaufpreises, der den Marktwert des erworbenen Nettovermögens überstieg, entstanden. Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über den erwarteten Nutzungszeitraum, der von drei bis zehn Jahren reicht, abgeschrieben. Gemäß SFAS Nr. 142 werden Geschäfts- und Firmenwerte nicht abgeschrieben, sondern nach den Vorgaben des SFAS Nr. 142 mindestens einmal jährlich auf eventuelle Wertminderungen geprüft. Gewöhnlich nimmt die Gesellschaft die jährlichen Überprüfungen im letzten Quartal des Geschäftsjahrs vor. Falls der Buchwert der Geschäftseinheit inklusive Geschäfts- und Firmenwert den Marktwert übersteigt, ergibt sich die Wertminderung aus der Differenz zwischen dem Buchwert des Geschäfts- und Firmenwerts und dem Marktwert des Geschäfts- und Firmenwerts. Die Ermittlung der Marktwerte für die einzelnen Geschäftseinheiten und der zugehörigen Geschäfts- und Firmenwerte erfordert wesentliche Annahmen seitens des Managements.

Vor der Anwendung des SFAS Nr. 142 wurden Geschäfts- und Firmenwerte über ihre erwarteten Nutzungsdauern abgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2001 betrug die Abschreibung für Geschäfts- und

Firmenwerte €21. Wären die Bestimmungen der SFAS Nr. 141 und 142 für alle dargestellten Geschäftsjahre angewendet worden, d. h. das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2001 wäre nicht um die Abschreibung von Geschäfts- und Firmenwerten reduziert worden, hätten der Jahresfehlbetrag und das Ergebnis pro Aktie den nachfolgend dargestellten Pro-forma-Beträgen entsprochen:

	Geschäftsjahr zum 30. September 2001
Jahresfehlbetrag	
Wie ausgewiesen	-591
Pro forma	-570
Verlust je Aktie (in Euro):	
Wie ausgewiesen – unverwässert und verwässert	-0,92
Pro forma – unverwässert und verwässert	-0,89

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die Gesellschaft überprüft Anlagegüter einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen, sobald Ereignisse oder Veränderungen eintreten, die darauf hindeuten, dass voraussichtlich dauernde Wertminderungen vorliegen könnten. Dabei wird der Restbuchwert mit den erwarteten künftigen Einnahmeüberschüssen, die von diesem Vermögensgegenstand generiert werden, verglichen. Eine außerplanmäßige Abschreibung wird insoweit vorgenommen, als nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Buchwert über dem Marktwert oder dem Barwert künftiger Einnahmeüberschüsse liegt. Die Beurteilung durch das Management erfordert wesentliche Annahmen, um diskontierte zukünftige Cash Flows abschätzen zu können.

Finanzinstrumente

Die Gesellschaft ist als weltweit operierendes Unternehmen den Auswirkungen von Währungsschwankungen ausgesetzt. Zur Sicherung gegen Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Das FASB veröffentlichte SFAS Nr. 133, Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften, geändert durch SFAS Nr. 137, SFAS Nr. 138 und SFAS Nr. 149. Sie beinhalten Aussagen zur Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten einschließlich solcher, die Bestandteil anderer Verträge sind, sowie von Sicherungsgeschäften. Derivative Finanzinstrumente werden mit ihrem Marktwert unter den sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenständen oder den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Veränderungen der Marktwerte werden in den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen

oder als Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, ausgewiesen, in Abhängigkeit davon, ob das Finanzinstrument Teil eines Sicherungsgeschäfts ist, und gemäß der Art des Sicherungsgeschäfts. Der Marktwert der derivativen Finanzinstrumente und anderer Finanzinstrumente wird in Anhang Nr. 29 erläutert.

Umsatzrealisierung

■ Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Produktverkäufen werden gemäß SEC Staff Accounting Bulletin („SAB“) Nr. 101 realisiert, wenn Vereinbarungen existieren, die Kaufpreise fest oder eindeutig bestimmbar sind, der Versand erfolgt ist und die Zahlung seitens des Kunden hinreichend wahrscheinlich ist. Die Gesellschaft erfasst zum Zeitpunkt der Umsatzlegung, mit Hinblick auf die mögliche Rückgabe von Produkten, Rabatte und Nachlässe aus Preissicherungsklauseln, Abschläge auf ihre realisierten Umsatzerlöse. Diese Abschläge basieren auf historischen Erfahrungen.

■ Lizenzen und Know-how-Überlassung

Lizenzgebühren und Erträge aus der Know-how-Überlassung werden vereinnahmt, wenn die Leistung erbracht ist (siehe Anhang Nr. 5). Einmalzahlungen werden abgegrenzt und über den Zeitraum der Leistungserbringung vereinnahmt. Gemäß EITF Issue 00-21 „Revenue Arrangements with Multiple Deliverables“ werden Umsatzerlöse aus Verträgen, die nach dem 1. Juli 2003 abgeschlossen wurden und Vereinbarungen mit mehreren Bestandteilen enthalten, mit dem relativen Marktwert eines jeden Bestandteils dann realisiert, wenn es keine nicht gelieferten Elemente gibt, die für das Funktionieren der gelieferten Bestandteile von Bedeutung sind und die Bezahlung nicht von der Lieferung der noch ausstehenden Bestandteile abhängt. Stücklizenzgebühren werden zum Zahlungszeitpunkt erfolgswirksam vereinnahmt.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Fördergelder für Investitionen beinhalten steuerfreie Investitionszulagen und zu versteuernde Investitionszuschüsse für Sachanlagen. Der Anspruch auf Fördermittel wird dann bilanziert, wenn ein rechtlicher Anspruch auf die Fördermittel besteht und die Kriterien für die Erlangung der Fördermittel erfüllt wurden. Steuerfreie Investitionszulagen werden über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten periodengerecht abgegrenzt (siehe Anhang Nr. 22) und erfolgswirksam über die verbleibende Nutzungsdauer der geförderten Sachanlagen vereinnahmt. Zu versteuernde Investitionszuschüsse reduzieren die Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Anhang Nr. 6) und reduzieren damit die Abschreibungen der zukünftigen Perioden. Sonstige zu versteuernde Zuschüsse werden aufwandsmindernd erfasst (siehe Anhang Nr. 6 und 22).

Produktbezogene Aufwendungen

Transport- und Abwicklungskosten, die auf den Verkauf von Produkten entfallen, sind in den Umsatzkosten enthalten. Ausgaben für Produktmarketing und Werbung sowie für sonstige vertriebsbezogene Maßnahmen werden zum Zeitpunkt des Anfalls als Aufwand erfasst. Gewährleistungsrückstellungen werden grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Umsatzrealisierung gebildet. Forschungs- und Entwicklungskosten werden bei Anfall in voller Höhe als Aufwand gebucht.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden nach der Verbindlichkeiten-Methode ermittelt. Aktive und passive latente Steuern werden als sonstige Vermögensgegenstände bzw. als Rückstellungen bilanziert, um die künftige steuerliche Wirkung aus zeitlichen Unterschieden zwischen dem bilanziellen Wertansatz von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten und dem steuerlich beizulegenden Wert zu berücksichtigen. Für die Ermittlung der aktiven und passiven latenten Steuern wird von den erwarteten Steuersätzen zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Realisierung ausgegangen. Wirkungen aus den Änderungen von Steuersätzen werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzlichen Regelung berücksichtigt.

Aktienoptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert Vergütungen in Form von Aktienoptionen auf der Grundlage der Inneren-Wert-Methode entsprechend der Accounting Principles Board („APB“) Opinion 25, Bilanzierung an Mitarbeiter ausgegebener Aktien, und hat das Wahlrecht, nur die Erläuterung dieser Aktienoptionspläne gemäß SFAS Nr. 123, Bilanzierung für Aktienoptionspläne, ergänzt durch SFAS Nr. 148, Bilanzierung für Aktienoptionspläne – Überleitung und Publizität, anzugeben, wahrzunehmen.

Kapitalerhöhungen von Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen

Gewinne oder Verluste aus der Durchführung von Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen werden entsprechend der Veränderung der Anteilshöhe gemäß der Regelungen des SAB Topic 5:H, Bilanzierung bei Anteilsverkäufen von Tochtergesellschaften, ergebniswirksam erfasst (siehe Anhang Nr. 16).

Schätzungen und Annahmen

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert Schätzungen und Annahmen des Managements. Diese haben Einfluss auf den Ausweis von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. Die tatsächlichen Beträge können wesentlich von den Schätzungen des Managements abweichen.

Aktuelle Verlautbarungen zur Bilanzierung

Im Mai 2003 hat das FASB das Statement SFAS Nr. 150, Bilanzierung bestimmter Finanzinstrumente mit sowohl Verbindlichkeits- als auch Eigenkapital-Charakter, veröffentlicht, welches regelt, wie Emittenten bestimmte Finanzinstrumente mit Verbindlichkeits- als auch Eigenkapital-Charakter zu klassifizieren und bewerten haben. Es verlangt, dass ein Emittent Finanzinstrumente, die bislang häufig als Eigenkapital klassifiziert worden sind, als Verbindlichkeit (oder bei bestimmten Umständen als Aktiva) auszuweisen hat. Es regelt auch die Klassifizierung bestimmter Finanzinstrumente, die die Verpflichtung zur Ausgabe eigener Aktien enthalten. Die Änderungen in diesem Statement führen zu einer umfassenderen Darstellung der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals einer Gesellschaft und helfen Investoren und Gläubigern, den Wert, den Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit möglicher zukünftiger Geldabflüsse und Ausgabe eigener Aktien abzuschätzen. Das Statement findet Anwendung für Finanzinstrumente, die nach dem 31. Mai 2003 begeben oder modifiziert wurden, und ist anzuwenden für die erste Zwischenberichtsperiode nach dem 15. Juni 2003, außer für zwingend rückzahlbare Finanzinstrumente nicht gelisteter Gesellschaften. Die Anwendung von SFAS Nr. 150 hatte keine materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Im Januar 2003 veröffentlichte das FASB die Interpretation Nr. 46, Konsolidierung von Objektgesellschaften, welche die Konsolidierung von Objektgesellschaften bei Unternehmungen regelt, die ein oder beide der folgenden Kriterien erfüllen: (1) Das Investment in Geschäftsanteile mit Verlustpartizipation ist nicht ausreichend, um die geschäftlichen Aktivitäten der Einheit ohne Unterstützung Dritter zu finanzieren, und (2) den Kapitalgebern fehlen eine oder mehrere festgelegte wesentliche Eigenschaften, die bei einem beherrschenden Einfluss üblich sind. Die Interpretation verlangt, dass existierende, nicht konsolidierte Objektgesellschaften vom Meistbegünstigten konsolidiert werden, wenn die Risiken nicht wirklich auf die Beteiligten verteilt sind. Die Interpretation findet sofort Anwendung auf alle Objektgesellschaften, die nach dem 31. Januar 2003 gegründet wurden oder an denen ein Unternehmen nach diesem Datum Anteile erworben hat. Am 9. Oktober wurde die FASB Staff Position FIN 46-6, Anwendungsbeginn der FASB Interpretation Nr. 46, Konsolidierung von Objektgesellschaften, veröffentlicht. Diese verzögert den Anwendungsbeginn der Interpretation für die Gesellschaft für Objektgesellschaften, die vor dem 1. Februar 2003 gegründet wurden, bis zum 31. Dezember 2003. Die Gesellschaft hat die Auswirkungen der Anwendung der Interpretation Nr. 46 abgeschätzt und glaubt, dass sie keine materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft hat.

Im Juli 2003 hat die Emerging Issues Task Force („EITF“) eine Übereinkunft für Issue 03-5, Applicability of AICPA Statement of Position 97-2 („SOP 97-2“) für Nicht-Softwareanteile einer Lieferung (EITF 03-5),

erzielt. Es wurde vereinbart, dass SOP 97-2 anwendbar ist auf den Nicht-Softwareanteil einer Lieferung, wenn der Liefervertrag Software enthält und die Software für die Funktionalität des Nicht-Softwareanteils wesentlich ist. Diese Übereinkunft findet für die Gesellschaft ab dem 1. Oktober 2003 Anwendung. Der Einfluss, den EITF 03-5 auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnte, wurde von der Gesellschaft noch nicht ermittelt.

3. AKQUISITIONEN

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots hat die Gesellschaft am 18. Juni 2003 92,5% sowie bis zum 30. Juni 2003 die restlichen 7,5% der ausstehenden Aktien der SensoNor AS für insgesamt €34 in bar erworben. Zusätzlich brachte die Gesellschaft im Zuge des Erwerbvorgangs €13 Eigenkapital ein. SensoNor entwickelt, produziert und vermarktet Reifendrucküberwachungssysteme und Sensoren für die Beschleunigungsmessung und war früher eine in Norwegen börsennotierte Gesellschaft. Mit dem Erwerb möchte die Gesellschaft ihre Position auf dem Automobilmarkt im Bereich der Halbleitersensoren stärken.

Am 1. April 2003 hat die Gesellschaft den Netto-Vermögenserwerb von MorphICs Technology Inc. („MorphICs“) für €6 in bar abgeschlossen. MorphICs entwickelt digitale Basisbandschaltungen der dritten Generation für drahtlose Kommunikation. Die Erwerbsvereinbarung beinhaltet ebenfalls eine zusätzliche Vergütung von bis zu €9, die bei Erreichen bestimmter Meilensteine bezahlt werden.

Im April 2001 hat die Gesellschaft ein Joint Venture (Infineon Technologies Flash; früher Ingentix), an dem die Gesellschaft 51% der Anteile hält, gegründet. Infineon Technologies Flash entwickelt Flash-Speicherprodukte. Das Geschäft von Infineon Technologies Flash wurde von Beginn an voll konsolidiert. Im Februar 2003 hat die Gesellschaft ihre Geschäftsanteile an der Infineon Technologies Flash auf 70% erhöht und dabei Barmittel und in Eigenkapital umgewandelte Darlehen eingebracht. Als Folge daraus entstand ein Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von €4 und ein reduzierter fremden Gesellschaftern zustehender Anteil.

Am 9. September 2002 erwarb die Gesellschaft alle Aktien der in Schweden ansässigen Ericsson Microelectronics AB („MIC“). MIC ist ein Hersteller von Hochfrequenz-Mikroelektronikbauteilen für Mobilfunkapplikationen, High-End-Leistungsverstärkern, Bluetooth-Bauteilen und Breitband-Kommunikationsprodukten. MIC ist ein strategischer Zulieferer von Ericsson, einem Marktführer bei Basisstationen, für Bluetooth-Lösungen und Hochfrequenz-Bauteile für Mobiltelefone und drahtlose Infrastruktur. Ferner traf die Gesellschaft eine strategische Liefervereinbarung mit Ericsson über eine Laufzeit von zwei Jahren mit bestimmten Einkaufsschwellenvereinbarungen, wofür eine Verbindlichkeit in Höhe von €50 zum 30. September 2002 gebildet worden ist.

Im Juni 2003 haben die Gesellschaft und Ericsson eine Ergänzungsvereinbarung zur MIC-Erwerbsvereinbarung unterschrieben. Die Gesellschaften wollen ihre strategische Kooperation auf verschiedenen Gebieten der Mobilfunktechnologie und Mobilfunkinfrastruktur inklusive Bluetooth-Lösungen, RF ICs, RF Power und anderer Anwendungen verstärken. Darüber hinaus haben die Gesellschaften den Verzicht auf die restliche, an Ericsson zahlbare Kaufpreisverpflichtung sowie die Aufhebung der noch nicht erfüllten Abnahmeverpflichtungen und zugehörigen Vertragsstrafe vereinbart. Zusätzlich erhielt die Gesell-

schaft €50 von Ericsson. Diese Beträge wurden angepasst, im Wesentlichen beim Geschäfts- und Firmenwert, aber auch bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den latenten Steuern. Zudem wurden auf Grund des restrukturierten MIC-Geschäfts die Eröffnungsbuchungen angepasst und die ursprünglich aktivierten latenten Steuern in Höhe von €16 wertberichtigt.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Akquisitionen der Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2002 und 2003 zusammen:

	2002	2003	2003
	MIC	SensoNor	Sonstige
Erwerbszeitpunkt	September 2002	Juni 2003	2003
Segment	Sichere Mobile Lösungen	Automobil- & Industrieelektronik	Verschiedene
Barmittel	50	3	–
Sonstiges Umlaufvermögen	120	6	1
Sachanlagen	60	25	1
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Aktuelle Produkttechnologie	15	21	5
Basistechnologie	42	–	–
Patente	24	–	2
Laufende F&E	37	4	2
Geschäfts- und Firmenwert	–	22	6
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	45	–	–
Gesamte erworbene Vermögensgegenstände	393	81	17
Kurzfristige Verbindlichkeiten	–38	–11	–9
Langfristige Verbindlichkeiten	–28	–36	–
Gesamte übernommene Verbindlichkeiten	–66	–47	–9
Erworbenes Nettovermögen	327	34	8
Barzahlung	–	34	8
Ausgegebene Aktien (in Stück)	27.500.000	–	–

Die oben aufgeführten Akquisitionen wurden nach der Erwerbsmethode bilanziert. Dementsprechend enthält das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit die Ergebnisse der erworbenen Gesellschaften ab dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt. Der Wert der zur teilweisen Kaufpreisbegleichung ausgegebenen Aktien wurde auf Grund der durchschnittlichen Marktpreise der Aktien der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwei Tagen vor und nach dem Tag, an dem die Anzahl der ausgegebenen Aktien festgelegt wurde, ermittelt.

Ausgegebene Aktien, die für Mitarbeiter als Anreiz für die Fortsetzung der Beschäftigung und die Erreichung bestimmter Meilensteine treuhänderisch hinterlegt wurden, werden als abgegrenzte Vergütung mit ihrem inneren Wert bilanziert. Die abgegrenzte Vergütung wird als Minderung der Kapitalrücklage in der Eigenkapitalveränderungsrechnung bilanziert

und linear über die entsprechenden Beschäftigungs- oder Meilensteinzeiträume abgeschrieben, die zwischen zwei und vier Jahren betragen.

Ausgegebene Aktien, die für die Aktionäre der erworbenen Gesellschaften als Anreiz zur Erreichung bestimmter Meilensteine treuhänderisch hinterlegt wurden, stellen eine anteilige Kaufpreiszahlung dar und betreffen vornehmlich den Erwerb von Catamaran Communications Inc. („Catamaran“) im August 2001. Diese Aktien, die bedingte Kaufpreiszahlungen darstellen, werden in der Eigenkapitalveränderungsrechnung nicht als ausgegeben und ausstehend dargestellt. Sollten die Meilensteine erreicht werden, wird der Kaufpreis um den jeweiligen Marktwert der ausgegebenen Aktien zum Stichtag angepasst. Während der Geschäftsjahre 2002 und 2003 wurden 546.183 bzw. 96.386 Aktien aus der treuhänderischen Hinterlegung freigegeben, da

die Meilensteine erreicht wurden, was zu einer Erhöhung des Geschäfts- und Firmenwerts von Catamaran in Höhe von €9 bzw. €1 führte.

Bei jeder wesentlichen Akquisition wurde ein unabhängiger Dritter zur Bewertung des erworbenen Nettovermögens hinzugezogen. Als Folge dieser Bewertungen wurden in den Geschäftsjahren 2001, 2002 und 2003 Beträge von €69, €37 und €6 als erworbene, noch nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte den F&E-Aufwendungen zugerechnet, da keine technologische Anwendung der Entwicklungen erkennbar war und keine zukünftige Alternativnutzung existierte. Die Beträge, die den erworbenen, noch nicht abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zugerechnet wurden, wurden durch anerkannte Bewertungspraktiken für den Hochtechnologiesektor und zugehörige Richtlinien der SEC ermittelt.

Die Basistechnologien und Patente, die bei diesen Akquisitionen erworben werden, werden über ihre erwartete Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben, aktuelle Produkttechnologie wird über ihre erwartete Nutzungsdauer von zwei bis acht Jahren abgeschrieben.

Auf die Aufstellung von Pro-forma-Finanzdaten wurde verzichtet, da die Akquisitionen keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

4. AUFGEGBENE GESCHÄFTE UND GESCHÄFTSANTEILSVERÄUSSERUNGEN

Aufgegebene Geschäfte

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und OSRAM GmbH („OSRAM“) hat die Gesellschaft ihre gesamten opto-elektronischen Aktivitäten zum 31. März 2003 an OSRAM übertragen. Die Vereinbarung beinhaltet die Übergabe aller Kundenbeziehungen und zugehörigen Auftragsbestände, die Kündigung aller opto-elektronischen Vertriebsvereinbarungen durch die Gesellschaft und gibt der Gesellschaft bestimmte Rechte zur Rückgabe von zum 31. März 2003 nicht verkauften Beständen. Der Gesellschaft ist aus der Aufgabe der opto-elektronischen Aktivitäten kein Verlust entstanden. Dementsprechend wurden die Ergebnisse der opto-elektronischen Aktivitäten in den beiliegenden Konzernfinanzdaten unter „Aufgegebene Geschäfte“ gezeigt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt Vergleichswerte für das aufgegebene Geschäft, das früher unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ enthalten war, für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003:

	30. September		
	2001	2002	2003
Opto-Elektronik:			
Umsatzerlöse:			
Dritte	271	241	113
Verbundene Unternehmen	53	76	32
Gesamte Umsatzerlöse	324	317	145
Ergebnis vor Steuern aus aufgegebenem Geschäft	–	–	–
Steuerertrag/-aufwendungen	1	–4	–
Ergebnis aus aufgegebenem Geschäft	1	–4	–

Die Bilanzpositionen für das aufgegebene Geschäft zum 30. September 2002 und 2003 sind wie folgt:

	30. September	30. September
	2002	2003
Umlaufvermögen:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52	–
Vorräte	7	–
Summe Umlaufvermögen	59	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten:		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60	–
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	60	–

(Euro in Mio., wenn nicht anders angegeben.)

Veräußerung von Geschäftsanteilen

Im August 2003 hat die Gesellschaft ihren Anteil an UMCi verkauft und einen Vor-Steuer-Verlust von €9 realisiert. Dieser Betrag ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen enthalten.

Am 1. Juli 2002 vollendete die Gesellschaft den Verkauf ihres Gallium-Arsenid-Geschäfts, das zum Bereich Sichere Mobile Lösungen gehörte, einschließlich bestimmter, nicht fertigungsrelevanter materieller und immaterieller Vermögensgegenstände sowie spezifizierter Kundenverträge und Verbindlichkeiten. Die Gesellschaft hat in diesem Zusammenhang eine ursprüngliche Zahlung in Höhe von €50 erhalten. Die Höhe des Verkaufserlöses wird durch die Menge verkaufter Gallium-Arsenid-Produkte beeinflusst, die bis zum 30. September 2004 durch den Käufer abgesetzt werden. Weitere Anpassungen können den Verkaufserlös beeinflussen. Die Anpassungen können sich in einer Bandbreite von Zahlungen in Höhe von €5 bis zu weiteren Erträgen in Höhe von €74 bewegen und werden gebucht, sobald die Eventualverbindlichkeit erloschen ist und die Beträge realisierbar sind. Die Gesellschaft war dazu verpflichtet, den Käufer bis zum Juni 2003 mit einer Mindestmenge an Gallium-Arsenid-Produkten zu beliefern, deren Preise deutlich unter den gängigen Marktpreisen liegen. Dementsprechend wurden Erträge in Höhe von €44 zum Zeitpunkt des Geschäftsverkaufs abgegrenzt und über den Zeitraum des Liefervertrags gemäß dem

Verkauf der Produkte und mit Erlöschen der Verkaufspreisanpassungsklausel realisiert. Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs hat die Gesellschaft im Zuge der Erfüllung der erwähnten Liefervereinbarung Umsatzerlöse in Höhe von €45 (von welchen €29 zuvor abgegrenzt wurden) und ein „earnings before interest and taxes“ („EBIT“) in Höhe von €5 erwirtschaftet.

Am 31. Dezember 2001 veräußerte die Gesellschaft ihren verbleibenden 81-prozentigen Anteil an der Infineon Technologies Krubong Sdn. Bhd., welcher das Geschäftsfeld Infrarotkomponenten darstellte und vorher unter den „Sonstigen Geschäftsbereichen“ ausgewiesen wurde.

Am 19. Dezember 2000 verkaufte die Gesellschaft das Geschäftsfeld Image & Video, welches Teil des Geschäftsbereichs Drahtgebundene Kommunikation war.

Des Weiteren trennte sich die Gesellschaft von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäften während der Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003.

Nachfolgend werden die Finanzinformationen zu den veräußerten Geschäftseinheiten (bis zum Tag der Veräußerung) für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 jeweils zum 30. September zusammenfassend dargestellt:

	30. September		
	2001	2002	2003
Umsatzerlöse:			
Gallium-Arsenid	36	24	45
Infrarotkomponenten	110	11	–
Image & Video	38	–	–
Summe Umsatzerlöse	184	35	45
EBIT:			
Gallium-Arsenid	–44	–18	5
Infrarotkomponenten	–22	–7	–
Image & Video	10	–	–
UMCi	–	–1	–11
Summe EBIT	–56	–26	–6
Ergebnis aus der Veräußerung vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
Gallium-Arsenid	–	2	–
Infrarotkomponenten	26	39	–
Image & Video	202	–	–
UMCi	–	–	–9
Sonstige	7	–2	–1
Summe Ergebnis aus der Veräußerung vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	235	39	–10

5. LIZENZEN UND KNOW-HOW-ÜBERLASSUNGSVERTRÄGE

In den Geschäftsjahren 2001, 2002 und 2003 weist die Gesellschaft Umsätze aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen in Höhe von jeweils €88, €147 und €183 in den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen aus. Darin enthalten sind früher abgegrenzte Lizenzerlöse in Höhe von €36, €85 und €135, die entsprechend SEC SAB 101 in den Geschäftsjahren 2001, 2002 und 2003 als Umsatz realisiert wurden, da alle Verpflichtungen erfüllt wurden.

Zum 30. September 2002 wurden bereits früher erhaltene Lizenzzahlungen von ProMOS in Höhe von €60 als Erträge abgegrenzt und mit der Beteiligung in der beigefügten Bilanz gemäß SEC SAB Nr. 5:H verrechnet (siehe Anhang Nr. 16).

Im Februar 2003 haben die Gesellschaft, ProMOS und MVI vereinbart, eine bestehende Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten in Höhe von €60 zu tilgen, für die die Gesellschaft eine Garantie übernommen hatte. Daher hat die Gesellschaft früher abgegrenzte Lizenzeinnahmen in Höhe von €60, die in Beziehung zu dieser Garantie standen, im abgelaufenen Geschäftsjahr realisiert, da der Betrag bezahlt wurde.

Auf Grund der Beendigung der Vereinbarung über den Austausch von Technologien zwischen der Gesellschaft und ProMOS wurden zusätzliche €36 als Umsatz während des abgelaufenen Geschäftsjahrs realisiert, da die Gesellschaft sämtliche Verpflichtungen erfüllt hat. Dieser Betrag wurde zuvor als abgegrenzte Lizenzeinnahmen erfasst.

Im März 2002 hat die Gesellschaft zusätzlich ihre Vereinbarungen mit ProMOS über die Bereitstellung von Kapazitäten (siehe Anhang Nr. 31) abgeändert und die Zahlungsbestimmungen existierender Lizenzverträge mit MVI angepasst. Die Vereinbarung verlängert den Zahlungszeitraum der ausstehenden Lizenzgebühren von \$54 bis zum Januar 2004 (diese werden als Ertrag beim Zugang der Barmittel erfasst) und verlängert weiterhin den Zahlungszeitraum weiterer ausstehender Beträge gegenüber der Gesellschaft. Im Gegenzug hinterlegte MVI 56.330.000 ProMOS-Aktien bei einem Treuhänder, um die ausstehenden Verpflichtungen gegenüber einem Zahlungsausfall abzusichern.

Im Rahmen der gemeinsamen Technologieentwicklung mit Nanya Technology Corporation („Nanya“) (siehe Anhang Nr. 16) hat die Gesellschaft Nanya die Benutzung ihrer 110-Nanometer-Technologie erlaubt. Daraus resultierende Lizenzeinnahmen werden über die geschätzte Nutzungszeit dieser Technologie realisiert. Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Lizenzeinnahmen von Nanya in Höhe von €32 realisiert.

6. ZUWENDUNGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND

Die Gesellschaft hat im Rahmen staatlicher Wirtschaftsförderungsprogramme von verschiedenen öffentlichen Stellen Fördermittel u. a. für die Errichtung von Fertigungsstätten, für Forschung und Entwicklung und Weiterbildungsmaßnahmen erhalten. Die in den vorliegenden Konzernabschlüssen enthaltenen Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2001	2002	2003
In der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung sind enthalten:			
Forschungs- und Entwicklungszuschüsse	71	59	59
Umsatzkosten	10	34	54
	81	93	113
Investitionszuschüsse, die von den Anschaffungskosten der Sachanlagen abgesetzt wurden	11	83	17
Abgegrenzte staatliche Zulagen (Anhang Nr. 22)	37	230	223

7. ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN

Die Materialaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2001	2002	2003
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.731	1.380	1.675
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.357	926	1.126
Summe Materialaufwendungen	3.088	2.306	2.801

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2001	2002	2003
Löhne und Gehälter	1.441	1.349	1.483
Sozialabgaben	229	254	259
Aufwendungen für Altersversorgung	11	29	27
Summe Personalaufwendungen	1.681	1.632	1.769

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter nach Regionen für die Geschäftsjahre zum 30. September ist in folgender Übersicht dargestellt:

	2001	2002	2003
Deutschland	16.279	15.773	16.043
Übriges Europa	4.921	4.376	4.753
Nordamerika	3.101	2.818	2.779
Asien-Pazifik	9.095	7.189	7.833
Übrige	7	24	115
Summe Mitarbeiter	33.403	30.180	31.523

Die gesamten Aufwendungen für Operating-Lease-Verträge betragen in den Geschäftsjahren 2001 €130, 2002 €133 und 2003 €138.

8. UMSTRUKTURIERUNGSMASSNAHMEN

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2003 hat die Gesellschaft angekündigt, Maßnahmen zur weiteren Kostensenkung umzusetzen.

	30. September		30. September		
	2002		2003		
	Rückstellungen	Abgrenzungen	Restrukturierungs- aufwendungen/-erträge	Zahlungen	Rückstellungen
Abfindungen	6	–	32	–20	18
Andere Ausstiegskosten	29	–11	–3	–6	9
Gesamt	35	–11	29	–26	27

Die Verbindlichkeit für Restrukturierung ist in der Position „Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten“ (siehe Anhang Nr. 20) enthalten. Frühere Perioden wurden in der Bilanz umgegliedert, um der jetzigen Darstellung zu entsprechen.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 fielen im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen Aufwendungen in Höhe von €16 durch unkündbare Verpflichtungen an.

Im Geschäftsjahr 2001 sind im Rahmen des Impact-Programms Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von €117 angefallen. Dieses Restrukturierungsprogramm hatte zum Ziel, den Einkauf und die Logistikprozesse zu rationalisieren und die Kosten der Produktion und Informationstechnologie zu reduzieren. Diese Aufwendungen enthielten €57 für Kündigungen und €44 auf Grund der Einstellung eines weltweiten IT-Projekts, die sich aus Abschreibungen bereits aktivierter Investitions-

Dies beinhaltet den Abbau von Mitarbeitern, Dezentralisierung und Outsourcing bestimmter Funktionen und Geschäfte. Als Teil dieser Umstrukturierungsmaßnahmen plant die Gesellschaft derzeit, etwa 550 Mitarbeiter zu entlassen. Dies betrifft hauptsächlich Zentralbereiche und die Produktion von Logikprodukten sowie Funktionen, die an externe Serviceanbieter ausgegliedert werden. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen wurden gemäß SFAS Nr. 146, Bilanzierung von Kosten im Zusammenhang mit der Aufgabe oder Veräußerung von Geschäftsaktivitäten, Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen in Höhe von €29 im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesen.

Zudem wurden €11, die früher für Umstrukturierung zurückgestellt wurden, im Rahmen einer Vereinbarung eines Dienstleistungsvertrags erlassen. Dieser Betrag wurde entsprechend in den Rückstellungen abgegrenzt und wird über die Laufzeit des Servicevertrags erfolgswirksam aufgelöst.

Die Komponenten der Restrukturierungsaufwendungen setzen sich zum 30. September wie folgt zusammen:

aufwendungen (€27) und mit dem Projekt verbundenen Ausstiegskosten (€17) zusammensetzen, sowie €16 infolge anderer Ausstiegskosten.

9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Der Gewinn/Verlust vor Steuern und vor Abzug der auf die Minderheitsgesellschafter entfallenden Ergebnisanteile verteilt sich in den Geschäftsjahren 2001, 2002 und 2003 wie folgt auf die Regionen:

	2001	2002	2003
Deutschland	–1.184	–1.403	–506
Ausland	159	236	147
	–1.025	–1.167	–359

Die Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ermitteln sich für die zum 30. September 2001, 2002 und 2003 endenden Geschäftsjahre wie folgt:

	2001	2002	2003
Laufender Steueraufwand:			
Deutschland	23	15	18
Ausland	43	124	50
	66	139	68
Latente Steuern:			
Deutschland	-489	-236	40
Ausland	-4	-46	-24
	-493	-282	16
Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von fortgeführten Geschäften	-427	-143	84
Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von aufgegebenen Geschäften	-1	4	-
Aufwand/Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-428	-139	84

Im Oktober 2000 hat die Bundesregierung neue Steuergesetze verabschiedet, welche den Körperschaftsteuersatz auf einheitlich 25% reduzieren. Für die Gesellschaft wurde die Gesetzesänderung in dem am 30. September 2002 endenden Geschäftsjahr wirksam. Zusätzlich werden ein Solidaritätszuschlag von 5,5% und Gewerbesteuer in Höhe von 13% erhoben, was einer Gesamtsteuerbelastung von 39% entspricht. Vor dem 1. Oktober 2001 war eine geteilte Regelung gültig, die 40% Körperschaftsteuer für einbehaltene Gewinne und 30% Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne vorsah und zu einer Gesamtsteuerbelastung von 52% führte. Die Berücksichtigung der reduzierten Steuersätze ergab eine Reduzierung der aktiven und passiven latenten Steuern bezüglich der fortgeführten Geschäfte in Höhe von €29 im Geschäftsjahr 2001.

Die nachfolgende Überleitung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zum 30. September 2001, 2002 und 2003 erfolgte unter Zugrundelegung einer Gesamtsteuerbelastung der deutschen Körperschaftsteuerquote zuzüglich Gewerbesteuer für 2001 in Höhe von 52% sowie für 2002 in Höhe von 39% und 2003 in Höhe von 41% (inklusive einer einjährigen Abgabe zur Flutopferhilfe von 2%):

	2001	2002	2003
Erwarteter Aufwand/Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-533	-455	-147
Veränderung verfügbarer Steuerfreibeträge	-13	30	-35
Steuerfreie Gewinne/Verluste aus Beteiligungen	-14	-39	14
Differenz aus abweichenden Steuersätzen im Ausland	-78	-46	1
Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen und sonstige Rückstellungen	41	99	58
Änderung der deutschen Steuerrate – Auswirkung auf die Eröffnungsbilanz	-29	-	2
Änderung der deutschen Steuerrate – Auswirkung im laufenden Geschäftsjahr	154	-2	7
Veränderung der Wertberichtigung	18	271	182
Nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	29	10	1
Sonstige	-2	-11	1
Tatsächlicher Aufwand/Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-427	-143	84

Die aktiven und passiven latenten Steuern setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Vermögensgegenstände:		
Immaterielle Vermögensgegenstände	232	115
Sachanlagen	43	105
Beteiligungen	10	8
Vorräte	27	15
Passive Rechnungsabgrenzung	148	117
Verlustvortrag und Steuervergünstigungen	820	1.029
Sonstiges	117	172
Bruttobetrag der aktiven latenten Steuern	1.397	1.561
Wertberichtigungen	-310	-521
Aktive latente Steuern	1.087	1.040
Verbindlichkeiten:		
Immaterielle Vermögensgegenstände	59	58
Sachanlagen	190	148
Rückstellungen	8	31
Sonstiges	40	56
Passive latente Steuern	297	293
Summe latente Steuern, Saldo	790	747

Die aktiven und passiven latenten Steuern werden in den Konzernbilanzen zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt ausgewiesen:

	2002	2003
Aktive latente Steuern:		
Kurzfristig	82	113
Langfristig	787	705
Passive latente Steuern:		
Kurzfristig	-21	-39
Langfristig	-58	-32
Summe latente Steuern, Saldo	790	747

Zum 30. September 2003 hatte die Gesellschaft steuerliche Verlustvorträge in Höhe von €2.195 (für Gewerbe- und Körperschaftsteuer und einen zusätzlichen Verlustvortrag nur auf Gewerbesteuer anwendbar in Höhe von €1.132) sowie Vorträge von Steuervergünstigungen in Höhe von €100. Diese steuerlichen Verlustvorträge und Steuervergünstigungen resultieren hauptsächlich aus der Geschäftstätigkeit in Deutschland und sind grundsätzlich nur durch die Gesellschaft nutzbar, bei der die steuerlichen Verluste oder die Steuerforderungen entstanden sind.

Nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung sind sie mit der Ausnahme von steuerlichen Verlustvorträgen in Höhe von €91 bei ausländischen Gesellschaften, die in den Jahren 2020 und 2021 verfallen, zeitlich unbeschränkt nutzbar.

Entsprechend dem SFAS Nr. 109 hat die Gesellschaft die aktivierten latenten Steuern auf die Notwendigkeit einer Wertberichtigung überprüft. Dazu ist eine Beurteilung erforderlich, ob es wahrscheinlich ist, dass Teile oder der Gesamtbetrag der aktiven latenten Steuern nicht realisierbar sein könnten. Die Überprüfung verlangt vom Management unter anderem eine Beurteilung von Erträgen aus verfügbaren Steuerstrategien und künftigem zu versteuerndem Einkommen sowie anderen positiven oder negativen Faktoren. Die tatsächliche Realisierung von aktivierten latenten Steuern hängt von der Möglichkeit der Gesellschaft ab, entsprechendes zukünftiges zu versteuerndes Einkommen zu generieren, um Verlustvorträge oder Steuervergünstigungen vor ihrem Verfall nutzen zu können. Da die Gesellschaft in bestimmten Steuergebieten zum 30. September 2003 über einen Dreijahreszeitraum einen kumulativen Verlust ausgewiesen hat, wird der Einfluss von geplantem zu versteuerndem Einkommen in Übereinstimmung mit den Vorschriften des SFAS Nr. 109 für diese Bewertung ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt für diese Steuergebiete dementsprechend nur auf Grund der Erträge, die durch verfügbare Steuerstrategien und die Umkehr von zeitlichen Unterschieden in zukünftigen Perioden erlöst werden können. Basierend auf den Ergebnissen dieser Überprüfung hat die Gesellschaft zum 30. September 2003 die Wertberichtigung auf die aktivierten latenten Steuern um €182 erhöht und damit auf einen Betrag gebracht, der wahrscheinlich in Zukunft realisiert werden kann. Während der Geschäftsjahre 2001 und 2002 wurden Wertberichtigungen auf Verlustvorträge für fortgeführte Geschäfte in Höhe von €18 und €271 gebildet, da die vollständige Ausnutzung dieser Verlustvorträge nicht wahrscheinlich erschien.

Die Veränderungen der Wertberichtigungen für steuerliche Verlustvorträge zum 30. September 2002 und 2003 sind wie folgt:

	2002	2003
Stand zu Beginn des Geschäftsjahrs	19	310
Anwendung auf fortgeführte Geschäfte	271	182
Anwendung auf aufgegebenen Geschäfte	4	-
Erworbene aktive latente Steuern	16	45
Anpassung aus der Erstkonsolidierung	-	-16
Stand zum Ende des Geschäftsjahrs	310	521

Zum 30. September 2003 enthält die Wertberichtigung €45 in Verbindung mit einem Geschäftszusammenschluss, die in zukünftigen Perioden bei ihrer Auflösung dem Buchwert des immateriellen Vermögensgegenstands zugerechnet wird.

Die Gesellschaft hat zum 30. September 2003 auf kumulierte einbehaltene Gewinne ausländischer Gesellschaften keine zusätzlichen Ertrag- oder Quellensteuern berechnet, da diese Gewinne in den Auslandsgesellschaften unbegrenzt reinvestiert bleiben sollen. Eine betragsmäßige Schätzung der nicht berücksichtigten passiven latenten Steuern auf diese einbehaltenen Gewinne ist nicht zweckmäßig.

Die Aufwendungen/Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 wurden im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und in den Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren,

erfasst. Die direkt im Eigenkapital erfassten Beträge für unrealisierte Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren und Pensionsverpflichtungen beliefen sich in den Jahren 2001, 2002 und 2003 auf €(15), €(6) und €4.

10. ERGEBNIS JE AKTIE

Das Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem angepassten Ergebnis, geteilt durch den gewogenen Mittelwert der während des Jahres ausstehenden Aktien. Bei dem verwässerten Ergebnis je Aktie wird der gewogene Mittelwert der ausstehenden Aktien um die Anzahl der zusätzlichen Stückaktien erhöht, die ausstünden, wenn potenziell verwässernde Stückaktien ausgegeben worden wären.

Ermittlung des Ergebnisses je Aktie sowie des verwässerten Ergebnisses je Aktie für die Jahre 2001, 2002 und 2003:

	2001	2002	2003
Zähler:			
Ergebnis von fortgeführten Geschäften	-592	-1.017	-435
Ergebnis von aufgegebenen Geschäften	1	-4	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-591	-1.021	-435
Nenner:			
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – unverwässert	640.566.801	694.729.462	720.850.455
Verwässerungseffekt durch Aktienoptionen	-	-	-
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – verwässert	640.566.801	694.729.462	720.850.455
Gewinn/Verlust je Aktie (in Euro):			
Unverwässert und verwässert – von fortgeführten Geschäften	-0,92	-1,46	-0,60
Unverwässert und verwässert – von aufgegebenen Geschäften	-	-0,01	-
Unverwässert und verwässert – Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,92	-1,47	-0,60

Das Ergebnis verwässernde Instrumente können sein: Aktienoptionen, die an Mitarbeiter ausgegeben werden, sowie nachrangige Wandelanleihen. Da die angenommene Ausübung dieser Instrumente derzeit

keinen Verwässerungseffekt im Ergebnis je Aktie ergibt, wird auf die Berechnung des verwässerten Verlusts je Aktie für die abgelaufenen Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 verzichtet.

11. WERTPAPIERE

Die Wertpapiere setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	30. September 2002				30. September 2003			
	Anschaffungskosten	Marktwert	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste	Anschaffungskosten	Marktwert	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste
Ausländische Staatsanleihen	10	10	–	–	10	11	1	–
Variabel verzinsliche Anleihen	299	299	2	–2	343	345	10	–8
Sonstige Gläubigerpapiere	23	21	–	–2	145	145	–	–
Summe Gläubigerpapiere	332	330	2	–4	498	501	11	–8
Anteilspapiere	9	7	–	–2	27	36	10	–1
Festgeldanlagen	413	413	–	–	1.261	1.260	–	–1
Summe Wertpapiere	754	750	2	–6	1.786	1.797	21	–10
Ausgewiesen als:								
Wertpapiere des Umlaufvermögens	742	738	2	–6	1.774	1.784	20	–10
Wertpapiere des Anlagevermögens (Anhang Nr. 17)	12	12	–	–	12	13	1	–
Summe Wertpapiere	754	750	2	–6	1.786	1.797	21	–10

Zum 30. September 2003 enthält der Posten „Anteilspapiere“ Anteile an ProMOS in Höhe von €17, die kurzfristigen Veräußerungsbeschränkungen unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die restlichen Anteile an ProMOS in naher Zukunft unter Berücksichtigung behördlicher Genehmigungen zu veräußern. Mit Wirkung vom 1. April 2003 werden die Anteile an ProMOS als Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziert (siehe Anhang Nr. 16). Aus dem Verkauf von ProMOS-Anteilen erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2003 einen Ertrag in Höhe €60.

Die realisierten Gewinne/Verluste aus Wertpapieren betragen zum 30. September 2001, 2002 und 2003 €1, €–1 und €56 und sind unter den sonstigen nichtoperativen Erträgen (Aufwendungen) in den jeweiligen Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen ausgewiesen.

Am 30. September 2003 hatten alle Festgeldanlagen Laufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten.

Die Gläubigerpapiere zum 30. September 2003 werden vertragsgemäß wie folgt fällig:

	Anschaffungskosten	Marktwert
Innerhalb eines Jahres	168	172
Zwischen einem und fünf Jahren	150	150
Nach fünf Jahren	180	179
Summe Gläubigerpapiere	498	501

Die tatsächlichen Fälligkeiten können auf Grund von Veräußerungs- oder Rückzahlungsrechten abweichen.

12. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Dritte	696	700
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (Anhang Nr. 27)	97	194
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (Anhang Nr. 27)	8	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto	801	902
Wertberichtigungen	-43	-26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	758	876

Die Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:

	2002	2003
Wertberichtigungen zu Beginn des Geschäftsjahrs	48	43
Zuführung zu Wertberichtigungen (Wiederaufholung), Saldo	-5	-16
Fremdwährungseffekte	-	-1
Wertberichtigungen zum Ende des Geschäftsjahrs	43	26

13. VORRÄTE

Die Vorräte setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105	85
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	463	489
Fertige Erzeugnisse und Handelswaren	323	385
Summe Vorräte	891	959

14. SONSTIGE KURZFRISTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Das sonstige Umlaufvermögen setzt sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Derivative Finanzinstrumente (Anhang Nr. 29)	138	154
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (Anhang Nr. 27)	28	125
Fördermittel	100	98
Sonstige Vermögensgegenstände	116	94
Umsatzsteuer und sonstige Steuerforderungen	54	28
Finanzforderungen und sonstige gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (Anhang Nr. 27)	23	18
Forderungen gegen Arbeitnehmer	8	7
Immaterieller Vermögensgegenstand, Pensionen (Anhang Nr. 28)	-	4
Sonstige	56	77
Summe sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	523	605

15. SACHANLAGEN

Eine Zusammenfassung der Sachanlagen sowie der Zu- und Abgänge zum 30. September 2003 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
Anschaffungskosten 30. September 2002	1.055	6.254	2.077	364	9.750
Zugänge	14	530	131	197	872
Abgänge	-1	-132	-98	-7	-238
Konsolidierungen	6	18	2	-	26
Umbuchungen	34	168	24	-226	-
Fremdwährungseffekte	-43	-188	-57	-30	-318
30. September 2003	1.065	6.650	2.079	298	10.092
Kumulierte Abschreibungen 30. September 2002	-418	-3.372	-1.469	-	-5.259
Zugänge	-67	-948	-353	-	-1.368
Abgänge	1	89	92	-	182
Umbuchungen	-15	11	4	-	-
Fremdwährungseffekte	11	119	40	-	170
30. September 2003	-488	-4.101	-1.686	-	-6.275
Buchwert 30. September 2002	637	2.882	608	364	4.491
Buchwert 30. September 2003	577	2.549	393	298	3.817

Die Gesellschaft ist Leasinggeber von technischen Anlagen und Maschinen (siehe Anhang Nr. 27). Deren Anschaffungskosten betragen zum 30. September 2002 und 2003 jeweils €215 und €191 bei korrespondierenden kumulierten Abschreibungen in Höhe von €183 und €179.

Zum 30. September 2002 enthalten die Anlagen im Bau €165, die im Zusammenhang mit dem Bau einer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Richmond/Virginia, USA, stehen. Das Bauvorhaben ist im Moment ausgesetzt und wird nicht abgeschrieben. Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Bau abhängig von der Marktentwicklung in naher Zukunft fortgesetzt wird.

16. FINANZANLAGEN

Die Finanzanlagen haben sich in dem am 30. September 2003 endenden Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Assoziierte Unternehmen	Beteili- gungen	Gesamt
Stand 30. September 2002	583	125	708
Zugänge	54	22	76
Abgegrenzte Einnahmen (Anhang Nr. 5)	60	-	60
Abgänge	-185	-11	-196
Übertragung zu Wertpapiere des Umlaufvermögens	-213	-	-213
Außerplanmäßige Abschreibungen	-8	-22	-30
Anteilige Jahresergebnisse asoziiierter Unternehmen	18	-	18
Umgliederung	6	-6	-
Wertminderungen durch Kapitalerhöhungen	-2	-	-2
Fremdwährungseffekte	7	-3	4
Stand 30. September 2003	320	105	425

Investitionen in Beteiligungen erfolgen überwiegend mit dem Ziel, das Zukunftspotenzial der Gesellschaft auf dem Gebiet der geistigen Eigentumsrechte zu stärken.

Die folgenden assoziierten Unternehmen wurden zum 30. September 2003 nach der Equity-Methode bilanziert:

Namen der assoziierten Unternehmen	Direkte und indirekte Anteile in %
Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG, Dresden („AMTC“)	33,3%
ALTIS Semiconductor, Essonnes, Frankreich („ALTIS“)	50,1%
Cryptomathic Holding ApS, Aarhus, Dänemark („Cryptomathic“)	25,4%
Enhanced Memory Systems Inc., Wilmington/Delaware, USA („EMS“)	20,0%
Hwa-Ken Investment Inc., Taipeh, Taiwan („Hwa-Ken“)	50,0%
Inotera Memories Inc., Taoyan, Taiwan („Inotera“)	50,0%
Maskhouse Building Administration GmbH & Co. KG, Dresden („BAC“)	33,3%
MICRAM Microelectronic GmbH, Bochum („MICRAM“)	25,1%
Newlogic Technologies AG, Lustenau, Österreich („Newlogic“)	24,9%
Ramtron International Corp., Colorado Springs/Colorado, USA („Ramtron“)	20,0%
StarCore LLC, Austin/Texas, USA („StarCore“)	35,7%

Die Gesellschaft hat diese Beteiligungen nach der Equity-Methode bilanziert, da keine einheitliche Leitung von der Gesellschaft ausgeübt worden ist (siehe Anhang Nr. 2). Die oben aufgeführten Gesellschaften sind vorwiegend mit Forschung und Entwicklung, Entwurf und Fertigung von Halbleiterprodukten, integrierten Schaltungen und damit in Zusammenhang stehenden Produkten befasst.

Am 16. Mai 2002 ging die Gesellschaft mit den Partnern Advanced Micro Devices Inc. („AMD“), USA, und DuPont Photomasks Inc. („DuPont“), USA, das AMTC-Joint-Venture mit dem Ziel ein, gemeinsam fortschrittliche Fotomaschinen zu entwickeln und herzustellen. Zudem vereinbarte die Gesellschaft den Verkauf von speziellen Fotomaschinen-Anlagen an DuPont und ging eine langfristige Bezugsvereinbarung bis 2011 ein. Dementsprechend wurden zum 30. September 2003 €28 abgegrenzt. Dieser Betrag wird über die Laufzeit der Bezugsvereinbarung vereinnahmt.

ALTIS ist ein Joint Venture von Infineon und IBM, in welchem beide Partner gleiches Stimmrecht haben.

Zum 1. Juli 2001 erwarb die Gesellschaft für €10 in bar einen Anteil von 25,4% an Cryptomathic.

Am 12. Januar 2001 erwarb die Gesellschaft 25,1% der Anteile an MICRAM. MICRAM entwickelt Hochgeschwindigkeits-ICs mit mehr als 40 Gigabit pro Sekunde.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2001 erwarb die Gesellschaft einen Gesamtanteil von 24,9% an Newlogic für ein Gesamtentgelt in Höhe von €21.

Im März 2001 erwarb die Gesellschaft für einen Betrag von €31, der sich aus 443.488 Aktien und Barmitteln in Höhe von €11 zusammensetzt, einen Anteil von 20,1% (danach verwässert zu einem Anteil von 20,0%) an Ramtron. Ramtron ist ein führender Entwickler von speziellen Halbleitern für Speicherprodukte mit Sitz in Colorado Springs/Colorado, USA, und ist unter dem Symbol RMTR an der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq notiert. Auf Grund einer voraussichtlich andauernden Minderung des Marktwerts von Ramtron führte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2002 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von €9 durch.

Am 13. November 2002 schlossen die Gesellschaft und Nanya Technology Corporation („Nanya“) eine Reihe von Abkommen über eine strategische Kooperation zur Entwicklung von DRAM-Speicherprodukten und ein 50:50-Gemeinschaftsunternehmen (Inotera, direkt und indirekt über die Beteiligung Hwa-Ken Investment Inc.) zur Errichtung und zum Betrieb einer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Taiwan. Gemäß den Vereinbarungen werden Nanya und die Gesellschaft fortschrittliche 90-Nanometer- und 70-Nanometer-Technologie entwickeln. Die Kosten hierfür werden zu zwei Dritteln von der Gesellschaft und zu einem Drittel von Nanya getragen. Die neue 300-Millimeter-Fertigungsstätte wird von dem Inotera-Gemeinschaftsunternehmen finanziert, die im Rah-

men der oben genannten Vereinbarung entwickelte Technologie einsetzen, um DRAM-Produkte herzustellen, und in zwei Stufen errichtet werden. Die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe ist für die zweite Hälfte des Kalenderjahrs 2004 geplant. Die Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe wird für das Geschäftsjahr 2006 erwartet. Beide Partner an diesem Joint Venture haben sich verpflichtet, jeweils die Hälfte der Produktion dieser Fertigungsstätte zu Preisen, die teilweise auf Marktpreisen basieren, abzunehmen.

Am 4. Oktober 2002 gab die Gesellschaft bekannt, dass sie den Aktionärsvertrag mit Mosel Vitelic Inc. („MVI“) über ihr Gemeinschaftsunternehmen ProMOS auf Grund schwer wiegender Verletzungen des Aktionärsvertrags durch MVI zum 1. Januar 2003 gekündigt hat. Die Kapazitäts- und Liefervereinbarung, die sowohl das Recht als auch die Pflicht zur Abnahme von Produkten von ProMOS für beide Anteilseigner enthielt, erlosch ebenfalls zum 1. Januar 2003. Am 27. Januar 2003 hat die Gesellschaft die Technologie-Lizenz-Vereinbarung mit ProMOS gekündigt. Daraufhin hat ProMOS ebenfalls dieselbe Vereinbarung gekündigt. Für den Streitfall sieht diese Vereinbarung ein Schiedsverfahren vor, das ProMOS im Mai 2003 gemäß der Schiedsgerichtsverordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) eingeleitet hat. Das Verfahren wird in München geführt.

Während der Geschäftsjahre 2001 und 2002 hat ProMOS durch Bonusprogramme Aktien an seine Mitarbeiter ausgegeben, welche einerseits den auf die Gesellschaft entfallenden Ergebnisanteil verwässerten und andererseits den Anteil der Gesellschaft am Eigenkapital von ProMOS um €11 und €18 erhöhten. Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2003 hat ProMOS eigene Aktien am Markt zurückgekauft. Dieses Vorgehen hat den Anteil der Gesellschaft an ProMOS erhöht und gleichzeitig den Anteil am Eigenkapital um €2 verringert.

Im Januar 2003 hat die Gesellschaft bekannt gegeben, dass sie ihre Geschäftsanteile an ProMOS, abhängig von Marktbedingungen und im Einklang mit taiwanesischen Börsenverordnungen, veräußern will. Da die Gesellschaft keinen wesentlichen Einfluss mehr auf ProMOS ausüben kann, wird die Beteiligung mit Wirkung zum 1. April 2003 nicht mehr nach der Equity-Methode, sondern unter Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziell ausgewiesen (siehe Anhang Nr. 11).

Am 1. Oktober 2002 gründeten die Gesellschaft, Agere Systems Inc. und Motorola Inc. die StarCore LLC, ansässig in Austin/Texas. Am 30. September 2003 hält die Gesellschaft 35,7% der Geschäftsanteile an StarCore zu einem Gesamtwert von €23. StarCore entwickelt, vereinheitlicht und vermarktet Basistechnologien für Digitalsignal-Prozessoren (DSP).

Die Gesellschaft hat während der Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 bei Finanzanlagen Wertminderungen in Höhe von €6, €39 und €30 erfasst, da der Buchwert den Marktwert nicht nur kurzfristig überstiegen hat.

In den Finanzanlagen sind für diese Beteiligungen zum 30. September 2003 Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von €38 enthalten.

Die zusammengefassten Finanzdaten der zum 30. September 2003 assoziierten Unternehmen für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 stellen sich wie folgt dar:

	2001	2002	2003
Umsatzerlöse	538	541	600
Bruttoergebnis vom Umsatz	45	62	67
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12	6	-6

	2001	2002	2003
Umlaufvermögen	329	269	243
Anlagevermögen	659	650	682
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-530	-442	-324
Langfristige Verbindlichkeiten	-8	-13	-15
Eigenkapital	450	464	586

17. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Immaterielle Vermögensgegenstände	554	411
Wechselforderungen	9	43
Wertpapiere des Anlagevermögens (Anhang Nr. 11)	12	13
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (Anhang Nr. 27)	92	11
Forderungen gegen Arbeitnehmer	2	2
Sonstige, netto	2	5
Summe sonstige langfristige Vermögensgegenstände	671	485

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2003 wie folgt zusammen:

	Firmenwerte	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	Gesamt
Anschaffungskosten 30. September 2002	387	301	688
Zugänge	–	58	58
Außerplanmäßige Abschreibungen	–68	–	–68
Abgänge	–	–30	–30
Zukäufe	29	34	63
Anpassungen	–70	–20	–90
Fremdwährungseffekte	–35	–4	–39
30. September 2003	243	339	582
Kumulierte Abschreibungen 30. September 2002	–31	–103	–134
Zugänge	–	–69	–69
Laufende F&E	–	–6	–6
Abgänge	–	30	30
Fremdwährungseffekte	4	4	8
30. September 2003	–27	–144	–171
Buchwert 30. September 2002	356	198	554
Buchwert 30. September 2003	216	195	411

Die geschätzten Abschreibungen der sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände weisen für die nächsten fünf Geschäftsjahre die folgenden Werte auf: 2004 €64, 2005 €48, 2006 €34, 2007 €27 und 2008 €10.

Im Juni 2003 hat die Gesellschaft eine Technologieentwicklungs- und Lizenzvereinbarung mit IBM und Chartered Semiconductor für fortschrittliche Logik-Produktionsprozess-Technologie abgeschlossen. Lizenzen in Höhe von €43 werden über die erwartete Nutzungsdauer der entsprechenden Technologie von fünf Jahren abgeschrieben.

Auf Grund reduzierter erwarteter Erträge und geringerer Markterwartungen und unter Berücksichtigung bis dato erreichter technischer Meilensteine hat die Gesellschaft die erwarteten Erträge ihres Optischen-Netzwerk-Geschäfts des Segments Drahtgebundene Kommunikation reduziert. Dementsprechend hat die Gesellschaft die Geschäfts- oder Firmenwerte dieser Berichterstattungseinheit gemäß SFAS Nr. 142, GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTE UND ANDERE IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, auf notwendige Wertberichtigungen hin überprüft und eine Wertberichtigung in Höhe von €68 im Geschäftsjahr 2003 vorgenommen. Die Ermittlung erfolgte über die Barwertmethode, welche den zukünftig erwarteten Cash Flow diskontiert.

In den Geschäftsjahren 2001 und 2002 hat die Gesellschaft Wertberichtigungen in Höhe von €42 und €12 vorgenommen.

18. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	837	750
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 27)	154	73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	206	54
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.197	877

19. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	187	257
Gewährleistungen und Lizenzen	103	169
Steuern	93	67
Zinsen	31	42
Sonstige	59	109
Summe Rückstellungen	473	644

20. SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Abgegrenzte Erträge	126	152
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	162	121
Umsatzsteuer- und sonstige Steuerverbindlichkeiten	108	100
Restrukturierung (Anhang Nr. 8)	35	27
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten (Anhang Nr. 29)	3	11
Finanzverbindlichkeiten und sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (Anhang Nr. 27)	62	5
Sonstige	76	9
Summe sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	572	425

Die abgegrenzten Erträge enthalten Erträge aus Lizenz- und Technologieübertragungen (siehe Anhang Nr. 5), Geschäftsanteilsveräußerungen (siehe Anhang Nr. 4) und Zuwendungen der öffentlichen Hand (siehe Anhang Nr. 6).

21. FINANZVERBINDLICHKEITEN

Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten:		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Durchschnittzinssatz 3,6%	96	8
Kurzfristige Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	23	138
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	1	3
Summe kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	120	149
Langfristige Finanzverbindlichkeiten:		
Ausstehende Wandelschuldverschreibung, Zinssatz 4,25%, fällig 2007	981	987
Ausstehende Wandelschuldverschreibung, Zinssatz 5,0%, fällig 2010	–	688
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:		
Unbesicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittzinssatz 2,35%, fällig 2004–2008	595	566
Besicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittzinssatz 6,31%, fällig 2004–2013	2	28
Verbindlichkeiten, Durchschnittzinssatz 4,0%, fällig 2004	6	6
Zinslose Darlehen, fällig 2004	51	–
Darlehen der öffentlichen Hand, Zinssatz 0,97%, fällig 2027–2031	70	60
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	5	8
Summe langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.710	2.343

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen hauptsächlich aus Kreditaufnahmen im Rahmen von kurzfristigen Darlehensvereinbarungen.

Am 5. Juni 2003 begab die Gesellschaft (als Bürgin) durch ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V. (als Emittentin) eine in 2010 fällige nachrangige Wandelschuldverschreibung zum Nennwert von €700 im Rahmen eines garantierten Angebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese auf Anforderung in maximal 68,4 Millionen Aktien der Gesellschaft umwandeln, wobei der Wandelpreis 10,23 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung kann die Gesellschaft bei einem Teil oder allen Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 5,0% pro Jahr. Die Schuldverschreibung ist unbesichert

und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und kann in den ersten drei Jahren nicht gewandelt werden. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren Sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Gläubiger der Anleihe gleichrangig an dieser Sicherheit teilnehmen. Die Wandelanleihe beinhaltet für die Gläubiger das Recht auf Rückzahlung der gesamten oder eines Teils der Schuldverschreibung zum Nennbetrag zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bei einem definierten Kontrollwechsel der Gesellschaft. Eine Reorganisation der Gesellschaft mit Substitution der Bürgin wird nicht als Kontrollwechsel angesehen. Nach drei Jahren kann die Gesellschaft die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls die Aktie der Gesellschaft 125% des Wandlungspreises an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt. Zum 30. September 2003 betragen die abgegrenzten Ausgabekosten dieser Anleihe €12.

Am 6. Februar 2002 begab die Gesellschaft (als Bürgin) durch ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V. (als Emittentin) eine in 2007 fällige nachrangige Wandelschuldverschreibung zum Nennwert von €1.000 im Rahmen eines garantierten Angebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese auf Anforderung in maximal 28,2 Millionen Aktien der Gesellschaft umwandeln, wobei der Wandelpreis 35,43 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung kann die Gesellschaft bei einem Teil oder allen Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 4,25% pro Jahr. Die Schuldverschreibung ist unbesichert und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren Sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Gläubiger der Anleihe gleichrangig an dieser Sicherheit teilnehmen. Die Wandelanleihe beinhaltet für die Gläubiger das Recht auf Rück-

zahlung der gesamten oder eines Teils der Schuldverschreibung zum Nennbetrag zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bei einem definierten Kontrollwechsel der Gesellschaft. Nach drei Jahren kann die Gesellschaft die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls die Aktie der Gesellschaft 115% des Wandlungspreises an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt. Zum 30. September 2003 betragen die abgegrenzten Ausgabekosten dieser Anleihe €13.

In den unbesicherten Darlehen mit Ratenzahlung ist eine Konsortialkreditlinie in Höhe von €450 für den Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden enthalten. Diese war zum 30. September 2002 und 2003 voll in Anspruch genommen. Die Kreditlinie ist teilweise von der Bundesrepublik Deutschland und einer anderen öffentlichen Körperschaft gesichert. Die Kreditlinie enthält bestimmte Restriktionen bezüglich der Bilanzrelationen, sieht jährliche Zinszahlungen vor und ist am 30. September 2005 rückzahlbar.

Das zinslose Darlehen, fällig im September 2004, das zum 30. September 2003 in kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten enthalten ist, besteht aus Krediten, bei denen die öffentliche Hand die gesamte Zinslast trägt. Darüber hinaus erstattet die öffentliche Hand der Gesellschaft die gesamten Darlehensrückzahlungen, falls die Gesellschaft bestimmte Bedingungen erfüllt. Bis zum 30. September 2003 hatte die Gesellschaft diese Bedingungen erfüllt.

Die Darlehen der öffentlichen Hand enthalten eine unbesicherte Industriefinanzierung im Zusammenhang mit dem Bau der Fertigungsstätte in Richmond.

Die Gesellschaft hat verschiedene, voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart.

Laufzeit	Zusage durch Finanzinstitut	Zweck/beabsichtigter Einsatz	Zum 30. September 2003		
			Gesamthöhe	In Anspruch genommen	Verfügbar
Kurzfristig	feste Zusage	Betriebskapital, Garantien Cash Management	612	63	549
Kurzfristig	keine feste Zusage	Betriebskapital	91	–	91
Langfristig	feste Zusage	Betriebskapital	378	3	375
Langfristig ¹	feste Zusage	Projektfinanzierung	751	751	–
			1.832	817	1.015

¹ Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Zum 30. September 2003 hatte die Gesellschaft alle Besicherungsauflagen zu den entsprechenden Krediten erfüllt. Die Gesellschaft hat eine im September 2005 fällige revolvingende Mehrwährungskreditlinie in Höhe von €375. Die Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinsen. Zum 30. September 2003 wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen. Die Gesellschaft hatte zum 30. September 2002 einen weiteren kurzfristigen Teil zur revolvingenden Mehrwährungskreditlinie in Höhe von €375 verfügbar. Im September 2003 entschied die Gesellschaft, diese Kreditlinie auf Grund der vorhandenen Barmittel nicht zu verlängern.

Zinsaufwendungen beliefen sich auf €42, €89 und €126 in den Geschäftsjahren 2001, 2002 bzw. 2003.

Von den langfristigen Finanzverbindlichkeiten und Finanzierungsleasing-Verpflichtungen werden in den nächsten Jahren folgende Beträge fällig:

Geschäftsjahr	Betrag
2005	530
2006	49
2007	1.008
2008	4
Folgende Jahre	752
Summe	2.343

22. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Rückgewährbare Einlagen	218	242
Abgegrenzte Investitionszulagen (Anhang Nr. 6)	230	223
Pensionsrückstellungen (Anhang Nr. 28)	82	87
Sonstige abgegrenzte Einnahmen	–	28
Abgegrenzte Erträge aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen (Anhang Nr. 5)	39	22
Pensionsähnliche Leistungszusagen (Anhang Nr. 28)	6	5
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Kapitalanteile	12	5
Sonstige	22	18
Summe sonstige langfristige Verbindlichkeiten	609	630

Nach den Verträgen der Gesellschaft mit anderen Investoren am Gemeinschaftsunternehmen Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG, Dresden („SC300“) hat jeder von ihnen das Recht, seinen Anteil an SC300 am 30. September 2005 und jedes dritte Folgejahr zum gleichen Datum an die Gesellschaft zurückzukaufen. Die Gesellschaft hat wiederkehrend alle drei Jahre, das erste Mal am 31. März 2004, das Recht, die Anteile der Investoren zu erwerben. Darüber hinaus hat jeder der anderen Investoren das Recht, seinen Anteil unter bestimmten Umständen an die Gesellschaft zu veräußern. Der Buchwert dieser Verbindlichkeit (Rückgewährbare Einlagen) besteht aus der Kapitaleinlage der Investoren und wird um aufgelaufene Zinsen erhöht, die bei Rücknahme fällig wären, sodass er dem jeweiligen Rücknahmebetrag zum jeweiligen Rücknahmezeitpunkt entspricht.

23. GRUNDKAPITAL

Am 30. September 2003 hatte die Gesellschaft 720.880.604 Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,00 Euro ausgegeben. Während des Geschäftsjahrs 2003 wurden 96.386 Aktien frei gegeben, die als bedingte Kaufpreiskomponenten im Zusammenhang mit der Akquisition von Catamaran (siehe Anhang Nr. 3) vor Beginn des Geschäftsjahrs ausgegeben waren und von einem Treuhänder verwahrt wurden, da vereinbarte Meilensteine erreicht wurden.

Genehmigtes und Bedingtes Kapital

Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt den Vorstand, zu den ausgegebenen Anteilen das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Anteile zu erhöhen. Zum Stichtag 30. September 2003 kann der Vorstand folgende Genehmigte Kapitalien zur Ausgabe neuer Aktien ausüben:

- Das Genehmigte Kapital I/2002 ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 21. Januar 2007 um bis zu €295 durch die Ausgabe von jungen Aktien gegen Bareinlagen, wobei das Bezugsrecht teilweise ausgeschlossen werden kann, oder im Zusammenhang mit Geschäftszusammenschlüssen (Sacheinlagen), wobei das Bezugsrecht für alle Aktien ausgeschlossen werden kann.

- Das Genehmigte Kapital II ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 31. März 2004 um bis zu €119, um Aktien an Mitarbeiter auszugeben (wobei die Bezugsrechte bestehender Aktionäre ausgeschlossen sind).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €96 („Bedingtes Kapital I“) bzw. um bis zu €29 („Bedingtes Kapital III“) bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital kann durch Ausgabe von bis zu 62,5 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien im Rahmen der Aktienoptionspläne der Gesellschaft verwendet werden (siehe Anhang Nr. 24).

Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €50 durch Ausgabe von bis zu 25 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die im Februar 2002 begeben wurden und bis zum 23. Januar 2007 umgewandelt werden können (siehe Anhang Nr. 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €136,8 durch Ausgabe von bis zu 68,4 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II/2002“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber der Wandelschuldverschreibung, die im Juni 2003 begeben wurde. Diese Wandelschuldverschreibung kann bis zum 22. Mai 2010 in Aktien umgetauscht werden (siehe Anhang Nr. 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Weiterhin ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu €213,2 durch Ausgabe von bis zu 106,6 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II/2002“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 21. Januar 2007 begeben werden können (siehe Anhang Nr. 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Kapitalmaßnahmen

Nach der Gründung wurde die Gesellschaft durch die Ausgabe von 600.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem gesamten Nennkapital von €1.200 ausgestattet. Am 13. März 2000 erfolgte der Börsengang der Gesellschaft mit 16.700.000 auf den Namen lautenden Stückaktien, die an der Frankfurter Börse bzw. die entsprechenden American Depository Shares, die an der New Yorker Börse gehandelt werden. Der Kapitalzufluss daraus nach Abzug von Emissionskosten betrug €562.

Im April 2000 hat die Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung 7.592.430 auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben und daraus €259 Erlöst.

Im Juni 2000 hat die Gesellschaft den Geschäftsbetrieb von Savan Communications Ltd. gegen Gewährung von 1.209.077 Aktien aus dem Genehmigten Kapital III erworben.

Im März 2001 hat die Gesellschaft 443.488 Namensaktien aus dem Genehmigten Kapital III zur teilweisen Bezahlung einer Beteiligung an Ramtron International Corp. ausgegeben.

Die Gesellschaft hat im April 2001 den Geschäftsbetrieb von Ardent Technologies Inc. gegen Gewährung von 706.714 Namensaktien aus dem Genehmigten Kapital III erworben.

Bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Juli 2001 hat die Gesellschaft weitere 60.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien an der Börse platziert und daraus €1.475 nach Abzug der Emissionskosten Erlöst.

Im August 2001 gab die Gesellschaft 6.373.435 Aktien des Genehmigten Kapitals III aus, um Catamaran zu erwerben.

Im September 2002 gab die Gesellschaft 27.500.000 Aktien des Genehmigten Kapitals I/2002 aus, um MIC zu erwerben (siehe Anhang Nr. 3).

Nach dem deutschen Aktiengesetz beruht der Betrag, der zur Dividendenzahlung an die Aktionäre zur Verfügung steht, auf dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft, der nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs ermittelt wird. Alle Dividendenzahlungen müssen von der Hauptversammlung beschlossen werden. Auf der Hauptversammlung im Januar 2003 wurde beschlossen, keine Dividende auszuzahlen. Ebenso wird für das Geschäftsjahr 2003 vom Vorstand vorgeschlagen, keine Dividende auszuschütten, da die Muttergesellschaft Infineon Technologies AG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzverlust auswies.

24. AKTIENOPTIONSPLÄNE

Aktienoptionsplan mit fester Ausübungshürde

Am 6. April 2001 stimmten die Aktionäre einem internationalen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive-Plan 2001) zu, der den Aktienoptionsplan 1999 ablöst. Optionen, die auf Grundlage des bisherigen Plans ausgegeben wurden, behalten ihre Wirksamkeit zu den damaligen Ausgabekonditionen. Entsprechend den Bedingungen des neuen Plans können insgesamt bis zu 51,5 Millionen Optionen innerhalb einer Fünfjahresfrist gewährt werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 105% des durchschnittlichen Aktienkurses während der fünf Handelstage vor Gewährung der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren ausgeübt werden, sofern seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwischen zwei und vier Jahre vergangen sind.

1999 verabschiedete die Hauptversammlung einen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive-Plan 1999), wonach nicht übertragbare Rechte zum künftigen Erwerb von Aktien gewährt werden. Entsprechend

diesem Plan können über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 48 Millionen Aktienoptionen ausgegeben werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 120% des durchschnittlichen Aktienpreises während der fünf Handelstage vor dem Ausgabebetrag der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden, jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwei Jahre vergangen sind und der Aktienkurs an mindestens einem Handelstag während der jeweiligen Laufzeit den Ausgabepreis erreicht hat.

Nach den Regelungen des Aktienoptionsplans von 2001 entscheidet der Aufsichtsrat jährlich innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Konzernabschlusses über die Zahl der dem Vorstand zu gewährenden Optionen. Der Vorstand wird im gleichen Zeitraum über die Zahl der den berechtigten Mitarbeitern zu gewährenden Optionen entscheiden.

Die Aktienoptionspläne von 1999 und 2001 sowie ihre Änderungen innerhalb der letzten drei Jahre stellen sich wie folgt dar:

	2001		2002		2003	
	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis
Ausstehende Optionen zu Beginn des Geschäftsjahrs	5.469.468	€ 42,15	11.267.878	€ 48,56	19.883.210	€ 35,96
Gewährte Optionen	6.013.060	€ 54,15	9.393.030	€ 21,74	11.724.760	€ 8,97
Ausgeübte Optionen	–	–	–	–	–	–
Verfallene Optionen	-214.650	€ 43,82	-777.698	€ 45,90	-1.718.486	€ 32,80
Ausstehende Optionen zum Ende des Geschäftsjahrs	11.267.878	€ 48,56	19.883.210	€ 35,96	29.889.484	€ 25,56
Ausübbar zum Ende des Geschäftsjahrs	–	–	5.060.460	€ 42,00	9.581.529	€ 48,56

Die folgende Tabelle fasst Informationen über die ausstehenden Aktienoptionen zum 30. September 2003 zusammen:

Spanne der Ausübungspreise	Ausstehend			Ausübbar	
	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis
€ 5 – €10	11.072.740	6,14	€ 8,91	–	–
€10 – €15	1.616.400	6,00	€ 12,65	–	–
€15 – €20	176.750	5,84	€ 15,75	–	–
€20 – €25	7.361.690	5,18	€ 23,70	–	–
€25 – €30	143.750	4,99	€ 27,44	63.375	€ 27,54
€40 – €45	4.675.214	3,46	€ 42,03	4.675.214	€ 42,03
€50 – €55	103.700	4,51	€ 53,26	103.700	€ 53,26
€55 – €60	4.739.240	4,16	€ 55,18	4.739.240	€ 55,18
Gesamt	29.889.484	5,15	€ 25,56	9.581.529	€ 48,56

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Die Gesellschaft bietet ein weltweites Programm zum Aktienerwerb durch Mitarbeiter, das den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Aktien der Gesellschaft mit einem Abschlag von 15% zu erwerben, solange eine bestimmte Obergrenze pro Mitarbeiter nicht überschritten und eine Mindesthaltedauer von einem Jahr eingehalten wird. Im Rahmen und unter den Bedingungen dieses Plans erwarben Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2002 355.460 Aktien. Im Geschäftsjahr 2003 gab es kein entsprechendes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.

Marktwertangaben

Wie in Anhang Nr. 2 erläutert, bilanziert die Gesellschaft Aktienoptionspläne gemäß APB Opinion 25, BILANZIERUNG VON AKTIONSOPTIONEN FÜR MITARBEITER, und den entsprechenden Regelungen zur Bilanzierung von Aktienoptionsplänen. SFAS Nr. 123 gibt eine alternative Möglichkeit zur Bewertung des Aufwands für Mitarbeitervergütung vor, indem der Marktwert der Optionen zum Gewährungszeitpunkt durch Optionspreismodelle bestimmt wird. Optionspreismodelle wurden entwickelt, um den Marktwert von frei handelbaren, fungiblen Optionen ohne Mindesthaltedauer zu bestimmen, die sich jedoch deutlich von den Optionen mit Ausübungsrestriktionen unterscheiden, die die Gesellschaft ihren Mitarbeitern gewährt. Diese Modelle benötigen weiterhin subjektive Annahmen, wie die zukünftige Volatilität des Aktienkurses und den erwarteten Zeitraum bis zur Ausübung, die den festgestellten Optionspreis erheblich beeinflussen. Die Gesellschaft bewertete den Marktwert einer gewährten Option zum Ausgabezeitpunkt mittels des Black-Scholes-Optionspreismodells, das von einer Einzelbewertung der Optionen ausgeht und den Verfall zum jeweiligen Eintrittszeitpunkt annimmt.

In der folgenden Tabelle sind die durchschnittlichen Annahmen zur Optionspreisbewertung in den einzelnen Geschäftsjahren dargestellt:

	2001	2002	2003
Durchschnittliche Annahmen:			
Risikofreier Zinssatz	5,35%	4,19%	3,85%
Erwartete Volatilität	50%	52%	59%
Dividendenertrag	0%	0%	0%
Erwartete Laufzeit in Jahren	4,50	4,50	4,50
Durchschnittlicher Marktwert pro Option zum Gewährungszeitpunkt in Euro			
	24,18	9,09	4,41

Wären Personalaufwendungen auf der Grundlage des Marktwerts nach SFAS Nr. 123 bilanziert worden, wodurch sich ein Aufwand für Mitarbeitervergütung auf Grundlage oben dargestellter Marktwerte ergeben hätte, so hätten sich der Konzernjahresfehlbetrag und das Ergebnis je Aktie gemäß der Anwendung von SFAS Nr. 148, BILANZIERUNG VON AKTIONSOPTIONEN – ÜBERGANG UND OFFENLEGUNG, wie in den folgenden Pro-forma-Angaben verändert:

	2001	2002	2003
Konzernjahresfehlbetrag			
Ist	-591	-1.021	-435
Abzüglich: im Konzernergebnis enthaltene Aufwendungen für aktienbezogene Mitarbeitervergütung, abzüglich zugehöriger Steuer	25	23	7
zuzüglich: Aufwendungen für alle aktienbezogenen Mitarbeitervergütungen über Marktwertmethode ermittelt, abzüglich Steuer	-72	-92	-43
Pro forma	-638	-1.090	-471
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie			
Ist	€-0,92	€-1,47	€-0,60
Pro forma	€-1,00	€-1,57	€-0,65

25. ÄNDERUNGEN IM EIGENKAPITAL, DIE NICHT AUS TRANSAKTIONEN MIT AKTIONÄREN RESULTIEREN

Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, haben sich für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 wie folgt entwickelt:

	2001			2002			2003		
	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren:									
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus gehaltenen Wertpapieren	-3	1	-2	-4	2	-2	11	-	11
Umgliederung von im Periodenergebnis enthaltenen Gewinnen/Verlusten	-13	7	-6	3	-1	2	4	-2	2
Nicht realisierte Gewinne/Verluste	-16	8	-8	-1	1	-	15	-2	13
Zusätzliche Mindestpensionsverbindlichkeit	-19	7	-12	-13	5	-8	4	-2	2
Unterschiede aus Fremdwährungsumrechnung	-19	-	-19	-92	-	-92	-76	-	-76
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-54	15	-39	-106	6	-100	-57	-4	-61
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren – zu Beginn des Geschäftsjahrs	119	-7	112	65	8	73	-41	14	-27
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, am Ende des Geschäftsjahrs	65	8	73	-41	14	-27	-98	10	-88

26. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG

	2001	2002	2003
Auszahlungen für:			
Zinsen	52	55	91
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	282	46	53
Aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Erhaltene Zahlungen für steuerfreie Investitionszulagen	22	86	34
Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungsaktivitäten:			
Einlagen von/an Siemens	-11	10	-6
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10	16	8
Über Kapitalleasing erworbene Vermögensgegenstände	-	2	5

Am 14. August 2001 hat die Gesellschaft vertraglich den Verkauf des von ihr gehaltenen Anteils von 49% an dem Gemeinschaftsunternehmen OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG („OSRAM Opto“) mit der OSRAM GmbH („OSRAM“) für €565 vereinbart. OSRAM ist

eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Siemens. Nach der Rechnungslegungsinterpretation 39 des Accounting Principles Board (APB) Opinion 16, ÜBERTRAGUNGEN UND AUSTAUSCH ZWISCHEN GESELLSCHAFTEN UNTER GEMEINSAMER KONTROLLE, müssen langlebige Vermögensgegenstände zwischen zwei Tochterunternehmen, die unter gemeinsamer Führung stehen, zu historischen Kosten transferiert werden. Der den Buchwert übersteigende Kaufpreis ist demnach als Kapitaleinlage auszuweisen. Da die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt eine Tochtergesellschaft von Siemens war, wurde der Kaufpreisüberschuss nach Steuern von €392 als direkte Kapitaleinlage zum 30. September 2001 bilanziert.

27. VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft unterhält übliche Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen des Siemens-Konzerns und zu den sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (im Folgenden als „verbundene Unternehmen“ bezeichnet). Infineon bezieht bestimmte Vorprodukte, insbesondere Chipsätze, von verbundenen Unternehmen. Zugleich verkauft die Gesellschaft auch einen beträchtlichen Teil der Produktion an verbundene Unternehmen. Diese Käufe von und Verkäufe an verbundene Unternehmen orientieren sich grundsätzlich an Marktpreisen oder an Herstellungskosten zuzüglich einer Gewinnmarge.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Arbeitnehmer setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Kurzfristig:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	97	194
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	8	8
Finanzforderungen und sonstige gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	23	18
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	28	125
Forderungen gegen Arbeitnehmer	8	7
	164	352
Langfristig:		
Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	92	11
Forderungen gegen Arbeitnehmer	2	2
	94	13
Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen	258	365

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich zum 30. September 2002 und 2003 wie folgt zusammen:

	2002	2003
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns	154	73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	206	54
Finanzverbindlichkeiten und sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	62	5
Summe Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	422	132

Bei den Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wird wie folgt unterschieden: (1) Positionen, bei denen entweder von oder an Siemens-Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft Geschäftsanteile hält, geschuldet wird, und (2) nach dem zu Grunde liegenden Geschäftsvorfall.

Die als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Beträge resultieren aus dem Kauf bzw. Verkauf von Produkten. Finanzforderungen und -verbindlichkeiten beinhalten die geschuldeten Beträge aus Darlehen sowie die zu Interbankensätzen aufgelaufenen Zinsen.

Die Gesellschaft und IBM haben jeweils einen befristeten revolving Kredit an ALTIS verlängert. Zum September 2003 wird der Kredit in Höhe von €61 in der Position „Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen“ ausgewiesen.

Am 30. September 2003 enthielten die „Finanzforderungen und sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen“ ein Darlehen in Höhe von €58 an Inotera, welches marktüblich verzinst und im Oktober 2003 in Eigenkapital umgewandelt wurde.

Am 30. September 2002 enthielten die „Finanzverbindlichkeiten und sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen“ ein Darlehen in Höhe von US-Dollar 55 Mio. von UMCi, welches marktüblich verzinst und im September 2003 fällig war und zurückbezahlt worden ist.

Darstellung des Geschäftsverkehrs mit verbundenen Unternehmen für die zum 30. September 2001, 2002 und 2003 endenden Geschäftsjahre:

	2001	2002	2003
Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen:			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	848	685	836
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	147	170	163
Gesamte Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen	995	855	999
Bezüge von verbundenen Unternehmen:			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	417	681	413
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	1.040	686	470
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	9	5	4
Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen	10	2	1

Die Umsätze mit Unternehmen des Siemens-Konzerns beinhalten Verkäufe an Siemens-Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Dritte, die sich in den Geschäftsjahren 2001, 2002 und 2003 auf jeweils €89, €77 und €86 beliefen. Grundsätzlich wird der Verkauf an Dritte über die eigenen Vertriebsorganisationen der Gesellschaften abgewickelt. In bestimmten Ländern, in denen die Gesellschaft keine eigene Vertriebsorganisation unterhält, unterstützen die Vertriebsgesellschaften des Siemens-Konzerns den Verkauf an Dritte und erhalten hierfür eine Kommission.

Die Käufe von Gesellschaften des Siemens-Konzerns bestehen hauptsächlich aus Vorräten, IT-Dienstleistungen und Verwaltungsdienstleistungen.

Die Gesellschaft least technische Anlagen und Maschinen an das Gemeinschaftsunternehmen ALTIS (siehe Anhang Nr. 15). Aus den unkündbaren Leasingverträgen erwartet die Gesellschaft Leasingzahlungen zum 30. September 2003 in Höhe von €17 für das Geschäftsjahr 2004.

Siemens hat am 10. August 2000 eine garantierte Wandelanleihe (Exchangeable Note) ausgegeben. Die Anleihe mit einem Nominalvolumen von €2.500 (was 4% des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht) ist in Teilschuldverschreibungen zu je €0,1 geteilt. Die mit 1% p. a. verzinsten Wertpapiere haben eine Laufzeit bis zum 10. August 2005. Jeder Inhaber einer Teilschuldverschreibung hat bei Eintritt bestimmter Bedingungen das Recht, diese Teilschuldverschreibung bis zum 10. August 2005 in 1.000 Aktien der Gesellschaft umzutauschen.

Am 5. Dezember 2001 übertrug Siemens in einem Treuhandabkommen 200 Millionen Aktien der Gesellschaft bzw. zirka 28,9% des zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft an eine nicht stimmberechtigte Treuhandgesellschaft, die nicht mit dem Siemens-Konzern in Beziehung steht. Der Treuhänder hat einen Rechtsanspruch auf die im Treuhandvermögen gebundenen Aktien, Siemens hat unwiderruflich alle Stimmrechte daraus aufgegeben. Der Treuhänder ist jedoch nicht berechtigt, das Stimmrecht der mit diesem Treuhandvertrag übertragenen Aktien auszuüben. Siemens ist weiterhin berechtigt, den wirtschaftlichen Nutzen aus den in Treuhandverwahrung befindlichen Aktien zu ziehen, einschließlich des Rechts auf Dividendenzahlung oder Erlösen aus einem erlaubten Verkauf der Aktien der Gesellschaft

aus der Treuhandverwahrung. Gemäß dem Treuhandvertrag hält der Treuhänder die Aktien zum Nutzen der Begünstigten, die sowohl Siemens als Treuhandgeber als auch fremde Dritte – Aktionäre der Gesellschaft – umfassen. Das Treuhandverhältnis erlischt, wenn der Siemens-Konzern direkt oder indirekt weniger als 50% des stimmberechtigten Grundkapitals der Gesellschaft, inklusive der im Treuhandverhältnis vom Treuhänder gehaltenen Anteile, über einen Zeitraum von zwei Jahren hält oder gehalten hat. Gewisse Bestimmungen des Treuhandvertrags, einschließlich derjenigen, die sich auf die Stimmrechte und die Übertragung der treuhänderisch gehaltenen Aktien beziehen, dürfen nicht ohne Zustimmung von Aktionären der Gesellschaft geändert werden.

Am 13. Dezember 2002 hat der Siemens Pension-Trust e. V. mitgeteilt, dass deren Stimmrechtsanteil am 2. Dezember 2002 unter 10% gefallen sei. Die Gesellschaft geht davon aus, dass damit der von Siemens gehaltene Anteil unter 50% gefallen ist.

Die Übertragung der Aktien der Gesellschaft an einen nicht stimmberechtigten Treuhänder durch Siemens am 5. Dezember 2001 verringerte die durch Siemens gehaltenen stimmberechtigten Anteile an der Gesellschaft um den der Anzahl der übertragenen Aktien entsprechenden Stimmrechtsanteil. Entsprechend hält Siemens am 30. September 2003 39,7% der Anteile der Gesellschaft und zirka 12,0% der Stimmrechte. Da andere Aktionäre außer Siemens und der Treuhandgesellschaft etwa 60,3% des Grundkapitals der Gesellschaft besitzen, können sie die Mehrheit der Stimmrechte auf einer Hauptversammlung innehaben. Die Auswirkung der Übertragung von Aktien der Gesellschaft an den nicht stimmberechtigten Treuhänder ist also, dass alle anderen Aktionäre einen nicht im Verhältnis zum Anteilsbesitz stehenden Stimmrechtsanteil innehaben.

28. PENSIONSVERPFLICHTUNGEN

Die Gesellschaft hat einem bedeutenden Anteil ihrer Mitarbeiter Pensionszusagen gewährt. Die Pensionszusagen richten sich im Wesentlichen nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Ein Teil der Altersversorgungspläne bezieht sich auf das Einkommen im letzten oder in den letzten fünf Jahren der Betriebszugehörigkeit, andere feste Versorgungspläne sind vom durchschnittlichen Einkommen und der Position abhängig.

Die Daten zu den Pensionsplänen der Gesellschaft sind für die deutschen Versorgungspläne („Inland“) und die ausländischen Versorgungspläne („Ausland“) zum 30. September 2001, 2002 und 2003 in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2001		2002		2003	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Entwicklung der Anwartschaftsbarwerte (PBO):						
Anwartschaftsbarwerte (PBO)						
zum Beginn des Geschäftsjahrs	-170	-50	-197	-47	-218	-58
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	-12	-2	-13	-5	-13	-5
Zinsaufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	-11	-3	-12	-3	-13	-4
Versicherungstechnische Gewinne/Verluste	-6	-1	-	2	3	-5
Akquisitionsbedingte Zugänge	-	-	-	-7	-	-7
Desinvestitionen	-	-	1	-	-	-
Neu geschaffener Plan	-	-	-1	-2	-	-
Planänderung	-	4	-	-	-4	-
Übertragung von Pensionsverpflichtungen	-	1	-	-	-	-
Gezahlte Versorgungsleistungen	2	1	2	2	2	1
Kürzungen	-	-	2	-	-	3
Fremdwährungseffekte	-	3	-	2	-	5
Anwartschaftsbarwerte (PBO)						
zum Ende des Geschäftsjahrs	-197	-47	-218	-58	-243	-70
Entwicklung des Marktwerts des Planvermögens:						
Marktwert zu Beginn des Geschäftsjahrs	155	9	133	24	130	26
Einlagen und Übertragungen	2	16	2	3	12	2
Tatsächliche Rendite auf das Planvermögen	-22	1	-13	1	3	-
Gezahlte Versorgungsleistungen	-2	-1	-2	-2	-2	-1
Akquisitionsbedingte Zugänge	-	-	-	-	-	4
Neu geschaffener Plan	-	-	-	2	-	-
Fremdwährungseffekte	-	-1	-	-2	-	-4
Marktwert am Ende des Geschäftsjahrs	133	24	120	26	143	27
Finanzierungsstatus des Planvermögens	-64	-23	-98	-32	-100	-43
Noch nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasster versicherungsmathematischer Verlust	52	4	68	3	66	6
Noch nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasste Versorgungsansprüche aus vorhergehenden Geschäftsjahren	-	-	-	-	4	-2
Noch nicht bilanzierte Verpflichtungen	2	-	-	-	-	-
Zuführungen nach der Gutachtenberechnung	-	-	10	-	16	-
Pensionsverpflichtungen	-10	-19	-20	-29	-14	-39

Die in der Bilanz zum 30. September ausgewiesenen Verpflichtungen setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

	2001		2002		2003	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen	–	–	–	–	–	1
Immaterielle Vermögensgegenstände (Anhang Nr. 14)	–	–	–	–	4	–
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	19	–	33	–	29	–
Pensionsverbindlichkeiten (Anhang Nr. 22)	–29	–19	–53	–29	–47	–40
Pensionsverpflichtungen, Saldo	–10	–19	–20	–29	–14	–39

Der Ermittlung der versicherungsmathematischen Werte der wesentlichen Versorgungspläne lagen folgende Annahmen zu Grunde:

	2001		2002		2003	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Abzinsungsfaktor	6,0%	7,5%	6,0%	5,5%–7,0%	5,8%	5,3%–6,0%
Personalkostenteuerungsrate	3,0%	4,5%	3,0%	3,0%–4,5%	3,0%	3,0%–4,5%
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	10,0%	8,0%	5,4%	6,0%–8,0%	4,9%	6,0%–7,0%

Die Abzinsungsfaktoren werden auf der Basis hochwertiger Rentenpapiere gebildet, die, falls die Pensionsanswartschaften zum Stichtag glattgestellt würden, bis zum Fälligkeitszeitpunkt die benötigten zukünftigen Einzahlungen bereitstellen würden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass kurzfristige Schwankungen der Zinssätze keinen Einfluss auf ihre langfristigen Verpflichtungen haben werden.

Die Pensionsaufwendungen in den Geschäftsjahren 2001, 2002 und 2003 beinhalten:

	2001		2002		2003	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	–12	–2	–13	–5	–13	–5
Zinsaufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	–11	–3	–12	–3	–13	–4
Erwarteter Ertrag aus Planvermögen	15	1	5	1	6	2
Amortisation von noch nicht realisierten Verlusten	–	3	–2	–	–3	–
Amortisation noch nicht realisierter Verpflichtungen, netto	–2	–	–2	–	–	–
Realisierter Gewinn aus Kürzungen	–	–	2	–	–	3
Aufwendungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	–10	–1	–22	–7	–23	–4

Am 25. September 2000 gründete die Gesellschaft den Infineon Technologies Pension Trust e.V. („Pension Trust“) zum Zwecke der Finanzierung zukünftiger Pensionszahlungen für Mitarbeiter in Deutschland. Die Gesellschaft leistete eine Einlage in Höhe von €155 in Form von Zahlungsmitteln und Wertpapieren, die Gläubiger- bzw. Eigentümerrechte verbriefen. Die Einlage fällt als Planvermögen des Pension Trust zur Finanzierung dieser Pensionsverpflichtungen unter die Bestimmungen von SFAS Nr. 87 und reduziert insoweit die Pensionsrückstellungen der Gesellschaft.

Die Auswirkungen der Mitarbeiterentlassungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Gesellschaft (siehe Anhang Nr. 8) auf die Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft werden auf Grund der Anwendung von SFAS Nr. 88, BILANZIERUNG FÜR ABGELTUNG UND KÜRZUNGEN VON PENSIONSVERPFLICHTUNGEN UND ABFINDUNGEN, als Kürzung in den Geschäftsjahren 2002 und 2003 dargestellt.

In den Geschäftsjahren 2002 und 2003 brachte die Gesellschaft Einlagen in Höhe von €12 und €28 in ihren deutschen Pensionsplan ein.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 etablierte die Gesellschaft ein Programm zur betrieblichen Altersvorsorge für deutsche Mitarbeiter, wobei die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einen Teil des Gehalts in eine Rentenzahlung inklusive aufgelaufener Zinsen zum Renteneintritt umzuwandeln. Die Verbindlichkeit für zukünftige Zahlungen ist versicherungsmathematisch bestimmt und auf der gleichen Basis wie andere Pensionspläne der Gesellschaft berechnet worden.

Nach der Ausgründung von Siemens gründete die Gesellschaft einen Pensionsplan für ihre amerikanischen Mitarbeiter gesondert von dem Siemens-US-Pensionsplan. Zum Zeitpunkt der Ausgründung wurde der eingezahlte Bestand des der Gesellschaft zuzurechnenden Teils des Siemens-US-Pensionsplans im Verhältnis zu den übertragenen Mitarbeitern als Pensionsrückstellung erfasst. Nachträglich transferierte Siemens, basierend auf einer versicherungsmathematischen Ermittlung, Vermögensgegenstände, um diese Rückstellung finanziell zu unterlegen. Die Differenz zwischen der versicherungsmathematischen Bewertung am Tag der Unterlegung und der ursprünglich verrechneten Rückstellung in Höhe von €10 und €-6 wurde als Eigenkapitalübertragung in den Geschäftsjahren 2002 und 2003 ausgewiesen.

Die Gesellschaft gewährt bestimmten Mitarbeitern in den USA nach ihrem Ausscheiden Krankenversicherungsleistungen. Der Gesellschaft entstanden hierfür Kosten in Höhe von €1 für das Geschäftsjahr 2001, €0 für das Geschäftsjahr 2002 und €0 für das Geschäftsjahr 2003. Die Nettoverbindlichkeit betrug in den Bilanzen der Geschäftsjahre 2001 und 2002 €6 und 2003 €5.

Gemäß den Richtlinien der Gesellschaft investieren die Pensionspläne der Gesellschaft nicht in eigene Aktien.

29. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Die Gesellschaft schließt Geschäfte über Derivate einschließlich Fremdwährungstermin- und -optionsgeschäften ab. Ziel dieser Transaktionen ist die Verringerung der Marktrisiken aus Veränderungen von Währungsrelationen für die in Fremdwährung lautenden Zahlungsströme. Derivative Finanzinstrumente werden bei der Gesellschaft nicht zu Handels- oder spekulativen Zwecken eingesetzt.

Die Nominal- und Marktwerte der von der Gesellschaft zum 30. September 2002 und 2003 gehaltenen Derivate sind im Folgenden dargestellt, in Mio. Euro:

	2002		2003	
	Nominalwert	Marktwert	Nominalwert	Marktwert
Forward-Verträge Verkauf:				
US-Dollar	313	6	306	5
Japanische Yen	–	–	8	–
Britisches Pfund	–	–	2	–
Forward-Verträge Kauf:				
US-Dollar	148	–	54	–1
Japanische Yen	75	–2	29	1
Singapur-Dollar	33	–1	20	–
Britisches Pfund	7	–	4	–
Sonstige Währungen	52	–	15	1
Währungsoptionen Verkauf:				
US-Dollar	–	–	175	–10
Währungsoptionen Kauf:				
US-Dollar	–	–	186	7
Währungsübergreifender Zinsswap:				
US-Dollar	616	106	547	113
Zinsswap	500	26	1.200	27
Termingeschäfte	150	–	–	–
Marktwert, Saldo		135		143

Zum 30. September 2002 und 2003 wurden die Derivate zu ihren Marktwerten bilanziert.

Die Gewinne aus Fremdwährungen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften betragen im Geschäftsjahr 2001 €34. In den Geschäftsjahren 2002 und 2003 sind mit Fremdwährungen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften Verluste in Höhe von €16 und €35 entstanden. Gewinne und Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten sind in den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen enthalten. Gewinne oder Verluste, die dem operativen Geschäft zuordenbar sind, werden überwiegend in den Umsatzkosten, und solche, die im Zusammenhang mit Finanztransaktionen entstanden, in den sonstigen Erträgen oder Aufwendungen gezeigt.

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen oder der DCF-Methode ermittelt. Der Marktwert der unbesicherten Darlehen und der verzinslichen Bankverbindlichkeiten entspricht annähernd dem Buchwert, da die Verzinsung den derzeit marktüblichen Zinsen entspricht. Der Marktwert des zinslosen Darlehens ist nicht aussagefähig, da dessen Übertragbarkeit beschränkt ist. Zum 30. September 2003 wurden die Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2007 bzw. 2010 an der Börse in Luxemburg mit einem Abschlag von 6,9% bzw. einem Aufschlag von 36,8% gegenüber ihrem Nominalwert gehandelt. Die Marktwerte der Zahlungsmittel, Forderungen gegen Dritte, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie der übrigen derivativen Finanzinstrumente entsprechen auf Grund ihrer kurzfristigen Fälligkeiten annähernd deren Buchwerten. Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Marktwerten bilanziert (siehe Anhang Nr. 11).

30. RISIKEN

Die Finanzrisiken der Gesellschaft resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften. Das Kreditrisiko bei Forderungen ist auf Grund der großen Anzahl sowie wegen der regionalen Verteilung der Kunden begrenzt. Die Gesellschaft steuert Kreditrisiken durch Kreditgenehmigungen, Kreditlimits und Überwachungsprozesse sowie umfassende Kreditprüfungen aller Kunden. Ein beträchtlicher Teil der Forderungen und Umsätze aus Lieferungen und Leistungen wird mit verbundenen Unternehmen realisiert. Das Kreditrisiko in Bezug auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Fremdwährungs-Derivate durch Transaktionen mit verschiedenen Banken ist auf vorgegebene Obergrenzen beschränkt. Die Gesellschaft glaubt, dass das Risiko einer Nichterfüllung eines Geschäftspartners gering ist, da die Gesellschaft deren Kreditrisiko prüft und die Höhe der Außenstände und die Anzahl der Vereinbarungen mit allen Finanzinstituten limitiert.

Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit hat die Gesellschaft anhaltend hohe Aufwendungen für Prozesstechnologien sowie für For-

schung und Entwicklung. Falls die Ergebnisse aus diesen Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Markt keine Akzeptanz finden oder die Marktbedingungen sich wesentlich verschlechtern, könnten Teile der erwarteten Rückflüsse aus diesen Investitionen ausbleiben.

31. FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Rechtsangelegenheiten

Am 7. und 8. August 2000 hat Rambus Inc., USA, („Rambus“) Klagen gegen die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten und in Deutschland erhoben. Rambus behauptet, die Gesellschaft habe Rambus' Patente in Bezug auf SDRAM- und DDR DRAM-Produkte verletzt.

Am 4. und 9. Mai 2001 hat ein Bezirksgericht in Virginia, USA, alle 57 Patentverletzungsansprüche von Rambus gegen die Gesellschaft abgewiesen. Zusätzlich befand das Gericht Rambus der arglistigen Täuschung durch ihr Verhalten gegenüber der JEDEC-Standardisierungsorganisation für schuldig und erkannte der Gesellschaft dafür Schadenersatz zu. Am 29. Januar 2003 verwarf das US-Berufungsgericht des betreffenden Bundesbezirks die Entscheidung des Bezirksgerichts bezüglich vier Ansprüchen und verwies die Klage an das Bezirksgericht für ein Geschworenengericht zurück. Die Gesellschaft glaubt, berechnete Einwände gegen die Klagevorwürfe zu haben. Das Berufungsgericht hat auch die Bezirksgerichtsentscheidung bezüglich der arglistigen Täuschung seitens Rambus im Verhalten gegenüber JEDEC aufgehoben. Die Gesellschaft hat gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts beim obersten US-Gericht erfolglos Einspruch eingelegt. Das Wiederaufnahmeverfahren der Patentverletzungsklage am Bezirksgericht ist in einem frühen Stadium. Die Gesellschaft glaubt, eine gute Verteidigungsposition gegen die Klage zu haben.

Das deutsche Gerichtsverfahren begann im Dezember 2000 und ist noch anhängig. Ein gerichtlich bestellter Gutachter legte ein Gutachten vor, das Gericht kam jedoch noch zu keiner Entscheidung auf Basis dieses Gutachtens. Das Europäische Patentamt hat am 11. September 2002 entschieden, dass das Rambus-Patent unzulässig erweitert wurde; dadurch ist der Gesellschaft die Verteidigung gegen die direkten Verletzungsansprüche erleichtert. Rambus hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, und es wird erwartet, dass das Europäische Patentamt bis Februar 2004 über die Beschwerde entscheiden wird. Das Gericht will im Mai 2004 nach der erwarteten Entscheidung des Europäischen Patentamts im Beschwerdeverfahren am Europäischen Patentamt in dieser Angelegenheit entscheiden. Die Gesellschaft glaubt, eine gute Verteidigungsposition gegen die Klage zu haben.

SDRAM und DDR DRAM Produkte, die die Technologie, die derzeit im Rambus-Verfahren behandelt wird, nutzen, stellen nahezu alle Produkte des Geschäftsgebiets Speicherprodukte dar. Dieses Segment erzielte im Geschäftsjahr 2003 Umsatzerlöse in Höhe von €2.485 und ein EBIT in Höhe von €31. Ein Fertigungsverbot von SDRAM- und DDR DRAM-Produkten würde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erheblich negativ beeinflussen, da die Produktlinien SDRAM und DDR RAM aufgegeben werden oder Lizenzabkommen mit Rambus geschlossen werden müssten, die erhebliche Lizenzzahlungen auslösen würden.

Die Gesellschaft lizenziert derzeit RDRAM-Technologie von Rambus. Die Nutzung dieser Technologie ist nicht Gegenstand des zuvor beschriebenen Rechtsstreits.

Am 17. Juni 2002 erhielt die US-Tochtergesellschaft der Gesellschaft in den USA eine „Subpoena“ (Anordnung) einer Grand Jury des US-Bundesgerichts für Nordkalifornien im Zusammenhang mit einer Ermittlung der Kartellabteilung des US-Bundesjustizministeriums („DOJ“) wegen möglicher Verletzungen US-amerikanischer Kartellgesetze in der DRAM-Speicherproduktindustrie. Die Gesellschaft wurde aufgefordert, der Grand Jury im Zusammenhang mit der Untersuchung Informationen zu übermitteln. Die Gesellschaft unterstützt kooperativ das DOJ bei der Untersuchung.

Seit dem Beginn des DOJ-Verfahrens sind mehrere Sammelklagen gegen die Gesellschaft, die Infineon Technologies North America Corp. und weitere Speicherchiphersteller eingereicht worden. Sechzehn Klagen wurden zwischen 21. Juni 2002 und 19. September 2002 bei Bundesgerichten eingereicht, davon eine im Südlichen Bezirk von New York, fünf im Bezirk von Idaho und zehn im Bezirk Nördliches Kalifornien. Jede dieser Klagen ist in der Form der Sammelklage für Einzelpersonen und juristische Personen erhoben worden, die DRAM-Produkte direkt von DRAM-Anbietern in einem festgelegten Zeitraum beginnend mit dem 1. Oktober 2001 erworben haben. Die Kläger behaupten die Verletzung des „Sherman Act“ durch Preisabsprachen und machen Schadensersatz in unspezifizierter, dreifacher Höhe, Anwaltskosten und sonstige Kosten sowie eine Unterlassungsverfügung gegen das angeblich rechtswidrige Verhalten geltend. In einem Termin am 26. September 2003 entschied das „Judicial Panel on Multi-District Litigation“ (Gerichtssenat für Zuständigkeitsentscheidungen bei Betroffenheit mehrerer Bezirke), diese Verfahren an das US-Bundesgericht für Nordkalifornien zu verweisen, um sie dort koordiniert und gemeinsam weiter zu behandeln.

Acht zusätzliche Klagen wurden zwischen 22. August 2002 und 11. März 2003 bei Gerichten des Staats Kalifornien eingereicht, nämlich fünf in San Francisco County, eine in Santa Clara County, eine in Los

Angeles County und eine in Humboldt County. Jede dieser Klagen ist in der Form der Sammelklage im Namen von Einzelpersonen oder juristischen Personen erhoben worden, die indirekt DRAM-Produkte in einem bestimmten Zeitraum beginnend mit dem 1. Dezember 2001 erworben haben. Die Kläger behaupten Verletzungen des kalifornischen „Cartwright Act“ und des Wettbewerbsrechts sowie eine angeblich ungerechtfertigte Bereicherung und beantragen Schadensersatz in – unspezifizierter – dreifacher Höhe, Anwaltskosten und sonstige Kosten sowie eine Unterlassungsverfügung gegen das angeblich rechtswidrige Verhalten. Auf Antrag eines der Kläger entschied ein vom „Judicial Council of California“ benannter Richter, dass die zu jenem Zeitpunkt anhängigen Fälle an den „San Francisco County Superior Court“ übertragen werden sollten, um dort koordiniert und gemeinsam behandelt zu werden.

Rückstellungen für Rechtsverfahren werden dann gebildet, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine Verpflichtung entstanden ist und der entsprechende Betrag annähernd abgeschätzt werden kann. Die Gesellschaft hat deshalb eine Rückstellung in Höhe von €28 für das DOJ-Verfahren und die zivilen Wettbewerbsrechtsklagen gebildet und im Betriebsergebnis ausgewiesen. Sollten weitere Informationen darüber verfügbar werden, wird eine mögliche Verpflichtung erneut überprüft, und wenn notwendig, werden die Abschätzungen entsprechend angepasst. Bei zukünftigen neuen Entwicklungen in jeder Angelegenheit oder veränderten Umständen wird die Rückstellung angepasst, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kann.

Im April 2003 hat die Gesellschaft ein Auskunftsverlangen der Europäischen Kommission erhalten, das einer Prüfung dienen soll, ob die EU-Wettbewerbsregeln im Rahmen bestimmter Praktiken am europäischen Markt für DRAM-Speicherprodukte verletzt wurden. Die Gesellschaft unterstützt die Anfragen der Europäischen Kommission kooperativ. Die Gesellschaft kann den Ausgang dieses Verfahrens nicht vorhersagen.

Ein negativer Ausgang der Rambus-Klagen, des DOJ-Verfahrens, der Untersuchung der EU-Kommission oder der oben beschriebenen Zivilklagen im Zusammenhang mit angeblich wettbewerbswidrigem Verhalten würde erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Gesellschaft begründen und andere negative Auswirkungen haben, was wiederum einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf das Geschäft, die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kann. Unabhängig von der Richtigkeit der Vorwürfe oder des Erfolgs der genannten Klagen können der Gesellschaft erhebliche Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen die Vorwürfe oder mit deren gütlichen Erledigung entstehen, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kann.

Im Oktober 1999 unterrichtete die Deutsche Telekom AG („DT“) Infineon über eine mögliche vertragliche Inanspruchnahme aus Gewährleistungsverpflichtungen in Bezug auf Chiplieferungen für Telefonkarten. Der Anspruch bezieht sich auf einen angeblichen Schaden der DT, der bei unrechtmäßigem Aufladen bereits benutzter Telefonkarten entstanden sei. Die DT machte ursprünglich einen Verlust von circa €90 geltend, was den erlittenen Schaden und die Aufwendungen für Abwehrmaßnahmen umfasst, und verlangte Schadensersatz von Siemens und Infineon. Im September 2001 hat die DT aber nur gegen Siemens Klage eingereicht. Siemens hat der Gesellschaft den Streit verkündet, und Infineon ist dem Verfahren auf Seiten von Siemens beigetreten. DT stellte Schadensersatzforderungen von rund €125. Anfang 2003 hat die DTAG die Klage auf €150 erweitert. Am 15. Juli 2003 wies das Gericht die Klage vollumfänglich ab und entschied, dass DT in der Sache keine Ansprüche gegen Siemens und die Gesellschaft habe. DT hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Sollte Siemens haftbar gemacht werden, könnte Infineon im Rahmen bestimmter Garantien, die bei der Gründung von Infineon gegenüber Siemens abgegeben wurden, für den Schaden einstehen müssen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Ansprüche unbegründet sind. Infineon geht davon aus, dass in diesem Zusammenhang kein wesentlicher negativer Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entstehen wird.

Einer der Kunden der Gesellschaft hat uns am 18. Mai 2000 mitgeteilt, dass er einen Brief von Rambus erhalten habe, in dem behauptet wurde, dass eine Komponente eines seiner Produkte Rambus' Patente verletze. Die Gesellschaft hat diesem Kunden die betreffende Komponente geliefert und dieser Kunde hat von der Gesellschaft verlangt, dass sie ihn von allen Forderungen von Rambus freistelle. Die Benachrichtigung enthielt keinen Betrag für diese Forderung. Daher kann die Gesellschaft derzeit nicht vorhersagen, wie hoch das Risiko, wenn es überhaupt eines gibt, aus diesem Anspruch ist, wenn er begründet sein sollte.

Am 7. Mai 2003 erhob ProMOS gegen die Gesellschaft eine Schiedsklage in München nach den ICC-Schiedsregeln. Die Gesellschaft hatte ProMOS eine bestimmte DRAM-Technologie lizenziert, diesen Vertrag aber wegen schwer wiegenden Vertragsbruchs durch ProMOS gekündigt. ProMOS beantragt ein Feststellungsurteil, dass ProMOS den Lizenzvertrag wegen eines Vertragsbruchs durch die Gesellschaft hätte kündigen können, aber weiter berechtigt sei, die lizenzierte Technologie zu nutzen. ProMOS klagt außerdem auf Zahlung von ca. US-\$ 31 Mio. für DRAM-Produkte, die der Gesellschaft verkauft wurden. Die Gesellschaft bestreitet den behaupteten Vertragsbruch und hat vollständige Klageabweisung beantragt. Mit einer Widerklage beantragt die Gesellschaft Feststellung, dass sie zur Kündigung des Lizenzvertrages wegen eines erheblichen Vertragsbruchs durch ProMOS berechtigt war, dass ProMOS verpflichtet werde, die Nutzung der DRAM-Technologie der

Gesellschaft zu unterlassen und der Gesellschaft Schadensersatz für die missbräuchliche Nutzung ihrer DRAM-Technologie in Höhe von mehr als \$31 Mio. zustehe. Die Gesellschaft geht nicht davon aus, dass dieses Verfahren erhebliche negative Auswirkungen auf ihre Ertrags- oder Finanzlage haben wird.

Gegen Jahresende 2002 behauptete MOSAID Technologies Inc. USA, dass die Gesellschaft 11 DRAM-bezogene US-Patente von MOSAID verletze. Im Dezember 2002 reichte die Gesellschaft beim US-Bundesgericht für Nordkalifornien eine Klage mit dem Antrag ein, festzustellen, dass die Gesellschaft diese US-Patente nicht verletze. Am 7. Februar 2003 erhob MOSAID Widerklage mit dem Antrag, neben der Klageabweisung auch auf Schadensersatz für Patentverletzung zu erkennen. Am 3. November 2003 gab MOSAID bekannt, dass sie die Widerklage um zwei weitere Patente erweitert hat. Dieses Verfahren ist in einem frühen Stadium. Ein negativer Ausgang der Widerklage könnte erhebliche finanzielle Verpflichtungen und andere negative Effekte für die Gesellschaft haben, was wiederum einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben kann.

Im Zusammenhang mit ihrer regelmäßigen Geschäftstätigkeit kann die Gesellschaft bei bestimmten Umsätzen und anderen Verträgen verpflichtet sein, ihre Vertragspartner unter bestimmten Konditionen vom Schadensersatz bei Gewährleistungsfällen, Patentverletzungen und anderen Vorfällen freizustellen. Der Höchstbetrag von eventuellen zukünftigen Zahlungen für diese Art von Vereinbarungen kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden, da die eventuelle Verpflichtung von Vorkommnissen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit nicht bestimmbar ist, und von bestimmten vertragspezifischen Fakten und Umständen abhängig ist. Historisch gesehen, hatten Zahlungen für diese Art von Vereinbarungen keinen materiellen Effekt auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Zum 30. September 2003 hat die Gesellschaft eine Rückstellung (nach Abzug der erwarteten Versicherungsdeckungsleistung) für einen Produktgewährleistungsfall gebildet und ergebniswirksam in den beiliegenden Finanzdaten bilanziert. Die Gesellschaft geht auf der Grundlage der ihr derzeit vorliegenden Informationen davon aus, dass die Rückstellung das bestehende Risiko angemessen abdeckt.

Gegen die Gesellschaft laufen verschiedene andere Rechtsstreite und Verfahren im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit. Diese betreffen Produkte, Leistungen, Patente und andere Sachverhalte. Hierfür werden Rückstellungen für Prozesskosten gebildet, sobald die mögliche Verpflichtung dem Grunde nach wahrscheinlich und in der Höhe hinreichend genau bestimmbar ist. Das Management der Gesellschaft ist nach derzeitigem Kenntnisstand der Auffassung, dass aus dem Aus-

gang der anhängigen Verfahren kein wesentlicher negativer Einfluss auf die Vermögenslage zu erwarten ist. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Zukunft liegenden Verfahrensschlüsse die Finanz- und Ertragslage wesentlich negativ beeinflussen können.

Im Rahmen der Gründung der Gesellschaft verblieben bei Siemens bestimmte Betriebsstätten in den USA sowie die damit zusammenhängenden Umweltaltlasten. Die von Siemens bei der Gründung der Gesellschaft eingebrachten Geschäfte haben in der Vergangenheit einige dieser Betriebsstätten genutzt. Auf Grund der US-amerikanischen Rechtsprechung könnte die Gesellschaft für die Beseitigung von Umweltaltlasten in Anspruch genommen werden, obwohl diese

Betriebsstätten bei Siemens verblieben sind. Siemens hat gegenüber bestimmten nicht zum Konzern gehörenden Gesellschaften sowie Behörden Garantien abgegeben. Alle beteiligten Parteien sehen die Verantwortung für die betreffenden Standorte bei Siemens. Bislang wurden keine Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht. Die Höhe eventueller Ansprüche aus der Beseitigung von Altlasten, sofern solche bestehen, wurde nicht ermittelt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihr Risiko zur Entsorgung der Altlasten der bei Siemens verbliebenen Betriebsstätten in den USA gering ist.

Vertragliche Verpflichtungen

Die Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Dritten zum 30. September 2003 sind wie folgt^{1,2,3}:

	Zahlungen fällig in						5 Jahren und länger
	Gesamt	Weniger als 1 Jahr	1–2 Jahren	2–3 Jahren	3–4 Jahren	4–5 Jahren	
Vertragliche Verpflichtungen:							
Zahlungen aus Leasingverträgen	391	82	76	68	46	44	75
Unbedingte Abnahmeverpflichtungen	1.062	420	206	121	68	55	192
Andere langfristige Verpflichtungen	636	334	227	75	–	–	–
Summe vertraglicher Verbindlichkeiten	2.089	836	509	264	114	99	267

1 Die Umrechnung von US-Dollar in Euro erfolgt mit dem Wechselkurs €1 = US-\$1,165, dem Mittagskurs vom 30. September 2003.

2 Oben stehende Tabelle enthält gewisse Rückzahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen, und solche, deren wahrscheinliche Fälligkeiten im jeweiligen Fall vom Management geschätzt wurden. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.

3 Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2003 nicht quantifizierbar sind. Die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betragen €486 im Geschäftsjahr 2003.

In vorheriger Tabelle ist enthalten:

■ In den nächsten zwei Jahren, bis zum 30. September 2005, muss die Gesellschaft das Gemeinschaftsunternehmen Inotera mit US-\$ 458 finanzieren.

■ Finanzierungszusagen in Höhe von US-\$ 242 sind im Zusammenhang mit dem Bau einer Backend-Fertigungsstätte in China gemacht worden.

Im Dezember 2002 haben die Gesellschaft und Semiconductor Manufacturing Industrial Corporation („SMIC“) eine Technologieübertragungs- und Kapazitätsreservierungsvereinbarung getroffen. Im Austausch für die Technologieübertragung wird SMIC für einen Zeitraum von fünf Jahren spezifische Produktionskapazitäten bereitstellen. Die Preise basieren auf einer Marktpreisformel.

Am 28. Juli 2003 vereinbarten die Gesellschaft und China-Singapore Suzhou Industrial Park Venture Company („CSVC“) die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Bau einer Backend-Fertigungsstätte in China. Das von CSVC investierte Kapital wird verzinst und hat im Falle einer Gesellschaftsauflösung einen bestimmten Rangvortritt. Alle aufgelaufenen Ergebnisse und Dividenden stehen der Gesellschaft zu. Die Gesellschaft wird deshalb von Beginn an voll konsolidiert.

Die Gesellschaft ist mit verschiedenen verbundenen Unternehmen und externen Zulieferern Vereinbarungen eingegangen, die der Gesellschaft Kapazitäten zur Produktion und zum Testen von Halbleiterprodukten garantieren. Diese verlängerbaren Vereinbarungen besitzen grundsätzlich eine Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Gesellschaft hat darin vereinbart, einen Teil von deren Produktion zu Marktpreisen zu kaufen.

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2003 änderten die Gesellschaft und IBM die Aktionärsvereinbarung von ihrem ALTIS-Semiconductor-Joint-Venture (ALTIS). Entsprechend wird die Gesellschaft ihre Produktionskapazitäten in den Kalenderjahren 2004 bis 2007 von derzeit 50% auf 100% erhöhen. IBM und die Gesellschaft haben vereinbart, über das zukünftige Geschäftsmodell von ALTIS vor dem 1. Januar 2007 eine Entscheidung zu treffen. Zusätzlich gewährt die geänderte Vereinbarung Infineon eine Option auf den Erwerb des IBM-Anteils an ALTIS bis einschließlich 1. Juli 2007.

Im Mai 2002 schloss die Gesellschaft eine Lizenz- und Produktabnahmevereinbarung mit Winbond Electronics Corp. („Winbond“). Gemäß den Bedingungen der Lizenzvereinbarung hat die Gesellschaft Know-how über spezielle DRAM-Technologien im Geschäftsjahr 2003 an Winbond übertragen. Die Lizenzvereinbarung sieht innerhalb ihrer Laufzeit von fünf Jahren auch die Zahlung von Lizenzgebühren für bestimmte Produkte vor, die seitens Winbond an Dritte verkauft werden. Die Lizenzgebühren werden abgegrenzt und über die Laufzeit des Produktabnahmevertrags linear erfolgswirksam vereinnahmt. Nach diesem Vertrag wird die Gesellschaft auch bestimmte Mengen von DRAM-Produkten

zu Preisen, welche teilweise auf Marktpreisen basieren, abnehmen. Außerdem wird die Gesellschaft über die Laufzeit der Vereinbarung die Verantwortung für die Belieferung eines wesentlichen Kunden von Winbond mit DRAM-Produkten übernehmen.

Bezüge aus diesen Vereinbarungen werden entsprechend dem üblichen Geschäftsverlauf als Aufwendungen erfasst. Um der Nachfrage seitens ihrer Kunden nach ihren Produkten entsprechen zu können, überprüft die Gesellschaft regelmäßig den voraussichtlichen Einkaufsbedarf. Die Einkaufsverträge werden regelmäßig auf drohende Verluste überprüft, die eintreten können, falls die voraussichtlichen Bedarfsmengen unter die Bestellmengen bzw. die Marktpreise unter die Vertragspreise fallen. ALTIS und Winbond sind ein wichtiger Teil im Produktbeschaffungsprozess der Gesellschaft.

Eventualverbindlichkeiten

Die folgende Tabelle zeigt die Eventualverpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Dritten zum 30. September 2003, ohne mögliche Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten¹²:

	Ende der Verpflichtungsdauer in						5 Jahren und länger
	Gesamt	Weniger als 1 Jahr	1–2 Jahren	2–3 Jahren	3–4 Jahren	4–5 Jahren	
Eventualverpflichtungen:							
Garantien ³	380	24	–	–	283	14	59
Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand ⁴	357	21	–	35	16	240	45
Summe der Eventualverpflichtungen	737	45	–	35	299	254	104

¹ Die Umrechnung von US-Dollar in Euro erfolgt mit dem Wechselkurs €1 = US-\$ 1,165, dem Mittagskurs vom 30. September 2003.

² Oben stehende Tabelle enthält gewisse Rückzahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen, und solche, deren wahrscheinliche Fälligkeiten im jeweiligen Fall vom Management geschätzt wurden. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.

³ Garantien für Konzerngesellschaften in Höhe von € 2.333 sind darin nicht enthalten, da sie auf Grund der Konsolidierung in den Verbindlichkeiten der Konzernfinanzdaten enthalten sind.

⁴ Bedingte Zuwendungen der öffentlichen Hand beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in Zusammenhang mit der Errichtung und Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten stehen und nicht anderweitig garantiert sind und gegebenenfalls zurückerstattet werden müssen, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden.

Die Gesellschaft hat Zuwendungen der öffentlichen Hand für den Bau und die Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten erhalten. Diese Beträge werden bei Erreichen definierter Kriterien erfolgswirksam vereinnahmt. Die Gesellschaft hat bestimmte Zuwendungen erhalten unter der Voraussetzung, dass bestimmte projektbezogene Kriterien inner-

halb einer bestimmten Periode nach Erhalt der Zuwendung erfüllt werden. Die Gesellschaft ist verpflichtet, diese Bedingungen zu erfüllen. Sollten jedoch die Anforderungen der Projekte nicht erfüllt werden, können zum Stichtag 30. September 2003 bis zu €357 der Zuwendungen zurückgefordert werden.

Im Juli 2003 kündigte die Europäische Kommission eine Ermittlung an, die die Rechtmäßigkeit staatlicher Subventionen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Fertigungsstätte in Portugal überprüft. Diese Zuwendungen haben eine Höhe von €77 und wurden von Infineon noch nicht vereinnahmt. Es wird überprüft, ob diese staatlichen Zuwendungen mit den Richtlinien der Europäischen Kommission übereinstimmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung der Gewährleistungsrückstellungen im Geschäftsjahr 2003:

	2003
Stand Gewährleistungsrückstellungen zum 1. Oktober 2002	77
Zugänge zu bestehenden Gewährleistungsrückstellungen	7
Neue Gewährleistungsrückstellungen	89
Auszahlungen für Gewährleistungen	-34
Stand Gewährleistungsrückstellungen zum 30. September 2003	139

Die Gesellschaft als Mutterunternehmen hat wie allgemein üblich in bestimmten Fällen Garantien für bestimmte Verpflichtungen ihrer konsolidierten Tochterunternehmen gegenüber Dritten übernommen. Diese Verpflichtungen sind in den konsolidierten Finanzdaten durch die Konsolidierung bereits enthalten. Zum 30. September 2003 betragen solche Intercompany-Garantien in Verbindung mit Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten von konsolidierten Tochterunternehmen €2.333, wovon €1.700 die Wandelschuldverschreibungen betreffen.

32. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Gesellschaft berichtet über ihre Geschäftsbereiche und nach Regionen gemäß den Regelungen des SFAS Nr. 131, ANGABEN ZU DEN SEGMENTEN EINES UNTERNEHMENS UND DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHENDE INFORMATIONEN.

Zum 1. Oktober 2002 organisierte die Gesellschaft einige ihrer Geschäftsbereiche neu, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. Zusätzlich beschloss die Gesellschaft die Zusammenlegung der Geschäftsbereiche Mobile Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs zu einem Geschäftsbereich unter dem Namen Sichere Mobile Lösungen und wird die Zusammenlegung als solche mit Wirkung vom 1. Oktober 2002 berichten. Die Ergebnisse des Opto-Elektronik-Geschäfts werden als aufgegebenes Geschäft für alle dargestellten Perioden berichtet. Die Ergebnisanteile der konzernfremden Gesellschafter sind jetzt im EBIT der Gesellschaft enthalten. Die Bereichsergebnisse der Jahre 2001 und 2002 wurden

demgemäß umgestellt, sodass sie der neuen Berichts- und Darstellungsstruktur des Geschäftsjahrs entsprechen und um die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen Ergebniszahlen zu ermöglichen.

Die Gesellschaft ist schwerpunktmäßig in vier Geschäftsbereichen tätig. Drei von ihnen sind anwendungsorientiert: Drahtgebundene Kommunikation, Sichere Mobile Lösungen und Automobil- und Industrie-elektronik. Der Geschäftsbereich Speicherprodukte ist produktorientiert. Ferner entsprechen einige der verbleibenden Aktivitäten aus verkauften Geschäften und neue Geschäftsaktivitäten der Definition gemäß SFAS Nr. 131 für ein Segment, erreichen aber nicht die Berichterstattungskriterien gemäß SFAS Nr. 131. Deshalb wurden für Berichterstattungszwecke diese Bereiche unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ zusammengefasst.

Jedes dieser Segmente wird von einem Bereichsleiter geführt, der direkt dem Chief Operating Officer und dem Finanzvorstand berichtet. Diese als Chief Operating Decision Makers („CODM“) bezeichneten tragen gemeinsam die Entscheidungsverantwortung für das laufende Geschäft. Sie entscheiden gemeinsam über die Ressourcenzuordnung auf die Geschäftsbereiche und beurteilen deren Erfolg anhand der Kennzahlen Umsatzerlöse und EBIT. Die Aktiva der Gesellschaft werden den Geschäftsbereichen nicht in einer regelmäßigen Berichterstattung zugerechnet, mit Ausnahme von bestimmten Vorratsinformationen, die den CODM regelmäßig auf Segmentbasis berichtet werden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für die Geschäftsbereiche entsprechen grundsätzlich den bereits erläuterten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen der Gesellschaft (siehe Anhang Nr. 2). Das Anlagevermögen wird für Management-Berichterstattungszwecke nicht regelmäßig in den einzelnen Geschäftsbereichen zugeordnet, und sie werden demzufolge nicht zugerechnet. Die Gesellschaft ordnet den einzelnen Geschäftsbereichen die Abschreibungen nach Maßgabe des Produktionsvolumens und der erzeugten Produkte auf Basis von Standardkosten zu, sodass das EBIT je Geschäftsbereich ermittelt werden kann.

Informationen zu den Geschäftsbereichen:

■ Drahtgebundene Kommunikation

Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Glasfaserbauteile für ein breites Anwendungsspektrum von Breitband-Kommunikationsanwendungen und Anwendungen mit geringen Übertragungsraten in den Bereichen WAN (Wide Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) und Access (sowohl Breitband als auch traditionelle Zugänge) des drahtgebundenen Kommunikationsmarkts.

■ Sichere Mobile Lösungen

Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt ein breites Spektrum von Bauelementen für drahtlose Anwendungen, Sicherheitskontrollbauelemente, Sicherheits-speicherbauelemente und andere Halbleiterprodukte sowie komplette Systemlösungen für Sicherheits- und drahtlose Anwendungen.

■ Automobil- und Industrieelektronik

Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systemlösungen zur Verwendung in der Automobilindustrie und für industrielle Anwendungen.

■ Speicherprodukte

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiter-Speicherprodukte in verschiedenen Gehäusen und optionalen Konfigurationen mit verschiedenen Leistungsparametern für den Einsatz in Standard-, speziellen und eingebetteten Speicheranwendungen.

■ Sonstige Geschäftsbereiche

Bestimmte verbleibende Aktivitäten von veräußerten Geschäften und andere sonstige Geschäftsaktivitäten sind in „Sonstige Geschäftsbereiche“ enthalten.

Die folgende Darstellung zeigt ausgewählte Segmentdaten für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003:

	2001	2002	2003
Umsatzerlöse:			
Drahtgebundene Kommunikation	766	386	459
Sichere Mobile Lösungen	1.522	1.278	1.645
Automobil- und Industrieelektronik	1.153	1.201	1.392
Speicherprodukte	1.614	1.861	2.485
Sonstige Geschäftsbereiche	236	117	139
Konzernfunktionen	56	47	32
Summe Umsatzerlöse	5.347	4.890	6.152

	2001	2002	2003
EBIT:			
Drahtgebundene Kommunikation	-93	-245	-188
Sichere Mobile Lösungen	-142	-116	-64
Automobil- und Industrieelektronik	143	111	186
Speicherprodukte	-938	-630	31
Sonstige Geschäftsbereiche	192	9	-49
Konzernfunktionen	-180	-264	-215
Summe EBIT	-1.018	-1.135	-299

	2001	2002	2003
Abschreibungen:			
Drahtgebundene Kommunikation	98	97	61
Sichere Mobile Lösungen	226	303	327
Automobil- und Industrieelektronik	186	226	246
Speicherprodukte	589	709	768
Sonstige Geschäftsbereiche	22	35	35
Konzernfunktionen	-	-	-
Summe Abschreibungen	1.121	1.370	1.437

	2001	2002	2003
Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften:			
Drahtgebundene Kommunikation	-	-	-2
Sichere Mobile Lösungen	-	-	-2
Automobil- und Industrieelektronik	-	-	-
Speicherprodukte	12	-56	22
Sonstige Geschäftsbereiche	-3	-1	-1
Konzernfunktionen	12	10	1
Summe Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften	21	-47	18

	2001	2002	2003
Vorräte:			
Drahtgebundene Kommunikation	101	62	59
Sichere Mobile Lösungen	179	188	160
Automobil- und Industrieelektronik	181	162	194
Speicherprodukte	270	360	452
Sonstige Geschäftsbereiche	41	21	21
Konzernfunktionen	110	98	73
Summe Vorräte	882	891	959

Zum 30. September 2003 verteilte sich der Geschäfts- und Firmenwert wie folgt auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

	2003
Geschäfts- und Firmenwert:	
Drahtgebundene Kommunikation	98
Sichere Mobile Lösungen	2
Automobil- und Industrieelektronik	22
Speicherprodukte	90
Sonstige Geschäftsbereiche	6
Konzernfunktionen	–
Summe Geschäfts- und Firmenwert	218

Zwischen den Geschäftsbereichen werden auf Grund ihrer spezifischen Anwendungen und der produktbezogenen Eigenarten keine Umsätze getätigt. Dementsprechend resultieren die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche aus Umsätzen mit Dritten.

Die Vorprodukte und unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Logik-Frontend-Fabriken sowie die unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Backend-Fabriken stehen nicht unter der Kontrolle und Verantwortung der zuständigen Bereichsleiter, sondern unter der des Standortmanagements, welches für die Umsetzung des Produktionsplans nach Mengen und Einheiten verantwortlich ist. Deshalb werden diese Vorräte in der Zeile „Konzernfunktionen“ ausgewiesen und nicht unter den einzelnen Geschäftsbereichen. Lediglich die Vorprodukte der Backend-Fabriken (Chipbestände) und Fertigprodukte sind den Geschäftsbereichen zugeordnet und in den Segmentinformationen, welche an die verantwortlichen CODM berichtet werden, enthalten.

Bestimmte Posten sind in den Konzernfunktionen enthalten und werden nicht auf die Segmente umgelegt. Dies gilt für bestimmte Kosten der Konzernzentrale, bestimmte Inkubatorkosten und Aufwendungen für Grundlagenforschung, Einmalgewinne und spezielle strategische Technologieinitiativen. Rechtskosten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum werden bei den Segmenten zum Zeitpunkt der Ausgabewirksamkeit gezeigt. Dies kann sich unterscheiden vom Zeitpunkt des Aufwands, wann er in den Konzernfunktionen gezeigt wird. Die Gesellschaft ordnet Leerkosten auf Basis eines Fremdfertigermodells zu, wobei die Vorlaufzeit der Auftragsstornierung oder -änderung bei der Leerkostenzuordnung berücksichtigt wird. Alle nicht verrechneten Leerkosten werden in Konzernfunktionen gezeigt. Wesentliche Positionen in den Konzernfunktionen für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003 sind wie folgt:

	2001	2002	2003
Konzernfunktionen:			
Nicht zugeordnete Leerkosten	27	211	101
Restrukturierungsaufwendungen	117	16	29
Zentrale IT-Entwicklungskosten	71	36	13
Andere	–35	1	72
Summe Konzernfunktionen	180	264	215

Es folgt eine Übersicht zu der Geschäftstätigkeit nach Regionen für die Geschäftsjahre 2001, 2002 und 2003:

	2001	2002	2003
Umsatzerlöse:			
Deutschland	1.636	1.266	1.535
Übriges Europa	1.172	943	1.112
Nordamerika	1.208	1.158	1.393
Asien-Pazifik	1.247	1.446	2.077
Andere	84	77	35
Summe Umsatzerlöse	5.347	4.890	6.152

	2001	2002	2003
Langfristig gebundenes Vermögen:			
Deutschland	3.454	3.113	2.628
Übriges Europa	1.006	1.172	936
Nordamerika	1.551	1.211	785
Asien-Pazifik	350	374	377
Andere	8	–	1
Summe Langfristig gebundenes Vermögen	6.369	5.870	4.727

Der Ausweis des Umsatzes (mit Dritten) richtet sich nach dem Sitz des Rechnungsempfängers. Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind den Regionen zugeordnet, in denen sie sich befinden. Sachanlagen, Finanzanlagen und sonstige nicht kurzfristige Vermögensgegenstände bilden die langfristigen gebundenen Vermögensgegenstände. Die Anzahl der Beschäftigten wird im Anhang Nr. 7 regional dargestellt.

Mit Ausnahme von Verkäufen an Siemens, die in Anhang Nr. 27 erläutert sind, entfielen in den Geschäftsjahren 2001, 2002 und 2003 auf keinen Einzelkunden mehr als 10% der Gesamtumsatzerlöse. Die Umsatzerlöse mit Siemens resultieren insbesondere aus den Nichtspeicher-Geschäftsbereichen.

EBIT ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das Management der Gesellschaft nutzt unter anderem das EBIT als Kennzahl für Budget- und operative Zielvorgaben, um seine Geschäfte zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Die Gesellschaft berichtet EBIT-Daten, um Investoren nützliche Informationen über den operativen Geschäftserfolg der Gesellschaft und im Speziellen über die einzelnen Segmente zur Verfügung zu stellen. Das EBIT wird ohne Anpassung der US-GAAP-Werte wie folgt aus den Gewinn- und Verlust-Rechnungen hergeleitet:

	Geschäftsjahr zum 30. September		
	2001	2002	2003
Konzernfehlbetrag von fortgeführten Geschäften	-592	-1.017	-435
Bereinigt um: Erträge/ Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-427	-143	84
Zinsaufwand	1	25	52
EBIT	-1.018	-1.135	-299

33. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Am 8. Oktober 2003 hat die Gesellschaft die Vereinbarung über den Erwerb von Vermögensgegenständen und die Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten des Protocol-Software-Geschäfts von Siemens für €13 und die Übernahme von rund 145 Software-Ingenieuren auf dem Gebiet der mobilen Kommunikation bekannt gegeben. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Lizenz- und einen Entwicklungsleistungsvertrag mit Siemens abgeschlossen und änderte ihren Produktliefervertrag mit Siemens. Die endgültige Umsetzung dieser Transaktion hängt von einer Vielzahl von Bedingungen ab.

Im Zusammenhang mit der fortgeführten Restrukturierung der Gesellschaft wurde mit Electronic Data Services (EDS) die Auslagerung von Teilen der weltweiten Personalbetreuung vereinbart. Der Umfang der Vereinbarung wird derzeit noch verhandelt und enthält den Übergang einiger Mitarbeiter der Gesellschaft zu EDS. Die Vereinbarung enthält bestimmte Kündigungsklauseln.

ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN

Ergänzende Erläuterungen für den nach US-GAAP aufgestellten Anhang zum Konzernabschluss entsprechend den Anforderungen nach § 292a HGB

Die Gesellschaft hat für das zum 30. September 2003 beendete Geschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsgesetzbuch aufgestellt. Sie hat sich dabei gemäß den handelsrechtlichen Regelungen dafür entschieden, über den Konzernabschluss auf der Grundlage der international anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze („US-GAAP“) zu berichten. Die Berichterstattung nach dem deutschen Handelsrecht umfasst neben dem Konzernabschluss nach US-GAAP zusätzliche Angaben sowie den Konzernlagebericht.

Hinweis für den Geschäftsbericht

Der Konzernabschluss nach deutschem Handelsrecht und der Konzernlagebericht unterliegen deutschen Prüfungsvorschriften. Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat hierzu einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister München unter der Nummer HRB 126492 hinterlegt oder kann in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.

Wesentliche Unterschiede zwischen deutscher und US-Rechnungslegung

■ Vorbemerkung

Die Gesellschaft muss als deutsches Mutterunternehmen grundsätzlich einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufstellen. § 292a HGB befreit jedoch von dieser Pflicht, wenn ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt und offen gelegt wird (wie z. B. US-GAAP). Die Gesellschaft stellt den Konzernabschluss nach US-GAAP auf. Im Folgenden werden die von den deutschen Rechnungslegungsvorschriften abweichenden Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden erläutert.

■ Grundsätzliche Unterschiede

Die Rechnungslegung nach US-GAAP unterscheidet sich von der nach dem deutschen HGB hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Während US-GAAP den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen für die Investoren legt, ist die HGB-Rechnungslegung von einer stärkeren Betonung des Gläubigerschutzes und Vorsichtsprinzips geprägt. Weiterhin sind Gesellschaften mit einer Börsennotierung in den USA verpflichtet, den Bilanzierungs- und Berichterstattungsanforderungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) zu entsprechen.

■ Gliederungsvorschriften

Die Bilanzgliederung nach US-GAAP orientiert sich an der geplanten Liquidation der Vermögensgegenstände und der Fristigkeit der Schulden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Bilanzgliederung für deutsche handelsrechtliche Zwecke ist für Kapitalgesellschaften grundsätzlich in § 266 HGB definiert. Die Gliederung orientiert sich hier an der geplanten Verweildauer von Vermögensgegenständen bzw. Finanzierungsquellen wie Schulden und Eigenkapital im Unternehmen.

■ Umsatzrealisierung

Die Umsatzrealisierung erfolgt nach HGB und US-GAAP grundsätzlich nach gleichen Grundsätzen, sofern die Leistung erbracht und die Zahlung erfolgt ist. Unterschiede können bezüglich des Zeitpunkts der Vereinnahmung auftreten, wenn die leistende Gesellschaft weitere finanzielle, operative oder leistungsbezogene Verpflichtungen gegenüber der leistungsempfangenden Gesellschaft übernommen hat oder die vereinbarten Beträge nicht hinreichend objektivierbar sind.

■ Marktgängige Wertpapiere

Marktgängige Wertpapiere, die Anteils- oder Gläubigerrechte verbrieften, sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind nach US-GAAP als Available-for-Sale-Securities zu klassifizieren und zum Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die Wertsteigerungen oder Wertminderungen dieser Wertpapiere werden, nach Berücksichtigung latenter Steuern, ergebnisneutral im Eigenkapital unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst.

■ Vorräte

Die Vorräte sind nach HGB ebenso wie nach US-GAAP mit den Herstellungskosten zu bewerten. Die Herstellungskosten nach US-GAAP werden als produktionsbezogene Vollkosten definiert, bei denen neben den Material- und Lohneinzelkosten sowie den Sondereinzelkosten der Fertigung die Material- und Fertigungsgemeinkosten einzubeziehen sind. Zudem sind Verwaltungskosten zu berücksichtigen, sofern sie in eindeutigem Zusammenhang mit der Erzeugung der zu bewertenden Produkte stehen. Nach HGB brauchen von den oben genannten Kosten Teile der indirekten Kosten wie z. B. Verwaltungskosten nicht in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen zu werden.

■ Geschäfts- und Firmenwert

Unter US-GAAP ist gemäß SFAS Nr. 141, Kapitalkonsolidierung, in Verbindung mit SFAS Nr. 142, Geschäfts- und Firmenwerte und andere immaterielle Vermögensgegenstände, der Geschäfts- und Firmenwert

bei Kapitalkonsolidierungen unter Anwendung der Erwerbsmethode nach dem 30. Juni 2001 nicht mehr länger abzuschreiben, sondern jährlich auf Werthaltigkeit zu überprüfen. Unter HGB ist der Firmen- oder Geschäftswert über den Zeitraum der zu erwartenden Lebensdauer abzuschreiben.

■ Nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte bei Beteiligungserwerben

Aufwendungen, die bei erworbenen Unternehmen für nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte entstanden sind, werden nach HGB nicht separat ermittelt, sondern als Bestandteil des Geschäfts- und Firmenwerts ausgewiesen. Nach US-GAAP werden diese Kosten zum Anschaffungszeitpunkt gesondert ermittelt und als Aufwand erfasst.

■ Derivative Finanzinstrumente

Nach HGB werden derivative Finanzinstrumente grundsätzlich nicht bilanziert. Dies bedeutet, dass Wertsteigerungen nicht zu berücksichtigen sind. Für Wertminderungen, die nicht realisierte Verluste darstellen, sind dagegen Rückstellungen zu bilden. Nach US-GAAP sind derivative Finanzinstrumente in der Bilanz mit ihrem Marktwert anzusetzen. Die Marktwertänderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung oder unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst. Dies ist einerseits abhängig davon, ob die derivativen Finanzinstrumente Bestandteil eines Sicherungsgeschäfts sind, und andererseits von der Art des Sicherungsgeschäfts.

■ Latente Steuern

Der wesentliche Unterschied in der Bilanzierung latenter Steuern zwischen HGB und US-GAAP ist, dass bislang nach den Vorschriften des HGB keine latenten Steuern auf Verluste aktiviert werden. Nach US-GAAP sind latente Steuern auf Verluste (inklusive Verlustvorträge) zu berücksichtigen. Auf aktive latente Steuern, deren Realisierung eher unwahrscheinlich ist, sind Wertberichtigungen vorzunehmen.

■ Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Nach US-GAAP sind Pensionsrückstellungen unter Berücksichtigung für die Zukunft zu erwartender Entgeltentwicklungen nach dem Anwartschaftsbarwert-Verfahren zu bewerten. Diese Methode ist auch nach dem HGB zulässig. Auf Grund der Übertragung der treuhänderischen Verwaltung von Pensionsfondsanteilen an einen Pension-Trust-Verein wurden nach US-GAAP die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen nicht mehr bei der Gesellschaft bilanziert. Nach HGB sind die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen trotz der Übertragung auf den Pension-Trust-Verein weiterhin bei der Gesellschaft zu bilanzieren.

■ Aktienoptionsprogramm

Für die gewährten Aktienoptionen werden nach HGB Rückstellungen gebildet, sofern der Marktwert zum Bilanzstichtag über dem Ausübungspreis für die Optionsrechte liegt. Nach US-GAAP bilanziert die Gesellschaft die gewährten Aktienoptionen nach der Inneren-Wert-Methode entsprechend APB Opinion 25, Bilanzierung von Aktienoptionen für Mitarbeiter, die nicht zu einer Aufwandserfassung führt, wenn der Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt der Ausgabe der Option nicht deren Ausübungspreis übersteigt.

■ Kosten für Kapitalerhöhungen

Nach HGB wurden Aufwendungen im direkten Zusammenhang mit dem Börsengang als Aufwendungen erfasst. Nach US-GAAP wurden diese Aufwendungen mit der Kapitalrücklage verrechnet.

■ Rückstellungen

Nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften dürfen Aufwandsrückstellungen in bestimmten Fällen auch ohne Verpflichtung gegenüber Dritten gebildet werden. Nach US-GAAP sind Rückstellungen nur bei gegenüber Dritten bestehenden Verpflichtungen und darüber hinaus nur für eng eingegrenzte Tatbestände zu bilden.

■ Fremdwährungsumrechnung

Nach HGB werden Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit dem Währungskurs zum Zeitpunkt der Erfassung des Geschäftsvorfalles bzw. jeweils zum ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet, wobei hieraus resultierende nicht realisierte Verluste in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasst werden. Nach US-GAAP erfolgt die Bewertung der Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten zum Fremdwährungskurs des Bilanzstichtags, wobei die daraus ermittelten nicht realisierten Gewinne und Verluste in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasst werden.

■ Zuwendungen der öffentlichen Hand

Nach HGB dürfen Investitionszulagen und Zinszuschüsse im Geschäftsjahr des Zuflusses erfolgswirksam vereinnahmt werden. Nach US-GAAP wurden diese Zuwendungen abgegrenzt und über den Zeitraum der Verrechnung der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen erfolgswirksam vereinnahmt.

■ Anteiliges Jahresergebnis von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Nach HGB dürfen die anteiligen Ergebnisse der assoziierten Unternehmen, basierend auf den nach den jeweiligen landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Ergebnissen, vereinnahmt werden. Unter US-GAAP werden die nach US-GAAP ermittelten Ergebnisse der assoziierten Unternehmen anteilig vereinnahmt.

■ Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen

Nach HGB dürfen Wertsteigerungen des anteiligen Eigenkapitals durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen erfolgswirksam erfasst werden. Nach US-GAAP und SEC-Rechnungslegungsvorschriften hängt eine solche erfolgswirksame Vereinnahmung von der Erfüllung weiterer Kriterien neben der Durchführung der Kapitalerhöhung ab. Sofern diese Kriterien nicht erfüllt sind, ist die Werterhöhung des anteiligen Eigenkapitals erfolgsneutral in die Kapitalrücklage einzustellen.

Anwendung von Befreiungsvorschriften

Nach § 264a HGB haben offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen keiner der Gesellschafter eine natürliche Person oder eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesellschafter ist, einen Jahresabschluss nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften aufzustellen. Die Gesellschaft hat die in § 264b HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

■ COMNEON GmbH & Co. OHG, Nürnberg,

■ Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden,

■ Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG, Dresden (ehemals Ingentix GmbH & Co. KG),

■ Infineon Technologies Immobilien Regensburg GmbH & Co. KG, Regensburg,

■ Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG, Dresden,

in Anspruch genommen, da diese Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen sind.

Die Gesellschaft hat die in § 264 Abs. 3 HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

■ Infineon Technologies Ventures GmbH, München,

in Anspruch genommen, da zwischen der Gesellschaft und der Infineon Technologies Ventures GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

Angabe gemäß §160 Nr. 8 AktG

Der Siemens Pension-Trust e.V., München, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 13. Dezember 2002 mitgeteilt, dass er am 2. Dezember 2002 die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe der von ihm gehaltenen Stimmrechte betrage damit 9,76%. Dies entspreche Stück 70.332.270 Infineon-Aktien, die eine gleiche Zahl von Stimmrechten vermittelten.

Der Siemens Pension-Trust e.V., München, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 20. März 2003, eingegangen am 24. März 2003, mitgeteilt, dass er am 18. März 2003 die Schwelle von 5% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe des Stimmrechtsanteils betrage nunmehr 0,00%. Ihm gehörten 0 Aktien, die eine gleiche Zahl von Stimmrechten vermittelten.

Die Fidelity Management & Research Company, 82 Devonshire Street, Boston, USA, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 5. Mai 2003, eingegangen am 8. Mai 2003, mitgeteilt, dass

- a) der Stimmrechtsanteil der Fidelity Management & Research Company, USA, an der Infineon Technologies AG am 30. April 2003 die Schwelle von 5% überschritten habe und nun 5,08% betrage. Die Stimmrechte würden der Fidelity Management & Research Company gem. § 22 (1) 1 Nr. 6 Wertpapierhandelsgesetz („WpHG“) zugerechnet,
- b) der Stimmrechtsanteil der FMR Corp., 82 Devonshire Street, Boston, MA 02109, USA, an der Infineon Technologies AG am 30. April 2003 die Schwelle von 5% überschritten habe und nun 5,08% betrage. Die Stimmrechte würden der FMR Corp. gem. § 22 (1) 2 i.V.m. § 22 (1) 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Die Fidelity Management & Research Company, 82 Devonshire Street, Boston, USA, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 11. August 2003, eingegangen am 29. August 2003, mitgeteilt, dass

- a) die Stimmrechtsanteile der Fidelity Management & Research Company, 82 Devonshire Street, Boston, USA, an der Infineon Technologies AG am 5. August 2003 die Schwelle von 5% unterschritten hätten und 4,98% betrügen. Diese Stimmrechtsanteile würden entsprechend § 22 Abs. 1 (2) des WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 (1), Nr. 6 WpHG der Fidelity Management & Research Company zugeschrieben,
- b) die Stimmrechtsanteile der FMR Corp., 82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts, USA, an der Infineon Technologies AG am 5. August 2003 die Schwelle von 5% unterschritten hätten und 4,98% betrügen. Diese Stimmrechtsanteile würden entsprechend § 22 Abs. 1 (2) WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 (1), Nr. 6 WpHG der FMR Corp. zugeschrieben.

Angaben nach Ziffer 6.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex

1. Am 30. Januar 2003 hat Herr Max Dietrich Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats, 5.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von €6,59 je Aktie erworben.
2. Am 17. Februar 2003 hat Herr Dr. Ulrich Schumacher, Vorsitzender des Vorstands, 10.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von €6,10 je Aktie erworben.
3. Am 25. Februar 2003 hat Herr Dr. Sönke Mehrgardt, damals Mitglied des Vorstands, 25.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von €6,00 je Aktie erworben.
4. Am 10. September 2003 hat Herr Dr. h. c. Martin Kohlhaussen, Mitglied des Aufsichtsrats, 5.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von €13,33 je Aktie erworben.

Angabe gemäß § 161 AktG

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung wurde am 3. Dezember 2002 abgegeben und den Aktionären im Internet dauerhaft zugänglich gemacht.

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2003 0,5 Mio. Euro. Darüber hinaus erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils 1.500 Wertsteigerungsrechte. Der Vorstand hat im Geschäftsjahr feste Gehaltsbestandteile in Höhe von 2,0 Mio. Euro bezogen und 750.000 Aktienoptionen erhalten. Die Aktienoptionen des Vorstands sowie die Wertsteigerungsrechte des Aufsichtsrats wurden im Geschäftsjahr 2003 nach den Regelungen des Long-Term-Incentive-Plans 2001 ausgegeben. Für variable Bezüge des Vorstands wurden im Geschäftsjahr 2003 4,2 Mio. Euro Rückstellungen gebildet, die von der Veränderung des Ergebnisses der Gesellschaft abgeleitet und in der Zielerreichungsspanne begrenzt sind. Der Wert pro Option bzw. Wertsteigerungsrecht, wenn nach den gleichen Grundsätzen wie Aktienoptionen bewertet, betrug zum Ausgabezeitpunkt 4,45 Euro.

Als Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr folgende Damen und Herren bestellt:

Der Vorstand der Infineon Technologies AG	Alter	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2003)
■ Dr. Ulrich Schumacher	45	<p>Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Deutsche Bahn AG, Berlin <p>Konzernmandate: Vorsitzender des Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur – Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China – Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan – Infineon Technologies North America Corp., Wilmington/Delaware, USA <p>Vorsitzender des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich
■ Peter Bauer	43	<p>Mitglied des Vorstands und Chief Sales and Marketing Officer</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Siemens VDO Automotive AG, München – Astron AG, Osterwieck <p>Konzernmandate: Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan <p>Mitglied des Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur – Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China – Infineon Technologies North America Corp., Wilmington/Delaware, USA – Infineon Technologies Savan Ltd., Netanya, Israel

Der Vorstand der Infineon Technologies AG	Alter	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2003)
■ Peter J. Fischl	57	Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer Konzernmandate: Mitglied des Board of Directors <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur – Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China – Infineon Technologies North America Corp., Wilmington/Delaware, USA Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich
■ Dr. Sönke Mehrgardt (bis 30. September 2003)	54	Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> – Loewe AG, Kronach – Loewe Opta GmbH, Kronach Konzernmandate: Vorsitzender der Gesellschafterdelegation <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Orion GmbH, München
■ Dr. Andreas von Zitzewitz	43	Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> – Steag Hamatech AG, Sternenfels Konzernmandate: Mitglied des Board of Directors <ul style="list-style-type: none"> – Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur – Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China – Infineon Technologies Richmond Limited Partnership, Wilmington/Delaware, USA Vorsitzender des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> – EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke Vorsitzender der Gesellschafterdelegationen <ul style="list-style-type: none"> – EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke – Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden

Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG	Alter	Ende der Amtszeit	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2003)
■ Max Dietrich Kley ^{1,2,3} Vorsitzender	63	2005	Mitglied des Aufsichtsrats der BASF AG Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats – Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München Vergleichbare externe Mandate: – Cazenove Group Plc., London, Großbritannien (Board of Directors) – Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz (Verwaltungsrat) – Schott Glas, Mainz (Unternehmensrat)
■ Alfred Eibl* ^{1,3} Stellvertretender Vorsitzender	54	2004**	Mitglied des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Straße
■ Dr. h. c. Martin Kohlhaussen ¹ Stellvertretender Vorsitzender	67	2005	Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerzbank AG Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats – Bayer AG, Leverkusen – Heraeus Holding GmbH, Hanau – HOCHTIEF AG, Essen – Schering AG, Berlin – ThyssenKrupp AG, Düsseldorf – Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Stuttgart
■ Ender Beyhan*	35	2004**	Mitglied des Gesamtbetriebsrats Mitglied des Betriebsrats München-Perlach
■ Johann Dechant*	38	2004**	Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West
■ Dr. Joachim Faber	53	2005	Mitglied des Vorstands der Allianz AG Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats – Bayerische Börse AG, München – Societa Metallurgica Italiana S. p. A., Florenz, Italien Konzernmandate: Vorsitzender des Aufsichtsrats – Allianz Dresdner Asset Management, München – DBI Dresdner Bank Investment Management Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt – DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH, Frankfurt – Deutscher Investment Trust Gesellschaft für Wertpapiieranlagen mbH, Frankfurt Vergleichbare Mandate: – RASBANK S. p. A., Mailand, Italien (Verwaltungsrat)

Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG	Alter	Ende der Amtszeit	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2003)
■ Heinz Hawreliuk*	56	2004**	<p>Leiter des Ressorts Unternehmensmitbestimmung der IG Metall</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Astrium GmbH, Ottobrunn bei München – DaimlerChrysler Aerospace AG, München – DaimlerChrysler Luft- und Raumfahrt Holding AG, München – Eurocopter Deutschland GmbH, Donauwörth – Siemens AG, Berlin und München
■ Dr. Stefan Jentzsch	42	2005	<p>Mitglied des Vorstands der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Deutsche Börse AG, Frankfurt <p>Konzernmandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – HVB Systems GmbH, München – HVB Info GmbH, München – HVB Alternative Financial Products AG, Wien (Vorsitzender) – HVB Alternative Investment AG, Wien (Vorsitzender) – DAB Bank AG, München (Vorsitzender) – Vereins- und Westbank AG, Hamburg (Stellvertretender Vorsitzender) – Bank Austria Creditanstalt AG, Wien, Österreich <p>Vergleichbare Mandate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – HVB Wealth Management Holding, München (Vorsitzender des Verwaltungsrats) – Bank von Ernst & Cie. AG, Bern, Schweiz (Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats)
■ Klaus Luschtinetz*	60	2004**	<p>Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats; Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats München Balan-Straße/St.-Martin-Straße</p> <p>Vergleichbare externe Mandate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Siemens Betriebskrankenkasse, München (Verwaltungsrat)

Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG	Alter	Ende der Amtszeit	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2003)
■ Karl Heinz Midunsky ^{2,3}	59	2005	<p>Corporate Vice President und Treasurer der Siemens AG</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hannover Rückversicherungs-AG, Hannover <p>Konzernmandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Krauss-Maffei Wegmann Verwaltungs-GmbH, München (Vorsitzender) – Risicom Rückversicherung AG, Grünwald bei München (Stellvertretender Vorsitzender) – Siemens Dematic AG, München (Stellvertretender Vorsitzender) – Siemens VDO Automotive AG, München (Stellvertretender Vorsitzender) – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München <p>Vergleichbare Mandate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fujitsu Siemens Computers (Holding) B.V., Amsterdam, Niederlande (Member of the Board) – Siemens Building Technologies AG, Zürich, Schweiz (Verwaltungsrat)
■ Wolfgang Müller**	55	2004**	<p>Gewerkschaftssekretär IG Metall – Bezirksleitung Bayern</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Siemens AG, Berlin und München
■ Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge	68	2005	<p>Professor an der Technischen Universität München</p>
■ Michael Ruth*	43	2004**	<p>Kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs Sichere Mobile Lösungen Vertreter der Leitenden Angestellten</p> <p>Vergleichbare Mandate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Comneon GmbH & Co. OHG, Nürnberg (Mitglied der Gesellschafterdelegation) – Comneon electronic technology GmbH & Co. OHG, Linz, Österreich (Mitglied der Gesellschafterdelegation) – DICE Danube Integrated Circuit Engineering GmbH & Co. KG, Linz, Österreich (Mitglied des Beirats) – Infineon Technologies Wireless Design Denmark A/S, Aalborg, Dänemark (Mitglied des Board of Directors)
■ Gerd Schmidt** ²	49	2004**	<p>Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West</p>

Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG	Alter	Ende der Amtszeit	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2003)
■ Dr. rer. nat. Martin Winterkorn	56	2005	<p>Vorsitzender des Vorstands der Audi AG Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats – Salzgitter AG, Salzgitter – FC Bayern München AG, München</p> <p>Vergleichbare Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats – SEAT S.A., Barcelona, Spanien – Lamborghini Holding S.p.A., Italien</p>
■ Prof. Dr.-Ing. Klaus Wucherer	59	2005	<p>Mitglied des Vorstands der Siemens AG</p> <p>Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats – Deutsche Messe AG, Hannover</p> <p>Konzernmandate: Mitglied des Aufsichtsrats – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München</p> <p>Vergleichbare Konzernmandate: – Siemens Ltd., Peking, China (Vorsitzender des Verwaltungsrats) – Siemens E&A, Atlanta, USA (Vorsitzender des Verwaltungsrats) – Siemens K. K., Tokio, Japan (Vorsitzender des Verwaltungsrats) – Eviop-Tempo, Athen, Griechenland (Verwaltungsrat) – Siemens Building Technologies AG, Zürich, Schweiz (Verwaltungsrat) – Siemens Ltd., Mumbai, Indien (Verwaltungsrat) – Siemens S. A., Lissabon, Portugal (Vorsitzender des Verwaltungsrats)</p>

Anmerkungen

1 Mitglied des Präsidialausschusses; 2 Mitglied des Vermittlungsausschusses; 3 Mitglied des Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschusses.

* Arbeitnehmervertreter; ** Wenn nicht vorher durch ein gewähltes Mitglied ersetzt.

Wesentliche Beteiligungen zum 30. September 2003

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil
EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke	100%
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden	100%
Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG, Dresden	87%
Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich	100%
Infineon Technologies-Fabrico de Semicondutores, Portugal S. A., Vila do Conde, Portugal	100%
Infineon Technologies France S. A. S., Saint Denis, Frankreich	100%
Infineon Technologies Holding B.V. Rotterdam, Niederlande	100%
Infineon Technologies Catamaran Inc., Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies Holding North America Inc., Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies Richmond LP, Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur	100%
Infineon Technologies (Advanced Logic) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies (Integrated Circuit) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan	100%
ALTIS Semiconductor S. N. C, Essonnes, Frankreich	50,1%

Infineon Technologies AG – Einzelabschluss* – Kurzfassung (Euro in Mio.)

Gewinn- und Verlustrechnungen*		
	2002	2003
Umsatz	6.765	8.122
Umsatzkosten	-6.669	-7.201
Bruttoergebnis	96	921
Aufwendungen der übrigen Funktionsbereiche	-1.358	-1.460
Übrige Aufwendungen und Erträge	580	252
Ergebnis vor Ertragssteuer	-682	-287
Ertragssteuern	65	0
Jahresfehlbetrag	-617	-287
Verlustvortrag aus Vorjahr	-435	-1.052
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0
Bilanzverlust	-1.052	-1.339

Bilanzen* zum 30.09.		
	2002	2003
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	991	794
Finanzanlagen	5.874	5.390
Anlagevermögen	6.865	6.184
Vorräte	340	461
Forderungen und Sonstiges	2.009	1.980
Wertpapiere, Flüssige Mittel	1.803	2.641
Umlaufvermögen	4.152	5.082
Summe Aktiva	11.017	11.266
Eigenkapital	7.061	6.774
Rückstellungen	631	612
Verbindlichkeiten und Sonstiges	3.325	3.880
Summe Passiva	11.017	11.266

* Erstellt nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB).
Ist nicht Teil des Anhangs zum Konzernabschluss.

Weitere Informationen

Mehrjahres-Übersicht 1999–2003

Ausgewählte Konzernfinanzdaten Infineon Technologies AG (in Mio. Euro)¹

Zum Ende des Geschäftsjahrs per 30. September	1999	2000	2001	2002	2003
Daten der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen					
Umsatzerlöse	3.992	6.989	5.347	4.890	6.152
nach Regionen:					
Deutschland	1.154	1.520	1.636	1.266	1.535
Übriges Europa	1.156	1.570	1.172	943	1.112
Nordamerika	757	1.747	1.208	1.158	1.393
Asien-Pazifik	862	2.047	1.247	1.446	2.077
Andere	63	105	84	77	35
nach Geschäftsbereichen ² :					
Drahtgebundene Kommunikation	499	661	766	386	459
Sichere Mobile Lösungen ³	1.141	1.559	1.522	1.278	1.645
Automobil- und Industrieelektronik	665	923	1.153	1.201	1.392
Speicherprodukte	1.406	3.479	1.614	1.861	2.485
Sonstige Geschäftsbereiche	202	276	236	117	139
Konzernfunktionen	79	91	56	47	32
Umsatzkosten	2.799	3.815	4.580	4.289	4.614
Bruttoergebnis vom Umsatz	1.193	3.174	767	601	1.538
Forschungs- und Entwicklungskosten	734	1.025	1.189	1.060	1.089
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	530	668	782	643	679
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	–	–	117	16	29
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, Saldo	2	–2	–200	–46	85
Betriebsergebnis	–73	1.483	–1.121	–1.072	–344
Zinsergebnis	43	75	–1	–25	–52
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Unternehmen	29	92	21	–47	18
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	–	53	11	18	–2
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	18	36	65	–41	21
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	–	–6	6	7	8
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17	1.733	–1.019	–1.160	–351
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36	–614	427	143	–84
Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss von fortgeführten Geschäften	53	1.119	–592	–1.017	–435
Ergebnis von aufgegebenen Geschäften	8	7	1	–4	–
Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss	61	1.126	–591	–1.021	–435
Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss pro Aktie in Euro – unverwässert und verwässert	0,10	1,83	–0,92	–1,47	–0,60
EBIT	–26	1.658	–1.018	–1.135	–299
nach Geschäftsbereichen ² :					
Drahtgebundene Kommunikation	24	48	–93	–245	–188
Sichere Mobile Lösungen ³	206	307	–142	–116	–64
Automobil- und Industrieelektronik	24	71	143	111	186
Speicherprodukte	–238	1.330	–938	–630	31
Sonstige Geschäftsbereiche	18	23	192	9	–49
Konzernfunktionen	–60	–121	–180	–264	–215

Fortsetzung Ausgewählte Konzernfinanzdaten Infineon Technologies AG (in Mio. Euro)¹

Zum Ende des Geschäftsjahrs per 30. September	1999	2000	2001	2002	2003
Daten der Konzern-Bilanzen					
Zahlungsmittel	30	511	757	1.199	969
Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	498	93	738	1.784
Vorräte	677	841	882	891	959
Summe Umlaufvermögen	2.523	3.835	2.876	4.191	5.306
Sachanlagen	3.014	4.034	5.233	4.491	3.817
Finanzanlagen	130	432	655	708	425
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel	64	132	86	70	67
Bilanzsumme	6.445	8.853	9.743	10.918	10.805
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristiger Teil langfristiger Finanzverbindlichkeiten	495	138	119	120	149
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	135	128	249	1.710	2.343
Summe Eigenkapital	3.656	5.806	6.900	6.158	5.666
Daten der Konzern-Kapitalflussrechnungen					
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	469	2.077	221	226	731
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	–918	–2.327	–1.813	–1.244	–1.522
Planmäßige Abschreibungen	573	834	1.121	1.370	1.437
Investitionen in Sachanlagen	–653	–1.571	–2.282	–643	–872
Börsenkennzahlen (zum 30. 9.) (Börsengang am 13. 03. 2000)					
Dividendenertrag pro Aktie (Euro)	–	0,65	–	–	–
Xetra Handelssystem (Euro)	n/a	54,88	13,50	5,61	11,22
New York Stock Exchange (NYSE) (US-Dollar)	n/a	47,50	12,39	5,70	12,89
Anzahl der Aktien (Mio. Stück)	n/a	625,5	692,4	720,8	720,9
Marktkapitalisierung (Mrd. Euro)	n/a	34.327	9.347	4.044	8.088
Marktkapitalisierung (Mrd. US-Dollar)	n/a	29.711	8.579	4.109	9.292
Kennzahlen					
Eigenkapitalquote	57%	66%	71%	56%	52%
Verschuldungsgrad	17%	5%	5%	30%	44%
Net Cash (am 30. 9.) ⁴	–536	875	568	177	328
Mitarbeiter zum 30. 9. (absolute Zahlen)					
Gesamt	25.779	29.166	33.813	30.423	32.308
nach Regionen:					
Deutschland	12.853	14.247	16.814	15.716	16.166
Übriges Europa	2.842	3.409	5.007	4.590	5.034
Nordamerika	2.563	2.838	3.023	2.889	2.757
Asien-Pazifik	7.521	8.672	8.949	7.200	8.234
Andere	–	–	20	28	117
nach Funktionen:					
Produktion	n/a	20.371	23.416	20.822	22.405
Forschung und Entwicklung	n/a	4.733	5.510	5.374	5.935
Vertrieb und Marketing	n/a	2.043	2.259	2.010	2.048
Verwaltung	n/a	2.019	2.628	2.217	1.920

1 Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

2 Zum 1. Oktober 2001 haben wir einige unserer Geschäftsbereiche reorganisiert, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. Die Bereichsergebnisse der Jahre 2000 und 2001 wurden entsprechend umgestellt, sodass sie der neuen Berichts- und Darstellungsstruktur des Geschäftsjahres entsprechen und um die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen Ergebniszahlen zu ermöglichen.

3 Infineon hat mit Wirkung zum 1. November 2002 den neuen Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen gegründet. Dieser fasst die bisherigen Bereiche Mobile Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs zusammen.

4 Entspricht der Kalkulation: Zahlungsmittel plus Wertpapiere des Umlaufvermögens plus als Sicherheitsleistung hinterlegte Zahlungsmittel minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

n/a Diese Informationen sind für Perioden vor dem Börsengang nicht verfügbar.

Finanzglossar

ADS – American Depositary Shares – ADSs sind in den USA gehandelte Aktienzertifikate über nichtamerikanische Aktien. Sie erleichtern nicht-amerikanischen Unternehmen den Zugang zu US-amerikanischen Kapitalmärkten und bieten so US-amerikanischen Anlegern Investitionsmöglichkeiten in nicht-amerikanische Gesellschaften. Infineons ADSs werden an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt (Verhältnis ADS : Aktie = 1 : 1).

Bilanz – Sie bildet die Finanzpositionen einer Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs ab und ist Teil des Konzernabschlusses. Die Bilanz zeigt die Mittelherkunft und Mittelverwendung einer Gesellschaft.

Brutto-Cash-Position – Zahlungsmittel plus Wertpapiere des Umlaufvermögens plus als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel.

Bruttoergebnis vom Umsatz – Umsatz abzüglich Herstellungskosten des Umsatzes.

Cash Flow – Zahlungswirksamer Saldo aus Mittelzuflüssen und -abflüssen innerhalb eines Geschäftsjahrs. Der Cash Flow ist Teil des Konzernabschlusses und zeigt für einen bestimmten Zeitraum, aus welchen Quellen sich eine Gesellschaft finanziert und wofür die Zahlungsmittel verwendet wurden, gegliedert nach laufender Geschäftstätigkeit (Mittel, die durch Verkauf von Produkten und Dienstleistungen generiert wurden), Investitionstätigkeit (Mittelabfluss einer Gesellschaft, um das zukünftige Wachstum zu sichern) und Finanzierungstätigkeit (Mittelzufluss durch die Ausgabe von Aktien und Anleihen).

Deutscher Corporate Governance Kodex – Kodex der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“, der die Vorgaben und Empfehlungen für gute Unternehmensleitung und -kontrolle bei börsennotierten Gesellschaften in Deutschland zusammenfasst.

DAX – Deutscher Aktienindex. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten deutschen Aktiengesellschaften ab, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

EBIT – Earnings Before Interests and Taxes. Bei Infineon ist das EBIT definiert als „Ergebnis vor Zinsen und Steuern“. Dies ist die Kennzahl, mit der Infineon die operative Ertragskraft seiner Geschäftsbereiche bewertet.

EBIT-Marge – Eine Kennzahl zur Bestimmung der operativen Ertragskraft, die das EBIT im Verhältnis zum Umsatz darstellt.

Eigenkapitalquote – Zeigt den Anteil des Eigenkapitals in der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft, berechnet aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

Eigenkapitalrendite – auch: Return On Equity (ROE). Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die den Jahresüberschuss im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

Ergebnisanteile, auf konzernfremde Gesellschafter entfallend – Anteile am Jahresergebnis, die nicht dem Konzern, sondern Konzernfremden, die Anteile an verbundenen Unternehmen des Konzerns halten, zugerechnet werden.

Ergebnis je Aktie bzw. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie – Das unverwässerte Konzernergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Berichtszeitraum (Quartal oder Geschäftsjahr) ausstanden, dividiert wird. Das verwässerte Konzernergebnis je Aktie wird errechnet, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Berichtszeitraum ausstanden, zuzüglich der Zahl der Aktien, die emittiert würden, falls ausstehende Aktienoptionen, zugeteilte Aktienrechte und Wandelschuldverschreibungen ausgeübt bzw. gewandelt würden, dividiert wird.

Free Cash Flow – Der für den Netto-Zahlungsmittelbestand relevante Saldo des Mittelzuflusses bzw. -abflusses aus Infineons laufender Geschäftstätigkeit und des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit, bereinigt um den dort gezeigten Mittelzufluss bzw. -abfluss aus kurzfristig verfügbaren Wertpapieren.

Gesamtkapitalrentabilität – auch: Return On Total Assets (ROTA). Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die das EBIT im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Gesamtkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

Gewinnrücklagen – Derjenige Teil des Eigenkapitals, der aus nicht ausgeschütteten Gewinnen gebildet wird.

Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) – Stellt den Erfolg der Geschäftstätigkeit einer Gesellschaft während des Berichtszeitraums dar und ist Teil des Konzernabschlusses. Die GuV folgt dem Umsatzkostenverfahren und zeigt die wesentlichen Kostenblöcke nach ihrer Funktionalität.

Goodwill (Geschäfts- und Firmenwert) – Ein immaterieller Vermögensgegenstand, der im Rahmen einer Unternehmensakquisition entstehen kann. Er stellt den Betrag dar, mit dem der Kaufpreis (die Kosten) für eine erworbene Gesellschaft den angenommenen Fair Value der erworbenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten übersteigt. Nach US-GAAP wird der Geschäfts- und Firmenwert nicht über eine Nutzungsdauer abgeschrieben, sondern bei einer eventuellen Wertminderung durch eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Die Überprüfung des Wertes erfolgt mindestens einmal jährlich.

Konzernjahresabschluss – Jahresabschluss der Infineon-Unternehmensgruppe, der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns am Ende eines Geschäftsjahrs so darstellt, als seien die rechtlich selbstständigen Konzernunternehmen wirtschaftlich eine Einheit. Der Konzernabschluss enthält die Bilanz, die Gewinn-und-Verlust-Rechnung, den Cash Flow, die Eigenkapital-Veränderungsrechnung sowie den Anhang.

Latente Steuern – Da die steuerliche Gesetzgebung des Öfteren von den handelsrechtlichen Vorgaben abweicht, können Unterschiede zwischen (a) dem zu versteuernden Einkommen und dem handelsrechtlichen Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und (b) der steuerlichen Bemessungsgrundlage von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten und ihren jeweiligen Buchwerten entstehen. Eine latente Steuerverbindlichkeit und der zugehörige Aufwand entstehen aus dem Einkommen, das bereits handelsrechtlich, jedoch nicht steuerrechtlich erfasst ist. Umgekehrt entsteht eine latente Steuerforderung, wenn der Aufwand erst in Zukunft steuerlich abzugsfähig ist, jedoch handelsrechtlich bereits erfasst wurde.

Namensaktien – Aktien, die auf den Namen einer bestimmten Person lauten. Diese Person wird entsprechend den aktienrechtlichen Vorgaben mit einigen persönlichen Angaben sowie der Aktienanzahl in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen. Nur wer im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist, gilt gegenüber der Gesellschaft als Aktionär und kann beispielsweise seine Rechte in der Hauptversammlung ausüben.

Netto-Cash-Position – Brutto-Cash-Position minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

Risikomanagement – Systematische Vorgehensweisen, um potenzielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten und Maßnahmen zur Risikohandhabung und -verringering auszuwählen und im Unternehmen umzusetzen.

Segmentberichterstattung – Darstellung von Vermögens- und Ergebnisinformationen nach Geschäftsbereichen und geografischen Regionen.

US-GAAP – US-amerikanische Norm der Rechnungslegung. Infineon stellt den Konzernabschluss gemäß den Vorgaben des US-GAAP auf.

Verschuldungsgrad – Kennzahl der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft. Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

Technologieglossar

2G – Zweite Generation: digitale Mobiltelefonie. Nach den analogen Netzen (erste Generation) bekommt der Teilnehmer hier mit digitalen Signalisierungen einheitlich gute Sprachqualität und zahlreiche Datendienste. Mobilfunkstandard der zweiten Generation: GSM.

2,5G – Gegenwärtige Infrastruktur des Mobilfunks. Mobilfunkstandard der 2,5-Generation: GPRS.

3G – Dritte Generation des Mobilfunks. Sprache und Daten werden gemeinsam breitbandig – also mit wesentlich höherer Transportkapazität als bei der zweiten Generation – übertragen. Mobilfunkstandard der dritten Generation: UMTS.

ASIC – Application Specific Integrated Circuit. Logikschaltung, die auf speziellen Kundenwunsch für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde.

ASSP – Application Specific Standard Product. Standardprodukt, das für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde und von vielen Kunden genutzt werden kann.

Basisband-IC – Im Basisband-IC werden die empfangenen und zu sendenden digitalen Signale verarbeitet. Dieser komplexe Baustein enthält üblicherweise einen digitalen Signalprozessor, einen Mikrokontroller, Speicher und analoge Schaltungen. Er bildet gewissermaßen das Herz eines drahtlosen Kommunikationssystems.

Bit – Eine Informations- bzw. Recheneinheit, die einen von zwei Werten annimmt, z. B. „richtig“/„falsch“ oder „0“/„1“.

Bluetooth – Technologie zur Funkübermittlung von Sprache und Daten über kurze Strecken.

Bluetooth Communication Gateway (BCG) – System zur drahtlosen Verbindung von Mobiltelefonen mit der Infotainment-Plattform im Auto.

Byte – Maß für Informationseinheit bei Datenverarbeitungsanlagen; ein Byte entspricht acht Bit.

CDMA – Code Division Multiple Access. Verfahren, das in Mobilfunksystemen eingesetzt wird und mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff auf einen Übertragungskanal ermöglicht. Vorteil: bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite.

Chipkarte – Kunststoffkarte mit eingebautem Speicherchip oder Mikroprozessor, kann mit Geheimzahl kombiniert werden.

CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor Technology. Technologie, um Mikrochips mit geringem Energieverbrauch und hohem Integrationsgrad zu produzieren.

DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Einheitlicher europäischer Standard für digitale schnurlose Kommunikationssysteme.

DRAM – Dynamic Random Access Memory. Auf Grund der hohen Integrationsdichte und des daraus resultierenden niedrigen Preises weit verbreitete Speicherchip-Technologie. Beispiele für DRAM-Chips sind SDRAM, DDR DRAM, RDRAM, SGRAM oder in Logikschaltungen eingebettete DRAM (vgl. RAM).

Ethernet – Netzwerk für Hochgeschwindigkeits-Kommunikation für den lokal begrenzten Einsatz (Ausdehnung von einigen zehn Metern bis zehn Kilometer).

Flash-Memory – Eine Sorte nicht flüchtiger Speicher. Sein Inhalt bleibt erhalten, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

Flow-Thru-Chip – Biochip, der aus porösem Silizium besteht. Auf einem Quadratzentimeter befinden sich etwa eine Million Kanäle, die 10-mal dünner sind als ein Haar. In den Siliziumkanälen befinden sich bis zu 400 unterschiedliche Genabschnitte, deren Aktivität mit einem bestimmten Krankheitsbild, z. B. Lungenkrebs, übereinstimmt. Zu testende Proben werden durch die Siliziumkanäle gepumpt (Flow-Thru-Technik) und analysiert.

Flüchtiger Speicher – Speicher, der die in ihm gespeicherten Informationen verliert, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

Giga – 2^{30} im informationstechnischen Sinn; z. B. Gigabit (Gbit), Gigabyte (Gbyte).

GPRS – General Packet Radio Service heißt eine neue Mobilfunkgeneration der 2,5-Gruppe für höhere Datenübertragungsraten (bis zu 115 Kilobit/Sekunde) in GSM-Netzen.

GPS – Global Positioning System. Funkortungsverfahren zur Positionsbestimmung anhand des direkten Empfangs von Radiosignalen.

GSM – Das Global System for Mobile Communication ist heute weltweit das am meisten genutzte digitale Mobilfunksystem.

Halbleiter – Ein kristalliner Werkstoff, der bei Erwärmung eine mit der Temperatur ansteigende elektrische Leitfähigkeit zeigt. Halbleiter sind z. B. Silizium und Germanium. Der Begriff wird auch für ICs aus diesem Werkstoff verwendet.

IC – Integrated Circuit (integrierte Schaltung). Bauelement auf Basis eines Halbleitermaterials wie Silizium, auf dem zahlreiche Komponenten wie Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Dioden integriert und miteinander verbunden sind.

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) – Spezifische Hochvolt-Halbleitertechnologie.

ISDN – Integrated Services Digital Network. Online-Verbindungstyp, der Telekommunikationsdienste wie Telefon, Telefax oder Datenkommunikation in einem Netz integriert.

Kilo – 2^{10} im informationstechnischen Sinn; z. B. Kilobit (Kbit), Kilobyte (Kbyte).

LAN – Local Area Network (lokales Netzwerk). Datenkommunikationsnetz in einem räumlich eng begrenzten Gebiet, z. B. innerhalb eines Gebäudes.

MAN – Metropolitan Area Network. Datenkommunikationsnetzwerk in einem relativ kleinen räumlichen Gebiet, z. B. einer Stadt.

Mega – 2^{20} im informationstechnischen Sinn; z. B. Megabit (Mbit): ca. eine Million Bit, Megabyte (Mbyte): ca. eine Million Byte.

Mikrokontroller – Mikroprozessor, der auf einem einzelnen IC, mit Speicher und Schnittstellen kombiniert, integriert ist und als eingebettetes System funktioniert. In einem Mikrokontroller lassen sich komplexe logische Schaltungen realisieren und per Software kontrollieren.

Mikrometer/Mikron – Metrisches Längenmaß. Entspricht dem millionsten Teil eines Meters (10^{-6} m), das Symbol ist μm (Mikron). Der Durchmesser eines Menschenhaars ist z. B. 0,1 Millimeter oder 100 Mikrometer.

Nichtflüchtiger Speicher – Speicher, der die gespeicherten Informationen behält, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

PDA – Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch, wird mit dem PC synchronisiert.

Plastic Optical Fiber – Kostengünstige und gewichtsoptimierte optische Kommunikations-Bus-Technologie für Unterhaltungs- und Sicherheitssysteme in Automobilen.

Radio Frequency Identification – Unter Radio Frequency Identification (RFID) versteht man den drahtlosen Datenaustausch mit einer Sendeeinheit und Empfangseinheit. Das Auslesen und Beschreiben erfolgt in Bruchteilen von Sekunden. Solche Identifikationssysteme werden z.B. in Form von Etiketten an Waren und Gütern angebracht.

RAM – Random Access Memory (Direktzugriffsspeicher). Auch als Haupt- oder Arbeitsspeicher bezeichneter Datenspeicher, enthält Programme und Daten von externen Speicherträgern. Er verliert seine Daten ohne Stromversorgung. Beispiele sind SRAM und SDRAM (vgl. DRAM).

RF-Transceiver – Transceiver ist ein Kunstwort aus Transmitter (= Sender) und Receiver (= Empfänger). Es beschreibt für die drahtgebundene und drahtlose Kommunikation eine Kombination aus Sende- und Empfangsschaltung in einer Einheit. RF-Transceiver werden in der drahtlosen Kommunikation eingesetzt, z. B. in Mobil- und Schnurlos-Telefonen.

ROM – Read Only Memory (Nur-Lese-Speicher). Digitaler, nichtflüchtiger Datenspeicher, in dem Daten auch ohne Spannungsversorgung dauerhaft gespeichert sind und nicht mehr geändert werden können.

Silizium – Werkstoff mit halbleitenden Eigenschaften. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in großem Umfang als Grundstoff verwendet.

Smartcard – Eine Smartcard ist eine Plastikkarte mit eingebautem Mikrokontroller. Im Gegensatz zu einer speicherbasierten Karte ermöglicht der Mikroprozessor die Verarbeitung großer Datenmengen mit einem hohen Grad an Sicherheit. Die Smartcard hat gewöhnlich die Maße einer Kreditkarte.

Telematics Communication Gateway (TCG) – Fahrzeugsystem mit Positionierungs- und Kommunikationstechnologie durch Einsatz von GPS und GSM für Telematikdienste.

Telematik – Aus Telekommunikation und Informatik zusammengesetztes Kunstwort.

Tire Pressure Monitoring System – Reifendrucksensoren überwachen den Luftdruck im Autoreifen und weisen den Fahrer auf zu geringen Luftdruck hin.

UMTS – Das Universal Mobile Telecommunications System soll ein künftiger digitaler Weltstandard für Mobilfunk werden. UMTS ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu zwei Megabit pro Sekunde – 200-mal so viel wie heute.

Wafer – Scheibe aus einem Halbleiterwerkstoff, z. B. Silizium, mit einem Durchmesser von bis zu 300 Millimetern.

WAN – Wide Area Network. Datenkommunikationsnetzwerk, das eine große geografische Fläche, wie zum Beispiel ein Land, abdeckt.

WDCT – Worldwide Digital Cordless Technology. Einheitlicher Standard für digitale schnurlose Kommunikationssysteme in Nordamerika, wurde vom DECT-Standard abgeleitet.

xDSL – x Digital Subscriber Line. Oberbegriff für verschiedene technische Konzepte zur breitbandigen, digitalen Datenübertragung über herkömmliche verdrehte Kupferdoppeladern. Je nach Konfiguration steht das x für Asymmetric (A), High Rate (H), Single Line (S), Symmetric High Data-Rate (SH) oder Very High Bit Rate (V).

Stichwortverzeichnis

Abschlussprüfer (Bericht der unabhängigen)	87
AG-Abschluss (Einzelabschluss)	143
Agenda 5-to-1	Umschlagklappe, 7, 10f., 26, 48
Akquisitionen	98ff.
Aktioptionspläne	40, 52, 97, 116ff., 135, 137
Anhang zum Konzernabschluss	94ff.
Assoziierte Unternehmen	69, 71, 90ff., 94, 110f., 119f.
Aufsichtsrat (Bericht)	48ff.
Aufsichtsrat (Besetzung)	139ff.
Ausblick	86
Automobil- und Industrieelektronik	6, 19f., 25, 26ff., 56, 59ff., 65ff., 86, 130f.
Bericht der Abschlussprüfer	87
Bericht des Aufsichtsrats	48ff.
Bericht des Vorstands (Lagebericht)	55ff.
Bestätigungsvermerk	87
Bilanz	89
Bilanzierung	94, 98, 133ff.
Brief an die Aktionäre	4
Campeon	79
Cash Flow	4, 58, 73, 92f.
Chancen (und Risiken)	80
Chronik 2003	18ff.
Corporate Governance	17, 51ff.
Desinvestitionen	62
Dividende	16, 84, 116
Drahtgebundene Kommunikation	25ff., 48, 56, 66ff., 69ff., 131
Eigenkapitalveränderungs-Rechnung	90
Einkauf (Rationalisierung)	59, 83, 129
Ereignisse nach dem 30.09.2003.	85, 133
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.	63
Ergebnis je Aktie	16, 106
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	4, 55, 58, 63f., 71
Fertigungskapazitäten (Optimierung)	61
Finanzanlagen	84, 109ff.
Finanzdaten (Ausgewählte Konzern-)	144f.
Finanzlage	73, 84
Finanzverbindlichkeiten	4, 75f., 113ff.
Forschung und Entwicklung (Aufwendungen)	13, 29ff., 59, 69f.
Fremdwährungsmanagement	82
Geschäftsanteilsveräußerungen	100ff.
Geschäftsbereiche	11, 25ff., 56ff., 144
Geschäftstätigkeit, Gründung	94
Gewinn- und -Verlust-Rechnung	88
Grundkapital.	15f., 115f.
Impact (Kostensenkungsprogramm)/Impact ²	6, 12, 59, 70, 79, 103
Impressum	innere Umschlagseite
Infineon-Aktie	14ff.

Infineon Technologies AG	84, 143
Innovationen	13, 29ff.
Investitionen	34f., 58ff., 78
Jahresabschluss	50, 84, 135
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	64, 88, 106, 111, 144
Kapitalbedarf	76
Kapitalerhöhung	97, 116, 135
Kapitalflussrechnung	74, 92, 93, 119
Kapitalmaßnahmen	118
Konjunktur	14, 57
Konsolidierungsgrundsätze	94
Konzern-Finanzdaten (ausgewählte)	144f.
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, -Bilanzen, -Kapitalflussrechnungen	88ff.
Konzernlagebericht	55
Konzernrechnungslegung	87
Kooperationen	12, 25f., 28, 34f.
Kostensenkungsprogramm (Impact)	6, 69, 70
KPMG (Wirtschaftsprüfer)	50, 87, 133
Kunden	10ff., 24ff., 51f., 67f.
Lagebericht	55
Märkte	12f., 25f.
Mehrjahres-Übersicht	144
Mission	8
Mitarbeiter	13, 25, 38ff., 79, 118
Pensionsverpflichtungen	121ff.
Quartalszahlen (Umsatz)	58, 65ff.
Risiken	80ff., 125
Sachanlagen	78, 95, 109
Segmentdaten, -berichterstattung	63, 66, 86, 130ff.
Sichere Mobile Lösungen	56, 66, 68ff., 86, 131
Speicherprodukte	48, 65f., 68ff., 86, 131
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72, 97, 103ff.
Tochtergesellschaften	84, 97, 143
Umsatzerlöse	58, 63ff., 84, 97
Umsatzkosten	68f.
Umstrukturierung (inkl. Restrukturierung)	70ff., 85, 103
Umweltschutz	41ff.
Unternehmensstrategie	10ff.
Vermögenslage	75, 128
Vertriebskosten	70
Verwaltungskosten (allgemeine)	70
Vision	8
Vorstand	4, 9, 49, 51ff., 137f.
Weltwirtschaft	57
Zinsergebnis	72

Finanzkalender

Wichtige Finanztermine 2004

Montag, 19. Januar

Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2004

Dienstag, 20. Januar, 10:00 Uhr

Hauptversammlung 2004 in München, Olympiahalle

Mittwoch, 21. April

Veröffentlichung des Berichts über das 2. Quartal 2004

Dienstag, 20. Juli

Veröffentlichung des Berichts über das 3. Quartal 2004

Dienstag, 9. November*

Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das 4. Quartal 2004 und das Geschäftsjahr 2004

* Vorläufig.

Impressum Geschäftsbericht 2003

Herausgeber	Infineon Technologies AG, München
Redaktion	Corporate Center Accounting & Financial Reporting
Geschäftsjahr	1. Oktober bis 30. September
Abschlussprüfer	KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin und Frankfurt am Main
Gestaltung	OgilvyOne worldwide GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Satz	OgilvyOne und Newway Agentur GmbH, Frankfurt am Main
Fotonachweis	Ansgar Pudenz, Uwe Sickinger, Marek Vogel
Lithografie	ProFab GmbH, Frankfurt am Main
Druck	Kunst- und Werbedruck GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen

Gedruckt in Deutschland.

Die folgenden Bezeichnungen sind **eingetragene Namen, Markennamen und/oder Markenzeichen** der Infineon Technologies AG: Infineon und das Infineon Technologies-Logo, 10BaseS, Bidi, BlueMoon, CoolMOS, CoolSET, Infineon FingerTIP, OptiMOS, PAROLI, S-Gold, SMARTI, StarCore, TriCore.

Das **Bluetooth**-Markenzeichen wird von Infineon in Lizenz verwendet.

Alle anderen in diesem Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte die Rechte ihrer Inhaber verletzen kann.

Wenn Sie **zusätzliche Exemplare** dieses Geschäftsberichts in deutscher oder englischer Sprache bestellen möchten oder wenn Sie diese Berichte und aktuelle Anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns doch im Internet unter www.infineon.com/boerse. Aktionäre und andere interessierte Anleger können kostenlose Einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der Abteilung Investor Relations anfordern.

Für interne Bestellungen

SPLS Fürth-Bislohe	
Per Intranet	http://www.click4business-supplies.com
Per Fax	+49 (0) 911 654 4271
Bestellnummer	(deutsch) B192-H8086-G1 (englisch) B192-H8086-G1-X-7600

Infiniteon Technologies AG

Hauptsitz

St.-Martin-Straße 53
D-81669 München
Telefon +49 (0)89 234-0

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.infineon.com

Kontakt für Anleger und Analysten

E-Mail: Investor.Relations@infineon.com
Telefon: +49 (0)89 234-26655
Fax: +49 (0)89 234-26155

Kontakt für Journalisten

E-Mail: Media.Relations@infineon.com
Telefon: +49 (0)89 234-28480
Fax: +49 (0)89 234-28482



Never stop thinking.